

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

粤芯半导体技术股份有限公司

CanSemi Technology Inc.

(广东省广州市黄埔区凤凰五路28号)



首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具
有以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资
决定的依据。

保荐人（主承销商）



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

联席主承销商



(中国（上海）自由贸易试验区商城路618号)

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业,也是广东省自主培养且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业,为广东省实现了 12 英寸晶圆制造从 0 到 1 的突破,对粤港澳大湾区集成电路的产业发展、产业升级、科技创新和产业安全都具有重要的意义。同时,公司积极承担国家任务,融入和服务国家产业战略,在“做精做细成熟制程”的征程上,深度参与国家高水平科技自立自强与现代化产业体系建设。

自 2017 年成立以来,公司专注于特色工艺晶圆代工业务,始终将锻造“特色工艺技术平台”和坚持“客户导向”共存并举,并作为持续积淀公司核心竞争力的立足点。目前,公司的主要客户涵盖境内外多家一流芯片设计企业,并与公司建立了长期战略合作伙伴关系。公司的工艺技术平台围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片,逐步实现了多品类布局,持续为消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等领域的客户赋能。尤其在硅光及光电融合领域,公司已成功推出 12 英寸硅光工艺技术平台,并已具备量产能力,跻身该领域的第一梯队,为国家硅光芯片规模化量产提供产能保障,为人工智能时代算力传输筑牢底层基础设施。公司通过持续聚焦成熟制程特色工艺,形成差异化竞争优势,助力我国集成电路产业实现技术突破和产业升级。

公司将始终坚守“服从国家产业战略、服从广东产业布局,坚持市场导向、坚持自主创新”的核心发展理念,并致力于将公司打造成为“扎根粤港澳大湾区,产能规模最大、产品线最丰富、体制机制最具创新活力的集成电路特色工艺制造企业”。

一、上市的目的

(一) 稳步扩充产能,助力实现中国集成电路产业链的自主可控

集成电路产业作为现代科技与经济的核心支柱,既是国家鼓励、扶持的战略性新兴产业,更在国家发展布局中占据至关重要的战略地位。其中,中国在模拟芯片领域的布局与拓展,具有尤为关键的战略意义。模拟芯片的竞争力体现在产品性能、稳定性和可靠性上,因而其主要采用较为成熟的制程;并且,该领域还

呈现出细分品类多、应用领域广、生命周期长的特点。特别是高端模拟芯片，可广泛应用于汽车电子、工业控制、智能制造、人工智能等领域，因而存在着大量的技术创新机会和创新发展空间。中国大陆已成为全球最大的模拟芯片消费市场，但目前产品自给率仍处于相对较低水平，国产替代仍存在着巨大的市场潜力。

借助本次上市融资，公司将有序推进产能的规划与建设，有针对性地扩张和补充产能：一方面，通过构建规模化产能优势，全面提升生产运营效率，增强盈利能力与市场竞争力，持续扩大市场份额，巩固行业地位，力争跻身中国大陆晶圆代工企业产能规模前列。另一方面，也为设备、材料、设计、EDA、IP 领域的国产化和技术迭代提供“演练场”，建立起本土较强的供需衔接，打造一个支持自主技术进步的本土产业生态，助力中国集成电路产业链实现自主可控。

(二) 做精做细成熟制程，加速特色工艺技术平台的研发

粤芯半导体是全球少数专注于模拟芯片领域的特色工艺晶圆代工企业之一。公司自成立以来，紧密贴合模拟芯片品类多样化的行业特点，致力于持续强化特色工艺技术平台与差异化布局。通过为客户提供创新性的特色工艺技术服务、自主可控的产能保障、稳定的质量与可靠性、及时交付以及合理价格，公司不仅构建了独特的竞争优势，形成了差异化的发展路径，实现了芯片设计企业与晶圆代工企业的双赢，更为模拟芯片供应链的专业化、现代化和协同化提供了有力支撑。

通过本次上市融资，公司将持续迭代三大特色工艺平台研发，加速前沿技术从研发到量产转化。一是聚焦硅光及光电融合工艺平台技术迭代，满足高速通信和人工智能对高带宽、低功耗光互连的需求，巩固行业领先地位；二是着力攻关存算一体工艺平台，为下一代高能计算芯片提供核心制造支撑；三是持续深化微控制器工艺平台，增强其在功能安全、可靠性与成本方面的综合竞争力，支撑智能汽车、机器人、工业控制等多个领域产业的快速发展。

公司还将不断优化生产工艺，进一步深化与芯片设计企业及终端产业深度融合，逐步拓展丰富多层次的特色工艺技术平台，为芯片设计公司赋能，增加其产品差异化优势和竞争力。

(三) 完善公司治理，持续为投资者和社会创造价值回报

公司将以本次上市为契机，进一步完善法人治理结构，建立健全有效的决策

机制与监督体系，确保公司规范运作、高效协同。始终坚持合规经营理念，加强内部控制，保障全体股东的合法权益。同时，立足长远发展，持续引进优秀人才，努力提高运营效率，以稳健的经营业绩为基础，建立并完善合理的利润分配机制，积极回报投资者。

此外，公司上市后将主动践行社会责任，在安全生产、环境保护、员工权益保障、上下游协同发展等方面持续投入。以可持续发展为核心导向，以推动社会科技的进步和新质生产力的发展为己任，为社会创造长期、可持续的价值回报，以卓越业绩回馈投资者的信任与期待。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次融资可满足公司产能扩张与技术升级需求。随着集成电路产业的市场需求持续攀升，公司现有产能规模及工艺技术平台不足以满足市场日益增长的需求，仍需要进一步加强在特色工艺研发、产品技术创新和产能建设等方面的投入。因此，公司结合实际业务需求合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。

本次募集资金投向聚焦公司主业，包括 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）、特色工艺技术平台研发项目和补充流动资金，均系围绕发行人主营业务展开，符合国家产业政策和公司发展战略。

本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司多个工艺技术平台的技术水平和产品竞争力，提升公司产能规模，助力公司加速从消费级晶圆代工向工业级、车规级晶圆代工迭代，并拓展人工智能的下游应用，构建“消费-工业-汽车-人工智能”多场景解决方案，丰富公司前沿技术储备，构筑竞争壁垒，有效支持公司未来的产品创新和行业拓展，并进一步巩固差异化竞争优势，提高在晶圆代

工行业的市场地位、行业影响力和核心竞争力。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司成立以来,抓住市场机遇,顺应国际形势和行业周期,稳步健康发展。报告期内,公司经营活动现金流量净额持续为正,经营业绩稳步攀升。2023年、2024年和2025年,公司营业收入分别为10.44亿元、16.81亿元和25.82亿元,2023-2025年均复合增长率高达57.30%,已展现出强劲的内生增长动力与良好的发展前景,为未来持续高质量发展奠定了坚实的基础。

集成电路产业是支撑经济社会发展、保障国家产业安全的战略性、基础性和先导性产业,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。在人工智能快速发展推动下,全球集成电路产业迎来重要战略机遇期。国家“十五五”规划纲要及六大新兴(支柱)产业布局,均将集成电路置于前所未有的战略高度,明确提出做精做细成熟制程、提升先进制程能力,提高成熟制程竞争力成为产业发展重点。坚持成熟制程与先进制程并举发展,是我国实现高水平科技自立自强、筑牢现代化产业体系、保障国家经济和产业安全的必然要求。

粤芯半导体主营业务聚焦领域和企业战略规划与国家“十五五”规划纲要高度契合,面向未来,公司将始终立足国家推动集成电路产业高质量发展与做精做细成熟制程的战略思路,在持续夯实高端模拟工艺优势的基础上,进一步深化高端数模混合工艺布局,并重点强化硅光及光电融合工艺技术的研发与产业化能力,力争成为支撑存算一体、光电融合等新一代信息技术发展的核心制造合作伙伴,持续深度赋能消费电子、工业控制、汽车电子、人工智能等多个领域。公司将致力于构建“以模拟为核心、以数字升级为蝶变、以光电融合为特色”的“一核两翼”发展格局,为中国集成电路产业的健康跨越式发展持续贡献粤芯力量!

董事长:



陈 谨

粤芯半导体技术股份有限公司

2026年4月18日



发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行股票数量不超过 788,530,465 股，不低于本次公开发行后公司总股本的 10%。不涉及公司股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权的发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15.00%。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 3,154,121,862 股（行使超额配售选择权前）
保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目录

重要声明	1
致投资者的声明	2
一、上市的目的	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况	4
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划	4
四、发行人持续经营能力及未来发展规划	5
发行概况	6
目录	7
第一节 释义	12
一、基本术语	12
二、专业术语	16
第二节 概览	19
一、重大事项提示	19
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	23
三、本次发行概况	24
四、发行人主营业务经营情况	25
五、发行人的板块定位	27
六、发行人报告期内的主要财务数据和财务指标	33
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况	34
八、发行人选择的具体上市标准	34
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项	34
十、募集资金运用与未来发展规划	35
十一、其他对发行人有重大影响的事项	35
第三节 风险因素	36
一、与发行人相关的风险	36
二、与行业相关的风险	44
三、其他风险	46
第四节 发行人基本情况	47

一、发行人基本情况	47
二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况	47
三、发行人报告期内的重大资产重组情况	58
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况	58
五、发行人股权结构	58
六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况	59
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及控股股东、实际控制人基本情况	62
八、发行人特别表决权股份或类似安排情况	72
九、发行人协议控制架构情况	72
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪、重大违法行为 ..	72
十一、发行人的股本情况	72
十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况	79
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况 ..	89
十四、董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况	90
十五、董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况	91
十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况	92
十七、发行人正在执行的对其董事、高级管理人员、其他核心人员实行的股 权激励及其他制度安排和执行情况	93
十八、发行人员工情况	94
第五节 业务与技术	97
一、发行人的主营业务情况	98
二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况	111
三、发行人销售情况和主要客户	145
四、发行人采购情况和主要供应商	147
五、发行人的主要资产情况	149
六、发行人核心技术及研发情况	154
七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力	162
八、发行人境外经营情况	163
第六节 财务会计信息与管理层分析	164

一、注册会计师审计意见.....	164
二、财务报表	164
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况	169
四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准	170
五、重要会计政策及会计估计	171
六、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策	201
七、分部信息	202
八、非经常性损益	202
九、主要财务指标	203
十、经营成果分析	205
十一、资产质量分析	238
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析	252
十三、持续经营能力分析	262
十四、报告期重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况	264
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	266
十六、盈利预测报告	266
十七、公司未来经营状况和盈利能力发展趋势	266
第七节 募集资金运用与未来发展规划	272
一、募集资金运用概况	272
二、募集资金投资项目介绍	274
三、项目的必要性与可行性分析	278
四、公司未来发展战略及发展规划	281
第八节 公司治理与独立性	284
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况	284
二、发行人内部控制情况	284
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况	285
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况	285

五、发行人独立经营情况.....	286
六、同业竞争情况	287
七、关联方、关联关系和关联交易情况	288
第九节 投资者保护	298
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序	298
二、本次发行前后的股利分配政策差异情况、股利分配政策、决策程序及监督机制.....	298
三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由	302
四、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排.....	302
五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在未弥补亏损的情况	307
六、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施	307
第十节 其他重要事项.....	308
一、重大合同	308
二、公司对外担保情况	309
三、重大诉讼或仲裁事项.....	310
第十一节 声明.....	311
一、发行人全体董事、高级管理人员声明	311
二、发行人第一大股东声明	313
三、保荐人（主承销商）声明	314
保荐机构董事长声明	315
保荐机构总经理声明	316
四、联席主承销商声明	317
五、发行人律师声明	318
六、审计机构声明	319
七、验资机构声明	320
八、验资复核机构声明	321
九、资产评估机构声明	322

第十二节 附件.....324

 一、备查文件 324

 二、查阅时间和地点 324

 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 325

 四、与投资者保护相关的承诺事项.....328

 五、发行人拥有的商标 351

 六、发行人拥有的专利 353

 七、发行人拥有的集成电路布图设计专有权.....377

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本术语

发行人、公司、粤芯半导体、粤芯股份、股份公司	指	粤芯半导体技术股份有限公司
粤芯有限、有限公司	指	广州粤芯半导体技术有限公司，系发行人前身
粤芯集成	指	广州粤芯集成电路有限公司，系发行人全资子公司
粤芯一、二期、第一工厂	指	粤芯半导体技术股份有限公司
粤芯三期、第二工厂	指	广州粤芯三期集成电路制造有限公司，系发行人控股子公司
粤芯四期、第三工厂	指	广州粤芯四期集成电路制造有限公司，系发行人全资子公司
粤芯国际	指	粤芯半导体国际有限公司，系发行人全资香港子公司
穗开创芯基金	指	广州穗开创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人参股企业
武粤光电	指	武汉武粤光电技术有限公司，系发行人参股公司
苏州德信	指	苏州德信芯片科技有限公司，系发行人参股公司
广汽埃安	指	广汽埃安新能源汽车股份有限公司，系发行人参股公司
联芯壹号	指	联芯壹号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
联芯贰号	指	联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
联芯叁号	指	联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
联芯肆号	指	联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
联芯伍号	指	联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
联芯陆号	指	联芯陆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人持股平台
誉芯众诚	指	广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
广东半导体基金	指	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
广州华盈	指	广州华盈企业管理有限公司，系发行人股东
科学城集团	指	科学城（广州）投资集团有限公司，系发行人股东
国投创业基金	指	国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
农银金融	指	农银金融资产投资有限公司，系发行人股东
广州科创产投	指	广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股

		东
苏州璞然	指	苏州璞然创业投资合伙企业(有限合伙), 曾用名为上海芯濮然创业投资合伙企业(有限合伙)、合肥璞然集成电路股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广东广祺智行肆号	指	广东广祺智行肆号股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州吉富新芯	指	广州吉富新芯创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州越秀创达八号	指	广州越秀创达八号实业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
嘉兴隼满	指	嘉兴隼满股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广东广祺辰途	指	广东广祺辰途瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
深圳惠友	指	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州合信芯赢	指	广州合信芯赢投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
合肥华芯康远	指	合肥华芯康远汽车电子投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州晶芯	指	广州晶芯创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
建信金融	指	建信金融资产投资有限公司, 系发行人股东
知识城集团	指	知识城(广州)投资集团有限公司, 系发行人股东
深圳山海叁号	指	深圳山海叁号科技合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
苏州晶璞	指	苏州晶璞创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州广祺欣芯	指	广州广祺欣芯管理咨询合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
苏州储芯	指	苏州工业园区储芯创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
合肥华登二期	指	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
盈科值得一号	指	淄博盈科值得一号股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州盛誉	指	广州盛誉工控产业投资基金合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
盈科吉运创投	指	淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
共青城吉富	指	共青城吉富启盛股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司, 系发行人股东
青岛新鼎	指	青岛新鼎哨哥捌陆投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
深圳安鹏	指	深圳市安鹏知行投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州华芯盛景	指	广州华芯盛景创业投资中心(有限合伙), 系发行人股东
中山广发信德	指	中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东

广州产投壹号	指	广州产投壹号集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙), 曾用名为合肥华芯胜科集成电路投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
淄博盈峰	指	淄博盈峰万晟股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广东珩芯	指	广东珩芯创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州合信芯达	指	广州合信芯达投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州吉富智芯	指	广州吉富智芯创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
厦门惠友	指	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广发信德二期	指	广州广发信德二期创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东
广州芯联心	指	广州芯联心企业管理有限责任公司, 系发行人持股平台的执行事务合伙人
金誉实业	指	广州市金誉实业投资集团有限公司
苏州兰璞创投	指	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)
嘉善存芯	指	嘉善存芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
中鑫产投	指	中鑫产投(广州)产业股权投资合伙企业(有限合伙)
产投中鑫	指	广州产投中鑫产业股权投资合伙企业(有限合伙)
工融金投	指	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
IMEC	指	IMEC International, stichting van openbaar nut
Sharp	指	Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd.
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司
格罗方德	指	Global Foundries Inc.
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华虹宏力	指	华虹半导体有限公司, 曾用中文证券简称“华虹公司”
华虹集团	指	包括华虹宏力和上海华力微电子有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
燕东微	指	北京燕东微电子股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《粤芯半导体技术股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	发行人本次发行上市后适用的《粤芯半导体技术股份有限公司章程(草案)》
股东会	指	粤芯半导体技术股份有限公司股东会

董事会	指	粤芯半导体技术股份有限公司董事会
监事会	指	粤芯半导体技术股份有限公司监事会
中共中央	指	中国共产党中央委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
税务总局	指	国家税务总局
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会
广东省工信厅	指	广东省工业和信息化厅
广东省科技厅	指	广东省科学技术厅
Yole	指	Yole Group 是一家全球知名的市场研究与战略咨询公司，专注于半导体、微电子、光子学、材料和相关领域的尖端技术及市场分析
TechInsights	指	TechInsights 是一家全球知名的半导体技术趋势分析、芯片拆解及供应链研究机构
Chip Insights	指	芯思想研究院，是一家专注于半导体行业的独立第三方研究机构
SEMI	指	国际半导体产业协会，是一个全球性的产业协会，服务于半导体、光伏、电子等高科技行业的制造供应链
Omdia	指	Informa TechTarget 旗下的一家全球性的市场研究和咨询公司，专注于消费电子、半导体、人工智能等领域的数据分析与行业研究
Frost & Sullivan	指	Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）是一家全球知名的商业咨询公司，业务范围涵盖跨行业的市场调研及分析、业务增长战略咨询及企业培训
Statista	指	Statista.com 是一个全球性综合数据资料库，所提供的权威有效的数据涵盖了世界主要国家和经济体
CINNO Research	指	CINNO Research（上海群辉华商光电科技有限公司）是一家专注于半导体、显示面板及消费电子领域的研究机构
Mordor Intelligence	指	Mordor Intelligence 是一家全球性的市场研究机构
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics（世界半导体贸易统计组织），是一个由全球半导体公司组成的非盈利性组织，负责制定和发布行业标准、跟踪行业市场数据等
Precedence Research	指	Precedence Research 是一家市场研究公司，覆盖半导体、生物医药、航空航天、能源、人工智能等领域
智研咨询	指	由北京智研钧略咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究

		报告
头豹研究院	指	头豹研究院是一个互联网商业咨询平台,业务内容涵盖行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议等
Gartner	指	Gartner 是一家全球知名的 IT 研究与顾问咨询公司
IDC	指	International Data Corporation 是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广发证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	广发证券股份有限公司
国泰海通、联席主承销商	指	国泰海通证券股份有限公司
致同、致同会计师、发行人会计师、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
康达、发行人律师、律师	指	北京市康达律师事务所
中企华、发行人评估机构	指	深圳中企华土地房地产资产评估有限公司
报告期、最近三年	指	2023 年度、2024 年度和 2025 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
“十五五”规划纲要	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

二、专业术语

BCD	指	Bipolar-CMOS-DMOS, 一种结合了双极型、CMOS 和 DMOS 的单片 IC 制造工艺。相对于传统的双极功率工艺, BCD 为一种单芯片功率集成电路技术
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补金属氧化物半导体
MS	指	Mixed Signal, 混合信号
CIS	指	CMOS Image Sensor, CMOS 图像传感器
DMOS	指	Double-diffused Metal Oxide Semiconductor, 双扩散金属氧化物半导体
MCU	指	Microcontroller, 微控制器, 是一种集成了计算功能的嵌入式设备, 将计算能力、存储单元以及输入/输出(I/O)接口集成在一个小型芯片上, 能够执行专门的任务, 通常用来实时控制复杂的系统
eNVM	指	Embedded Non-Volatile Memory, 嵌入式非易失存储器
OTP	指	One-Time Programmable, 一次性可编程, 是一种独特的非易失性存储器, 其特点在于仅允许进行一次编程操作, 且一旦编程完成, 数据将保持永久有效
MTP	指	Multiple-Times Programmable, 多次可编程, 具备灵活性, 能够根据用户需求进行多次重新编程与更新, 从而满足不断变化的应用场景

EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read-Only-Memory, 指带电可擦可编程只读存储器, 是一种掉电后数据不丢失的存储芯片
eFLASH	指	Embedded Flash Memory, 指嵌入式闪存, 是一种可快速读写并在掉电后不丢失数据的存储器
DDIC	指	Display Driver IC, 面板显示驱动芯片
HV	指	High Voltage DDIC, 高压显示驱动
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor, 绝缘栅双极型晶体管, 同时具备 MOSFET 和双极性晶体管的优点, 如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高等特点
MOS、MOSFET	指	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 金属-氧化物-半导体场效应晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管, 按导电方式分为 PMOS 晶体管和 NMOS 晶体管两种类型
TMOS	指	Trenched MOSFET, 沟槽型场效应晶体管, 采用垂直的沟道设计, 进一步提高其沟道密度, 减小芯片尺寸, 降低导通电阻, 拥有更低的导通电阻和栅漏电荷密度, 因而拥有更低的导通和开关损耗及更快的开关速度
SGT	指	Shield Gate Trenched MOSFET, 屏蔽栅沟槽型场效应晶体管, 在沟槽内栅多晶硅电极下面引入另一多晶硅电极, 并使之与源电极电气相连, 采用氧化层将上下二个多晶硅电极隔开, 具有导通电阻低、栅电荷低、米勒电容低等特点
SiPho	指	Silicon Photonics, 硅光或硅光子技术, 是利用硅和硅基衬底材料作为光学介质, 通过集成电路工艺来制造相应的光子器件和光电器件, 这些器件用于对光子的激发、处理和操纵, 实现其在光通信、光互连、光计算等多个领域的应用
LCD	指	Liquid Crystal Display, 液晶显示屏
LED	指	Light-Emitting Diode, 发光二极管
数字芯片	指	主要处理离散的、不连续的数字信号, 通过逻辑门、存储单元等结构进行二进制计算(0 和 1), 适合精确计算和逻辑控制
模拟芯片	指	主要处理连续变化的模拟信号(如声音、光线、温度、电压等), 通过电容、电阻、晶体管等电路元件对信号进行放大、滤波、调节等功能
晶圆	指	晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于是圆形晶体材料, 所以称为晶圆。按照直径进行分类, 主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
光掩模版	指	制造半导体芯片时, 将电路印制在硅晶圆上所使用的图形母版, 是根据芯片设计公司设计的集成电路版图来生产制作的, 又被称为光掩模、掩模版、光罩
光刻胶	指	又称光致抗蚀剂及其配套化学品, 是光敏高分子聚合物材料, 由成膜材料、光敏材料、溶剂及添加剂组成。该材料通过光化学反应实现图形转移, 具有光化学敏感性、抗蚀性及机械耐热特性
封测	指	“封装、测试”的简称; “封装”指为芯片安装外壳, 起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用; “测试”指检测封装后的芯片是否可正常运作
线宽、制程、制程节	指	集成电路制造过程中, 以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术

点、工艺节点		工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
pitch	指	集成电路中相邻功能单元（如晶体管、引脚等）中心之间的固定距离，它是衡量元件布局密度与制造工艺精度的核心参数
IDM	指	垂直整合模式，涵盖集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测以及后续的产品销售等环节
Fabless	指	无晶圆厂模式，不涵盖集成电路制造环节和集成电路封测环节，专门负责集成电路设计和后续的产品销售，将集成电路制造和封测外包给专业的集成电路制造、封测企业
Foundry	指	晶圆代工模式，不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务
EDA	指	Electronic Design Automation 的简称，EDA 工具指电子设计自动化，是 IC 电子行业必备的设计工具软件，是从计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助测试和计算机辅助工程的概念发展而来的。以计算机为工具，设计者在 EDA 软件平台上，将芯片从电路设计、性能分析到设计出 IC 版图的全过程都交由计算机自动处理完成
IP、IP 核	指	Intellectual Property 的简称，指知识产权。IP 核指知识产权核或知识产权模块。IP 核是将一些在数字电路中常用，但比较复杂的功能块，如 FIR 滤波器、SDRAM 控制器等设计成可修改参数的模块
电阻	指	对电流产生阻碍作用的元件
电容	指	能够储存电量和电能的元件
铜制程	指	集成电路内部器件之间互连使用铜线
μm	指	微米，长度的度量单位，1 微米等于 10 的负 6 次方米
nm	指	纳米，长度的度量单位，1 纳米等于 10 的负 9 次方米
NRE	指	Non-Recurring Engineering，是集成电路研发阶段产生的非重复性工程费用，包含设计人工费、制版工艺费、测试分析费等一次性开支
CPO	指	共封装光学技术（Co-Packaged Optics），指将交换（ASIC）芯片和光引擎在同一基板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成
NPO	指	近封装光学技术（Near-Packaged Optics），指将光引擎封装在与交换（ASIC）芯片相邻的独立基板上，或者通过中介层连接，通过短距离电信号路径提升带宽密度、降低功耗，并保持一定可维护性与开放性；通常被视为从传统可插拔光模块向 CPO 演进的中间状态

注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

(一) 重大风险提示

公司提醒投资者关注以下风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。

1、无控股股东和实际控制人的风险

报告期内，公司股权结构较为分散。截至本招股说明书签署日，公司持股 5% 以上的股东包括誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金，持股比例分别为 16.88%、11.29%、9.51%、8.82%和 7.05%。无任一股东及其一致行动人可控制股东会或对股东会的决议产生决定性的影响；可控制董事会或对董事会的决议产生决定性的影响；可决定董事会半数以上成员任免；可实际支配或决定公司的重大经营决策、重要人事任命。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定建立了较为完善的法人治理结构，并严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定开展经营活动，但公司股权结构分散可能会降低股东会、董事会对于重大事项决策的效率，进而导致公司治理效率降低，**造成生产经营风险的情形**；此外，公司控制权可能于未来发生变动，从而给公司经营与发展带来潜在的风险。

2、报告期内公司尚未实现盈利，最近一期期末存在累计未弥补亏损

由于晶圆制造行业的重资产属性、技术密集型特征、模拟芯片的产品特性及公司股份支付等因素的影响，公司报告期内归属于母公司股东的净利润分别为-191,711.34 万元、-225,326.91 万元和-234,582.32 万元。截至报告期末，公司未分配利润为-1,008,096.75 万元。公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

公司自设立以来，因应市场及客户需求、以及公司规划的技术平台演进的需

要,公司持续扩充产能,目前已建设两座晶圆厂,相应晶圆厂的规划和建设需兼顾公司当前产品需求和未来技术延展布局,因此固定资产投入规模较大、资产折旧金额较高。同时,晶圆制造领域普遍存在产能爬坡周期较长,产能需逐步释放的现实状况,资产折旧对财务业绩产生重大影响。报告期内,公司机器设备的折旧费用分别为 151,877.14 万元、170,155.08 万元和 230,161.48 万元。

公司处于技术密集型行业,致力于打造多元化的技术平台,存在持续进行高强度研发的需求。自设立以来,公司保持大规模的研发投入,研发投入费用占营业收入比重较高。报告期内,公司发生的研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元。

模拟芯片存在品类多样化的特点,产品生命周期长,客户粘性高。公司持续进行大规模研发投入的同时,产品存在一定的验证周期,尚未形成突出的规模效应。公司实现盈亏平衡的时间相对较长。

为吸引和保留优秀技术和管理人才,公司实施了员工股权激励。报告期内,影响当期损益的股份支付费用分别为 6,717.10 万元、6,371.51 万元和 6,443.68 万元,占当期营业收入比例分别为 6.44%、3.79%和 2.50%,对当期净利润产生一定程度的影响。

随着公司客户持续开拓,经营管理不断优化,以及工艺技术平台取得重点突破,公司预计未来几年亏损规模将不断收窄,但公司资产折旧费用、研发费用还将持续处于较高水平,叠加股权激励产生的股份支付费用的影响,公司可能短期内还将面临持续亏损的风险。预计本次发行后,公司账面累计未弥补亏损将持续存在,导致一定时期内无法进行现金分红,可能对股东的投资收益会造成一定程度的影响。

3、宏观经济波动、行业周期性的风险

半导体行业受全球宏观经济波动、下游应用市场需求变化、产能和库存周期等因素影响,呈现较强周期性特征。主导半导体周期的核心因素系供需关系的变化,具体表现为在行业上升周期时,下游订单饱满,公司产能利用率趋于饱和,经营业绩增长;在行业下降周期时,下游订单需求下降,公司产能利用率不足,经营业绩下滑。

2022 年以后受全球宏观经济下行、地缘政治冲突及消费电子疲弱等因素影响, 半导体行业进入了去库存的下行周期; 但 2024 年以来, 全球半导体市场呈现强劲复苏态势, 消费电子综合景气指标持续上升, 行业逐渐回暖。

根据 Yole 预测, 受益于终端市场复苏和 AI 的需求增长, 全球晶圆代工行业于 2024-2029 年预计进入新一轮增长周期, 2024-2029 年全球晶圆代工行业营收年均复合增长率预计将达 12.05%。

如果未来全球经济发生较大波动, 半导体晶圆制造行业的产业政策发生重大不利变化, 或半导体行业重新进入下行周期导致晶圆代工的需求下降, 则可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

4、国际贸易摩擦的风险

公司使用的部分设备及零部件、原材料通过向境外供应商采购取得。公司目前暂未受到境外国家出口管制的影响。未来, 如因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级或相关国家政策由先进制程向更广泛范围延伸等不可抗力因素造成公司的部分设备及零部件、原材料成本增加或者停止供应, 则可能导致公司无法进行正常生产, 进而将对公司的业务和经营产生不利影响。

同时, 报告期内, 公司部分产品外销至境外国家或地区, 外销收入占主营业务收入的比例分别为 4.71%、9.19%和 8.58%。未来, 倘若因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级等不可抗力因素造成公司产品境外销售成本增加或不能出售至相关国家或地区, 可能存在公司外销收入下降的风险。”

5、工艺技术平台迭代不达预期的风险

公司的工艺技术平台围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片, 逐步实现了多品类布局, 已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台, 技术节点覆盖 180nm-55nm, 可提供多种工艺技术平台和多样化制程节点的一站式解决方案, 产品可广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等领域。

未来, 公司将紧跟全球半导体行业发展及国家半导体产业政策趋势, 在硅光及光电融合芯片、微控制器、存算一体芯片等多个领域加大研发投入, 逐步拓宽深化公司技术平台和产品应用, 实现 22nm 及以上制程全覆盖。

公司所处的晶圆代工行业技术门槛高,技术研发验证周期长,尤其在新制程节点开发过程中可能面临关键技术突破困难、研发进度不及预期等风险,如公司无法及时完成相关技术平台的研发以响应市场需求,将对公司的市场竞争力及市场份额造成不利影响。

6、固定资产投资风险

晶圆代工行业属于资本密集型行业,设备投资成本较高。公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充,固定资产投资规模较大。

公司目前拥有两座 12 英寸晶圆厂,分别为第一工厂(粤芯一、二期)和第二工厂(粤芯三期),规划产能合计为 8 万片/月。报告期内,公司各期末固定资产的账面价值分别为 708,891.57 万元、841,784.01 万元和 1,239,559.85 万元,占公司总资产的比例为 37.24%、42.94%和 50.66%;公司各期末在建工程的账面价值分别为 290,469.43 万元、546,020.79 万元和 158,647.41 万元,占公司总资产的比例为 15.26%、27.85%和 6.48%。目前,公司已启动建设一条规划产能为 4 万片/月的 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线,即第三工厂(粤芯四期)。

大规模的固定资产建设对公司后续资金投入提出较高要求,使公司的资金筹措能力面临较大考验;此外,晶圆制造产线从建设完成、试生产、产品认证到最后的批量生产,需要经历较长的时间,如公司未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧,公司还将面临盈利能力下降的风险。

7、业绩未及预期的风险

报告期内,公司营业收入实现快速增长,但受固定资产投资较大、研发投入较高、行业周期波动等因素影响,尚未实现盈利。在晶圆代工行业市场空间广阔、下游应用需求旺盛的背景下,随着公司高附加值产品导入放量、产能逐步释放、新产品客户开拓稳步推进,公司预计未来产销规模将持续提升,长期盈利能力将得到有效改善,合并口径预计最早将于 2029 年实现扭亏为盈。

公司盈利预期及前瞻性信息是基于报告期内经营情况及假设基础上得出。考虑到行业周期性波动、市场竞争、客户及产品开拓进度等影响经营结果的因素较为复杂,公司有可能面临产品销量、销售单价、毛利率等指标不及预期、整体扭亏为盈时间延后的风险。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

发行人及相关责任主体已按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求，就股份限售安排、业绩下滑延长股份锁定期限、股东持股及减持意向、稳定股价等重要事项作出相关承诺。

本公司提示投资者阅读本公司、主要股东、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”。

（三）本次发行后公司的利润分配政策

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用的<粤芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年分红回报规划的议案》，对公司本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定。

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后的股利分配政策差异情况、股利分配政策、决策程序及监督机制”之“（二）本次发行上市后的股利分配政策、决策程序及监督机制”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	粤芯半导体技术股份有限公司	成立日期	2017 年 12 月 12 日
注册资本	236,559.1397 万元	法定代表人	陈谨
注册地址	广州市黄埔区凤凰五路 28 号	主要生产经营地址	广州市黄埔区凤凰五路 28 号
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	广发证券股份有限公司	主承销商	广发证券股份有限公司

发行人律师	北京市康达律师事务所	联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	深圳中企华土地房地产资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股说明书签署日，广发证券控制的广发乾和、中山广发信德、广发信德二期分别直接持有发行人 0.45%、0.35%、0.23% 的股份，合计持有发行人 1.03% 的股份；国泰海通及其关联主体国泰君安证裕投资有限公司等在间接股东层面存在极少量持股，合计间接持有发行人不超过 0.1% 的股份。 除前述情形外，不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形。	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 788,530,465 股（行使超额配售选择权前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权前）
其中：发行新股数量	不超过 788,530,465 股（行使超额配售选择权前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权前）
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 3,154,121,862 股（行使超额配售选择权前）		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍（每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股	发行前每股收益	【】元/股
发行后每股净资产	【】元/股	发行后每股收益	【】元/股
发行市净率	【】倍（按照每股价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行采用网下向符合适用法律法规和证券监管机构规定条件的询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或者证券监管机构认可的其他方式。		
发行对象	符合适用法律法规和证券监管机构规定条件的询价对象和已经在深交所开立证券账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会		

	会、深交所规定的其他投资者（法律、法规禁止购买者除外）。证券监管机构、深交所另有规定的，按其规定处理
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元，根据发行价格乘以发行股数确定
募集资金净额	【】万元，由募集资金总额扣除发行费用后确定
募集资金投资项目	12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）
	特色工艺技术平台研发项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中：承销及保荐费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照深交所相关规定执行；保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不涉及
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品或服务及其用途

公司是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。公司以特色工艺晶圆代工为核心商业模式，服务芯片设计公司和终端客户，主要客户涵盖境内外多家一流半导体行业设计公司。公司具备集成电路、功率器件等产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

公司目前拥有两座 12 英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为 8 万片/月，截至 2025 年末已实现产能 6.33

万片/月。目前，公司已启动建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期）。粤芯四期建成后，公司产能合计将达到12万片/月。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	197,544.22	78.68%	130,971.78	80.26%	75,585.59	74.05%
功率器件代工	53,543.43	21.32%	32,218.36	19.74%	26,491.90	25.95%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

公司在集成电路领域，经过长期的技术积淀，形成了 MS（混合信号）、HV（高压显示驱动）、CIS（CMOS 图像传感器）、eNVM（嵌入式非易失存储器）、BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）和 SiPho（硅光）工艺技术平台。功率器件领域，公司拥有 MOSFET（金属-氧化物-半导体场效应晶体管）和 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）工艺技术平台。丰富的产品组合和技术优势，使公司能响应客户的多元化需求，为设计调整制造工艺，成功实现客户的产品性能和设计目标。同时，公司积极布局行业前瞻领域，打造硅光及光电融合芯片、微控制器、存算一体芯片等产业平台，进一步拓宽前沿科技的下游应用市场。

（二）所需主要原材料及重要供应商

发行人生产经营所需的原材料主要包括硅片、备品备件、气体、化学品等。发行人根据整体战略和实际业务需求，建立了完善的采购管理制度，执行统一、规范的供应商管理体系；已与境内外行业知名供应商建立了稳定的合作关系，主要涵盖了境内外半导体领域的知名上市公司。

（三）主要生产模式

公司采用以销定产的模式，生产流程上主要包括生产计划、生产准备、加工制造、产品入库等阶段。销售部门依据与客户沟通的未来业务规划、与客户达成的商业计划、工艺技术准备情况及营收目标制定业务需求预测计划，生产计划部门结合业务需求预测计划、产能规划和原材料供应情况制定主生产计划。生产部门组织生产，产品完工经检验合格后入库，并按照客户需求完成产品交付。

(四) 销售方式和渠道及重要客户

公司主要采用直销模式开展销售业务,与客户建立合作关系后,进行直接沟通并形成符合客户需求的解决方案,推动签署订单。报告期内,发行人的主要客户群体为境内外知名芯片设计公司,客户产品类别涵盖指纹识别芯片、CMOS 图像传感器、功率器件、电源管理芯片、LCD 及 LED 显示驱动芯片、电子标签显示驱动芯片等。

(五) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是广东省自主培养且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业,专注于模拟芯片制造,规划产能 12 万片/月,为国家集成电路产业战略布局提供重要的产能支撑。根据 SEMI 预测,2025 年粤芯半导体 12 英寸晶圆产能规模位于中国大陆晶圆厂前列。

公司目前已形成多元化的特色工艺技术平台,并在细分产品领域建立核心竞争优势,对应产品出货量位居行业前列。公司已成为全球出货量领先的电容指纹识别芯片晶圆代工厂之一和国内少数具备硅基 CMOS 超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。公司手机电源管理芯片已向全球前三大独立手机芯片公司的其中两家供货。公司前瞻性布局前沿科技领域,是国内少数拥有 12 英寸硅光芯片工艺技术平台的晶圆代工厂之一。

行业竞争情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况”之“(四)所属细分行业竞争格局、行业内主要企业”。

五、发行人的板块定位

(一) 发行人所属行业符合创业板定位

公司是一家专注于特色工艺的 12 英寸晶圆代工企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)大类中“电子器件制造”(C397)项下的“集成电路制造”(C3973)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号),公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”(分类代码:1.2.1)及“集成电路制造”(分类代码:1.2.4)。

公司主营业务不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，亦不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求及其依据

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条关于量化指标的规定中第（二）项标准，具体如下：

评价指标	是否符合	备注
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	公司最近三年累计研发投入 14.73 亿元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年公司营业收入为 25.82 亿元，超过 3 亿元，不适用营业收入复合增长率的要求

注：最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已在境外上市的红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。

（三）公司的创新、创造、创意性特征

公司目前已形成平台多样化、工艺精进化、产品差异化、布局前沿化等创新性优势，并具备创新资源保障。

1、平台多样化：布局全链路产品矩阵，构筑技术护城河

公司的工艺技术平台围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片，逐步实现了多品类布局，已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台，工艺制程覆盖 180nm-55nm，构建了完整的“感知-传输-计算-存储-控制-显示”全链路技术矩阵。产品线覆盖指纹识别芯片、LCD 及 LED 显示驱动芯片、电子标签显示驱动芯片、CMOS 图像传感器、电源管理芯片、功率器件、硅光芯片等终端产品，可应用于消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等领域。

2、工艺精进化：立足全平台优势，布局多场景解决方案

在工艺能力上，公司以多品类产品研发为纽带，依托现有平台优势，建立从“消费级-工控级-车规级-人工智能”芯片的递进式爬坡路径，构建“消费-工业-汽车-人工智能”多场景解决方案。目前，公司已在高性能消费级芯片领域实现大批量生产，工业级芯片、车载芯片领域亦已有量产出货。

公司联合相关科研院所，积极承担相关车载芯片的工艺研发。目前，公司已有多平台处于车规工艺的研发、验证及量产阶段，其中 18 款产品已通过终端整车厂的车规认证。

公司围绕电力、轨道交通、石油石化等关键工业领域，已开展工业芯片工艺开发及工业核心芯片产品技术研究，推动重点工业领域芯片制造国产化进程。

3、产品差异化：开发特色 BCD 工艺技术平台，实现差异化竞争优势

公司致力于成为国内少数能够提供多样化特色 BCD 解决方案的模拟芯片晶圆代工企业，建立公司差异化竞争优势。为了满足高性能、高集成度、高性价比的市场需求，公司基于已有的传统 BCD 平台，已开发或正在开发 BCD 与功率器件集成工艺(BCD+SGT)、BCD 与数字隔离器集成工艺(BCD+Digital Isolator)、支持 120V 及以上器件击穿电压的高压 BCD 工艺、支持单相电流 40A 及以下的低压大电流 BCD 工艺等更高价值量、更高技术难度的特色 BCD 工艺技术平台。

4、布局前沿化：联合终端应用、设计与先进封装，构建硅光全产业链生态布局

公司集中优势资源开发硅光工艺技术平台，已于 2024 年成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台。截至本招股说明书签署日，公司的硅光工艺技术平台累计投片量已超过 1,000 片，已具备规模化量产能力。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高速可插拔硅光光模块应用，与国际领先水平相当。同时，公司与业界先进水平保持同步，开展近封装光学(NPO)的工艺制造技术研发，目前正在导入 3.2TNPO 产品。基于 90nm SiPho 工艺技术平台基础，公司将延续平台布局前沿化策略，强化技术平台优势，进一步开展 65nm 硅光及光电融合工艺的研发和量产，实现从可插拔光模块向近封装光学(NPO)、光电共封装(CPO)的演进。

未来，公司将进一步加强与科研院所及龙头企业的深度合作，打通“终端应用-设计-制造-先进封装”的硅光全产业链生态布局。目前公司通过与研究机构、科研院所等研发组织共同建设与运营“光电子与光子芯片研发中试平台”，重点攻关光电融合芯片领域的关键技术。公司目前已与多家光芯片设计公司形成合作，终端客户涵盖行业知名云服务厂商。

综上，公司具备平台多样化、工艺精进化、产品差异化、布局前沿化等创新性优势。此外，公司已具备形成优质特色工艺晶圆代工企业的人才梯队、研发体系、产能组合、客户基础、公司治理及股权激励机制等系统化优势，为公司形成创新优势提供极为重要的创新资源保障。

（四）公司的科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节，是半导体制造产业的核心构成。模拟芯片的性能（如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性）更依赖于工艺创新与器件优化，需通过特色工艺与设计的深度融合实现，而非仅通过制程缩小。

公司采用特色工艺晶圆代工的创新模式，深度协同芯片设计公司及终端客户，推动需求、设计与制造的协同优化，以高标准满足其特色工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。

此外，公司致力于特色工艺制程技术的创新优化，积极布局自有知识产权体系，由研发实力雄厚的技术研发团队进行自有技术的开发，构建完整全面的技术体系。公司的工艺技术平台已涵盖 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等平台的制造能力，可为客户提供 180-55nm 等制程节点的特色工艺晶圆代工服务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获授权专利（含境外专利）712 项，其中发明专利 343 项。公司先后被评为广东省工程技术研究中心、广东省重点项目、广州市独角兽创新企业等，在集成电路制造领域构建了坚实的技术壁垒。

综上，公司依托特色工艺晶圆代工的创新模式，有力支持芯片设计企业及终端客户，同时通过积极构建自有知识产权体系、拓展多元工艺技术平台，已具备较强的市场竞争力和较高的行业认可度。未来，公司将持续聚焦科技创新与模式升级，持续致力于加速高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的全面国产替代进程。

（五）公司具有较强的成长性

在晶圆代工行业保持稳定增长、国产替代空间广阔背景下，公司内生增长

动力强劲，具备高成长性。

1、公司所处的晶圆代工行业预计将保持稳定增长

近年来，由于地缘政治、供应链安全性、兼容性 & 成本效益及终端市场等因素，伴随中国半导体产业链的日渐成熟、晶圆制造水平的提升，一方面，国内的芯片设计企业开始逐步将订单转回国内的晶圆代工厂，半导体的国产替代需求持续提升；另一方面，国际半导体巨头如意法半导体、英飞凌、恩智浦等也先后将面向中国终端市场产品的制造需求转移至国内晶圆代工厂。

根据 Yole 预测，全球晶圆代工行业因“终端需求回暖+AI 需求攀升”，2024-2029 年的年均复合增长率约 12.05%。充足的市场需求空间叠加地缘政治较高不确定性等因素，加速中国芯片厂商的发展进程，公司所处的晶圆代工领域增长潜力大。

2、消费电子行业拥有广阔的市场空间

消费电子行业属于国家支柱产业，在国民经济生产中占有重要地位。近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提升，加之我国居民消费水平不断提高，消费电子产品市场需求持续增长，促进了消费电子行业的快速健康发展。

根据 Statista 数据，2018 年，全球消费电子市场规模约为 9,195 亿美元，2023 年增长至 10,276 亿美元，2018-2023 年期间年均复合增长率约为 2.25%。预计 2028 年全球消费电子市场规模将达到 11,767 亿美元，2018-2028 年期间年均复合增长率约为 2.50%，市场规模达到历史新高。

虽然消费电子行业受各类因素影响呈现周期性变化特点，但随着全球经济发展和消费电子产品的推陈出新，消费电子行业市场会总体呈现稳步增长趋势。2024 年来，随着全球智能手机市场的复苏及 PC 市场的回暖，消费电子设备出货量稳步增加。同时，随着 2024 年第四季度以来具有端侧 AI 功能的终端消费电子产品的涌现，驱动消费电子市场出现新的增长动力。消费电子行业的稳步发展将带来上游行业需求的持续增长，为公司创造良好且可持续的业务发展空间。2024 年和 2025 年，公司消费电子领域营业收入为 141,545.08 万元和 195,324.58 万元，

2024 年度、2025 年度消费电子领域收入较上年同期分别增长 56.25%、37.99%，消费电子市场复苏已传导到公司的业绩表现，未来仍有较大的增长空间。

3、汽车和工业领域的芯片需求旺盛

受益于智能驾驶和智能座舱的渗透率提升及汽车销量的增加，车用芯片需求量增加。随着技术的成熟和成本降低，越来越多的汽车开始搭载智能驾驶及智能座舱硬件，智能驾驶与智能座舱的渗透率逐渐提升，拉动对上游电子元器件需求。首先智能座舱与智能驾驶带动单车芯片数量倍增，更高阶智能驾驶和智能座舱的要求将会驱动更多微控制器、存储、信号处理、电源管理、电机驱动、图像传感器等芯片的需求，进而带动对车规级芯片晶圆代工服务的需求。公司已通过了 IATF 16949 汽车质量管理体系认证，且有多种工艺技术平台和丰富的制程节点工艺，能够满足汽车芯片行业客户对晶圆代工服务的需求。

工业自动化与智能化设备普及率提升带动工业级芯片下游用量增加。自动化智能设备需要实现“感知+决策+控制”的融合，需要视觉传感器、运动控制 MCU 及决策 SoC 等芯片共同支持设备实现自动化及智能化。自动化与智能化工业设备的逐渐增加将会带动工业级芯片需求，公司产品应用领域覆盖工业级芯片产品，可为不同的工业级芯片产品提供晶圆代工服务。

4、硅光市场增长潜力巨大

AI 大模型训练与推理需求增加，硅光芯片预期将发挥关键作用，下游需求有望持续增加。硅光技术的核心价值在于其能够突破传统电子芯片在数据传输带宽、功耗和延迟上的物理极限，为下一代信息技术提供全新的解决方案。随着人工智能、大数据和高性能计算需求的快速增长，在 AI 大模型训练和推理场景中，海量数据的处理需求对芯片间的传输能效提出了前所未有的挑战，硅光芯片凭借其高带宽、低延迟和高能效比特性，成为解决这一难题的关键技术。

根据 Yole 预测，2029 年全球硅光光模块市场规模预计将达 102.60 亿美元，2023-2029 年均复合增长率接近 40%，需求增长空间巨大。

截至本招股说明书签署日，公司的 SiPho 工艺技术平台累计投片量已超过 1,000 片，已具备规模化量产能力，并已与多家光芯片设计公司形成合作，终端客户涵盖行业知名云服务厂商。公司预期在未来的硅光芯片市场，拥有较大的增

长潜力，预计未来公司硅光产品的销售收入占比将逐步提升。

5、公司内生增长动力强劲

公司高质量服务客户需求，帮助客户提高产品竞争力，促进自身业绩总体稳定向好。公司致力于满足国产模拟芯片制造需求，助力中国实现集成电路产业链的自主可控。

报告期内，公司经营活动现金流量净额持续为正，分别为 9,971.89 万元、63,964.58 万元和 62,122.54 万元；营业收入分别为 10.44 亿元、16.81 亿元和 25.82 亿元，2023-2025 年均复合增长率高达 57.30%。

伴随业务规模的持续扩张，产品结构不断优化，公司工业控制及汽车电子领域于报告期内分别合计实现销售收入 1.11 亿元、2.10 亿元和 5.44 亿元，年均复合增长率超过 120%，2025 年收入占比已突破 20%。同时，随着产能建设稳步推进，产能持续释放，公司 2025 年产能利用率已提升至 96.38%，产销规模显著提升，彰显出强劲且可持续的经营能力和增长动力。

综上所述，公司所处的半导体及集成电路行业仍处于快速发展阶段，晶圆代工行业具备较大增长潜力，模拟芯片晶圆代工领域国产替代空间广阔。受惠于半导体及集成电路国产替代的迫切需求、晶圆代工行业持续向好、下游消费电子市场回暖、车规级和工业级芯片市场需求增长和硅光芯片起量，公司增长动力充足，具备较强的成长性。

六、发行人报告期内的主要财务数据和财务指标

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	2,447,017.07	1,960,350.63	1,903,369.22
归属于母公司所有者权益（万元）	265,184.18	497,843.50	711,513.44
资产负债率（合并）	84.13%	67.79%	62.62%
资产负债率（母公司）	77.61%	59.12%	56.13%
营业收入（万元）	258,236.87	168,132.90	104,371.92
净利润（万元）	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-234,582.32	-225,326.91	-191,711.34

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-274,404.61	-250,338.60	-247,000.87
基本每股收益（元/股）	-0.99	-0.95	-0.81
稀释每股收益（元/股）	-0.99	-0.95	-0.81
加权平均净资产收益率	-61.16%	-37.30%	-23.87%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	62,122.54	63,964.58	9,971.89
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	16.36%	26.50%	58.00%

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，所处行业的产业政策未发生重大变化，公司经营模式、主要原材料采购及重要供应商、主要产品销售及重要客户情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

八、发行人选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》2.1.2 条之“（三）预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元。”

公司最近一次外部股权融资对应的投后估值为 253 亿元，公司预计市值不低于 50 亿元；此外，公司 2025 年度实现营业收入 25.82 亿元，最近一年营业收入不低于 3 亿元。综上，公司符合上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

(一) 募集资金用途

公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额计划投入如下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）	162.50	35.00
2	特色工艺技术平台研发项目	30.00	25.00
2.1	基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封装关键技术研发项目	7.70	7.30
2.2	基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目	6.50	6.20
2.3	基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目	15.80	11.50
3	补充流动资金	15.00	15.00
合计		207.50	75.00

(二) 未来发展规划

未来，公司将在巩固特色工艺优势的前提下，战略性地精准补充和优化产能，将重心转向深度强化特色工艺技术平台能力与构建跨越式差异化竞争优势，实现从“纯模拟代工”向“以模拟为核心，以数字升级为蝶变，以光电融合为特色”的复合型技术平台演进。12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）和特色工艺技术平台研发项目作为发行人本次募集资金投资项目，是这一转型的主要承载主体，其关键在于深化与设计企业和终端产业链协同，通过持续升级特色工艺水平、提供多样化和专业化的解决方案，最终构建起多层次、高价值的特色工艺技术平台，精准契合国家对于高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片自主可控与创新发展的迫切需求。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人及本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、与发行人相关的风险

(一) 技术风险

1、工艺技术平台迭代不达预期的风险

公司的工艺技术平台围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片,逐步实现了多品类布局,已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台,技术节点覆盖 180nm-55nm,可提供多种工艺技术平台和多样化制程节点的一站式解决方案,产品可广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等领域。

未来,公司将紧跟全球半导体行业发展及国家半导体产业政策趋势,在硅光及光电融合芯片、微控制器、存算一体芯片等多个领域加大研发投入,逐步拓宽深化公司技术平台和产品应用,实现 22nm 及以上制程全覆盖。

公司所处的晶圆代工行业技术门槛高,技术研发验证周期长,尤其在新制程节点开发过程中可能面临关键技术突破困难、研发进度不及预期等风险,如公司无法及时完成相关技术平台的研发以响应市场需求,将对公司的市场竞争力及市场份额造成不利影响。

2、核心技术泄密的风险

截至 2025 年 12 月 31 日,公司已取得专利权(含境外专利)712 项及大量技术积累。为避免核心技术泄露,保障经营过程中所积累的专利及技术的安全性,公司建立了较为完善的保密体系,例如与核心员工签署保密及竞业禁止相关协议、规范化研发流程管理以及申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等。但上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况,一旦核心技术失密并被行业内竞争企业掌握,可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

3、研发人员流失的风险

截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有 343 名研发人员,占公司员工总数比例为 17.65%。晶圆代工行业涉及数百道工艺流程、上百种半导体设备,主要工艺流程包括热处理、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等,对从业人员的知识结构、技术水平等综合素质提出较高的要求。如果公司未来不能持续向研发人员提供具有市场竞争力的薪酬及福利,或激励政策不能持续吸引研发人才,可能造成研发人员流失,且公司可能无法在短期内找到合适的替代人选,将会在一定程度上对公司的生产经营和稳定发展产生不利影响。

4、技术许可及 IP 授权商终止对公司授权的风险

截至 2025 年 12 月 31 日,发行人获得的技术许可包括 IMEC、Sharp 等厂商提供的 CMOS、LCD Driver 及 BCD 等相关技术许可,该等技术许可期限为永久,是公司早期工艺平台研发的初始技术起点,用于加速工艺开发进程,发行人在此基础上进行二次开发和持续的创新升级,已构建起具有自主知识产权的自有工艺技术平台;发行人获得的 IP 授权包括标准单元库、存储器编译器、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟 IP,该等 IP 授权期限为永久或较长,晶圆代工企业或芯片设计公司普遍通过引入成熟、可靠的 IP 授权,实现产品特定功能模块的快速集成,从而有效降低设计难度、缩短产品开发周期、提升流片成功率。

如未来因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级等不可抗力因素,导致发行人部分技术许可或 IP 授权被终止、无法续期,或续期成本大幅增加,公司可能需寻求替代供应商或者自研 IP,从而对公司技术平台及产品开发量产进度产生一定影响,进而影响到公司正常生产经营。

(二) 经营风险

1、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险

(1) 报告期内公司尚未实现盈利,最近一期期末存在累计未弥补亏损

由于晶圆制造行业的重资产属性、技术密集型特征、模拟芯片的产品特性及公司股份支付等因素的影响,公司报告期内归属于母公司股东的净利润分别为-191,711.34 万元、-225,326.91 万元和-234,582.32 万元。截至报告期末,公司未分配利润为-1,008,096.75 万元。公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

公司自设立以来,因应市场及客户需求、以及公司规划的技术平台演进的需要,公司持续扩充产能,目前已建设两座晶圆厂,相应晶圆厂的规划和建设需兼顾公司当前产品需求和未来技术延展布局,因此固定资产投入规模较大、资产折旧金额较高。同时,晶圆制造领域普遍存在产能爬坡周期较长,产能需逐步释放的现实状况,资产折旧对财务业绩产生重大影响。报告期内,公司机器设备的折旧费用分别为 151,877.14 万元、170,155.08 万元和 230,161.48 万元。

公司处于技术密集型行业,致力于打造多元化的技术平台,存在持续进行高强度研发的需求。自设立以来,公司保持大规模的研发投入,研发投入费用占营业收入比重较高。报告期内,公司发生的研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元。

模拟芯片存在品类多样化的特点,产品生命周期长,客户粘性高。公司持续进行大规模研发投入的同时,产品存在一定的验证周期,尚未形成突出的规模效应。公司实现盈亏平衡的时间相对较长。

为吸引和保留优秀技术和管理人才,公司实施了员工股权激励。报告期内,影响当期损益的股份支付费用分别为 6,717.10 万元、6,371.51 万元和 6,443.68 万元,占当期营业收入比例分别为 6.44%、3.79%和 2.50%,对当期净利润产生一定程度的影响。

随着公司客户持续开拓,经营管理不断优化,以及工艺技术平台取得重点突破,公司预计未来几年亏损规模将不断收窄,但公司资产折旧费用、研发费用还将持续处于较高水平,叠加股权激励产生的股份支付费用的影响,公司可能短期内还将面临持续亏损的风险。预计本次发行后,公司账面累计未弥补亏损将持续存在,导致一定时期内无法进行现金分红,可能对股东的投资收益会造成一定程度的影响。

(2) 公司未来在资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场拓展等方面可能受到限制或存在不利影响的风险

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,971.89 万元、63,964.58 万元和 62,122.54 万元;投资活动产生的现金流量净额分别为-185,409.73 万元、-470,774.05 万元和-170,759.23 万元;若未来公司累计未弥补亏

损无法得到有效控制、无法维持充足的现金流或出现其他经营状况恶化的情形，则可能对公司资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面造成一定程度的负面影响，从而对公司正常生产经营造成不利影响。

(3) 公司无法保证未来几年内实现盈利，上市后亦可能面临退市的风险

公司未来几年折旧费用、研发费用还将持续处于较高水平，同时公司实施的股权激励计划在未来几年亦将持续确认股份支付费用摊薄公司经营业绩，上市后未盈利状态可能持续存在。若公司上市后触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条的财务状况，即最近一个会计年度经审计的净利润（含被追溯重述及以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负且营业收入（含被追溯重述及扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于 1 亿元，或最近一个会计年度经审计的净资产（含被追溯重述）为负，则可能导致公司触发退市风险警示条件甚至触发退市条件。

2、市场开拓不及预期的风险

公司将研发作为核心驱动力，持续在新产品、新制程及特色工艺平台领域进行战略布局与深耕。未来，公司计划开展 40nm/28nm/22nm 的技术布局，完善高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术储备和工艺平台。新产品的陆续研发完成并通过认证及量产，将为公司业绩注入新的增长动力。若公司相关新产品的客户验证进度不及预期、或相关新产品通过客户验证后市场开拓不及预期，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、新增产能无法及时消化的风险

现阶段，公司为把握行业发展机遇，抢占市场份额，积极扩大产能。本次募集资金投资项目 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）、已启动建设的 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线项目（四期项目）完全达产后，公司产能将在现有基础上大幅提升，12 英寸晶圆代工产能将达 12 万片/月。产能的扩充将在一定程度上提升公司的经营规模和盈利能力，但也对公司市场开拓能力提出更高的要求。虽然公司已经结合市场前景、产业政策以及公司的技术、人员及市场储备等情况对本次募集资金投资项目及第三工厂（粤芯四期）项目的可行性进行了分析和论证，对新增产能的消化做了充分的准备工作，但如果项目

建成投产后,国家产业政策、市场环境发生了较大不利变化、市场需求增速低于预期,或者公司的市场开拓工作未达预期、公司产品工艺技术水平不能完全满足客户需求,公司将面临新增产能不能被及时消化的风险。

4、客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户的主营业务收入合计分别为 55,020.20 万元、98,460.77 万元和 157,389.56 万元,占主营业务收入的比例分别为 53.90%、60.34%和 62.68%,客户集中度较高。未来如果公司不能持续开拓新的客户,且现有客户受宏观经营环境、自身经营状况等因素影响而导致与公司的业务合作发生重大不利变化,或公司不能保持产品及技术优势而导致对现有客户的销售出现较大幅度下降,公司经营业绩将受到较大影响。

5、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括硅片、备品备件、气体、化学品等,报告期内,直接材料占主营业务成本比例分别为 9.39%、11.26%和 8.47%。受全球宏观经济、地缘政治及供需关系影响,半导体上游原材料价格可能存在波动。若未来国际贸易摩擦或供应中断导致主要原材料采购价格大幅上涨,而公司未能及时、有效地将成本上涨压力传导至下游客户,或议价能力受限,将可能导致公司毛利率下滑,盈利能力受到不利影响。此外,若原材料价格大幅下跌,公司可能需对库存原材料及在产品计提大额跌价准备,从而对公司经营成果和财务状况产生不利影响。

6、发行人与行业领先企业在技术水平、业务规模存在差距的风险

技术水平方面,公司专注于特色工艺 12 英寸晶圆代工业务,具备模拟芯片、功率器件及硅光芯片等产品的制造能力,制程节点覆盖 180nm-55nm,未来将进一步延伸至 40nm、22nm。但是台积电、联华电子、格罗方德、中芯国际等同行领先企业已达到 14nm、12nm 及 3nm 等制程节点,发行人与其仍存在较大差距。

业务规模方面,报告期内,公司主营业务收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元及 251,087.66 万元,年产能分别为 44.95 万片、47.80 万片及 61.48 万片。公司的业务规模与台积电、联华电子、格罗方德、中芯国际等同行领先企业仍存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步,丰富产品结构,拓展客户储备,

提高业务规模和市场占有率,将可能难以缩窄与行业领先企业的差距,进而在激烈的市场竞争中面临不利局面。

7、业绩未及预期的风险

报告期内,公司营业收入实现快速增长,但受固定资产投资较大、研发投入较高、行业周期波动等因素影响,尚未实现盈利。在晶圆代工行业市场空间广阔、下游应用需求旺盛的背景下,随着公司高附加值产品导入放量、产能逐步释放、新产品客户开拓稳步推进,公司预计未来产销规模将持续提升,长期盈利能力将得到有效改善,合并口径预计最早将于 2029 年实现扭亏为盈。

公司盈利预期及前瞻性信息是基于报告期内经营情况及假设基础上得出。考虑到行业周期性波动、市场竞争、客户及产品开拓进度等影响经营结果的因素较为复杂,公司有可能面临产品销量、销售单价、毛利率等指标不及预期、整体扭亏为盈时间延后的风险。

(三) 管理内控风险

1、无控股股东和实际控制人的风险

报告期内,公司股权结构较为分散。截至本招股说明书签署日,公司持股 5% 以上的股东包括誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金,持股比例分别为 16.88%、11.29%、9.51%、8.82%和 7.05%。无任一股东及其一致行动人可控制股东会或对股东会的决议产生决定性的影响;可控制董事会或对董事会的决议产生决定性的影响;可决定董事会半数以上成员任免;可实际支配或决定公司的重大经营决策、重要人事任命。因此,公司不存在控股股东和实际控制人。

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定建立了较为完善的法人治理结构,并严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定开展经营活动,但公司股权结构分散可能会降低股东会、董事会对于重大事项决策的效率,进而导致公司治理效率降低,造成生产经营风险的情形;此外,公司控制权可能于未来发生变动,从而给公司经营与发展带来潜在的风险。

(四) 财务风险

1、经营业绩下滑，未来收入规模不及预期的风险

报告期内，公司营业收入分别为 104,371.92 万元、168,132.90 万元和 258,236.87 万元。公司营业收入的增长受模拟芯片国产替代市场空间、公司**产能爬坡情况**、产品工艺水平、产业政策支持力度、行业发展周期、新老客户续约情况等因素影响。如未来国产模拟芯片市场需求下降、公司因持续亏损导致研发资金不足、**产能建设**和产品研发不达预期、未来国家产业政策出现重大不利变化、行业发展周期**波动**、新老客户续约率无法维持较高水平，则公司可能存在经营业绩下滑，未来收入规模不及预期的风险。

2、存货跌价的风险

报告期内，公司各期末存货账面价值分别为 47,233.37 万元、36,621.70 万元和 53,882.68 万元，占各期末流动资产的比例分别为 12.86%、11.77%和 6.29%。报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 23,500.07 万元、20,460.59 万元和 30,483.71 万元，对应期末余额的计提比例是 33.22%、35.84%和 36.13%。公司各期存货跌价准备金额较高的原因系公司尚处产能爬坡阶段，单个产品承担较大的折旧、摊销，未能良好地释放经济效益，导致单个产品生产成本高于可变现净值。如果未来公司产能爬坡未达预期，可能持续存在存货跌价风险。

3、固定资产投资风险

晶圆代工行业属于资本密集型行业，设备投资成本较高。公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。

公司目前拥有两座 12 英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为 8 万片/月。报告期内，公司各期末固定资产的账面价值分别为 708,891.57 万元、841,784.01 万元和 1,239,559.85 万元，占公司总资产的比例为 37.24%、42.94%和 50.66%；公司各期末在建工程的账面价值分别为 290,469.43 万元、546,020.79 万元和 158,647.41 万元，占公司总资产的比例为 15.26%、27.85%和 6.48%。目前，公司已启动建设一条规划产能为 4 万片/月的 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期）。

大规模的固定资产建设对公司后续资金投入提出较高要求，使公司的资金筹

措能力面临较大考验；此外，晶圆制造产线从建设完成、试生产、产品认证到最后的批量生产，需要经历较长的时间，如公司未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司还将面临盈利能力下降的风险。

4、政府补助政策变化的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 53,690.93 万元、25,332.66 万元和 41,270.23 万元，均属于非经常性损益。如果未来政府部门对半导体产业的鼓励政策发生变化，导致公司取得的政府补助金额减少，可能将对公司的经营业绩产生不利影响。

5、汇率波动的风险

公司的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元、欧元、日元等外币计价。报告期内，公司汇兑损益分别为 47.26 万元、3,782.73 万元和 689.33 万元。公司已通过合理使用外汇衍生品，降低汇率风险可能带来的不利影响，但未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，导致外币汇率出现大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

6、偿债及流动性风险

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.14、1.14 和 1.80，速动比率分别为 0.99、1.01 和 1.69，公司资产负债率分别为 62.62%、67.79%和 84.13%，资产负债率相对较高。

公司处于生产经营快速扩张阶段，设备、工程支出金额较大，受限于融资渠道，公司主要通过借款筹集资金。若未来受国家宏观经济政策、国际贸易摩擦等因素影响，或因原材料价格上涨、下游市场需求波动等因素影响，导致公司盈利水平不及预期，亦或其他原因导致公司未能获得足够资金，不能有效进行资金管理、拓宽融资渠道，公司的短期支付能力将承压，存在一定的偿债及流动性风险。

(五) 法律风险

1、安全生产的风险

公司生产过程中涉及热处理、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等工艺，生产涉及操作难度高的大型设备、部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料，存在一

定危险性,对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。公司高度重视安全生产,制定了完备的安全生产管理规范,建立了完善的安全生产管理体系,自设立以来在产品生产过程中未发生重大安全事故。但如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用失误或其他意外事故等,公司将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险。

2、环境保护的风险

公司生产过程中以硅片、光刻胶、含羟胺溶液、盐酸、硫酸、过氧化氢等作为主要原材料,生产过程中会产生少量废气、废水和固废等污染物。如果公司未来的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求,将可能导致公司受到罚款、停限产等监管措施,从而对公司的生产经营造成不利影响。此外,国家及地方政府可能在将来颁布更严格的环境保护法律法规,提高环保标准,公司可能需要进一步增加环保投入以满足监管部门对环保的要求,从而导致经营成本增加。

二、与行业相关的风险

(一) 宏观经济波动、行业周期性的风险

半导体行业受全球宏观经济波动、下游应用市场需求变化、产能和库存周期等因素影响,呈现较强周期性特征。主导半导体周期的核心因素系供需关系的变化,具体表现为在行业上升周期时,下游订单饱满,公司产能利用率趋于饱和,经营业绩增长;在行业下降周期时,下游订单需求下降,公司产能利用率不足,经营业绩下滑。

2022 年以后受全球宏观经济下行、地缘政治冲突及消费电子疲弱等因素影响,半导体行业进入了去库存的下行周期;但 2024 年以来,全球半导体市场呈现强劲复苏态势,消费电子综合景气指标持续上升,行业逐渐回暖。

根据 Yole 预测,受益于终端市场复苏和 AI 的需求增长,全球晶圆代工行业于 2024-2029 年预计进入新一轮增长周期,2024-2029 年全球晶圆代工行业营收年均复合增长率预计将达 12.05%。

如果未来全球经济发生较大波动,半导体晶圆制造行业的产业政策发生重大不利变化,或半导体行业重新进入下行周期导致晶圆代工的需求下降,则可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(二) 市场竞争加剧的风险

晶圆代工技术迭代快，市场竞争激烈。由于模拟芯片种类众多，头部厂商也较难取得垄断优势，整体竞争格局较为分散，排名第一的模拟芯片企业德州仪器2023年全球市占率为19%。目前全球前十模拟芯片企业分别在电源管理、运算放大器、数据转换器、功率半导体、MEMS传感器、射频芯片等领域各有侧重，下游应用市场覆盖工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备等。因头部厂商难以实现垄断，有利于国内厂商通过自身研发、并购等从细分赛道切入，并通过产品线扩张逐步实现国产替代。

海外厂商凭借强大的资金及技术实力，在国内下游市场占据了较大的市场份额；同时，国内半导体公司纷纷加快技术研发及新产品推广，技术水平逐渐成熟，市场竞争日益加剧。如果公司无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

(三) 国际贸易摩擦的风险

公司使用的部分设备及零部件、原材料通过向境外供应商采购取得。公司目前暂未受到境外国家出口管制的影响。未来，如因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级或相关国家政策由先进制程向更广泛范围延伸导致的制裁风险等不可抗力因素造成公司的部分设备及零部件、原材料成本增加或者停止供应，则可能导致公司无法进行正常生产，进而将对公司的业务和经营产生不利影响。

同时，报告期内，公司部分产品外销至境外国家或地区，外销收入占主营业务收入的比例分别为4.71%、9.19%和8.58%。未来，倘若因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级等不可抗力因素造成公司产品境外销售成本增加或不能出售至相关国家或地区，可能存在公司外销收入下降的风险。

三、其他风险

(一) 与募集资金运用相关的风险

1、募投项目无法顺利实施的风险

公司本次拟募集资金 75.00 亿元，其中 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）拟使用募集资金 35.00 亿元，特色工艺技术平台研发项目拟使用募集资金 25.00 亿元，合计占拟募集资金总额的比例为 80.00%；补充流动资金约 15.00 亿元，占拟募集资金总额的比例为 20.00%。

公司已经对 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）和特色工艺技术平台研发项目进行了充分的分析和论证，但该可行性分析是基于当前市场环境、公司现有业务状况和未来发展战略等因素作出的，若前述因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的投资进度、建设过程和投资收益等将存在一定的不确定性。如果本次募集资金投资项目无法顺利实施，将对公司生产经营产生不利影响。

2、募投项目短期影响经营业绩或未来无法达到预期收益的风险

公司本次募投项目中的 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）已完成项目备案、环评等相关手续。如公司工业级和车规级工艺技术平台开发遇到技术瓶颈、集成电路市场环境发生重大不利变化，或公司 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）产生的收入及利润水平未能实现既定目标，其新增的折旧和摊销或将对发行人经营业绩产生一定的影响，延后公司实现盈利的时间；如公司特色工艺技术平台研发项目研发失败或研发成果不达预期，则可能导致公司募投项目不能如期实施的风险。

(二) 本次发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响。若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量未能满足相关法律法规的要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，或者存在其他影响发行的不利情形，可能会导致公司面临发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	粤芯半导体技术股份有限公司
英文名称	CanSemi Technology Inc.
注册资本	236,559.1397 万元
法定代表人	陈谨
有限公司成立日期	2017 年 12 月 12 日
股份公司成立日期	2023 年 3 月 2 日
公司住所	广州市黄埔区凤凰五路 28 号
邮政编码	510555
电话号码	020-61878866
传真号码	020-89856327
互联网网址	www.cansemittech.com
电子信箱	info@cansemittech.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	吴漾
信息披露负责人电话	020-62322134

二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况

发行人的前身为粤芯有限，设立时名称为广州粤芯半导体技术有限公司。2023 年 3 月 2 日，广州粤芯半导体技术有限公司整体改制变更为粤芯半导体技术股份有限公司。

(一) 有限公司设立情况

粤芯有限设立于 2017 年 12 月 12 日，由誉芯众诚、科学城集团共同出资设立，设立时注册资本为 100,000.00 万元。

2017 年 12 月 12 日，股东誉芯众诚及科学城集团签署了《广州粤芯半导体技术有限公司章程》。

2017 年 12 月 12 日，广州开发区市场和质量技术监督局向粤芯有限核发了统一社会信用代码为 91440101MA5AMY9D1D 的《营业执照》。

粤芯有限设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	誉芯众诚	80,000.00	80.00%
2	科学城集团(SS)	20,000.00	20.00%
合计		100,000.00	100.00%

(二) 股份公司设立情况

粤芯股份系由粤芯有限整体变更设立的股份有限公司。

2023年2月10日,粤芯有限通过股东会决议,同意粤芯有限整体变更为股份有限公司。

2023年2月10日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(致同审字(2023)第440B000160号),确认截至2022年11月30日,粤芯有限经审计净资产为883,728.25万元。

2023年2月10日,深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具《资产评估报告》(深中企华评报字(2023)第003号),确认截至2022年11月30日,粤芯有限经评估净资产为994,426.38万元。

2023年2月26日,粤芯有限全体发起人股东签署了《粤芯半导体技术股份有限公司发起人协议》,决定共同发起设立粤芯半导体技术股份有限公司。

2023年2月26日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立股份公司的相关议案,同意以截至2022年11月30日经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2023)第440B000160号)审计的账面净资产883,728.25万元折股,其中236,559.14万元折为236,559.14万股,每股面值1.00元,整体变更后股份公司的股本与整体变更前的注册资本保持一致,资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2023年3月2日,广州市黄埔区市场监督管理局对本次工商变更登记予以核准,并向公司换发了《营业执照》。

发行人整体变更完成后的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	誉芯众诚	39,933.33	16.88%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
2	广东半导体基金	26,718.09	11.29%
3	科学城集团(SS)	23,225.81	9.82%
4	广州华盈	22,500.00	9.51%
5	国投创业基金	16,666.67	7.05%
6	农银金融(SS)	9,675.08	4.09%
7	广州科创产投	9,350.16	3.95%
8	苏州璞然	8,333.33	3.52%
9	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.30%
10	广州吉富新芯	5,000.00	2.11%
11	广州越秀创达八号	4,838.71	2.05%
12	联芯叁号	4,401.75	1.86%
13	CHEN, WEI TONY (陈卫)	4,000.00	1.69%
14	嘉兴隼满	3,763.44	1.59%
15	陈谨	3,500.00	1.48%
16	广东广祺辰途	3,333.33	1.41%
17	深圳惠友	3,333.33	1.41%
18	广州合信芯赢	3,333.33	1.41%
19	合肥华芯康远	3,225.81	1.36%
20	广州晶芯	3,118.28	1.32%
21	建信金融(SS)	2,805.05	1.19%
22	联芯贰号	2,155.20	0.91%
23	深圳山海叁号	2,150.54	0.91%
24	苏州晶璞	2,150.54	0.91%
25	广州广祺欣芯	2,096.77	0.89%
26	合肥华登二期	1,666.67	0.70%
27	苏州储芯	1,666.67	0.70%
28	联芯肆号	1,486.40	0.63%
29	联芯陆号	1,453.26	0.61%
30	盈科值得一号	1,451.61	0.61%
31	广州盛誉	1,344.09	0.57%
32	盈科吉运创投	1,290.32	0.55%
33	广州华芯盛景	1,075.27	0.45%
34	广发乾和	1,075.27	0.45%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
35	共青城吉富	1,075.27	0.45%
36	青岛新鼎	1,075.27	0.45%
37	深圳安鹏	1,075.27	0.45%
38	中山广发信德	833.33	0.35%
39	广州产投壹号	833.33	0.35%
40	淄博盈峰	752.69	0.32%
41	广东珩芯	645.16	0.27%
42	联芯伍号	570.06	0.24%
43	广发信德二期	537.63	0.23%
44	广州吉富智芯	537.63	0.23%
45	厦门惠友	537.63	0.23%
46	广州合信芯达	537.63	0.23%
合计		236,559.14	100.00%

(三) 报告期内的股本和股东变化情况

1、发行人报告期初的股权结构

报告期初，粤芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	誉芯众诚	50,000.00	30.00%
2	广州华盈	30,000.00	18.00%
3	科学城集团(SS)	20,000.00	12.00%
4	广东半导体基金	16,666.67	10.00%
5	国投创业基金	16,666.67	10.00%
6	苏州璞然	8,333.33	5.00%
7	农银金融(SS)	5,000.00	3.00%
8	广州吉富新芯	5,000.00	3.00%
9	广东广祺辰途	3,333.33	2.00%
10	深圳惠友	3,333.33	2.00%
11	广州合信芯赢	3,333.33	2.00%
12	合肥华登二期	1,666.67	1.00%
13	苏州储芯	1,666.67	1.00%
14	中山广发信德	833.33	0.50%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
15	广州产投壹号	833.33	0.50%
合计		166,666.67	100.00%

2、发行人报告期内的股本和股东变化

(1) 2022 年 1 月，报告期内有限公司第一次股权转让

2021 年 8 月 6 日，粤芯有限召开股东会并作出决议，同意公司实施首轮员工股权激励计划。

2021 年 12 月 30 日，粤芯有限召开股东会并作出决议，同意公司股东誉芯众诚和广州华盈向陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）以及持股平台联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号转让共计 10.54%股权用于员工股权激励。公司其他股东放弃优先购买权。

2021 年 12 月 31 日，上述各方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

本次股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让股权比例	转让价格(元)
广州华盈	陈谨	3,500.00	2.10%	1.00
	CHEN, WEI TONY（陈卫）	4,000.00	2.40%	1.00
誉芯众诚	联芯贰号	2,155.20	1.29%	1.00
	联芯叁号	4,401.75	2.64%	1.00
	联芯肆号	1,486.40	0.89%	1.00
	联芯伍号	570.06	0.34%	1.00
	联芯陆号	1,453.26	0.87%	1.00
合计		17,566.67	10.54%	-

2022 年 1 月 25 日，广州市黄埔区市场监督管理局核准了本次变更事项。

本次变更完成后，粤芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	誉芯众诚	39,933.33	23.96%
2	广州华盈	22,500.00	13.50%
3	科学城集团(SS)	20,000.00	12.00%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
4	广东半导体基金	16,666.67	10.00%
5	国投创业基金	16,666.67	10.00%
6	苏州璞然	8,333.33	5.00%
7	农银金融(SS)	5,000.00	3.00%
8	广州吉富新芯	5,000.00	3.00%
9	联芯叁号	4,401.75	2.64%
10	CHEN, WEI TONY(陈卫)	4,000.00	2.40%
11	陈谨	3,500.00	2.10%
12	广东广祺辰途	3,333.33	2.00%
13	深圳惠友	3,333.33	2.00%
14	广州合信芯赢	3,333.33	2.00%
15	联芯贰号	2,155.20	1.29%
16	合肥华登二期	1,666.67	1.00%
17	苏州储芯	1,666.67	1.00%
18	联芯肆号	1,486.40	0.89%
19	联芯陆号	1,453.26	0.87%
20	中山广发信德	833.33	0.50%
21	广州产投壹号	833.33	0.50%
22	联芯伍号	570.06	0.34%
合计		166,666.67	100.00%

(2) 2022年6月,报告期内有限公司第一次增资

2022年5月27日,粤芯有限召开股东会并作出决议,同意公司融资450,000.00万元,公司增加注册资本至215,053.76万元,新增注册资本48,387.10万元由广东广祺智行肆号、广东半导体基金、广州越秀创达八号、嘉兴隼满、科学城集团、合肥华芯康远、广州晶芯、深圳山海叁号、苏州晶璞、广州广祺欣芯、盈科值得一号、广州盛誉、盈科吉运创投、广州华芯盛景、广发乾和、共青城吉富、青岛新鼎、深圳安鹏、淄博盈峰、广东珩芯、广发信德二期、广州吉富智芯、厦门惠友和广州合信芯达认缴,并相应修改《公司章程》。

2022年6月28日,广州市黄埔区市场监督管理局核准了本次变更事项。

2022年6月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具《验

资报告》（致同验字（2022）第 440C000379 号），经其审验，截至 2022 年 6 月 30 日，粤芯有限已收到参与本次增资的股东缴纳的新增出资额 450,000.00 万元，其中新增注册资本合计人民币 48,387.10 万元，资本公积 401,612.90 万元，各股东出资方式为货币出资。

本次变更完成后，粤芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	誉芯众诚	39,933.33	18.57%
2	科学城集团（SS）	23,225.81	10.80%
3	广州华盈	22,500.00	10.46%
4	广东半导体基金	22,043.01	10.25%
5	国投创业基金	16,666.67	7.75%
6	苏州璞然	8,333.33	3.88%
7	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.52%
8	农银金融（SS）	5,000.00	2.32%
9	广州吉富新芯	5,000.00	2.32%
10	广州越秀创达八号	4,838.71	2.25%
11	联芯叁号	4,401.75	2.05%
12	CHEN, WEI TONY （陈卫）	4,000.00	1.86%
13	嘉兴隼满	3,763.44	1.75%
14	陈谨	3,500.00	1.63%
15	广东广祺辰途	3,333.33	1.55%
16	深圳惠友	3,333.33	1.55%
17	广州合信芯赢	3,333.33	1.55%
18	合肥华芯康远	3,225.81	1.50%
19	广州晶芯	3,118.28	1.45%
20	联芯贰号	2,155.20	1.00%
21	深圳山海叁号	2,150.54	1.00%
22	苏州晶璞	2,150.54	1.00%
23	广州广祺欣芯	2,096.77	0.98%
24	合肥华登二期	1,666.67	0.78%
25	苏州储芯	1,666.67	0.78%
26	联芯肆号	1,486.40	0.69%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
27	联芯陆号	1,453.26	0.68%
28	盈科值得一号	1,451.61	0.68%
29	广州盛誉	1,344.09	0.62%
30	盈科吉运创投	1,290.32	0.60%
31	广州华芯盛景	1,075.27	0.50%
32	广发乾和	1,075.27	0.50%
33	共青城吉富	1,075.27	0.50%
34	青岛新鼎	1,075.27	0.50%
35	深圳安鹏	1,075.27	0.50%
36	中山广发信德	833.33	0.39%
37	广州产投壹号	833.33	0.39%
38	淄博盈峰	752.69	0.35%
39	广东珩芯	645.16	0.30%
40	联芯伍号	570.06	0.27%
41	广发信德二期	537.63	0.25%
42	广州吉富智芯	537.63	0.25%
43	厦门惠友	537.63	0.25%
44	广州合信芯达	537.63	0.25%
合计		215,053.76	100.00%

(3) 2022 年 11 月，报告期内有限公司第二次增资

2022 年 11 月 23 日，粤芯有限召开股东会并作出决议，同意公司融资 230,000.00 万元，公司增加注册资本至 236,559.14 万元，新增注册资本 21,505.38 万元由广州科创产投、广东半导体基金、农银金融、建信金融认缴，并相应修改《公司章程》。

2022 年 11 月 29 日，广州市黄埔区市场监督管理局核准了本次变更事项。

2022 年 12 月 9 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000770 号），经其审验，截至 2022 年 11 月 30 日，粤芯有限已收到当期全体股东以货币出资缴纳的出资额 230,000.00 万元，其中实收资本人民币 21,505.38 万元，资本公积人民币 208,494.62 万元。

本次变更完成后，粤芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	誉芯众诚	39,933.33	16.88%
2	广东半导体基金	26,718.09	11.29%
3	科学城集团(SS)	23,225.81	9.82%
4	广州华盈	22,500.00	9.51%
5	国投创业基金	16,666.67	7.05%
6	农银金融(SS)	9,675.08	4.09%
7	广州科创产投	9,350.16	3.95%
8	苏州璞然	8,333.33	3.52%
9	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.30%
10	广州吉富新芯	5,000.00	2.11%
11	广州越秀创达八号	4,838.71	2.05%
12	联芯叁号	4,401.75	1.86%
13	CHEN, WEI TONY(陈卫)	4,000.00	1.69%
14	嘉兴隼满	3,763.44	1.59%
15	陈谨	3,500.00	1.48%
16	广东广祺辰途	3,333.33	1.41%
17	深圳惠友	3,333.33	1.41%
18	广州合信芯赢	3,333.33	1.41%
19	合肥华芯康远	3,225.81	1.36%
20	广州晶芯	3,118.28	1.32%
21	建信金融(SS)	2,805.05	1.19%
22	联芯贰号	2,155.20	0.91%
23	深圳山海叁号	2,150.54	0.91%
24	苏州晶璞	2,150.54	0.91%
25	广州广祺欣芯	2,096.77	0.89%
26	合肥华登二期	1,666.67	0.70%
27	苏州储芯	1,666.67	0.70%
28	联芯肆号	1,486.40	0.63%
29	联芯陆号	1,453.26	0.61%
30	盈科值得一号	1,451.61	0.61%
31	广州盛誉	1,344.09	0.57%
32	盈科吉运创投	1,290.32	0.55%
33	广州华芯盛景	1,075.27	0.45%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
34	广发乾和	1,075.27	0.45%
35	共青城吉富	1,075.27	0.45%
36	青岛新鼎	1,075.27	0.45%
37	深圳安鹏	1,075.27	0.45%
38	中山广发信德	833.33	0.35%
39	广州产投壹号	833.33	0.35%
40	淄博盈峰	752.69	0.32%
41	广东珩芯	645.16	0.27%
42	联芯伍号	570.06	0.24%
43	广发信德二期	537.63	0.23%
44	广州吉富智芯	537.63	0.23%
45	厦门惠友	537.63	0.23%
46	广州合信芯达	537.63	0.23%
合计		236,559.14	100.00%

（4）2023 年 3 月，股份公司设立

公司整体变更具体情况请参见本节之“二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况”之“（二）股份公司设立情况”。

（5）2024 年 8 月，报告期内股份公司第一次股权转让

2024 年 7 月 5 日，广州开发区国有资产监督管理局作出批复，同意科学城集团将其持有的粤芯半导体 1%股权无偿划转给知识城集团。

2024 年 8 月 23 日，股份公司召开股东会并作出决议，同意股东科学城集团将其持有的 1%股权无偿划转给知识城集团，并相应修改《公司章程》。

本次变更完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	誉芯众诚	39,933.33	16.88%
2	广东半导体基金	26,718.09	11.29%
3	广州华盈	22,500.00	9.51%
4	科学城集团（SS）	20,860.22	8.82%
5	国投创业基金	16,666.67	7.05%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
6	农银金融(SS)	9,675.08	4.09%
7	广州科创产投	9,350.16	3.95%
8	苏州璞然	8,333.33	3.52%
9	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.30%
10	广州吉富新芯	5,000.00	2.11%
11	广州越秀创达八号	4,838.71	2.05%
12	联芯叁号	4,401.75	1.86%
13	CHEN, WEI TONY(陈卫)	4,000.00	1.69%
14	嘉兴隼满	3,763.44	1.59%
15	陈谨	3,500.00	1.48%
16	广东广祺辰途	3,333.33	1.41%
17	深圳惠友	3,333.33	1.41%
18	广州合信芯赢	3,333.33	1.41%
19	合肥华芯康远	3,225.81	1.36%
20	广州晶芯	3,118.28	1.32%
21	建信金融(SS)	2,805.05	1.19%
22	知识城集团(SS)	2,365.59	1.00%
23	联芯贰号	2,155.20	0.91%
24	深圳山海叁号	2,150.54	0.91%
25	苏州晶璞	2,150.54	0.91%
26	广州广祺欣芯	2,096.77	0.89%
27	合肥华登二期	1,666.67	0.70%
28	苏州储芯	1,666.67	0.70%
29	联芯肆号	1,486.40	0.63%
30	联芯陆号	1,453.26	0.61%
31	盈科值得一号	1,451.61	0.61%
32	广州盛誉	1,344.09	0.57%
33	盈科吉运创投	1,290.32	0.55%
34	广州华芯盛景	1,075.27	0.45%
35	广发乾和	1,075.27	0.45%
36	共青城吉富	1,075.27	0.45%
37	青岛新鼎	1,075.27	0.45%
38	深圳安鹏	1,075.27	0.45%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
39	中山广发信德	833.33	0.35%
40	广州产投壹号	833.33	0.35%
41	淄博盈峰	752.69	0.32%
42	广东珩芯	645.16	0.27%
43	联芯伍号	570.06	0.24%
44	广发信德二期	537.63	0.23%
45	广州吉富智芯	537.63	0.23%
46	厦门惠友	537.63	0.23%
47	广州合信芯达	537.63	0.23%
合计		236,559.14	100.00%

三、发行人报告期内的重大资产重组情况

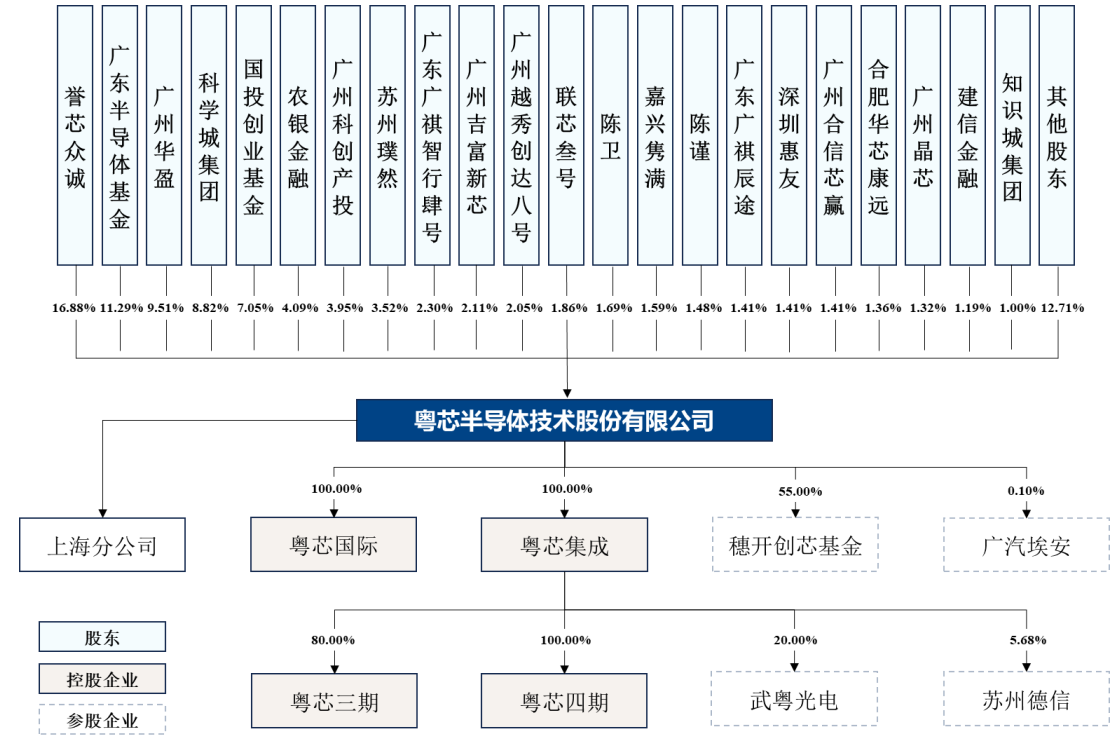
报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。

五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：



六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 4 家控股子公司、1 家分公司，3 家参股公司，并作为有限合伙人参与投资了 1 家合伙企业。各公司基本情况如下：

（一）发行人控股子公司

1、粤芯集成

公司名称	广州粤芯集成电路有限公司
统一社会信用代码	91440112MABWQ0AP6W
成立时间	2022 年 9 月 5 日
注册资本	100,000 万元
实收资本	100,000 万元
注册地址	广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 栋 11 号
主要生产经营地	广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 栋 11 号
主营业务及在发行人业务板块中定位	报告期内未实际开展经营
股东构成及控制情况	粤芯半导体持股 100%

粤芯集成最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	1,443,866.25
净资产	85,165.47
营业收入	118,813.05
净利润	-77,231.99

注：上述财务数据已经致同会计师审计。

2、粤芯三期

公司名称	广州粤芯三期集成电路制造有限公司
统一社会信用代码	91440112MABY65CHX7
成立时间	2022 年 9 月 6 日
注册资本	750,000 万元
实收资本	750,000 万元
注册地址	广州市黄埔区凤凰五路 26 号
主要生产经营地	广州市黄埔区凤凰五路 26 号

主营业务及在发行人业务板块中定位	集成电路晶圆代工、销售		
股东构成	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
	粤芯集成	600,000.00	80.00
	中鑫产投	50,000.00	6.67
	产投中鑫	50,000.00	6.67
	工融金投	50,000.00	6.67
	合计	750,000.00	100.00

粤芯三期最近一年的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	1,383,002.89
净资产	616,318.78
营业收入	118,813.05
净利润	-63,066.10

注: 上述财务数据已经致同会计师审计。

3、粤芯四期

公司名称	广州粤芯四期集成电路制造有限公司
统一社会信用代码	91440112MAG064X85E
成立时间	2025 年 10 月 10 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	-
注册地址	广州市黄埔区凤凰五路 26 号自编 1 栋 2 号
主要生产经营地	广州市黄埔区凤凰五路 26 号自编 1 栋 2 号
主营业务及在发行人业务板块中定位	集成电路晶圆代工、销售
股东构成及控制情况	粤芯集成持股 100%

粤芯四期最近一年的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	54,999.98
净资产	4,998.73
营业收入	-
净利润	-1.27

注：上述财务数据已经致同会计师审计。

4、粤芯国际

公司名称	粤芯半导体国际有限公司
成立时间	2018 年 7 月 24 日
注册资本	100 万港币
实收资本	100 万港币
注册地址	Flat C, 20/F, COS centre, 56 Tsun Yip street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主要生产经营地	Flat C, 20/F, COS centre, 56 Tsun Yip street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主营业务及在发行人业务板块中定位	报告期内未实际开展经营
股东构成及控制情况	粤芯半导体持股 100%

粤芯国际最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	794.45
净资产	-429.61
营业收入	-
净利润	-288.41

注：上述财务数据已经致同会计师审计。

(二) 发行人参股企业

序号	公司名称	注册资本	持股比例	首次入股时间	主营业务
1	穗开创芯基金	5,000 万元	发行人作为 LP 持有 55%的合伙份额	2019 年 7 月 08 日	股权投资
2	武粤光电	10,000 万元	发行人持股 20%	2024 年 5 月 28 日	集成电路设计服务、销售
3	苏州德信	52,800 万元	发行人持股 5.68%	2024 年 6 月 14 日	半导体器件的研发、生产
4	广汽埃安	780,338.84 万元	发行人持股 0.10%	2022 年 10 月 18 日	新能源汽车的研发、制造、销售

(三) 发行人分公司

1、粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司

公司名称	粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310115MACKDPRT5A

成立时间	2023 年 5 月 26 日
营业场所	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 570 号 1 幢 1003A、1003B 室
经营范围	集成电路销售

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及控股股东、实际控制人基本情况

(一) 控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日,公司第一大股东誉芯众诚持股比例为 16.88%,第二大股东广东半导体基金持股比例为 11.29%,任一股东均无法控制股东会的决议或对股东会决议产生决定性影响。公司董事会由 11 名董事组成,其中 10 名董事由公司董事会提名,1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生,任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此,公司无控股股东和实际控制人。

(二) 控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形的情况

截至本招股说明书签署日,公司无控股股东、实际控制人。

(三) 持有发行人 5%以上股份的主要股东

1、单独持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日,单独持有公司 5%以上股份的股东包括誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金,其中誉芯众诚持有发行人 16.88%的股份,广东半导体基金持有发行人 11.29%的股份,广州华盈持有发行人 9.51%的股份,科学城集团持有发行人 8.82%的股份,国投创业基金持有发行人 7.05%的股份,基本情况如下:

(1) 誉芯众诚

誉芯众诚成立于 2017 年 12 月 4 日,持有发行人 16.88%的股份,其基本情况如下表所示:

企业名称	广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440101MA5AMBMT2Q
企业类型	有限合伙企业

成立日期	2017 年 12 月 4 日
执行事务合伙人	万联天泽资本投资有限公司
出资总额(万元)	52,000.00
注册地/主要生产经营地	广州市中新广州知识城九佛建设路 333 号 681 房
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	GC2600011704
私募基金备案	SCL033

誉芯众诚的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	万联天泽资本投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.19%
2	广州市金誉实业投资集团有限公司	有限合伙人	26,300.00	50.58%
3	广州智光电气股份有限公司	有限合伙人	15,600.00	30.00%
4	科学城(广州)投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	19.23%
合计			52,000.00	100.00%

誉芯众诚最近一年的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	438,939.85
净资产	438,912.45
营业收入	30,312.38
净利润	30,264.06

注: 上述财务数据已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(2) 广东半导体基金

广东半导体基金成立于 2020 年 12 月 3 日, 持有发行人 11.29% 的股份, 其基本情况如下表所示:

企业名称	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440101MA9W1EM57L
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020 年 12 月 3 日
执行事务合伙人	广东粤财基金管理有限公司

出资总额(万元)	1,000,100.00
注册地/主要生产经营地	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之405
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	P1032281
私募基金备案	SNL096

广东半导体基金的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	广东粤财基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.01%
2	广东粤财投资控股有限公司	有限合伙人	1,000,000.00	99.99%
合计			1,000,100.00	100.00%

广东半导体基金最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度
总资产	1,045,259.63
净资产	1,045,245.08
营业收入	-
净利润	59,205.25

注:上述财务数据未经审计。

(3) 广州华盈

广州华盈成立于2018年9月18日,持有发行人9.51%的股份,其基本情况如下表所示:

公司名称	广州华盈企业管理有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CC9WR1D
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2018年9月18日
注册资本(万元)	30,500.00
实收资本(万元)	30,500.00
注册地/主要生产经营地	广州市黄埔区茅岗路848号8楼B200房
法定代表人	郑驰
主营业务	股权投资

上述主营业务与发行人 主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系

广州华盈的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州宏芯企业管理有限公司	30,200.00	99.02%
2	广州润丰企业管理有限公司	300.00	0.98%
合计		30,500.00	100.00%

广州华盈最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	22,777.43
净资产	22,777.43
营业收入	-
净利润	-0.14

注：上述财务数据未经审计。

（4）科学城集团

科学城集团成立于 1984 年 8 月 21 日，持有发行人 8.82%的股份，其基本情况如下表所示：

公司名称	科学城（广州）投资集团有限公司
统一社会信用代码	914401011906700395
公司类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1984 年 8 月 21 日
注册资本（万元）	606,054.44
实收资本（万元）	523,090.04
注册地/主要生产经营地	广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
法定代表人	向奔
主营业务	城市建设开发与城市更新综合服务
上述主营业务与发行人主 营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系

科学城集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州经济技术开发区管理委员会	578,651.84	95.48%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
2	广东省财政厅	27,402.60	4.52%
合计		606,054.44	100.00%

科学城集团最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	17,431,202
净资产	3,143,678
营业收入	1,833,701
净利润	-693,947

注：上述财务数据未经审计。

（5）国投创业基金

国投创业基金成立于 2020 年 12 月 16 日，持有发行人 7.05%的股份，其基本情况如下表所示：

企业名称	国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA9W26UP51
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020 年 12 月 16 日
执行事务合伙人	国投（广东）创业投资管理有限公司
出资总额（万元）	1,500,000.00
注册地/主要生产经营地	广州市黄埔区神舟路 18 号 3 栋（自编号 C-1）501 房
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	P1071534
私募基金备案	SQH950

国投创业基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	国投（广东）创业投资管理有限公司	普通合伙人	7,500.00	0.50%
2	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	310,000.00	20.67%
3	科学技术部新质生产力促进中心	有限合伙人	300,000.00	20.00%
4	中国人寿保险股份有限公司	有限合伙人	160,000.00	10.67%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
5	上海旷兴企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	150,000.00	10.00%
6	广州凯得投资控股有限公司	有限合伙人	100,000.00	6.67%
7	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	有限合伙人	100,000.00	6.67%
8	广东省粤科金融集团有限公司	有限合伙人	100,000.00	6.67%
9	广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	4.00%
10	中投保信裕资产管理（北京）有限公司	有限合伙人	50,000.00	3.33%
11	长江创业投资基金有限公司	有限合伙人	50,000.00	3.33%
12	广东省粤科创业投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	3.33%
13	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	23,000.00	1.53%
14	佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	1.33%
15	广州金融控股集团有限公司	有限合伙人	17,000.00	1.13%
16	舟山瀚业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	0.17%
合计			1,500,000.00	100.00%

国投创业基金最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	1,882,078.52
净资产	1,885,364.68
营业收入	125,390.46
净利润	104,963.60

注：上述财务数据未经审计。

2、合并计算后持有发行人 5%以上股份的股东

苏州璞然的执行事务合伙人为嘉善存芯；嘉善存芯、苏州晶璞、苏州储芯的执行事务合伙人均为苏州兰璞创投。

苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯分别持有公司 3.52%、0.91%、0.70%的股份，合并计算后持有公司 5.14%的股份。

(1) 苏州璞然

企业名称	苏州璞然创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91340100MA2WJA617H
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020 年 12 月 21 日
执行事务合伙人	嘉善存芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
出资总额（万元）	52,000.00
注册地/主要生产经营地	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 9 幢 301 室
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	P1067353
私募基金备案	SNS273

苏州璞然的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例
1	嘉善存芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.19%
2	宁波上融物流有限公司	有限合伙人	20,000.00	38.46%
3	安徽辉克药业有限公司	有限合伙人	8,000.00	15.38%
4	卢健	有限合伙人	4,800.00	9.23%
5	淮北市正鹏物资有限公司	有限合伙人	3,500.00	6.73%
6	上海昊燚企业管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	5.77%
7	上海正帆科技股份有限公司	有限合伙人	2,900.00	5.58%
8	王强	有限合伙人	2,850.00	5.48%
9	安徽中昊环保科技有限公司	有限合伙人	2,500.00	4.81%
10	宁波孔偕企业管理有限公司	有限合伙人	1,750.00	3.37%
11	安徽玺昌控股集团有限公司	有限合伙人	1,200.00	2.31%
12	蔡倩	有限合伙人	1,000.00	1.92%
13	陈松权	有限合伙人	250.00	0.48%
14	刘剑	有限合伙人	150.00	0.29%
合计			52,000.00	100.00%

（2）苏州晶璞

企业名称	苏州晶璞创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA7GPEFM45
公司类型	有限合伙企业

成立时间	2022 年 1 月 26 日
执行事务合伙人	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）
出资总额（万元）	21,400.00
注册地/主要生产经营地	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 9 幢 301 室
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	P1067353
私募基金备案	STP372

苏州晶璞的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例
1	苏州工业园区兰璞创业投资管理 合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.47%
2	深圳市朗日实业发展有限公司	有限合伙人	5,000.00	23.36%
3	郑汉栩	有限合伙人	3,000.00	14.02%
4	宁波上融物流有限公司	有限合伙人	2,800.00	13.08%
5	胡洪	有限合伙人	1,600.00	7.48%
6	李红	有限合伙人	1,600.00	7.48%
7	刘毅	有限合伙人	1,150.00	5.37%
8	北京众联晟通国际贸易有限公司	有限合伙人	1,000.00	4.67%
9	陈静	有限合伙人	500.00	2.34%
10	刘剑	有限合伙人	500.00	2.34%
11	吴宝	有限合伙人	500.00	2.34%
12	卢艳红	有限合伙人	450.00	2.10%
13	刘宝	有限合伙人	400.00	1.87%
14	贺吉	有限合伙人	400.00	1.87%
15	段连峰	有限合伙人	300.00	1.40%
16	张晓梅	有限合伙人	300.00	1.40%
17	钱冰峤	有限合伙人	300.00	1.40%
18	吴亦丰	有限合伙人	200.00	0.93%
19	林惜春	有限合伙人	200.00	0.93%
20	宁波钰健投资合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	200.00	0.93%
21	郑化强	有限合伙人	200.00	0.93%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
22	袁晓明	有限合伙人	200.00	0.93%
23	孙金香	有限合伙人	150.00	0.70%
24	黄晓燕	有限合伙人	150.00	0.70%
25	侯向东	有限合伙人	100.00	0.47%
26	姚玉麟	有限合伙人	100.00	0.47%
合计			21,400.00	100.00%

(3) 苏州储芯

企业名称	苏州工业园区储芯创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA25UYMD8J
公司类型	有限合伙企业
成立时间	2021 年 4 月 27 日
执行事务合伙人	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）
出资总额（万元）	10,700.00
注册地/主要生产经营地	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 9 幢 301 室
主营业务	股权投资
上述主营业务与发行人 主营业务的关系	与发行人不存在同业竞争或上下游关系
基金管理人登记编号	P1067353
私募基金备案	SQM989

苏州储芯的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.93%
2	南正花	有限合伙人	3,000.00	28.04%
3	合肥民和科技实业有限公司	有限合伙人	2,000.00	18.69%
4	蔡倩	有限合伙人	1,000.00	9.35%
5	青岛同联芯企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	9.35%
6	连云港观志企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	9.35%
7	何修文	有限合伙人	600.00	5.61%
8	共青城和谦投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	4.67%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
9	余海涛	有限合伙人	400.00	3.74%
10	宁波上融物流有限公司	有限合伙人	350.00	3.27%
11	安徽昊燚创业投资有限公司	有限合伙人	300.00	2.80%
12	王智慧	有限合伙人	150.00	1.40%
13	裴力	有限合伙人	150.00	1.40%
14	张骅	有限合伙人	150.00	1.40%
合计			10,700.00	100.00%

(四) 发行人主要股东持有发行人股份的质押或争议情况

截至本招股说明书签署日,持有公司 5%以上股份的主要股东持有的公司股份存在被质押的情形,具体如下:

1、发行人股东科学城集团质押其持有的发行人股权

截至本招股说明书签署日,发行人的股东科学城集团质押了其直接、间接持有的公司股份,具体如下:

科学城集团质押其直接持有的公司股份					
直接持股数量 (万股)	直接 持股比例	已质押的直接 持股数量 (万股)	质押股份占 该股东直接 持股比例	质押股份占 公司发行前 总股本比例	质权人
20,860.22	8.82%	20,860.22	100.00%	8.82%	知识城集团
科学城集团质押其间接持有的公司股份					
具体请参见本节之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及控股股东、实际控制人基本情况”之“(四) 发行人主要股东持有发行人股份的质押或争议情况”之“2、发行人股东誉芯众诚的合伙份额被质押”。					

2、发行人股东誉芯众诚的合伙份额被质押

截至本招股说明书签署日,发行人的股东誉芯众诚的合伙份额存在被质押的情况,具体如下:

合伙人名称	持有的 合伙份额 (万元)	间接持有的 公司股 权比例	已质押的 合伙份额 (万元)	质押的合伙 份额占该合 伙企业比例	质押的间接 股份占公司 发行前总股 本比例	质权人
科学城集团	10,000	3.25%	10,000	19.23%	3.25%	知识城集团
金誉实业	26,300	8.54%	10,933	21.03%	3.55%	华兴银行
合计				40.26%	6.80%	

除上述情形外，发行人其他主要股东所持有的发行人股份均不存在质押、争议的情形。

八、发行人特别表决权股份或类似安排情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

九、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪、重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东、实际控制人。持有发行人 5% 以上股份的主要股东报告期内不存在刑事犯罪、重大违法行为。

十一、发行人的股本情况

（一）本次发行前后股本结构

本次发行前，公司的总股本为 236,559.14 万股。公司本次拟公开发行不超过 78,853.05 万股，且占发行后公司总股本的比例不低于 10%（行使超额配售选择权前），若本次发行股份为 78,853.05 万股，本次发行前后公司股本结构如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	誉芯众诚	39,933.33	16.88%	39,933.33	12.66%
2	广东半导体基金	26,718.09	11.29%	26,718.09	8.47%
3	广州华盈	22,500.00	9.51%	22,500.00	7.13%
4	科学城集团（SS）	20,860.22	8.82%	20,860.22	6.61%
5	国投创业基金	16,666.67	7.05%	16,666.67	5.28%
6	农银金融（SS）	9,675.08	4.09%	9,675.08	3.07%
7	广州科创产投	9,350.16	3.95%	9,350.16	2.96%
8	苏州璞然	8,333.33	3.52%	8,333.33	2.64%
9	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.30%	5,430.11	1.72%
10	广州吉富新芯	5,000.00	2.11%	5,000.00	1.59%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
11	广州越秀创达八号	4,838.71	2.05%	4,838.71	1.53%
12	联芯叁号	4,401.75	1.86%	4,401.75	1.40%
13	CHEN, WEI TONY (陈卫)	4,000.00	1.69%	4,000.00	1.27%
14	嘉兴隼满	3,763.44	1.59%	3,763.44	1.19%
15	陈谨	3,500.00	1.48%	3,500.00	1.11%
16	广东广祺辰途	3,333.33	1.41%	3,333.33	1.06%
17	深圳惠友	3,333.33	1.41%	3,333.33	1.06%
18	广州合信芯赢	3,333.33	1.41%	3,333.33	1.06%
19	合肥华芯康远	3,225.81	1.36%	3,225.81	1.02%
20	广州晶芯	3,118.28	1.32%	3,118.28	0.99%
21	建信金融(SS)	2,805.05	1.19%	2,805.05	0.89%
22	知识城集团(SS)	2,365.59	1.00%	2,365.59	0.75%
23	联芯贰号	2,155.20	0.91%	2,155.20	0.68%
24	深圳山海叁号	2,150.54	0.91%	2,150.54	0.68%
25	苏州晶璞	2,150.54	0.91%	2,150.54	0.68%
26	广州广祺欣芯	2,096.77	0.89%	2,096.77	0.66%
27	合肥华登二期	1,666.67	0.70%	1,666.67	0.53%
28	苏州储芯	1,666.67	0.70%	1,666.67	0.53%
29	联芯肆号	1,486.40	0.63%	1,486.40	0.47%
30	联芯陆号	1,453.26	0.61%	1,453.26	0.46%
31	盈科值得一号	1,451.61	0.61%	1,451.61	0.46%
32	广州盛誉	1,344.09	0.57%	1,344.09	0.43%
33	盈科吉运创投	1,290.32	0.55%	1,290.32	0.41%
34	广州华芯盛景	1,075.27	0.45%	1,075.27	0.34%
35	广发乾和	1,075.27	0.45%	1,075.27	0.34%
36	共青城吉富	1,075.27	0.45%	1,075.27	0.34%
37	青岛新鼎	1,075.27	0.45%	1,075.27	0.34%
38	深圳安鹏	1,075.27	0.45%	1,075.27	0.34%
39	中山广发信德	833.33	0.35%	833.33	0.26%
40	广州产投壹号	833.33	0.35%	833.33	0.26%
41	淄博盈峰	752.69	0.32%	752.69	0.24%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
42	广东珩芯	645.16	0.27%	645.16	0.20%
43	联芯伍号	570.06	0.24%	570.06	0.18%
44	广发信德二期	537.63	0.23%	537.63	0.17%
45	广州吉富智芯	537.63	0.23%	537.63	0.17%
46	厦门惠友	537.63	0.23%	537.63	0.17%
47	广州合信芯达	537.63	0.23%	537.63	0.17%
本次发行的社会公众股		-	-	78,853.05	25.00%
合计		236,559.14	100.00%	315,412.19	100.00%

(二) 本次发行前的前十名股东

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	誉芯众诚	39,933.33	16.88%
2	广东半导体基金	26,718.09	11.29%
3	广州华盈	22,500.00	9.51%
4	科学城集团（SS）	20,860.22	8.82%
5	国投创业基金	16,666.67	7.05%
6	农银金融（SS）	9,675.08	4.09%
7	广州科创产投	9,350.16	3.95%
8	苏州璞然	8,333.33	3.52%
9	广东广祺智行肆号	5,430.11	2.30%
10	广州吉富新芯	5,000.00	2.11%
合计		164,466.99	69.52%

(三) 本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处的任职情况

截至本招股说明书签署日，本次发行前的前十名自然人股东及其在公司任职情况如下：

序号	姓名	持股数量 (万股)	直接持股 比例	职务
1	陈谨	3,500.00	1.48%	董事长
2	CHEN, WEI TONY（陈卫）	4,000.00	1.69%	董事、总经理

(四) 发行人国有股份及外资股份情况

1、国有股份情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 4 名国有股东，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	科学城集团（SS）	20,860.22	8.82%
2	农银金融（SS）	9,675.08	4.09%
3	建信金融（SS）	2,805.05	1.19%
4	知识城集团（SS）	2,365.59	1.00%
合计		35,705.94	15.10%

根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，科学城集团、农银金融、建信金融、知识城集团的证券账户应标注“SS”。

2025 年 9 月 26 日，公司已取得广州市国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于粤芯半导体技术股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》，确认公司总股本为 236,559.14 万股，其中科学城集团、农银金融、建信金融、知识城集团合计持有公司 35,705.94 万股，占公司总股本的 15.10%，股东性质为国有股东，在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”标识。

2、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司有 1 名外资股东，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	直接持股比例
1	CHEN, WEI TONY (陈卫)	4,000.00	1.69%
合计		4,000.00	1.69%

(五) 发行人最近一年新增股东情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在最近一年新增股东的情况。

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司股东之间的关联关系或一致行动关系，及持股比例如下：

序号	股东名称	出资比例	关联关系/一致行动关系
1	誉芯众诚	16.88%	间接持有誉芯众诚 5%以上合伙份额的自然人均为广州华盈的实际控制人。
	广州华盈	9.51%	
2	苏州璞然	3.52%	苏州璞然的执行事务合伙人为嘉善存芯；嘉善存芯、苏州晶璞、苏州储芯的执行事务合伙人均为苏州兰璞创投。
	苏州晶璞	0.91%	
	苏州储芯	0.70%	
3	广东广祺智行肆号	2.30%	广东广祺智行肆号、广东广祺辰途、广州广祺欣芯的执行事务合伙人均为广州盈蓬私募基金管理有限公司。
	广东广祺辰途	1.41%	
	广州广祺欣芯	0.89%	
4	广州科创产投	3.95%	广州科创产投、广州产投壹号的执行事务合伙人均为广州产投私募基金管理有限公司。
	广州产投壹号	0.35%	
5	陈 谨	1. 48%	联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号为公司持股平台，其执行事务合伙人均为广州芯联心企业管理有限责任公司，陈谨为广州芯联心企业管理有限责任公司董事、法定代表人，陈卫为广州芯联心企业管理有限责任公司总经理。
	陈 卫	1. 69%	
	联芯叁号	1.86%	
	联芯贰号	0.91%	
	联芯肆号	0.63%	
	联芯陆号	0.61%	
	联芯伍号	0.24%	
6	广州吉富新芯	2.11%	广州吉富新芯、共青城吉富、广州吉富智芯的执行事务合伙人均为吉富创业投资股份有限公司。
	共青城吉富	0.45%	
	广州吉富智芯	0.23%	
7	合肥华芯康远	1.36%	合肥华芯康远、合肥华登二期、广州华芯盛景的私募基金管理人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司。
	合肥华登二期	0.70%	
	广州华芯盛景	0.45%	
8	广州合信芯赢	1.41%	广州合信芯赢、广州合信芯达的执行事务合伙人均为广州合信方册股权投资管理有限公司。
	广州合信芯达	0.23%	

序号	股东名称	出资比例	关联关系/一致行动关系
9	深圳惠友	1.41%	深圳惠友与厦门惠友的私募基金管理人均为深圳市惠友私募股权基金管理有限公司。
	厦门惠友	0.23%	
10	盈科值得一号	0.61%	盈科值得一号的执行事务合伙人为上海盈科值得私募基金管理有限公司，其基金管理人于盈科吉运创投的执行事务合伙人均为盈科创新资产管理有限公司。
	盈科吉运创投	0.55%	
11	广发乾和	0.45%	中山广发信德与广发信德二期的执行事务合伙人为广发信德投资管理有限公司，其与广发乾和投资有限公司均为广发证券股份有限公司的全资子公司。
	中山广发信德	0.35%	
	广发信德二期	0.23%	
12	广州晶芯	1.32%	广州晶芯、广州盛誉的执行事务合伙人均为广州广视盛誉私募股权投资基金管理有限公司。
	广州盛誉	0.57%	

(七) 发行人股东公开发售股份的情况

公司本次公开发行股份全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。

(八) 发行人私募投资基金等金融产品股东的情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 2 名自然人股东，45 名机构股东，其中有 32 名股东属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，具体情况如下：

序号	股东名称	私募投资基金备案编号	私募基金管理人名称	私募基金管理人登记编号
1	誉芯众诚	SCL033	万联天泽资本投资有限公司	GC2600011704
2	广东半导体基金	SNL096	广东粤财基金管理有限公司	P1032281
3	国投创业基金	SQH950	国投（广东）创业投资管理有限公司	P1071534
4	广州科创产投	SNS226	广州产投私募基金管理有限公司	P1067734
5	苏州璞然	SNS273	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）	P1067353
6	广东广祺智行肆号	SVU718	广州盈蓬私募基金管理有限公司	P1063917
7	广州吉富新芯	SNV516	吉富创业投资股份有限公司	P1010839

序号	股东名称	私募投资基金备案编号	私募基金管理人名称	私募基金管理人登记编号
8	广州越秀创达八号	SVP003	广州越秀产业投资基金管理有限公司	P1000696
9	嘉兴隼满	SVA320	上海上汽恒旭投资管理有限公司	P1070270
10	广东广祺辰途	SNS135	广州盈蓬私募基金管理有限公司	P1063917
11	深圳惠友	SLE922	深圳市惠友私募股权基金管理有限公司	P1023992
12	广州合信芯赢	SQS860	广州合信方册股权投资管理有限公司	P1070311
13	合肥华芯康远	SVG765	华芯原创(青岛)投资管理有限公司	P1060141
14	广州晶芯	SVH555	广州广视盛誉私募股权投资基金管理有限公司	P1060888
15	苏州晶璞	STP372	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)	P1067353
16	合肥华登二期	SNC493	华芯原创(青岛)投资管理有限公司	P1060141
17	苏州储芯	SQM989	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)	P1067353
18	盈科值得一号	SVJ325	上海盈科值得私募基金管理有限公司	P1023083
19	广州盛誉	SVM070	广州广视盛誉私募股权投资基金管理有限公司	P1060888
20	盈科吉运创投	SJJ329	盈科创新资产管理有限公司	P1001263
21	广州华芯盛景	STG174	华芯原创(青岛)投资管理有限公司	P1060141
22	共青城吉富	STJ803	吉富创业投资股份有限公司	P1010839
23	青岛新鼎	STD744	北京新鼎荣盛资本管理有限公司	P1018330
24	深圳安鹏	SVL605	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司	P1010069
25	中山广发信德	SNE602	广发信德投资管理有限公司	PT2600011589
26	广州产投壹号	SQU855	广州产投私募基金管理有限公司	P1067734
27	淄博盈峰	SVE535	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司	P1065362
28	广东珩芯	STS108	广东珩创私募基金管理有限公司	P1066619
29	广发信德二期	SJN515	广发信德投资管理有限公司	PT2600011589
30	广州吉富智芯	SVL332	吉富创业投资股份有限公司	P1010839
31	厦门惠友	SQQ369	深圳市惠友私募股权基金管理有限公司	P1023992
32	广州合信芯达	STT830	广州合信方册股权投资管理有限公司	P1070311

截至本招股说明书签署日,相关股东已按照相关法律法规完成私募投资基金备案手续与私募投资基金管理人登记手续。

除上述股东外,发行人本次发行前的其他股东不属于以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,不存在以非公开方式募集设立私募投资基金或者参与管理私募投资基金的情形,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需履行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记程序。

(九) 发行人与股东之间的特殊权益安排及解除情况

1、发行人与股东间特殊权利的签署情况

发行人在历次融资过程中,与相应投资方或股东签署了相关的股东协议,相关协议中约定了优先权、反稀释权、共同出售权、知情权及检查权等股东特殊权利条款。

2、上述特殊权利的清理情况

2025 年 9 月,发行人与全体股东签署了《关于粤芯半导体技术股份有限公司股东协议之补充协议》,明确约定公司承担义务及责任的特殊权利条款自协议生效之日起已无条件不可撤销地终止,且自始无效,不附带任何恢复条件。

截至本招股说明书签署日,公司与其股东之间不存在特殊权益安排,亦不存在由发行人作为对赌义务承担主体的任何条款约定。

(十) 发行人穿透计算股东人数情况

截至本招股说明书签署日,公司经穿透后共有 58 名股东,按照穿透计算的相关规定,公司股东人数未超过 200 人。

十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订公司章程并相应办理工商变更登记备案的议案》,公司不再设置监事会,《公司法》规定

的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

(一) 董事会成员

公司董事会由 11 名董事组成。公司董事由股东会及职工代表大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任。公司现任董事的基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人/选举机构	任期
1	陈谨	董事长	董事会	2026.3.31-2029.3.30
2	CHEN, WEI TONY (陈卫)	董事、总经理	董事会	2026.3.31-2029.3.30
3	黄铠生	董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
4	欧阳俊	董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
5	张瑞双	董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
6	毛寒梅	董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
7	HAN, RUIJING (韩瑞津)	职工代表董事、 副总经理、首席 运营官	职工代表大会	2026.3.31-2029.3.30
8	石水平	独立董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
9	庄巍	独立董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
10	郑德程	独立董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30
11	彭燎原	独立董事	董事会	2026.3.31-2029.3.30

公司董事简历情况如下：

陈谨先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州粤芯半导体技术有限公司董事长；2023 年 2 月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司董事长。曾任广州智光电气股份有限公司董事兼总裁，广州金鹏集团有限公司董事长兼总裁，广州凯得控股有限公司副总经理，广州开发区建设发展集团有限公司总经理助理，广州开发区建设创业投资有限公司董事长、总经理，广州开发区建设开发（香港）有限公司总经理等职务。

CHEN, WEI TONY (陈卫) 先生，1959 年 3 月出生，硕士研究生学历。2018 年 1 月至 2023 年 2 月，任广州粤芯半导体技术有限公司董事、总经理；2023 年 2 月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司董事、总经理。现同时担任华南理工大学客座教授，西安电子科技大学兼职教授，中山大学电子信息与工程学院顾问教授，香港科技大学微电子学域实践教授，广州市半导体协会会长，粤港澳大湾区

区半导体产业联盟理事长,广州光电存算芯片融合创新中心管理委员会委员等职务。曾任上海华虹宏力半导体制造有限公司销售及客户支持副总裁,新加坡特许半导体制造有限公司中国分公司首席代表及总经理、新加坡特许半导体制造有限公司市场和技术支持副总监。

黄铠生先生,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师、建筑经济师、造价工程师。2017年12月至2023年2月,任广州粤芯半导体技术有限公司董事;2023年2月至今,任粤芯半导体技术股份有限公司董事。现同时担任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁,广州智光电气股份有限公司董事、董事长特别助理、党委副书记,广州金泰丰投资有限公司执行董事、经理,广州誉新环保科技有限公司董事长,天津壹新环保科技有限公司董事,广州中科投置业有限公司董事长,广州泰丰投资有限公司监事,华工科创(广东)有限公司董事等职务。曾任广州经济技术开发区国有资产投资公司总经理助理,广州开发区商业发展集团有限公司副主任等职务。

欧阳俊先生,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2025年6月至今,任粤芯半导体技术股份有限公司董事。现同时担任广东粤财创业投资有限公司副总经理,广东芯粤能半导体有限公司董事等职务。曾任广东粤财基金管理有限公司副总经理,粤财中垠股权投资管理(广东)有限公司总经理助理,中国中投证券有限责任公司研究所行业研究员等职务。

张瑞双先生,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年12月至2023年2月,任广州粤芯半导体技术有限公司董事;2023年2月至今,任粤芯半导体技术股份有限公司董事。现同时担任广东珩创私募基金管理有限公司执行董事兼经理等职务。曾任万联天泽资本投资有限公司董事、总经理,万联证券股份有限公司柜台及做市业务部副总经理等职务。

毛寒梅女士,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师。2024年8月至今,任粤芯半导体技术股份有限公司董事。现同时担任知识城(广州)投资集团有限公司计划财务部副总经理,知识城(广州)融资租赁有限公司董事,捷创(广州)投资运营有限公司董事,知识城(广州)投资发展集团有限公司董事。曾任广州高新区投资集团有限公司计划财务部高级主管,中船黄埔文冲船舶有限公司财务部主管,广州市明和实业

有限公司财务部会计等职务。

HAN, RUIJING (韩瑞津) 先生, 1963 年 8 月出生, 博士研究生学历。2017 年 12 月至 2018 年 11 月, 任广州粤芯半导体技术有限公司董事、总经理; 2018 年 11 月至 2023 年 2 月, 任广州粤芯半导体技术有限公司副总经理、首席运营官; 2023 年 2 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司副总经理、首席运营官, 2026 年 3 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司职工代表董事。曾任武汉新芯集成电路股份有限公司信息技术副总裁, 阿特斯阳光电力集团股份有限公司生产制造副总裁, 上海宏力半导体制造有限公司生产制造副总裁, 英特尔工艺部高级资深工艺工程师等职务。

石水平先生, 1975 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2025 年 9 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司独立董事。现同时担任暨南大学管理学院会计学系教授, 广州市广百股份有限公司独立董事, 山河智能装备股份有限公司独立董事, 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事等职务。曾任暨南大学管理学院会计学系助教、讲师、副教授。

庄巍先生, 1968 年 8 月出生, 中国国籍, 拥有中国香港永久居留权, 硕士研究生学历, 俄罗斯工程院外籍院士, 教授级高级工程师。2025 年 9 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司独立董事。现同时担任广东省科学院半导体研究所学科带头人, 潍坊星达信息科技有限公司董事长兼总经理, 西安芯威星达电子科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人, 浙江星通信息科技有限公司执行董事兼经理, 天津联星高通科技有限公司执行董事兼经理, 宁波星导信息科技有限公司执行董事兼总经理, 常州联星智通科技有限公司执行董事兼总经理, 北京联星科通微电子技术有限公司执行董事、总经理等职务。曾任华润微电子有限公司独立董事、华润微电子(控股)有限公司助理总经理等职务。

郑德理先生, 1952 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 高级经济师。2025 年 9 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司独立董事。现同时担任信基沙溪集团股份有限公司独立董事, 深圳市威创聚能投资管理有限公司董事、广州航润技术集团股份有限公司独立董事等职务。曾任宏信悦友股份有限公司董事、广州市水务投资集团有限公司董事、威创集团股份有限公司独立董事、董事、监事, 广州广证恒生证券投资咨询有限公司董事长兼总经理、

首席经济学家，广州证券有限责任公司副总裁兼首席经济学家、美国华盛顿世界银行政策研究局转型经济处经济顾问等职务。

彭燎原先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2025年9月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司独立董事。现同时担任广东连越律师事务所高级合伙人，广州珠江实业集团有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司董事，恒大物业集团有限公司独立董事，广州轻工工贸集团有限公司董事。

(二) 高级管理人员

根据《公司章程》，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司现任高级管理人员共5名，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	CHEN, WEI TONY (陈卫)	董事、总经理	2026.3.31-2029.3.30
2	HAN, RUIJING (韩瑞津)	职工代表董事、副总经理、首席运营官	2026.3.31-2029.3.30
3	周来春	副总经理、首席财务官	2026.3.31-2029.3.30
4	DU, YANG (杜扬)	副总经理、首席技术官	2026.3.31-2029.3.30
5	吴漾	董事会秘书	2026.3.31-2029.3.30

公司高级管理人员简历情况如下：

CHEN, WEI TONY (陈卫) 先生的简历情况请参见本节之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(一) 董事会成员”。

HAN, RUIJING (韩瑞津) 先生的简历情况请参见本节之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(一) 董事会成员”。

周来春先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。2020年9月至2023年2月，任广州粤芯半导体技术有限公司副总经理、首席财务官；2023年2月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司副总经理、首席财务官。曾任深圳力维智联技术有限公司董事、副总裁、首席财务官，新加坡GMG环球有限公司副总裁、首席财务官，佐敦涂料（张家港）有限公司全国财务经理、销售总监、副总经理，埃尔夫润滑油（广州）有限公司财务副经理等职务。

DU, YANG (杜扬) 先生, 1958 年 11 月出生, 博士研究生学历。2023 年 9 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司副总经理、首席技术官, 现同时担任华南理工大学客座教授, 中山大学顾问教授, 广东工业大学博士生导师。曾任世界先进积体电路股份有限公司研发副总裁, 美国高通公司高级总监、美国摩托罗拉半导体首席研究员、美国亚德诺半导体技术有限公司主任工程师等职务。

吴漾女士, 1991 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2022 年 5 月至 2023 年 2 月, 任广州粤芯半导体技术有限公司投资者关系总监; 2023 年 2 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司董事会秘书。现同时担任武汉武粤光电技术有限公司董事、苏州德信芯片科技有限公司董事、广芯微电子(广州)股份有限公司董事。曾任芯联集成电路制造股份有限公司投资者关系总监等职务。

(三) 其他核心人员

公司其他核心人员为核心技术人员。公司现有 5 名核心技术人员, 基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	HAN, RUIJING (韩瑞津)	职工代表董事、副总经理、首席运营官
2	DU, YANG (杜扬)	副总经理、首席技术官
3	陈忠奎	运营中心助理副总裁
4	林伟铭	运营中心 助理副总裁
5	ZHANG, YONGHUA (张拥华)	研发中心高级总监

公司核心技术人员简历情况如下:

HAN, RUIJING (韩瑞津) 先生的简历情况请参见本节之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(一) 董事会成员”。

DU, YANG (杜扬) 先生的简历情况请参见本节之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(二) 高级管理人员”。

陈忠奎先生, 1977 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2018 年 4 月至 2023 年 2 月, 任广州粤芯半导体技术有限公司运营中心高级总监; 2023 年 2 月至今, 任粤芯半导体技术股份有限公司运营中心高级总监、助理副总裁。曾任武汉新芯集成电路制造有限公司光刻部副总监, 新加坡格罗方

德半导体股份有限公司光刻部技术专员，中芯国际集成电路制造（北京）有限公司光刻部资深经理。

林伟铭先生，1974年8月出生，硕士研究生学历。2021年1月至2023年2月，任广州粤芯半导体技术有限公司运营中心总监；2023年2月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司运营中心总监、高级总监、**助理副总裁**。曾任福建省福联集成电路有限公司总监，上海华虹宏力半导体制造有限公司科长，台湾联华电子半导体制造有限公司副理。

ZHANG, YONGHUA（张拥华）先生，1976年11月出生，博士研究生学历。2022年2月至2023年2月，任广州粤芯半导体技术有限公司研发中心总监；2023年2月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司研发中心总监、高级总监。曾任格科微电子（上海）有限公司总监，新加坡晶圆系统公司资深经理、新加坡格罗方德半导体股份有限公司经理，上海宏力半导体制造有限公司主任工程师。

（四）董事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员在公司及其子公司以外的企业或单位的主要兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	兼职企业/单位名称	所任职务	兼职企业/单位与公司的关联关系
1	陈谨	董事长	广州金微软件技术有限公司	董事长	关联方
			广州芯联心企业管理有限责任公司	董事	关联方
2	CHEN, WEI TONY (陈卫)	董事、总经理	广州芯联心企业管理有限责任公司	总经理	关联方
			广州市半导体协会	会长	无关联关系
			粤港澳大湾区半导体产业联盟	理事长	
			中山大学	电子信息与工程学院 顾问教授	
			香港科技大学	微电子学域实践教授	
			西安电子科技大学	兼职教授	
			华南理工大学	客座教授	
			广州光电存算芯片融合创新中心	管理委员会委员	关联方
3	黄铠生	董事	广州市金誉实业投资集团有限公司	高级副总裁、董事	关联方

序号	姓名	公司职务	兼职企业/单位名称	所任职务	兼职企业/单位与公司的关联关系
			广州泰丰投资有限公司	监事	无关联关系
			广州智光电气股份有限公司	董事、董事长特别助理、党委副书记	关联方
			广州金泰丰投资有限公司	执行董事、经理	
			广州誉新环保科技有限公司	董事长	
			广州中科投置业有限公司	董事长	
			天津壹新环保科技有限公司	董事	
			广州市万臻房地产有限公司	董事	
			华工科创(广东)有限公司	董事	
4	欧阳俊	董事	广东粤财创业投资有限公司	副总经理	关联方
			广东芯粤能半导体有限公司	董事	
5	张瑞双	董事	广州如珩企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	关联方
			广东珩创私募基金管理有限公司	执行董事、经理	
6	毛寒梅	董事	知识城(广州)投资集团有限公司	计划财务部副总经理	关联方
			捷创(广州)投资运营有限公司	董事	
			知识城(广州)投资发展集团有限公司	董事	
			知识城(广州)融资租赁有限公司	董事	
7	石水平	独立董事	暨南大学	会计学系教授	无关联关系
			广州市广百股份有限公司	独立董事	
			山河智能装备股份有限公司	独立董事	
			广州珠江发展集团股份有限公司	独立董事	
			广东四会农村商业银行股份有限公司(非上市)	独立董事	
			广州农村商业银行股份有限公司	外部监事	
8	庄巍	独立董事	广东省科学院半导体研究所	学科带头人	无关联关系
			潍坊星达信息科技有限公司	董事长兼总经理	关联方

序号	姓名	公司职务	兼职企业/单位名称	所任职务	兼职企业/单位与公司的关联关系
			限公司		
			西安芯威星达电子科技有限公司	执行董事兼总经理，财务负责人	
			浙江星通信息科技有限公司	执行董事，经理	
			天津联星高通科技有限公司	执行董事，经理	
			宁波星导信息科技有限公司	执行董事兼总经理	
			常州联星智通科技有限公司	执行董事兼总经理	
			南京尊丰信息科技有限公司	执行董事，经理	
			深圳宙合微电子有限公司	执行董事	
			北京联星科通微电子技术有限公司	执行董事、总经理	
			深圳硅励企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
			常州冠诚投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
			深圳硅豪企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
			深圳光科智能投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
9	郑德理	独立董事	信基沙溪集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
			深圳市威创聚能投资产管理有限公司	董事	关联方
			广州航润技术集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
10	彭燎原	独立董事	广东连越律师事务所	高级合伙人	关联方
			广州珠江实业集团有限公司	董事	
			广东省广晟控股集团有限公司	董事	
			大业信托有限责任公司	独立董事	无关联关系
			恒大物业集团有限公司	独立董事	
			广州轻工工贸集团有限公司	董事	关联方
11	DU, YANG (杜扬)	副总经理、首席	华南理工大学	客座教授	无关联关系
			中山大学	顾问教授	

序号	姓名	公司职务	兼职企业/单位名称	所任职务	兼职企业/单位与公司的关联关系
		技术官	广东工业大学	博士导师	
12	吴漾	董事会秘书	广芯微电子(广州)股份有限公司	董事	关联方
			苏州德信芯片科技有限公司	董事	
			武汉武粤光电技术有限公司	董事	

除上述兼职情况外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。

(五) 董事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

(六) 发行人董事、高级管理人员及其他核心人员最近 3 年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员最近 3 年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

(七) 发行人与董事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况

公司与在公司内部任职的董事、高级管理人员及其他核心人员均签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》；公司与独立董事签署了《独立董事聘任合同书》。

截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均正常有效履行，不存在违约情形。

十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况

(一) 董事变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司董事变动情况如下：

时间	董事会成员	人数	变动说明
2023 年 1 月-2024 年 8 月	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、魏义良、张瑞双、罗燕玉、陈明先	7	-
2024 年 8 月-2025 年 3 月	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、魏义良、张瑞双、毛寒梅、陈明先	7	股东科学城集团不再提名董事，另由知识城集团提名
2025 年 3 月-2025 年 6 月	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、魏义良、张瑞双、毛寒梅	6	股东广东半导体基金提名董事因退休辞任，新提名董事于聘任程序中
2025 年 6 月-2025 年 9 月	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、魏义良、张瑞双、毛寒梅、欧阳俊	7	股东广东半导体基金提名董事变更
2025 年 9 月-2026 年 3 月	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、魏义良、张瑞双、毛寒梅、欧阳俊、石水平、郑德理、庄巍、彭燎原	11	为完善公司治理结构，公司聘任独立董事
2026 年 3 月至今	陈谨、CHEN, WEITONY (陈卫)、黄铠生、张瑞双、毛寒梅、欧阳俊、HAN, RUIJING (韩瑞津)、石水平、郑德理、庄巍、彭燎原	11	董事魏义良因工作原因不再担任董事，职工代表大会选举 HAN, RUIJING (韩瑞津) 为职工代表董事

(二) 监事变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司监事变动情况如下：

时间	监事会成员	人数	变动说明
2023 年 2 月-2025 年 9 月	杜渝、李海涛、黎德坚、童世峰、于光宇	5	1、股东科学城集团不再提名监事，另由广州科创产投提名； 2、公司职工代表监事发生变更。
2025 年 9 月至今	-	-	根据《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司不再设置监事会或监事。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

(三) 高级管理人员变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司高级管理人员未发生变动。

（四）其他核心人员变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司其他核心人员未发生变动。

公司董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动主要是为了适应公司经营发展需要、加强公司治理水平、规范公司法人治理结构。近两年内，公司的核心管理层保持稳定，相关人员变动对公司日常经营管理未构成不利影响，不会影响公司的持续经营。公司董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员变动均履行了必要的法律程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员在最近两年内未发生重大不利变化。

十四、董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其业务相关或与公司存在利益冲突的对外投资情形。除对公司、公司持股平台及其执行事务合伙人的直接投资外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的其他直接对外投资情况如下：

序号	姓名	公司职务	直接投资企业名称	直接持股比例/出资比例
1	陈谨	董事长	广州源康精密电子股份有限公司	1.56%
2	黄铠生	董事	泉州珩创芯耀贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	2.97%
			广州合信芯赢投资合伙企业（有限合伙）	1.00%
3	欧阳俊	董事	广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）	1.31%
			珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）	1.07%
4	张瑞双	董事	广东珩创私募基金管理有限公司	85.50%
			广州如珩企业管理合伙企业（有限合伙）	68.97%
			泉州珩创芯耀贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	10.53%
			新余汇泽投资企业（有限合伙）	12.30%
			泉州珩创芯耀一号创业投资合伙企业（有限合伙）	6.00%
			泉州珩创芯耀柒号创业投资合伙企业（有限合伙）	11.32%

序号	姓名	公司职务	直接投资企业名称	直接持股比例/出资比例
			泉州珩创芯耀玖号创业投资合伙企业（有限合伙）	8.33%
			广东茗晖新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	12.48%
			广州瀚泽投资企业（有限合伙）	12.50%
5	庄巍	独立董事	潍坊星达信息科技有限公司	36.00%
			西安芯威星达电子科技有限公司	95.00%
			浙江星通信息科技有限公司	100.00%
			深圳硅励企业管理合伙企业（有限合伙）	99.00%
			常州冠诚投资中心（有限合伙）	84.00%
			天津联星高通科技有限公司	95.00%
			宁波星导信息科技有限公司	90.00%
			常州联星智通科技有限公司	80.00%
			南京尊丰信息科技有限公司	99.00%
			深圳硅豪企业管理合伙企业（有限合伙）	90.00%
			深圳光科智能投资合伙企业（有限合伙）	51.00%
			河北昊斯环境科技有限公司	4.00%
			嘉兴智慧城市技术研发有限公司	3.33%
			海宁宇新微智能科技有限公司	30.00%
6	郑德理	独立董事	广州拓谱基因技术有限公司	28.50%

除上述情况外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员无其他对外投资情况。公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其业务相关或与公司存在利益冲突的对外投资情形。

十五、董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/ 亲属关系	直接 持股 比例	间接持股情况		合计持股 比例
				间接持股主体	间接持股 比例	
1	陈谨	董事长	1.48%	联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号	0.31%	1.79%

序号	姓名	职务/ 亲属关系	直接 持股 比例	间接持股情况		合计持股 比例
				间接持股主体	间接持股 比例	
2	CHEN, WEI TONY (陈 卫)	董事、 总经理	1.69%	联芯贰号、联 芯叁号、联芯 肆号、联芯伍 号、联芯陆号	0.0090%	1.70%
3	HAN, RUIJING (韩瑞津)	职工代表董 事、副总经 理、首席运 营官	-	联芯贰号	0.85%	0.85%
4	黄铠生	董事	-	广州合信芯 赢、联芯贰号	0.08%	0.08%
5	张瑞双	董事	-	广东珩芯	0.0004%	0.0004%
6	周来春	副总经理、 首席财务官	-	联芯贰号、联 芯叁号、联芯 肆号、联芯伍 号、联芯陆号	0.17%	0.17%
7	DU, YANG (杜扬)	副总经理、 首席技术官	-	联芯叁号	0.17%	0.17%
8	吴漾	董事会秘书	-	联芯陆号	0.08%	0.08%
9	陈忠奎	运营中心助 理副总裁	-	联芯叁号	0.10%	0.10%
10	林伟铭	运营中心助 理副总裁	-	联芯肆号	0.06%	0.06%
11	ZHANG, YONGHUA (张拥华)	研发中心高 级总监	-	联芯陆号	0.06%	0.06%

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员直接或间接持有的公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况

(一) 薪酬组成、确定依据及所履行的程序情况

在公司内部担任具体经营职务的董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员依据其在发行人处担任的职务、对发行人生产经营活动的重要性、发行人经营计划的完成情况、市场平均薪酬水平等领取薪酬，薪酬总额主要由基本薪酬、绩效奖金等组成。独立董事薪酬为独立董事津贴，未在公司担任具体经营职务的董事不领取薪酬或津贴。

公司董事会下设薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并进行考核。发行人董事、监事（已取消）的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员的薪酬由董事会审议批准。

（二）薪酬总额及占各期利润总额的比重情况

报告期各期，公司董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及占当期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	1,994.47	1,941.73	1,728.98
利润总额	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
薪酬总额/利润总额	-0.80%	-0.83%	-0.90%

（三）最近一年从公司领取薪酬的情况

公司外部董事、外部监事（已取消）均不在公司领取薪酬；独立董事（含审计委员会中独立董事）在本公司只领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

除上述人员外的董事、监事（已取消）、高级管理人员以及其他核心人员均在公司及/或公司控股子公司领取薪酬；2025 年公司董事、监事（已取消）、高级管理人员、其他核心人员薪酬总额为 1,994.47 万元。

除上述薪酬待遇外，公司董事、监事（已取消）、高级管理人员、其他核心人员最近一年未在公司享受其他特殊待遇和退休金计划。

十七、发行人正在执行的对其董事、高级管理人员、其他核心人员实行的股权激励及其他制度安排和执行情况

为健全公司中长期激励与约束机制，将核心人才的根本利益与公司的股东价值及长远发展深度绑定，进而推动公司的可持续发展，发行人已实施股权激励计划，对为公司作出突出贡献及对未来发展将发挥重要作用的人员进行激励。

（一）股权激励计划的决策流程

2021 年 8 月 6 日，粤芯有限召开股东会并作出决议，同意公司实施首轮股权激励计划。

2021 年 12 月 30 日，粤芯有限召开股东会并作出决议，同意公司股东誉芯众诚和广州华盈向陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）以及持股平台联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号转让股权用于股权激励。公司其他股东放弃优先购买权。

2021 年 12 月 31 日，上述各方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

2022 年 1 月 25 日，广州市黄埔区市场监督管理局核准了本次变更事项。

（二）股权激励计划的实施情况

公司首轮股权激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、技术和业务人员及其他骨干员工。

截至本招股说明书签署日，公司的持股平台包括联芯壹号、联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号，其执行事务合伙人为广州芯联心。公司激励对象通过持股平台、直接持股的方式合计持有公司 7.42%的股权。

（三）股份锁定期及上市后的处置安排

股权激励相关主体出具的关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”。

（四）对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司首轮股权激励计划充分调动了公司员工的工作积极性，保证了公司管理团队和人才队伍的稳定，有利于公司的长期稳定发展。

2023 年、2024 年和 2025 年，公司股份支付金额分别为 6,717.10 万元、6,371.51 万元和 6,443.68 万元，上述股份支付费用未对公司财务状况产生重大影响。

上述股权激励的实施未导致公司控制权发生变化。

十八、发行人员工情况

（一）员工基本情况

1、员工人数及其变化情况

2023 年、2024 年和 2025 年，公司员工人数分别为 1,510 人、1,677 人和 1,943

人。

2、员工构成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构、受教育程度、年龄结构情况如下：

(1) 员工专业结构

专业结构	员工人数（人）	比例
研发人员	343	17.65%
管理人员	240	12.35%
销售人员	61	3.14%
生产人员	1,299	66.86%
合计	1,943	100.00%

(2) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	比例
硕士及以上	398	20.48%
本科	944	48.58%
大专及以下	601	30.93%
合计	1,943	100.00%

(3) 员工年龄结构

年龄分布	员工人数（人）	比例
30 岁以下	1,124	57.85%
30 岁-40 岁	652	33.56%
40 岁-50 岁	130	6.69%
50 岁及以上	37	1.90%
合计	1,943	100.00%

(二) 社会保险和住房公积金缴纳情况

1、社会保险、住房公积金缴纳情况

公司实行劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地方有关劳动法律、法规、规范性文件的规定聘用员工，与员工签订劳动合同，员工根据劳动合同享受权利和承担义务。公司已按照相关规

定为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险并缴纳了住房公积金。

报告期各期末，公司及其控股子公司为员工缴纳社会保险的基本情况如下：

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
社会保险缴纳人数（人）	1,919	1,634	1,470
员工总人数（人）	1,943	1,677	1,510
缴纳社保人数占员工总人数的比例	98.76%	97.44%	97.35%
社会保险未缴纳人数（人）	24	43	40

报告期各期末，发行人及子公司为其员工缴纳住房公积金的情况如下：

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
住房公积金缴纳人数（人）	1,916	1,632	1,468
员工总人数（人）	1,943	1,677	1,510
缴纳住房公积金人数占员工总人数的比例	98.61%	97.32%	97.22%
住房公积金未缴纳人数（人）	27	45	42

报告期内少量员工未缴纳社会保险或住房公积金的原因为：（1）部分**港澳台籍**、外籍员工未缴纳社会保险和住房公积金，公司已为其缴纳商业保险；（2）退休返聘人员不需缴纳社会保险和住房公积金；（3）部分新入职员工的社会保险和住房公积金缴纳手续在当月社会保险和住房公积金的申报时点尚未办理完成；（4）**发行人境外子公司不适用中国大陆社会保险和住房公积金缴纳的相关规定，无需为其员工缴纳社会保险和住房公积金。**

2、政府主管部门关于社会保险和住房公积金缴纳情况的证明

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司均已取得其所在地公共信用信息平台出具的信用报告，确认其报告期内不存在因违反法律法规受到社会保险和住房公积金方面行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

模拟芯片细分品类多，应用领域广，生命周期长，其技术提升更依赖企业自身的研发能力与经验积累，尤其是高端模拟芯片可应用于汽车电子、工业控制、智能制造、人工智能等领域，与终端应用市场的技术迭代和创新发展息息相关。中国拥有模拟芯片最广泛的应用场景和市场需求，是全球最大的模拟芯片消费市场，但是目前模拟芯片的自给率仍然较低，国产替代空间巨大。中国各类终端应用产业集群的蓬勃发展，也带来了多样化的客户结构和产能需求，急需经验丰富和工艺技术成熟的模拟芯片晶圆制造企业提供特色化的制造工艺和产能支持。

粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。自 2017 年成立以来，公司专注于特色工艺晶圆代工业务，坚持打造“特色工艺技术平台”，坚持“客户导向”，持续积淀公司核心竞争力。

公司在集成电路制造领域，经过长期的技术积淀，形成了 MS（混合信号）、HV（高压显示驱动）、CIS（CMOS 图像传感器）、eNVM（嵌入式非易失存储器）、BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）和 SiPho（硅光）等工艺技术平台。功率器件领域，公司拥有 MOSFET（金属-氧化物-半导体场效应晶体管）和 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）工艺技术平台。丰富的产品组合和技术优势，使公司能快速响应客户需求，为客户产品设计需求调整制造工艺，成功实现客户的产品性能和设计目标。同时，公司积极布局行业前瞻领域，打造硅光及光电融合芯片、微控制器、存算一体芯片等产业平台，进一步拓宽前沿科技的下游市场。

公司面向广阔的模拟芯片应用市场，以客户需求为先，推动设计、制造和终端产业链的优化协同，提供多元化平台和多样制程节点的特色工艺一站式解决方案，助力中国模拟芯片产业链的技术迭代和创新升级，对于中国实现集成电路产业链的自主可控，发挥了重要的作用。

一、发行人的主营业务情况

(一) 主营业务情况及主要产品情况

1、主营业务情况

公司以特色工艺晶圆代工为核心商业模式，服务芯片设计公司和终端客户，主要客户涵盖境内外多家一流半导体行业设计公司。公司具备集成电路、功率器件等产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

公司是广东省自主培育且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业，广东省集成电路行业协会和广州市半导体协会会长单位。公司拥有一支研发经验丰富、技术能力成熟的研发团队，能够快速响应客户的工艺研发和制造需求，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得授权专利（含境外专利）712 项，其中发明专利 343 项。公司已通过 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证。公司承担了多项国家级、省市级半导体领域相关的科研项目，并先后被认定为“广东省企业技术中心”、“广东省工程研究中心”。

公司目前拥有两座 12 英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为 8 万片/月，截至 2025 年末已实现产能 6.33 万片/月。目前，公司已启动建设一条规划产能为 4 万片/月的 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期），产线建成后将为硅光及光电融合、嵌入式存储、图像传感器、数模混合及射频（存算一体芯片）、OLED 显示驱动等工艺技术平台提供产能保障，工艺制程节点涵盖 65nm-22nm，下游应用覆盖人工智能、高端工业控制、新能源汽车等领域。粤芯四期建成后，公司产能合计将达到 12 万片/月。

2、主要产品及服务情况

公司聚焦模拟和数模混合芯片领域，工艺技术平台目前已围绕“感、传、算、存、控、显”逐步实现了多品类布局，已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台，集成电路工艺技术节点覆盖 180nm-55nm，可提供集成电路及功率器件等晶圆制造的一站式解决方案。

公司主要产品分类如下：

(1) 集成电路

工艺技术平台	主要技术特点	主要应用场景
MS	制程范围：180nm-55nm 可为客户提供极具成本竞争力的工艺流程方案	指纹识别、LED 显示驱动、电源管理、锂电保护、信号链等
HV	制程范围：180nm-55nm 提供大、中、小屏及不同电压组合的工艺组合，满足多种应用场景	非触控式/触控式 LCD 屏幕显示驱动、电子标签显示驱动等
CIS	制程范围：153nm-55nm 提供集成了高性能小尺寸 Pixel 的工艺技术方案	智能手机、安防、平板电脑、数码产品等图像传感器等
BCD	制程范围：180nm-90nm 电压范围覆盖 5V-120V 的 BCD 工艺技术平台，可为客户提供丰富多样的器件类型	电池管理、电源管理、信号链等
eNVM	制程范围：180nm-95nm 提供嵌入式存储单元（包含 EEPROM、OTP、MTP 和 eFLASH）	消费、工业微控制器（MCU）等
SiPho	集成低损耗 Si/SiN 波导、高带宽热/电调制器、面耦合器/端侧耦合器以及高速的锗光电探测器等	智算中心光互联、自动驾驶激光雷达等

在 MS 工艺技术平台方面，工艺节点覆盖 180nm 至 55nm。主要代工的产品包括电容指纹识别芯片、超声波指纹识别芯片、电源管理芯片、LED 显示驱动芯片、锂电保护芯片、数模信号处理芯片等。公司与全球指纹识别芯片龙头企业建立了深度战略协同关系，已成为全球出货量领先的电容指纹识别芯片晶圆代工厂之一和国内少数具备硅基 CMOS 超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。

在 HV 工艺技术平台方面，工艺节点覆盖 180nm 至 55nm。公司主要代工的产品包括触控式及非触控式 LCD 屏幕显示驱动芯片、电子标签显示驱动芯片等。公司已构建覆盖大、中、小全屏幕尺寸的 LCD 显示驱动芯片的工艺技术平台，覆盖包括消费电子、工业控制等终端产品。根据 CINNO Research 统计，2025 年四季度公司高压显示驱动芯片晶圆出货量排名全球晶圆厂第七名、中国大陆晶圆厂第三名。

在 CIS 工艺技术平台方面，工艺节点覆盖 153nm 至 55nm。公司主要代工的产品包括前照式、背照式（前段工艺）CMOS 图像传感器。公司 CIS 工艺技术平台已集成高性价比的 Pixel 工艺方案，可为智能手机前/后置摄像头提供特色化的

解决方案。

在 BCD 工艺技术平台方面，工艺节点覆盖 180nm 至 90nm，具备 5V-120V 的超宽电压范围，并可为客户提供丰富多样的器件类型及丰富的工艺选择，可满足多元化的应用场景需求。目前，公司的 BCD 平台产品已成功导入消费电子、工业控制及汽车电子等核心应用领域，覆盖低压、中压、高压范围，形成了完整的全电压工艺技术布局。

在 eNVM 工艺技术平台方面，工艺节点覆盖 180nm 至 95nm，提供 EEPROM、OTP、MTP 和 eFLASH 等多种存储单元的集成工艺。可根据客户的设计方案调试和优化制造工艺，使其产品在成本、性能、功耗、集成度等方面更具优势，稳定性、可靠性。

在 SiPho 工艺技术平台方面，公司于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台，集成低损耗 Si/SiN 波导、高带宽热/电调制器、面耦合器/端侧耦合器以及高速的锗光电探测器等，为下游客户发展智算中心光互联建设、自动驾驶激光雷达等领域提供关键支撑。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高速可插拔硅光光模块应用，与国际领先水平相当。同时，公司与业界先进水平保持同步，开展近封装光学（NPO）的工艺制造技术研发，目前正在导入 3.2T NPO 产品。

(2) 功率器件

工艺技术平台	主要技术特点	主要应用场景
MOSFET (TMOS/SGT)	电压范围覆盖 12V-200V，提供丰富多样的器件类型及多种衬底工艺类型，满足不同产品需求	计算机、新能源汽车、智能家电、电动工具等
IGBT	电压范围覆盖 650V-1700V，具备深沟槽蚀刻工艺技术、超薄片工艺、背面高能离子注入及激光退火等技术	工业变频、新能源汽车、光伏发电、储能等

在 MOSFET 工艺技术平台方面，公司基于 12 英寸晶圆平台的精密工艺控制自主开发了沟槽型 MOSFET（TMOS）和屏蔽栅型 MOSFET（SGT）工艺，凭借其优异的导通电阻和功率密度表现，已获得客户的广泛认可。MOSFET 产品覆盖 12V-200V 的电压范围，可充分满足电机驱动、LED 智能照明驱动、数据中心服务器电源、新能源充电桩及车载充电机等高端应用场景的严苛需求。

在 IGBT 工艺技术平台方面，公司具备大电流、高可靠性产品的代工能力，产品已成功应用于工业变频器、工业大功率电源逆变器，新能源主驱逆变器、充电桩，光伏逆变器以及消费电子等领域。同时，公司还提供与 IGBT 模块配套的 FRD（快恢复二极管）产品，形成完整的一站式解决方案。通过持续的技术创新和工艺优化，公司功率器件产品在效率、可靠性和成本等方面具有竞争力。

3、主营业务收入的构成及特征

报告期内，公司按照工艺技术平台分类的主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	197,544.22	78.68%	130,971.78	80.26%	75,585.59	74.05%
功率器件代工	53,543.43	21.32%	32,218.36	19.74%	26,491.90	25.95%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

报告期各期，公司主营业务实现的收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元和 251,087.66 万元，由集成电路代工及功率器件代工业务构成。

(二) 发行人主要经营模式

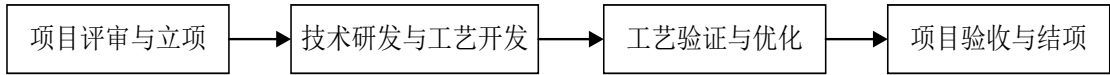
1、盈利模式

发行人专注于半导体制造环节，主要向客户提供集成电路、功率器件等产品的 12 英寸特色工艺晶圆代工服务，从而获取收入和利润。

2、研发模式

发行人坚持以自主创新为核心策略开展研发工作，建立了系统化、规范化的研发管理体系，并不断完善研发项目管理，保证研发效率及成本控制，实现研发资源的最优配置与经营效能最大化。

公司的主要研发流程如下：



(1) 项目评审与立项

基于公司战略规划和业务经营需要，筛选适配的潜在研发项目，通过对行业

和产品的市场规模与客户需求调研，竞争格局和竞争对手分析，技术发展和技术路线方向论证，项目可行性与风险评估等前期工作，确定项目的技术研发目标和范围，发起项目的立项评审。经项目评审通过后，项目正式立项和启动。

(2) 技术研发和工艺开发

依据研发项目的技术研发目标与检测规格指标，进行器件技术研发和工艺流程开发、工艺配方调试、整合开发相关器件和生产工艺流程，技术参数检测等研发工作。

(3) 工艺验证与优化

对工艺技术可靠性及生产工艺实现的产品功能、性能、良率、可靠性进行验证，进行针对性的工艺与器件优化。

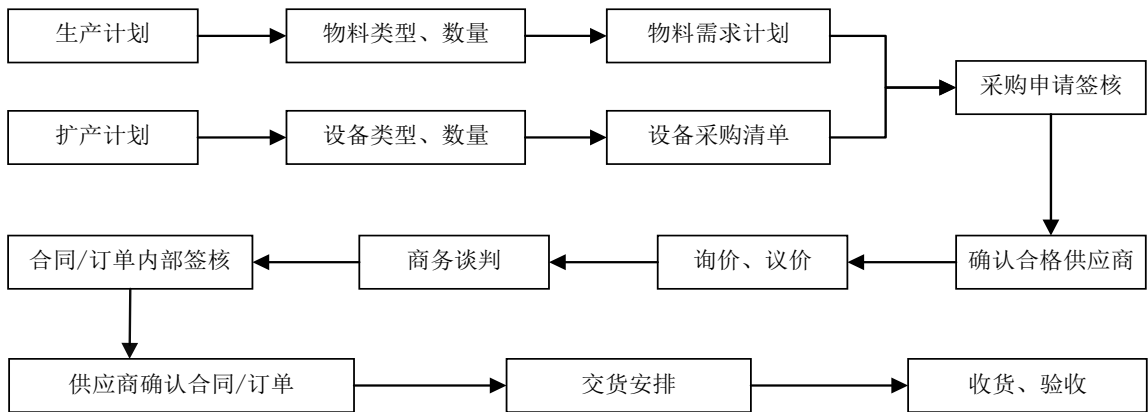
(4) 项目验收与结项

研发项目完成整体研发工作并且各项检测指标达到项目立项预期和要求，具备进入量产条件，该研发项目完成验收并结项。

3、采购模式

(1) 采购流程

公司根据整体战略和实际业务需求，建立了完善的采购管理体系。公司的采购类型主要分为原材料类采购和设备类采购，采购流程具体如下：



① 采购申请

原材料：原材料计划部门依据主生产计划需求，结合安全库存、在途订单、生产周期、采购周期、未来需求等因素，确认所需购买的物料项目、数量、规格

等信息，制定物料需求计划，发起内部采购申请流程；

设备：工业工程部门依据产能规划或特殊工艺扩产需求，确认所需购买的设备类型、技术规格、设备数量等信息，制定设备需求清单并由使用单位提交技术评审委员会审核，审核通过后发起内部采购申请流程。

② 询价、议价及商务谈判

采购申请签核完成后，采购部门与合格供应商进行询价、议价并开展商务谈判，结合价格、品质、交期、技术等维度，选定一家或多家供应商。

③ 订单签核

采购部门发起采购合同/订单签核流程，提交相应主管部门逐级审批，审批通过后向供应商出具采购合同/订单，并确认采购合同/订单回签或盖章生效，同时采购部门根据物料需求计划跟踪供应商的交货进度。

④ 收货、验收

原材料：仓管部门根据送货单检查货物标签、外观包装、数量后入库，发起收货签核流程。

设备：设备搬入后，仓管部门发起收货签核流程；设备需求部门根据相关技术规格文件进行验收。

(2) 供应商管理体系

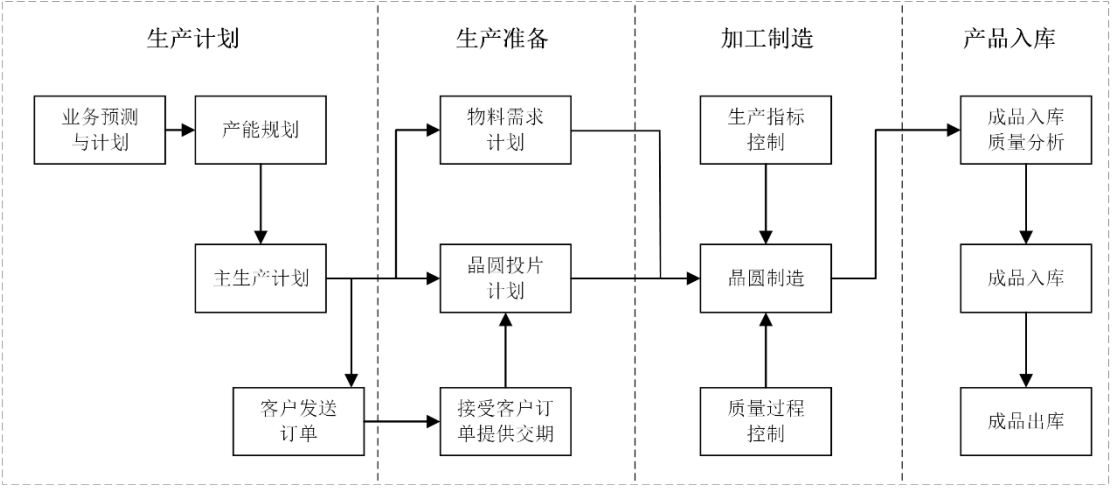
公司建立了完善的供应商认证准入机制和供应商考核评价体系，以保证原材料、设备零配件及设备质量的稳定性和供应的持续性。

供应商通过资质评估、采购效益评估、样品验证等环节评估后，方可成为公司的合格供应商，公司主要向入围公司合格供应商名单的供应商进行采购。

为对合格供应商进行有效管理，保证采购质量，发行人建立了严格的供应商考核评价体系和有效的供应商沟通机制，由相关部门对采购产品的质量、价格、交期、服务、安全环保等进行考核评价，若存在不符合公司供应商考核要求的情形，则与供应商进行沟通整改。

4、生产模式

公司的生产流程主要包括生产计划、生产准备、加工制造及产品入库，具体情况如下：



(1) 生产计划

销售部门依据与客户沟通的未来业务规划、与客户达成的商业计划、工艺技术准备情况及营收目标制定业务需求预测计划，生产计划部门结合业务需求预测计划、产能规划和原材料供应情况制定主生产计划。

(2) 生产准备

原材料计划部门根据主生产计划制定物料需求计划，生产计划部门根据主生产计划及物料需求计划制定晶圆投片计划。

(3) 加工制造

生产部门根据主生产计划及晶圆投片计划安排和管理生产；生产计划部门监督生产周期、生产进度、产量等指标；品质管控部门对产品全生产流程做质量管控。

(4) 产品入库

公司完成全部生产流程的产品经检验合格后入库，并按照客户需求完成产品交付。

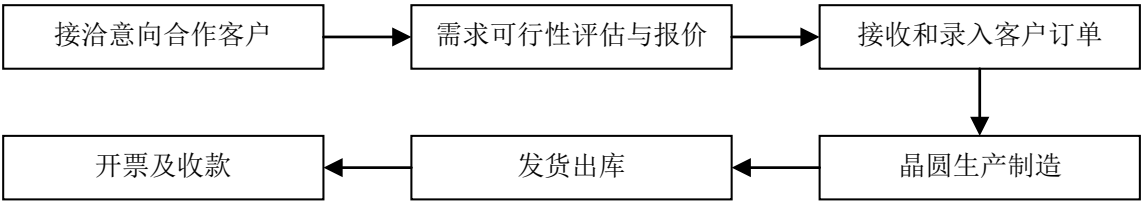
5、营销模式

公司采取多样化营销策略，通过多种渠道积极拓展客户资源，具体方式包括：

- (1) 公司依托市场研究与分析，识别并主动接洽潜在客户，通过举办业务洽谈会等方式，向客户推介符合其需求的工艺技术平台与服务；
- (2) 积极与产业链上下游企业（如芯片设计公司、封装测试厂商等）及相关行业协会、产学研机构开展合作，共同开发潜在业务资源；
- (3) 通过参与各类行业活动，包括技术研讨会、学术论坛、半导体峰会及专业展会，提升企业形象并吸引潜在客户；
- (4) 利用官方网站、新闻媒体及口碑传播等公开渠道，展示公司工艺技术与服务能力，吸引客户主动联系并促成合作。

6、销售模式

公司主要采用直销模式开展销售业务。通过制定相应的销售管理制度，对销售行为与销售流程进行规范化管理。公司销售流程如下：



(1) 接洽意向合作客户

销售部门结合业务需求预测计划、市场资讯与客户需求等信息，接洽目标客户，了解客户的产品需求。

(2) 需求可行性评估与报价

综合考虑客户对于工艺制程、产品性能等需求并结合市场行情、订单规模、生产成本、产能安排、工艺技术要求等因素，评估客户需求的可行性并拟定报价，由相应主管部门逐级审批通过后，向客户提供报价单。

(3) 接收和录入客户订单

客户下达订单后，由销售部门核对并将订单信息录入系统，经主管部门逐级审批通过，公司正式接收订单。

(4) 晶圆生产制造

生产部门将依据客户交期需求与产能状况制定生产计划并组织投产,销售部门与客户及时沟通生产状态。

(5) 发货出库

产品生产完成后,公司安排发货至客户指定地点或由客户自提,并提供出货签收单。

(6) 开票及收款

销售部门将发票发送给客户;客户按照约定的付款方式进行付款;财务部门收到支付款项后通知销售部门进行确认,完成相关账务处理。

7、采用目前经营模式的主要原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司结合中长期发展战略、市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素,形成了目前的晶圆代工经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来亦不会发生重大变化。

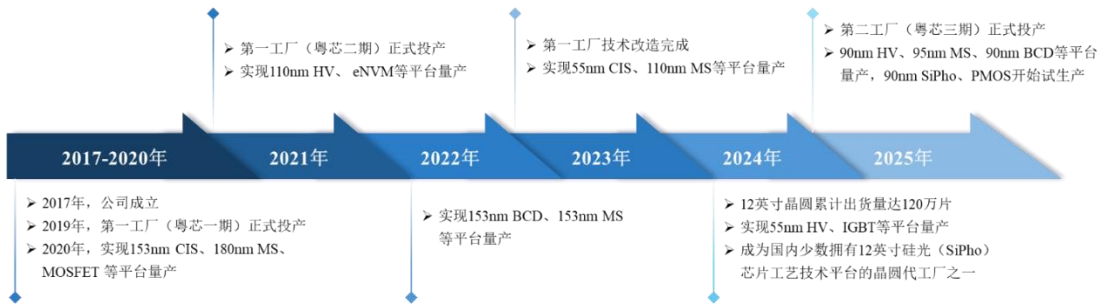
(三) 成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

1、主营业务、主要经营模式的演变情况

发行人自设立以来主要向客户提供 12 英寸特色工艺晶圆代工服务,主营业务及主要经营模式均未发生改变。

2、主要产品的演变情况

公司目前已实现 180nm-55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产,已具备 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台的生产能力。在不同发展阶段,公司主要制程及工艺技术平台的演进情况如下:

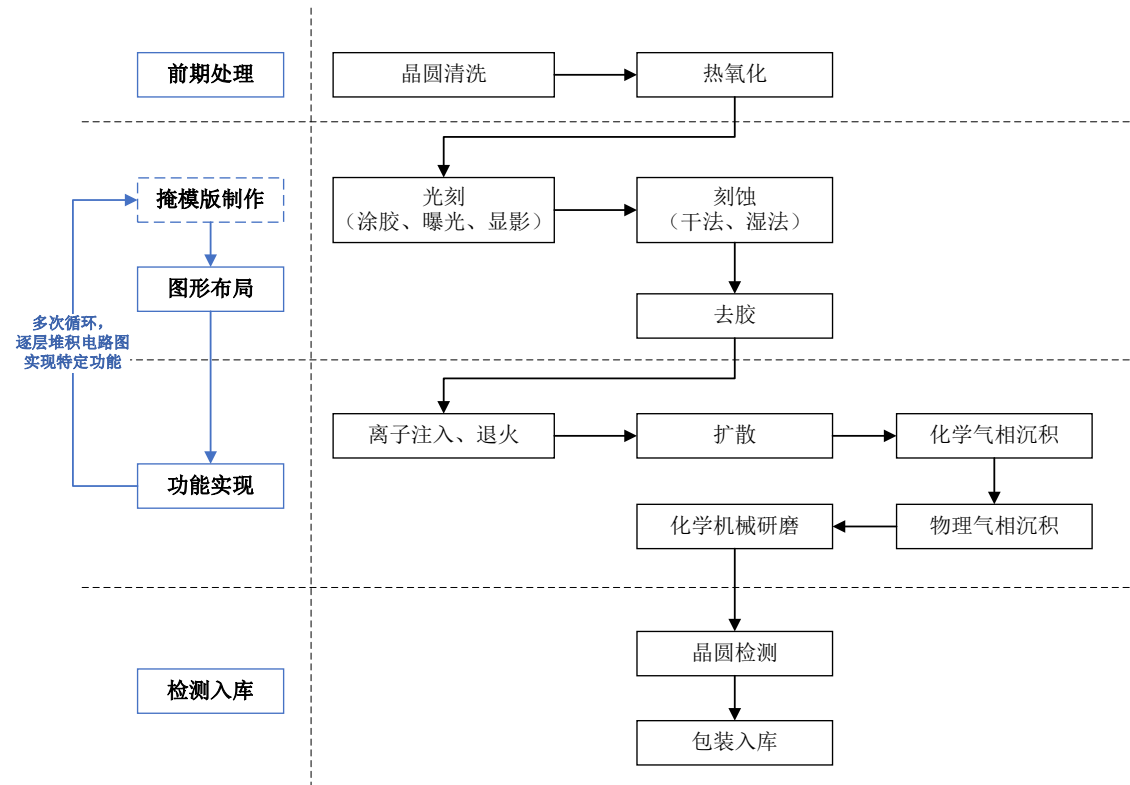


（四）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

发行人的核心技术体系已融入并应用于主营业务中，与产业实现了深度融合。报告期内，公司核心技术产生的收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元和 251,087.66 万元，占各期营业收入比例分别为 97.80%、97.06%及 97.23%。

（五）主要产品的工艺流程

发行人的主营业务为 12 英寸特色工艺晶圆代工，生产过程包括晶圆清洗、热氧化、光刻、刻蚀、去胶、离子注入、退火、扩散、化学气相沉积、物理气相沉积、化学机械研磨等环节，主要工艺流程如下：



注：掩模版由其他专业厂商生产，发行人不涉及掩模版制造业务。

1、前期处理

(1) 晶圆清洗

晶圆清洗是指使用喷淋或沉浸的方式，先使用多种化学品对晶圆进行清洗，再使用超纯水对晶圆进行二次清洗去除残留的化学液，目的是为了去除晶圆表面的杂质颗粒和残留物等，提高后续生长热氧化层的质量，保证后续工艺的稳定性。

(2) 热氧化

热氧化是指在高温氧气和惰性气体的环境下，在晶圆表面形成二氧化硅薄膜。

2、图形布局

(1) 光刻

光刻的主要环节包括涂胶、曝光和显影，具体情况如下：

① 涂胶：将光刻胶均匀地涂布在高速旋转的晶圆上，以形成一层均匀的感光层；

② 曝光：利用光刻机，通过特定波长的光线的照射，改变光刻胶的性质，将光掩模版上的电路图形复制到光刻胶上；

③ 显影：利用显影液，去除曝光后光刻胶中的可溶解部分，从而使光掩模版上的图形显示在晶圆上。

(2) 刻蚀

刻蚀是指在光刻工序后，有选择性地去除晶圆上未被光刻胶覆盖区域的材料。主要的刻蚀方式包括湿法刻蚀和干法刻蚀，其中湿法刻蚀是指使用液态化学溶剂进行刻蚀；干法刻蚀是指用等离子体或气态化学品进行刻蚀。

(3) 去胶

去胶是指去除刻蚀完成后在晶圆上未被溶解的光刻胶。

3、功能实现

(1) 离子注入、退火

离子注入是指通过高能轰击将硼、磷、砷等杂质离子以离子束的形式植入晶

圆表面的特定区域，以改变半导体材料在这些特定区域的性能。

退火是指将晶圆放置于较高温度的环境中，使得晶圆表面或内部的微观结构发生变化，以实现特定性能。

(2) 扩散

扩散是指在高温环境下使杂质离子在离子浓度有梯度的区域间发生扩散，改变和控制晶圆内杂质的浓度和分布，形成不同电特性的区域，改变晶圆的电特性。

(3) 化学气相沉积

化学气相沉积是指应用气态化学原材料在晶圆表面上产生化学反应，并在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

(4) 物理气相沉积

物理气相沉积是指利用溅射镀膜、真空蒸发、离子体镀膜、分子束外延等物理方法，在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

(5) 化学机械研磨

化学机械研磨是指利用机械力的摩擦原理及化学反应，借助研磨颗粒，以机械摩擦的方式将物质从晶圆表面逐层剥离以实现晶圆表面的平坦化。

4、检测入库

(1) 晶圆检测

晶圆检测是指晶圆加工完成后，使用探针等电性检测设备对晶圆性能进行测试，验证其电性规格是否符合工艺技术平台或客户产品特性的规格要求。

(2) 包装入库

包装入库是指将生产加工完后检测合格的晶圆真空包装入库。

(六) 报告期各期具有代表性的业务指标

报告期内，公司具有代表性的业务数据包括产能、产量、销量、产能利用率及产销率等，相关业务数据的具体变动情况及原因参见本节“三、发行人销售情况和主要客户”之“（一）发行人主要产品产能、产量及销量”。

(七) 主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

集成电路产业是现代科技与经济的核心支柱，是国家鼓励、扶持的战略性新兴产业，在国家发展中占据至关重要的战略地位。国家“十五五”规划纲要中，以及国家最新发布的六大新兴（支柱）产业，集成电路均被置于前所未有的战略高度，特别是“十五五”规划纲要明确提出“做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力”，标志着“十五五”期间将成熟制程竞争力提升置于集成电路产业发展更加重要的位置。坚定不移地发展集成电路产业，成熟制程与先进制程能力并举提升，已明确是中国实现高水平科技自立自强、筑牢现代化产业体系根基以及保障国家经济和产业安全的必然要求。

广东省作为中国集成电路产业发展的核心承载区域之一，在国家战略布局中承担着打造粤港澳大湾区集成电路产业集群的关键角色。广东省政府将集成电路产业纳入省级战略性新兴产业集群发展重点，提出了重点推进模拟及数模混合芯片生产制造，优先发展特色工艺制程芯片制造，大力支持技术先进的 IDM 企业和晶圆代工企业布局研发、生产的运营中心，重点推动 12 英寸晶圆线项目建设等指导性意见。

发行人主要向客户提供集成电路模拟芯片、功率器件等产品的 12 英寸特色工艺晶圆代工服务，所属行业为半导体和集成电路制造行业，符合产业政策和国家经济发展战略。2022 年以来，广东省和广州市陆续发布的《广东省加快半导体及集成电路发展若干意见》《广东省建设现代化产业体系 2025 年行动计划》《2024 年广东省数字经济工作要点》《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划（2022-2024 年）》等一系列支持集成电路产业发展的政策中，明确推动粤芯半导体项目建设作为广东“强芯工程”、做大做强芯片制造业的重要任务。

(八) 发行人特色工艺技术的具体体现

特色工艺指的是非标准的半导体制造工艺，通常是为了满足特定应用场景对芯片在功耗、电压、信号处理、可靠性等方面的需求而设计的。与大规模生产的标准工艺相比，特色工艺并不完全依赖于缩小晶体管线宽，而是更注重特定功能的优化，主要体现在器件结构的改进、工艺方案的调整、材料的选择等多个方面。

在器件结构的改进方面,为了满足高性能、高集成度、高性价比的市场需求,公司基于已有的传统BCD平台,已开发或正在开发BCD与功率器件集成工艺(BCD+SGT)、BCD与数字隔离器集成工艺(BCD+Digital Isolator)、支持120V及以上器件击穿电压的高压BCD工艺、支持单相电流40A及以上的低压大电流BCD工艺等更高价值量、更高技术难度的特色BCD工艺技术平台。

在工艺方案的调整方面,公司基于对指纹识别芯片工艺技术与产品应用的深刻理解,通过调整工艺方案,不但将传统的双电压工艺优化为单电压工艺,并且搭配大幅减少光刻层数的工艺方案,显著降低了芯片成本,助力客户提升产品竞争力。

在材料选择方面,公司通过在硅基晶圆衬底上生长锗外延层,解决了室温下硅材料在近红外波段光响应弱的问题,使光电探测器在响应波段具备了高响应度、高带宽和低暗电流等关键特质,从而有效提升了公司硅光工艺技术平台的器件性能与集成能力。

二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况

(一) 发行人所属行业及确定所属行业的依据

公司是一家专注于特色工艺的12英寸晶圆代工企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)大类中“电子器件制造”(C397)项下的“集成电路制造”(C3973)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”(分类代码:1.2.1)及“集成电路制造”(分类代码:1.2.4)。

(二) 行业主管部门、行业监管机制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门与监管体制

公司所处的半导体行业主管部门为工信部,主要职责包括:研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资等项目等。

公司所处的半导体行业主要自律组织和协调机构为中国半导体行业协会，主要职责包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、研究、预测本行业产业与市场，汇集企业要求，反映行业发展呼声；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等任务。

2、行业主要法律法规和政策

公司所处行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。近年来，各相关部委相继出台了多项政策支持行业的发展，相关文件的主要内容如下：

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	主要内容
1	2026 年 3 月	全国人大常委会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器。加快宽禁带半导体产业规模提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用。
2	2025 年 8 月	中国人民银行、工信部、发改委、财政部、金融监管总局、证监会、国家外汇局	《关于金融支持新型工业化的指导意见》	发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资，构建“融资期限与产业周期相协调”的资金保障机制。
3	2024 年 9 月	广东省人民政府	关于印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024-2030 年）》的通知	在符合国家产业政策基础上，大力支持技术先进的光芯片 IDM（设计、制造、封测一体化）、Foundry（晶圆代工）企业，加大基于硅基、锗基、化合物半导体、薄膜铌酸锂等平台材料，以及各类材料异质异构集成、多种功能光电融合的光芯片、光模块及光器件的产线和产能布局。
4	2024 年 3 月	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求	2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于 65nm（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	主要内容
			的通知》(发改高技〔2024〕351号)	
5	2024年1月	广东省发改委、广东省科技厅、广东省工信厅	关于印发《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2023-2025年)》的通知	以广州、深圳、珠海为核心区域,积极推进特色制程和先进制程集成电路制造,加快培育化合物半导体,在晶圆制造工艺、FPGA、DSP、数模混合芯片、模拟信号链芯片、射频前端、EDA工具、关键IP核等领域实现突破,打造涵盖设计、制造、封测等环节的全产业链。
6	2023年8月	工信部、财政部	关于印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案的通知》(工信部联电子〔2023〕132号)	提升产业链现代化水平。聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域,推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,促进产业链上中下游融通创新、贯通发展,全面提升产业链供应链稳定性。
7	2022年12月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》	深入推进国家战略性新兴产业集群发展,建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力,推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。
8	2022年8月	国家产业基础专家委员会	《产业基础创新发展目录(2021年版)》	基础零部件和元器件、基础材料、工业基础软件、基础制造工艺及装备、产业技术基础创新发展目录,列入了我国产业基础发展的核心产品和技术,涵盖显示驱动芯片、ADC/DAC/Tranceiver、手机高性能电源管理芯片PMIC等基础零部件和元器件。
9	2022年1月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域,发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势,提高数字技术基础研发能力。
10	2021年12月	中央网络安全和信息化委员会	《“十四五”国家信息化规划》	加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新,加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发,推动绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。
11	2021年8月	广东省人民政府	《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》	依托广州、深圳、珠海做大做强特色工艺制造,广州以硅基特色工艺晶圆代工线为核心,布局建设12英寸集成电路制造生产线;深圳定位28纳米及以下先进制造工艺和射频、功率、传感器、显示驱动等高端特色工艺,推动现有生产线产能和技术水平提升。
12	2021年7月	工信部、科技部、财政部、	《关于加快培育发展制造业优质企业的指	组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	主要内容
		商务部、国资委、证监会	导意见》(工信部 联 政 法 (2021) 70 号)	件、基础工艺、集成电路等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
13	2021 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
14	2021 年 4 月	广东省人民政府	《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	发挥广州、深圳、珠海的辐射带动作用,形成穗莞深惠和广佛中珠两大发展带。积极发展第三代半导体、高端 SOC、FPGA(半定制化、可编程集成电路)、高端模拟等芯片产品,加快推进 EDA 软件国产化,布局建设较大规模特色工艺制程生产线和 SOI 工艺研发线,积极发展先进封装测试。
15	2021 年 1 月	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》	重点发展微型化、片式化阻容感元件,高频率、高精度频率元器件,耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块,小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件,高性能、多功能、高密度混合集成电路。
16	2020 年 7 月	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国发〔2020〕8 号)	为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,推出一系列支持性财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作政策。

3、行业主要法律法规及行业政策对发行人经营发展的影响

发行人所处行业是国家重点鼓励发展的高新产业,政府在财税、投融资、研究开发、人才、市场应用等领域对集成电路产业提供全方位的政策支持,为公司以及集成电路全产业链的健康长远发展提供了有力保障。发行人所处的晶圆代工行业是中国半导体和集成电路产业链中极为重要的一环,其发展牵动了消费电子、汽车、工业控制、通信、人工智能、交通等各下游领域的发展。相应政策和法规的发布落实,为半导体行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持,促进了半导体行业的发展,为公司创造了良好的经营环境。

（三）行业发展特点及发展态势

1、半导体行业概况

（1）半导体行业简介

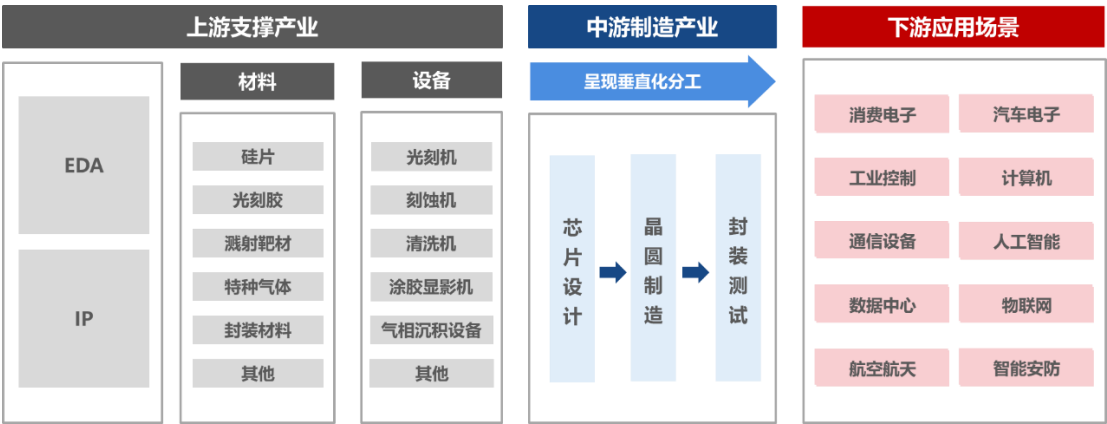
半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是诸多电子产品的核心部件，常见的半导体包括硅、锗等元素半导体和碳化硅、砷化镓、氮化镓等化合物半导体。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于移动通信、消费电子、计算机、汽车电子、航空航天、工业电子等核心领域。

按产品划分，半导体产品可分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器，其中集成电路占 80%以上的份额；其中，集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、微处理器和模拟电路。集成电路是绝大多数电子设备的核心组成部分，也是现代信息产业的基础，下游应用较为广泛。

（2）半导体产业链

半导体行业呈现垂直化分工格局，上游为半导体支撑产业，包括 EDA、IP、集成电路原材料及集成电路设备；中游为半导体制造产业，涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节；下游为各终端应用场景。

半导体产业链



其中，半导体制造的主要环节如下：

① 芯片设计

芯片设计是指通过电路设计，将系统、逻辑与性能的要求转化为电路设计版图，系后续晶圆制造环节的基础。

② 晶圆制造

晶圆制造是指根据电路设计版图，通过光刻、刻蚀、离子注入、退火、扩散、化学气相沉积、物理气相沉积、化学机械研磨、晶圆检测等工艺流程，在半导体硅片上生成电路图形，产出可以实现预期功能的晶圆片。

③ 封装测试

封装测试过程包括封装、测试两个环节，是集成电路进入终端系统前的最后一道工序。其中，封装是指通过切割、焊线、塑封等工艺，为晶圆提供物理保护，并使其与外部器件实现电气连接；测试是指在晶圆封装后，利用集成电路测试专用设备和工具，对其功能和性能进行测试。

(3) 半导体行业经营模式

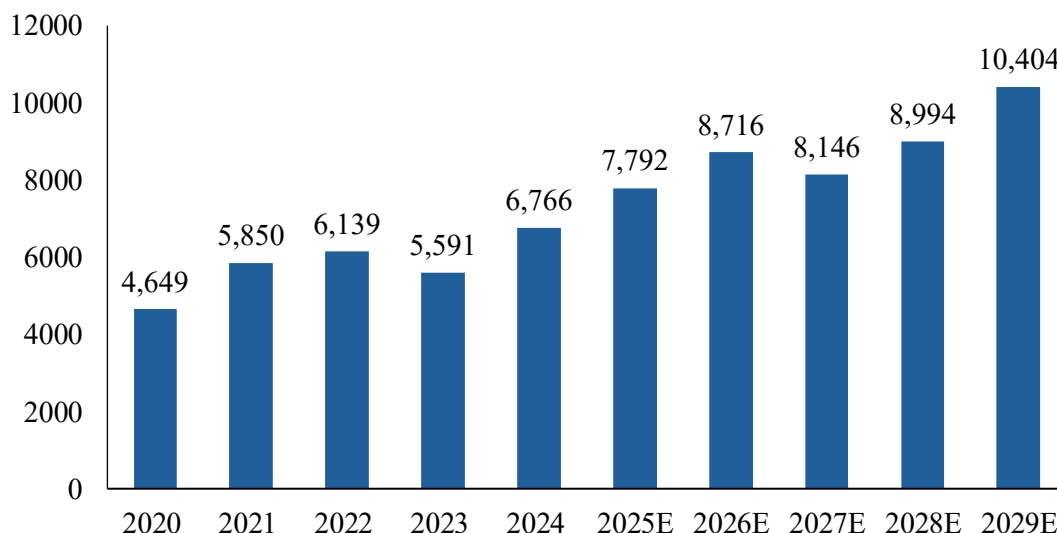
根据所包含的集成电路生产环节的不同，集成电路厂商可分为垂直整合模式（IDM 模式）、晶圆代工模式（Foundry 模式）和无晶圆厂模式（Fabless 模式）。

序号	模式	内容简述	代表企业
1	垂直整合模式（IDM 模式）	涵盖集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测以及后续的产品销售等环节	英特尔、三星、德州仪器、英飞凌等
2	晶圆代工模式（Foundry 模式）	不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务	台积电、中芯国际、联华电子、格罗方德、华虹宏力、发行人等
3	无晶圆厂模式（Fabless 模式）	不涵盖集成电路制造环节和集成电路封测环节，专门负责集成电路设计和后续的产品销售，将集成电路制造和封测外包给专业的集成电路制造、封测企业	高通、英伟达、联发科技、兆易创新等

(4) 全球半导体行业市场规模

随着人工智能、物联网、汽车电子、消费电子、云计算等多个应用领域的市场增量需求，半导体行业迎来蓬勃发展。根据 TechInsights 统计，2024 年全球半导体市场规模提升至 6,766 亿美元，同比增长 21.02%。预计 2029 年全球半导体行业市场规模将进一步增长至 10,404 亿美元，2024-2029 年均复合增长率为 8.99%。

2020-2029 年全球半导体行业市场规模（亿美元）



数据来源：TechInsights

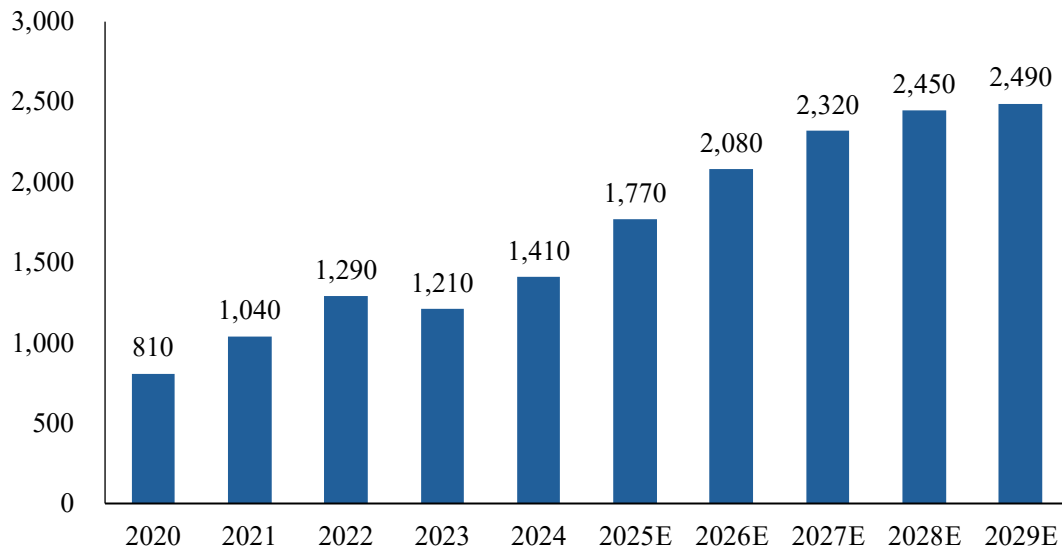
2、晶圆代工行业概况

（1）晶圆代工行业简介

晶圆代工行业源于集成电路产业链的专业化分工，晶圆代工企业不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片设计公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的研发成本、资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。根据 Chip Insights 统计，2025 年全球专属晶圆代工行业市占率前五名分别为台积电（74.25%）、中芯国际（5.92%）、联华电子（4.54%）、格罗方德（4.21%）、华虹集团（2.86%），行业前五大企业市场集中度达 91.78%。

（2）全球晶圆代工行业市场规模

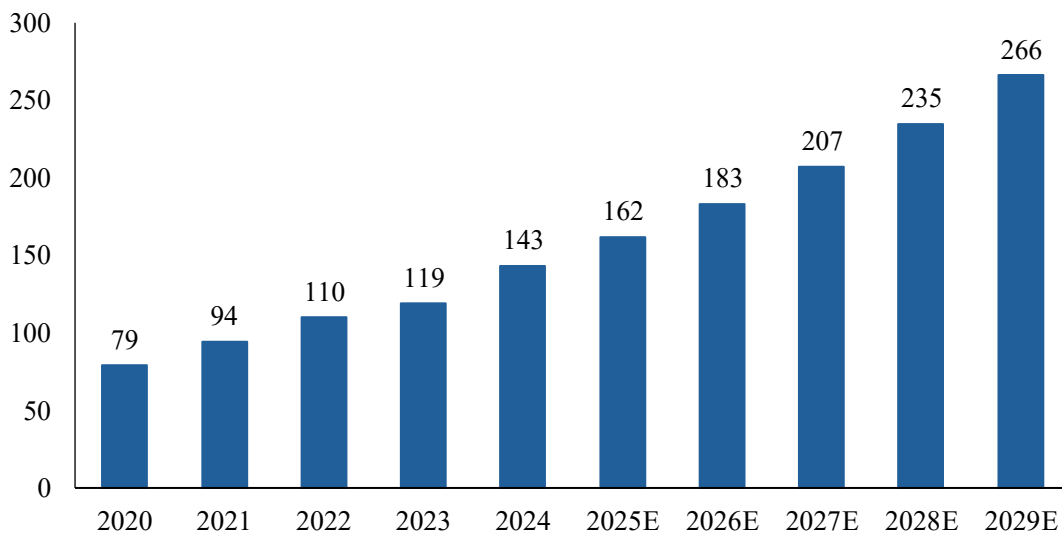
受到全球宏观经济波动、行业下行周期等影响，全球集成电路行业于 2023 年进入低谷。根据 Yole 统计，2023 年全球晶圆代工行业市场规模为 1,210 亿美元，同比下降 6.20%。2024 年，全球晶圆代工行业迎来回暖，市场规模达到 1,410 亿美元，同比增长 16.53%，预计 2029 年全球晶圆代工市场规模将达到 2,490 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 12.05%，领先全球半导体行业市场规模 8.99% 的年均复合增长率。未来随着人工智能、智能驾驶、智慧工业、新一代移动通讯及物联网等行业的发展与相关技术升级，预计全球晶圆代工行业景气度将进一步提升。

2020-2029 年全球晶圆代工行业市场规模（亿美元）

数据来源：Yole

（3）中国晶圆代工行业市场规模

根据 SEMI 等机构统计，2024 年中国晶圆代工行业市场规模提升至 143 亿美元，同比增长 20.17%；预计 2029 年将达到 266 亿美元，2024-2029 年均复合增长率预计为 13.22%。未来，随着中国半导体产业链逐渐完善、产业内生性及国产替代需求增加，预计中国晶圆代工行业市场将持续保持较高速增长趋势。

2020-2029 年中国晶圆代工行业市场规模（亿美元）

数据来源：SEMI、Omdia、Frost&Sullivan

3、模拟芯片行业概况

(1) 模拟芯片行业简介

模拟芯片主要是指用于处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路;根据功能不同,模拟芯片可细分为电源管理芯片和信号链芯片等。根据 Statista 统计,2024 年全球模拟芯片行业市场规模为 826.8 亿美元,约占集成电路市场规模的 15%。

与数字芯片相比,模拟芯片拥有设计难度高、工艺类型复杂、细分品类多、下游应用广、生命周期长等特点,具体如下:

项目	模拟芯片	数字芯片
处理信号	连续函数形式的模拟信号	离散的数字信号
设计难度	设计门槛高,严重依赖设计经验,芯片设计师平均学习曲线 10 年以上	EDA 辅助设计软件成熟,芯片设计师平均学习曲线 3 年左右
工艺类型	工艺标准化程度低,需要通过特色工艺与设计结合实现定制化需求,采用 CMOS、Bipolar、DMOS、BiCMOS、BCD 等工艺	工艺标准化程度高,主要采用 CMOS 工艺
制程节点	目前业界大量使用 180nm-55nm,少量使用 40nm/28nm	按照摩尔定律的发展,使用最先进的工艺,目前 3-5nm 工艺已量产
产品应用	放大器、信号接口、数据转换、比较器、电源管理等	CPU、微处理器、微控制器、数字信号处理单元、存储器等
产品特点	产品种类较多	产品种类较少
生命周期	长,一般 5-10 年,甚至超过 10 年	短,一般 2-3 年

① 模拟芯片设计与工艺协同要求高

模拟芯片的设计主要依赖于物理和电路,设计需要考虑元器件的特性、匹配、噪声、失真等因素,并且制造工艺较为复杂,需要通过特色工艺与设计结合实现定制化需求,会采用 CMOS、Bipolar、DMOS、BiCMOS、BCD 等多种工艺。

② 模拟芯片主要采用成熟工艺节点

与数字芯片追求工艺节点持续微缩不同,模拟芯片的核心性能指标在于低失真、高信噪比及高可靠性与稳定性等,而非仅运算速度。因此,模拟芯片的工艺节点主要分布于 180nm-55nm,仅少量采用 40nm/28nm 工艺。同时,模拟芯片制造对设备要求相对较低,无需依赖成本高昂且受出口管制的高端光刻机等设备。这一特性为中国模拟芯片行业创造了相对有利的发展条件,其技术提升更依赖企

业自身的研发能力与经验积累，受外部因素的制约较小。

③ 模拟芯片细分品类多、应用领域广

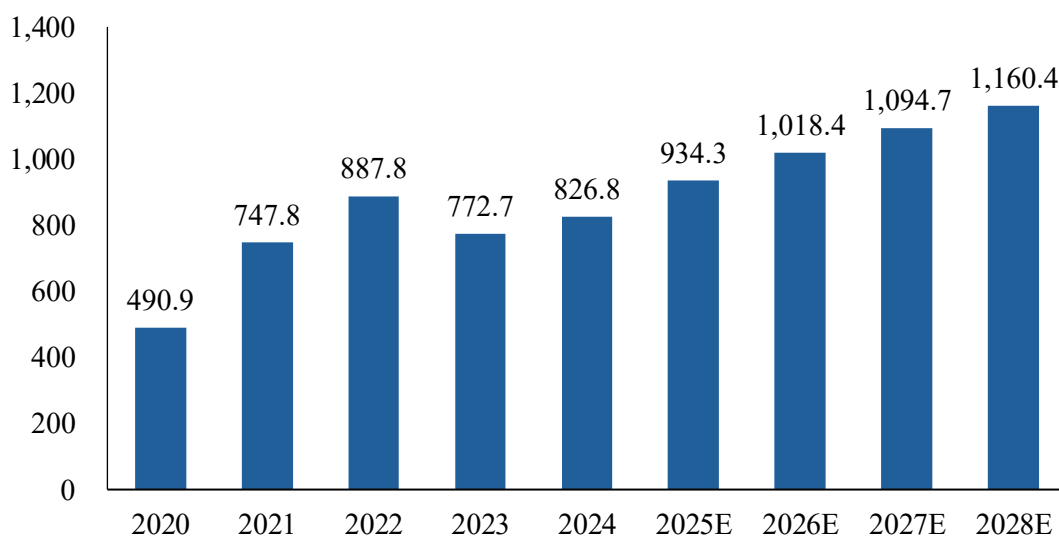
模拟芯片更加注重满足现实世界的物理需求以及特殊功能的实现，其应用领域较广，下游市场对于模拟芯片品类的需求多样化，扩充产品品类、完善产品体系是模拟芯片企业保持行业竞争地位的重要方式。以行业龙头厂商德州仪器（2023 年全球模拟芯片行业市占率为 19%）为例，其通过广泛的产品组合及终端市场应用构筑公司竞争护城河：一是产品线丰富，包括 17 个产品类别，覆盖器件近 14 万种；二是产品下游应用广泛，应用于工业自动化、汽车电子及消费电子等多个领域。

④ 模拟芯片生命周期长、客户粘性强

相较于数字芯片，模拟芯片的认证流程更为复杂且周期漫长，其迭代速度受摩尔定律影响较小，因而达标产品的生命周期通常更长。以汽车应用为例，车规级芯片需在极端温度、震动、湿度及电磁干扰等恶劣条件下确保高稳定性和安全性，其认证周期长达 18 至 24 个月，从研发到量产的全流程更可长达 3 至 5 年。较长的认证周期导致下游客户更换供应商时，必须重新进行全套验证，转换成本较高，也使得单颗达标芯片的市场生命周期得以大幅延长。

（2）全球模拟芯片市场规模

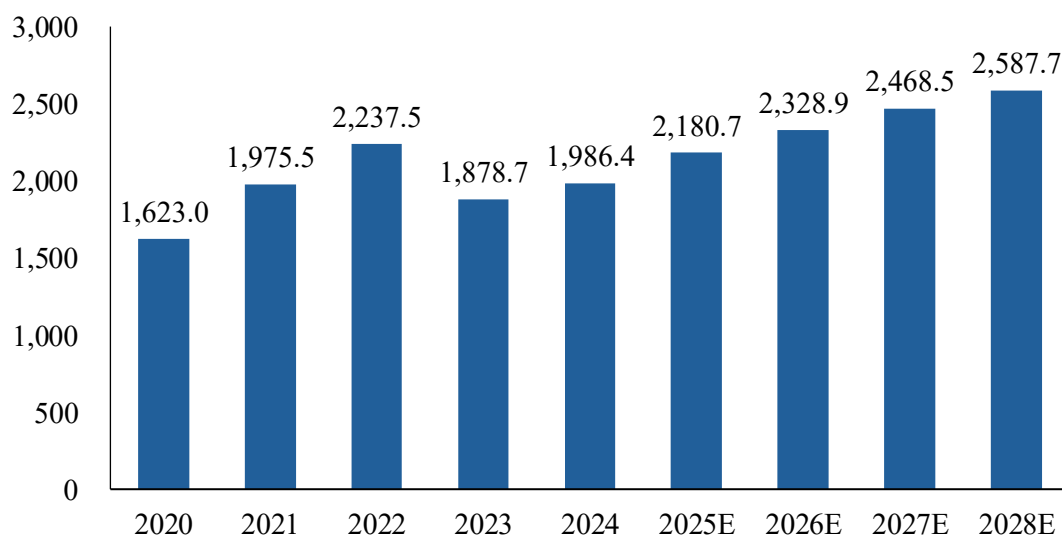
根据 Statista 统计，2024 年全球模拟芯片行业市场规模为 826.8 亿美元，同比增长 7.00%，预计 2028 年全球模拟芯片行业市场规模将达 1,160.4 亿美元，2024-2028 年均复合增长率为 8.84%。

2020-2028 年全球模拟芯片行业市场规模（亿美元）

数据来源：Statista

(3) 中国模拟芯片市场规模

根据 Statista 统计，2024 年中国模拟芯片行业市场规模为 1,986.4 亿元，同比增长 5.73%，预计 2028 年中国模拟芯片行业市场规模将达 2,587.7 亿元，2024-2028 年均复合增长率为 6.83%。中国在 5G、工业自动化及汽车智能化等领域的快速推进，持续释放对高性能模拟芯片的需求。中国已成为全球最大的模拟芯片消费市场，但是自给率仍然较低。根据智研咨询统计，中国模拟芯片自给率从 2019 年的 9% 提升至 2024 年的 16% 左右，国产替代空间巨大。

2020-2028 年中国模拟芯片行业市场规模（亿元）

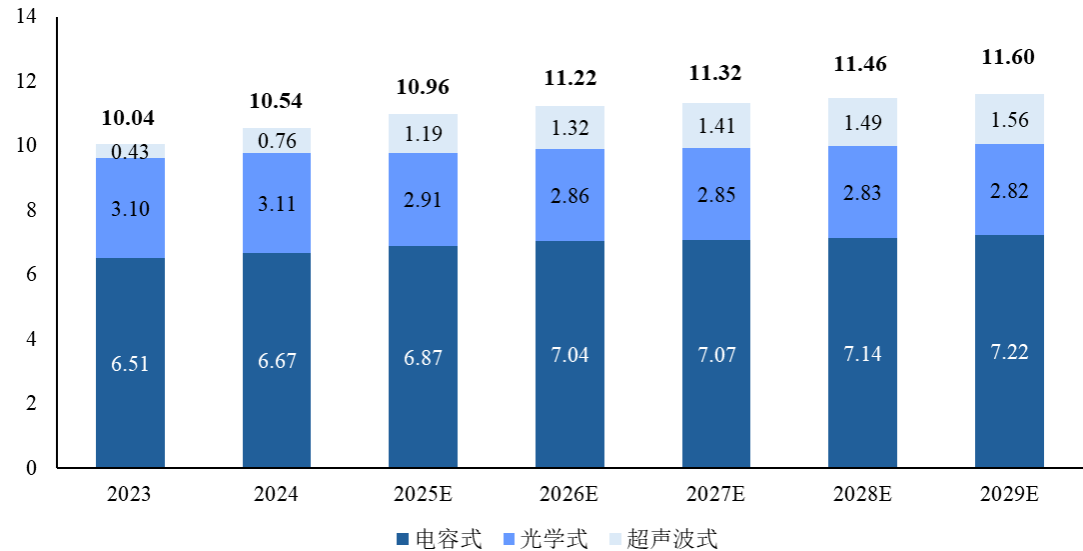
数据来源：Statista

4、特色工艺晶圆代工产品细分领域的发展概况

(1) 指纹识别芯片行业概况

指纹识别芯片是集成指纹图像采集、特征提取和比对功能的嵌入式芯片，广泛应用于智能终端、智能门锁、金融支付、物联网设备等领域。目前，市场主流的指纹识别技术主要可以分为电容式指纹识别、光学指纹识别和超声波指纹识别。随着市场对手机高屏占比、薄机身的追求，传统电容式指纹识别将逐渐被光学式、超声波式屏下指纹识别替代；其中，超声波指纹识别技术正逐步实现技术成熟与成本优化，推动其在智能手机市场加速普及，有望进一步扩大在中高端机型的渗透。但是凭借技术成熟、成本较低等特性，电容式指纹识别芯片仍在中低端智能手机、个人电脑、智能门锁、家电设备等领域占据主要市场份额。根据 Omdia 统计，2024 年全球指纹识别芯片出货量为 10.54 亿颗，其中电容式指纹识别芯片 6.67 亿颗，占比 63.27%；光学式指纹识别芯片 3.11 亿颗，占比 29.52%；超声波指纹识别芯片 0.76 亿颗，占比 7.21%。预计 2029 年全球指纹识别芯片出货量将增加至 11.60 亿颗，其中超声波指纹识别芯片出货量将达 1.56 亿颗，全球超声波指纹识别芯片 2023-2029 年均复合增长率预计为 24.08%。

2023-2029 年全球指纹识别芯片出货量（亿颗）



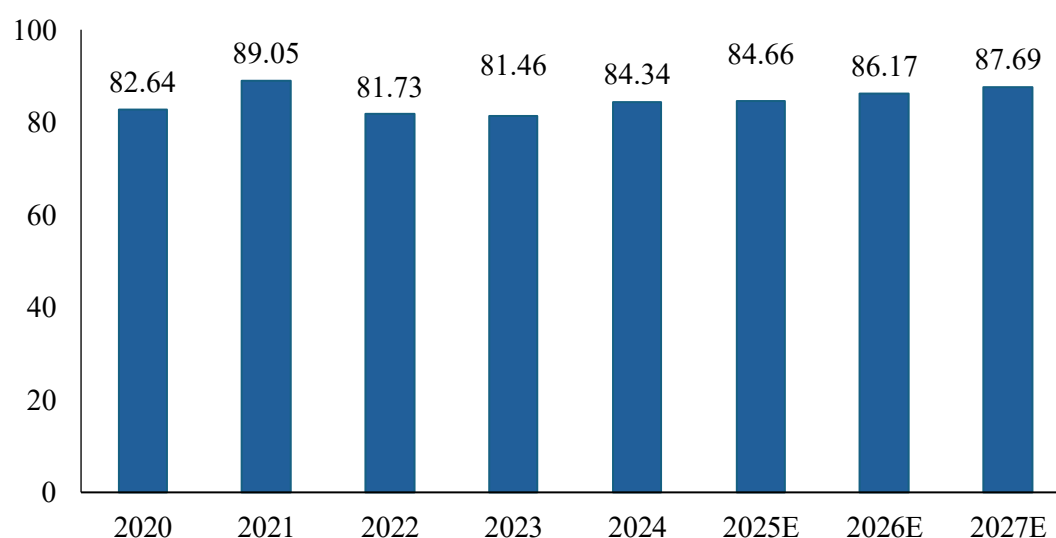
数据来源：Omdia

(2) 显示驱动芯片行业概况

面板显示驱动芯片（DDIC）是显示面板的主要控制器件，通过向显示面板发送驱动信号和数据，实现对屏幕亮度和色彩的控制，使得图像信息能够在屏幕

上显示。根据 CINNO Research 统计，2024 年全球显示驱动芯片需求量为 84.34 亿颗，同比增长 3.54%，预计 2027 年全球显示驱动芯片需求量将达 87.69 亿颗，市场需求整体较为平稳。

2020-2027 年全球显示驱动芯片需求量（亿颗）

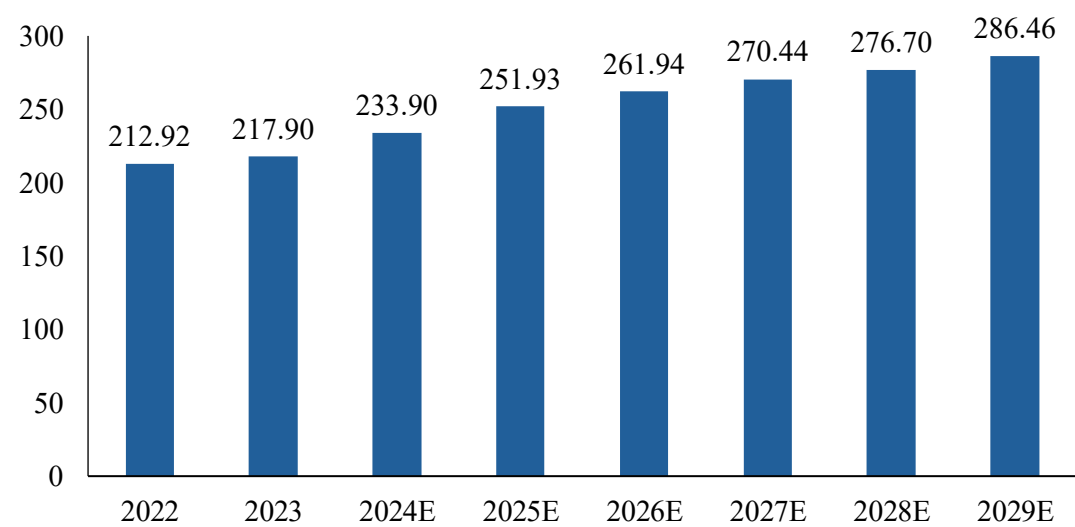


数据来源：CINNO Research

（3）CMOS 图像传感器行业概况

CMOS 图像传感器（CIS）是一种采用 CMOS 工艺制造的图像传感元件，是将光子转换为电子进行数字处理，把图像信号转换为数字信号的芯片，广泛应用于智能终端、汽车电子、移动支付、安防监控、医疗影像等领域，已成为移动互联网和物联网应用的核心传感器件。智能驾驶、智能工业、智能安防等技术的快速发展驱动了终端市场对摄像头的需求，CMOS 图像传感器市场呈现出了良好的发展态势。根据 Yole 统计，2024 年全球 CMOS 图像传感器市场规模将达 233.90 亿美元，同比增长 7.34%，预计 2029 年市场规模将达到 286.46 亿美元，2024-2029 年均复合增长率为 4.14%，呈现逐年稳步上升的态势。

2022-2029 年全球 CMOS 图像传感器市场规模（亿美元）



数据来源：Yole

（4）电源管理芯片行业概况

电源管理芯片在电子设备系统中负责管理电源供应、功率输出、电源滤波和电压调节等功能，主要包括线性稳压器（LDO）、电池管理芯片、DC-DC 开关稳压器、AC-DC 转换器和控制器、BMS 电源管理等产品。

新能源汽车、工业控制等领域的快速发展，推动电源管理芯片的需求增加，根据 Mordor Intelligence 统计，2025 年全球电源管理芯片市场规模为 416.6 亿美元，2030 年有望达到 596.4 亿美元，2025-2030 年均复合增长率约为 7.44%。根据 WSTS、Frost&Sullivan 等机构统计，2025 年中国电源管理芯片市场规模预计为 1,417 亿元，预计 2029 年将达 2,234 亿元，2025-2029 年均复合增长率约为 12.05%，预计中国电源管理芯片市场规模将持续保持较高增速。

（5）硅光行业概况

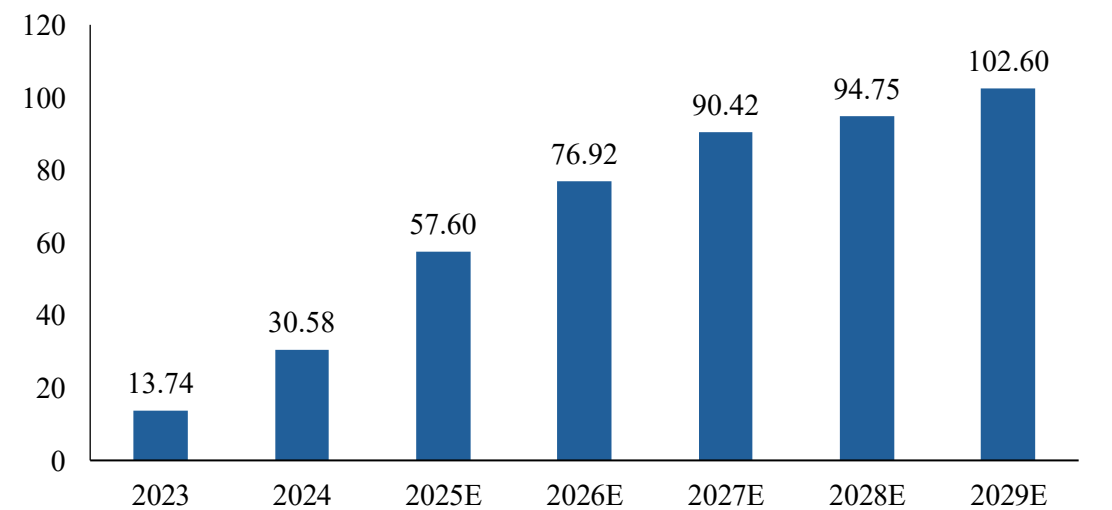
硅光（SiPho）工艺技术是一种基于硅光子学的高速光通信技术，融合了 CMOS 的超大规模逻辑、高精度加工优势以及光子技术的高带宽、低功耗特性，成为后摩尔时代的关键技术之一。硅光的核心理念是“光电融合”，即用光信号替代电信号传输数据，并将光学与电子元件集成于单一芯片。硅光技术的应用方向主要为光传输、光感知和光电计算三大方向，具体如下：

分类	应用方向
光传输	聚焦高速光互连，支撑数据中心、5G 及光通信网络的发展

分类	应用方向
光感知	应用于激光雷达（如自动驾驶、机器人）、生物医疗传感及特殊电子系统
光电计算	赋能人工智能、超级计算机等高性能计算场景，突破传统芯片的算力瓶颈

随着人工智能生成内容时代加速到来，以 DeepSeek、ChatGPT 为代表的生成式人工智能正引领全球科技变革浪潮，大模型参数呈百倍级跃升，数据中心算力需求持续攀升。在这场技术变革中，传统电互连逐渐显现瓶颈，光互联正以更高带宽、更低功耗、更低时延、高可靠性等优势，迅速崛起为支撑智算中心高效运行的“神经系统”。硅光光模块凭借高度集成优势，显著降低光模块成本、体积及功耗。Meta、微软、谷歌等国际巨头正加速导入硅光光模块，国内则以阿里云、腾讯为代表，积极布局并导入硅光光模块。根据 Yole 预测，2029 年全球硅光光模块市场规模预计将达 102.60 亿美元，2023-2029 年均复合增长率接近 40%。

2023-2029 年全球硅光光模块市场规模及预测（亿美元）



资料来源：Yole

为实现更小的尺寸、更高的性能、更低的功耗等性能，硅光技术开始从芯片层面进一步向封装层面深度融合，催生出光电共封(CPO)与光接口(Optical I/O)两大技术方向。其中，光电共封技术的核心是将光引擎与交换芯片、GPU 等计算芯片在封装层面直接集成，替代传统的分离式架构，通过缩短芯片间的互联距离进一步降低时延；光接口技术则是聚焦芯片内部与芯片间的超高速互联，通过将硅光芯片与 GPU/XPU/CPU 等计算芯片封装在同一基板上，直接以光信号替代电信号实现芯片级数据传输，进一步实现了更高的带宽密度、更低的延迟与功耗及更小的尺寸，彻底突破传统电接口的带宽与距离瓶颈。

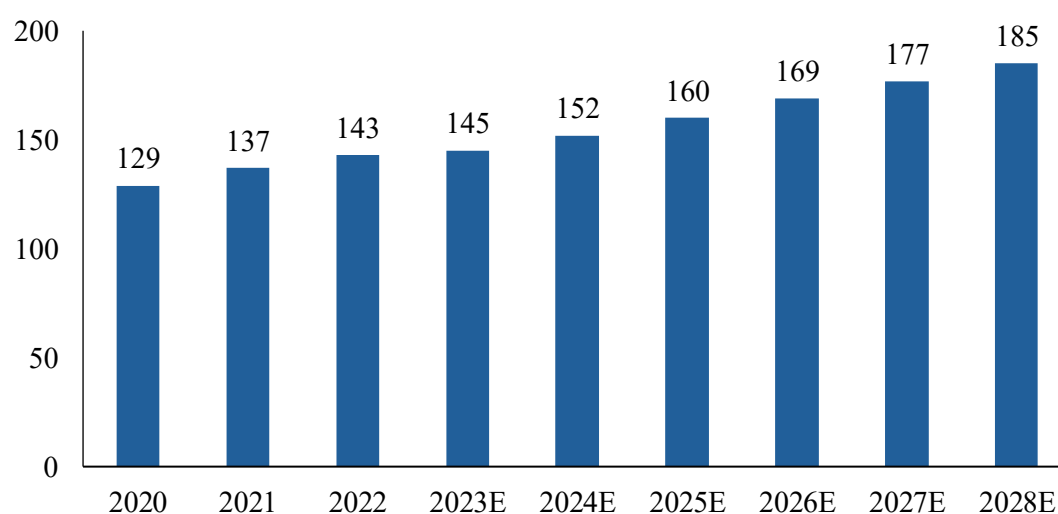
光电共封与光接口技术并非脱离硅光基础的独立方向，而是硅光器件集成、三维集成等技术在封装层面的深化技术。光电共封在“封装级”上解决数据中心跨节点互联瓶颈，光接口在“芯片级”上突破芯片间互联限制，二者共同构成了硅光技术从“器件-芯片-封装-系统”的完整闭环，为智算中心的高性能互联提供了解决方案。

光电共封技术当前正处于市场爆发前期，根据 Yole 统计，全球光电共封市场规模预计将从 2024 年的 0.46 亿美元增长至 2030 年的 81.39 亿美元，2024-2030 年均复合增长率约 137%。随着硅光光模块的渗透率不断提升，叠加光电共封、光接口对更多硅光芯片的需求，预期硅光芯片的市场将持续大幅度增长，必将带动国内光互联产业链的不断升级。

（6）功率器件行业概况

功率器件主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面的大功率的电子元器件，基本的电能转换方式包括逆变、整流、斩波和变频。功率器件可分为二极管、晶体管 and 晶闸管，其中二极管为不可控器件，晶闸管为半控型器件，晶体管为全控型器件，主流的晶体管包括 MOSFET、IGBT、BJT 等。随着新能源汽车和新能源发电产业的快速发展，功率器件市场空间不断扩大。根据 Yole 统计，2022 年全球功率器件市场规模为 143 亿美元，同比增长 4.38%，预计 2028 年将增长至 185 亿美元，2022-2028 年均复合增长率为 4.39%。

2020-2028 年全球功率器件市场规模（亿美元）



数据来源：Yole

5、特色工艺晶圆代工产品终端应用行业发展概况

(1) 消费电子行业拥有广阔的市场空间

消费电子行业属于国家支柱产业,在国民经济生产中占有重要地位。近年来,在技术不断创新等因素推动下,全球消费电子产品创新层出不穷,渗透率不断提升,消费电子行业快速发展,并形成了庞大的产业规模。消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提升,加之我国居民消费水平不断提高,消费电子产品市场需求持续增长,促进了消费电子行业的快速健康发展。

根据 Statista 统计,2018 年,全球消费电子市场规模约为 9,195 亿美元,2023 年增长至 10,276 亿美元,2018-2023 年均复合增长率约为 2.25%。预计 2028 年全球消费电子市场规模将达到 11,767 亿美元,2018-2028 年均复合增长率约为 2.50%,市场规模达到历史新高。

(2) 车规级和工业级芯片市场需求旺盛

受益于智能驾驶和智能座舱的渗透率提升及汽车销量的增加,车用芯片需求量增加。随着技术的成熟和成本降低,越来越多的汽车开始搭载智能驾驶及智能座舱硬件,智能驾驶与智能座舱的渗透率逐渐提升,拉动对上游电子元器件需求。首先智能座舱与智能驾驶带动单车芯片数量倍增,更高阶智能驾驶和智能座舱的要求将会驱动更多微控制器、存储、信号处理、电源管理、电机驱动、图像传感器等芯片的需求,进而带动对车规级芯片晶圆代工服务的需求。根据 Precedence Research 统计,2024 年全球汽车半导体市场规模为 467.9 亿美元,预计 2034 年市场规模将达 1,021.5 亿美元,2024-2034 年均复合增长率达 8.12%。

工业自动化与智能化设备普及率提升带动工业级芯片下游用量增加。自动化智能设备需要实现“感知+决策+控制”的融合,需要视觉传感器、运动控制 MCU 及决策 SoC 等芯片共同支持设备实现自动化及智能化。自动化与智能化工业设备的逐渐增加将会带动工业级芯片需求。

(3) 人工智能带动半导体行业快速发展

在数字化浪潮席卷全球背景下,人工智能已成为引领新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。随着技术从理论走向大规模应用,大模型需要处理海量数据,对芯片的算力、连接、存储、传输带宽及速度等要求进一步提升,带动半导

体行业快速发展。根据头豹研究院数据,2020 年全球人工智能市场规模约为 2,335 亿美元,预计 2030 年市场规模将达到 26,383 亿美元,2020-2030 年均复合增长率约为 27.44%,市场规模增长迅速。

6、进入行业的主要壁垒

(1) 资金壁垒

晶圆代工行业属于资本密集型行业。一方面,晶圆代工行业对专用设备有较高要求,前期需要投入大量资金购买生产设备。另一方面,晶圆代工行业研发投入资金量大,需要大量高级专业技术人员和高水平研发手段。芯片制造公司为保持公司核心竞争力,需要持续投入研发资金,研发市场所需的制程工艺,对后进者而言具有较高的资金壁垒。

(2) 技术壁垒

晶圆代工行业具有技术密集的特点,涉及电子技术、光电子学、激光技术、材料科学、机械工程与化学工程等多个学科领域的知识。集成电路制造公司既需要掌握各种元器件的应用特性,又要掌握先进、复杂的工艺,制造技术难度高。一方面,随着制程工艺的不断提高,晶圆尺寸从 6 英寸到 8 英寸、12 英寸,芯片制程从 180nm 到 28nm/22nm 的平面工艺、14nm 及以下的 FinFET 工艺,晶圆代工企业需要更加丰富的技术储备。另一方面,高质量的芯片不仅需要在体积、容量、安全性方面满足市场要求,模拟芯片还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等多方面的诸多需求,需要较长的学习曲线,具有较高的技术壁垒。

(3) 人才壁垒

芯片制造行业对高端技术人才和高素质管理人员具有较高要求。为保证芯片产品满足不同客户的特定需求,生产出性能稳定、高良品率的芯片产品,需要全方位专业人才,包括富有技术创新力的研发团队、经验丰富的工程师、生产人员、设备维护及厂务建设人员,以及高素质的经营管理人员。由于我国半导体行业起步较晚,行业内资深从业人员较少,专业人才供不应求,对新进入者形成人才壁垒。

(4) 客户资源壁垒

芯片是电子元器件的核心，其可靠性和稳定性对电子产品意义重大。芯片行业下游终端客户对上游芯片供应商的选择极为谨慎。通常而言，下游终端客户会对芯片制造商进行严格的筛选与评测，一款新产品从流片到量产一般需要半年至一年，甚至更长时间。同时，许多芯片设计企业与晶圆代工厂深度绑定，依据代工厂的制程工艺进行芯片设计，一旦设计公司选定晶圆制造厂开始量产后，通常不会再进行更换。因此，晶圆代工行业存在一定的客户资源壁垒。

7、面临的机遇与挑战

(1) 面临的机遇

① 产业政策的大力支持

半导体行业是我国重点鼓励和支持的产业之一，半导体产品被广泛应用于消费电子、汽车、工业控制、通信、交通、安防等领域，在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用。为保证国家经济安全、完善国产半导体产业链条，近年来国家发改委等有关部门陆续出台利好政策，支持半导体产业发展。

② 模拟芯片晶圆代工领域国产替代空间充足

根据 Statista 统计，2024 年全球模拟芯片市场规模为 826.8 亿美元，其中中国模拟芯片市场规模为 1,986.4 亿元，约占全球模拟芯片市场规模的 33.39%。根据智研咨询统计，中国模拟芯片自给率从 2019 年的 9% 提升至 2024 年的 16% 左右。中国模拟芯片行业自给率仍然较低，国产替代空间巨大且长期存在市场机遇。

③ 应用市场快速升级，行业市场空间迅速扩大

随着人工智能、物联网、新一代移动通信等新技术的不断成熟，工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快，下游高科技领域的技术更新，带动了半导体企业的规模增长。下游科技行业的快速升级，已成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业市场空间将迅速扩大。

(2) 面临的挑战

① 与国际集成电路行业龙头的技术差距犹存

与西方主要国家相比,由于起步时间晚、专业人才稀缺、资金投入长期不足等诸多原因,中国大陆集成电路产业在发展上存在着难以避免的滞后性。此外,因地缘政治及多边贸易合作关系变动、国际贸易摩擦升级等不可抗力因素,中国集成电路行业的发展受到一定影响。在多重因素影响下,国内集成电路企业资金、技术仍有短板,在核心技术实力上依然存在很大的提升空间,短期内难以超越国际集成电路行业龙头的领先地位。

② 高端专业技术人才储备不足

集成电路行业属于技术、人才密集型行业,对从业人员的知识背景、研发能力及经验积累均具有较高要求。近年来,中国集成电路行业发展迅速,但具有完备知识储备、具备丰富技术和经营经验、能胜任相应工作岗位的人才仍较为稀缺,这也一定程度上成为了当前制约集成电路行业发展的主要因素。

③ 中国集成电路产业链配套能力有待加强

近年来,中国集成电路产业链上下游快速发展,已取得许多技术突破、高端产品初步量产,在国际集成电路产业链中拥有一定话语权,但是在高端集成电路配套产业方面,与美国、韩国、中国台湾等地区仍存在一定差距。特别是在上游支撑产业方面,目前高端集成电路原材料、设备及零部件仍高度依赖进口,中国集成电路产业链配套能力有待进一步加强。

8、行业周期性特征

半导体及集成电路行业具有一定的周期性波动特征,其主要表征形式为:终端应用领域(如消费电子、汽车电子、工业控制等)的景气度决定其对于各类芯片产品的采购需求,直接影响了芯片供给方(通常为芯片设计公司、芯片方案商)的供给策略,进而传导至芯片制造端(晶圆制造厂、封测厂)及上游的原材料、设备供应商。

发行人所处的晶圆代工行业与宏观经济和半导体及集成电路行业的关联度较高,如果全球宏观经济或半导体及集成电路终端行业出现周期性波动,可能会对发行人的经营状况造成一定影响。

9、发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

发行人所处的晶圆代工行业源自于半导体行业的垂直化、专业化分工，是半导体制造产业极为重要的一环，是将集成电路等产品从设计布图转变为实体芯片的关键步骤。发行人所处行业上游为半导体支撑产业，包括半导体材料、设备、IP、EDA等供应厂商，下游为终端应用场景，包括消费电子、汽车电子、工业控制、人工智能、移动通信等领域。公司自成立至今，致力于提升中国半导体全面国产替代的能力，通过上、下游国产厂商的紧密合作，推动半导体全产业链国产化自主可控。

与上游行业之间，公司持续配合国家半导体和集成电路制造产业的国产化政策，大胆创新、积极引进国产半导体设备、原材料、IP及EDA供应商。在原材料方面，公司的硅片、化学品、特气、研磨液等原材料已引入多家国产供应商；在设备方面，公司在离子注入、刻蚀、薄膜沉积、化学机械研磨等核心工序均已引入国产设备厂商；在IP及EDA方面，公司已与多家国内供应商构建长期合作伙伴关系，已取得多项国产IP授权及EDA。公司持续配合国家战略，对于国产供应链做到“应试尽试”，在帮助公司提升供应链安全的同时，也为国产供应商创造进入专业市场的机会，协助提升国产供应商的整体竞争力。

与下游行业之间，公司采用特色工艺代工，深度协同芯片设计公司及其终端客户的创新模式，推动需求、设计与制造的协同优化，以高标准满足其特色工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。

（四）所属细分行业竞争格局、行业内主要企业

1、行业竞争格局和主要竞争对手

公司所处行业为晶圆代工行业。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，具有较高的进入壁垒，市场集中度较高。中国台湾、美国、韩国等地区进入晶圆代工行业较早，拥有先发优势，经过多年的技术、资本、人才的积累，占据了全球半导体行业中较高的市场份额。中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，在国家政策的大力支持下，中国大陆

晶圆代工行业实现了快速的发展。

公司主要竞争对手包括台积电、联华电子、格罗方德、中芯国际、华虹宏力、晶合集成、芯联集成和燕东微，具体情况如下：

(1) 台积电 (2330.TW)

台积电成立于 1987 年，总部位于中国台湾，是世界领先的晶圆代工企业。台积电的主营业务为集成电路及其他半导体装置的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。台积电代工的主要产品包括逻辑芯片、混合信号/射频芯片、电源管理芯片、MEMS 传感器、显示驱动芯片、CMOS 图像传感器、先进封装等，工艺平台包括智能手机平台、高性能计算平台、IoT 平台、汽车电子平台和数字消费电子平台。2025 年，台积电营业收入为 38,090.54 亿新台币，净利润为 17,153.97 亿新台币。

(2) 联华电子 (2303.TW)

联华电子成立于 1980 年，总部位于中国台湾，专注于逻辑及特殊技术，为电子行业的各项主要应用产品生产晶圆。联华电子的主营业务为集成电路及其他半导体装置的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。联华电子的制程技术及制造解决方案包括逻辑/混合信号、嵌入式高压、嵌入式非易失性存储器、射频 SOI 及 BCD 等。2025 年，联华电子营业收入为 2,375.53 亿新台币，净利润为 415.35 亿新台币。

(3) 格罗方德 (GFS.O)

格罗方德成立于 2009 年，总部位于美国，其代工业务包括 FD-SOI、射频 SOI、FinFET、硅光、硅锗、BCD 及体硅 CMOS 七大技术平台，产品主要应用于智能移动终端、汽车、沟通网络和数据中心、物联网市场等领域。2025 年，格罗方德营业收入为 67.91 亿美元，净利润为 8.88 亿美元。

(4) 中芯国际 (688981.SH)

中芯国际成立于 2000 年，总部位于上海市，是行业内知名的集成电路晶圆代工企业，拥有全球化的制造和服务基地。中芯国际主要工艺平台包括电源/模拟、高压显示驱动、IGBT、嵌入式非易失存储器、非易失存储器、混合信号/射

频、IoT、汽车电子等。2025 年，中芯国际营业收入为 673.23 亿元，净利润为 72.09 亿元。

(5) 华虹宏力 (688347.SH)

华虹宏力成立于 2005 年，总部位于上海市，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务，产品主要应用于手机通讯、消费电子产品、智能卡、物联网、穿戴电子及汽车等设备产品。2025 年，华虹宏力营业收入为 172.91 亿元，净利润为-8.07 亿元。

(6) 晶合集成 (688249.SH)

晶合集成成立于 2015 年，总部位于安徽省合肥市，主要从事 12 英寸晶圆代工业务，已实现显示驱动、CMOS 图像传感器、电源管理、逻辑芯片、微控制器等平台各类产品量产，产品应用涵盖消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制、AI 及物联网等领域。2025 年，晶合集成营业收入为 108.85 亿元，净利润为 4.66 亿元。

(7) 芯联集成 (688469.SH)

芯联集成成立于 2018 年，总部位于浙江省绍兴市。芯联集成主要从事 MEMS 传感器、IGBT、MOSFET、模拟芯片、微控制器的研发、生产及销售，为汽车、新能源、工控、家电等领域提供一站式芯片系统代工方案。2025 年，芯联集成营业收入为 81.82 亿元，归母净利润为-5.74 亿元。

(8) 燕东微 (688172.SH)

燕东微成立于 1987 年，总部位于北京市。燕东微是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。燕东微的主营业务分为产品与方案及制造与服务两大类，面向消费电子、新能源、电力电子、智能终端等多个领域。其中，制造与服务聚焦功率器件、ASIC 等领域，提供晶圆加工服务；产品与方案则为客户提供分立器件及模拟集成电路整体解决方案。2025 年，燕东微营业收入为 18.33 亿元，归母净利润为-3.92 亿元。

2、公司的行业地位

公司是广东省自主培养且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业，专注于模拟芯片制造，规划产能 12 万片/月，为国家集成电路产业战略布局提供重要的产能支撑。根据 SEMI 预测，2025 年粤芯半导体 12 英寸晶圆产能规模位于中国大陆晶圆厂前列。

公司目前已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台，并在部分细分产品领域已建立竞争优势，对应产品出货量位居行业前列。

公司不同工艺技术平台的行业地位情况如下：

工艺技术平台	制程节点/参数指标	主要应用场景	行业地位、发展现状	市场主流产品工艺节点/参数指标
MS	180nm-55nm	指纹识别、LED 显示驱动、电源管理、锂电保护、信号链等	（1）公司是全球出货量领先的电容指纹识别芯片晶圆代工厂之一和国内少数具备硅基 CMOS 超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一； （2）公司手机电源管理芯片已实现全球前三大独立手机芯片公司的其中两家的供应。	180nm-28nm
HV	180nm-55nm	非触控式/触控式 LCD 屏幕显示驱动、电子标签显示驱动等	（1）根据 CINNO Research 统计，2025 年四季度公司高压显示驱动芯片晶圆出货量排名全球晶圆厂第七名、中国大陆晶圆厂第三名； （2）公司是国内主要电子标签显示驱动芯片制造供应商之一。	180nm-40nm
CIS	153nm-55nm	智能手机、安防、平板电脑、数码相机产品等图像传感器等	公司已实现前照式 CMOS 图像传感器及背照式（前段工艺）CMOS 图像传感器大规模量产，广泛使用于各大品牌手机。	153nm-40nm
BCD	180nm-90nm	电池管理、电源管理、信号链等	（1）公司器件性能对标国际主流水平； （2）针对细分应用领域（包括手机快充、信号链、服务器电源等），公司配合客户开展工艺、器件方案的调试和优化，建立差异化竞争优势。	350nm-55nm
eNVM	180nm-95nm	消费、工业微控制器（MCU）等	公司基于 eNVM 技术的内嵌存储微控制器制造工艺产品性能好，性价比高。	180nm-28nm
MOSFET	12V-200V	计算机、新能源汽车、智能家电、电动工具等	（1）公司涵盖了低压、中压到高压的沟槽型 MOSFET 制造平台。通过使用红磷衬底进一步降低导通电阻，大幅度提升了器件性能；通过增加聚酰亚胺保护层、铜电镀层等方式增强了芯片可靠性，适用于车规级产品等高可靠性应用； （2）公司工艺技术平台适用面广，提供多种电压选择，具有一定的竞争力。	12V-200V
IGBT	650V-1700V	工业变频、新能源汽车、光伏发电、储能等	（1）公司的工艺技术水平可对标国际主流工艺水平，满足车规应用需求；	650V-2500V

工艺技术平台	制程节点/参数指标	主要应用场景	行业地位、发展现状	市场主流产品工艺节点/参数指标
			（2）公司的 IGBT 产品正持续实现量产爬坡。	
SiPho	90nm	智算中心光互联、自动驾驶激光雷达等	公司搭建了硅光研发团队，和人工智能领域终端企业紧密配合，根据光芯片需求开发对标全球领先的硅光器件，是国内领先的拥有 12 英寸硅光芯片工艺技术平台及规模化量产能力的公司之一。	180nm-45nm

公司目前各工艺技术平台已覆盖下游主流产品的主要工艺节点，制程节点与同行业可比公司相当。未来，公司计划开展 40nm/28nm/22nm 的技术布局，完善高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术储备和工艺平台，响应数字化模拟技术的市场需求，助力数字中心和人工智能产业拓展。

3、同行业可比公司的选择依据及相关业务可比程度

发行人的主营业务为集成电路制造环节中的晶圆代工业务。发行人选取同行业可比公司主要考虑的因素包括主营业务、主要产品及其应用领域，同时兼顾其经营数据的可获得性及可比性。

发行人根据以上选取依据，选取境外企业台积电、联华电子、格罗方德作为同行业可比公司；选取境内企业中芯国际、华虹宏力、晶合集成、芯联集成、燕东微作为同行业可比公司。

（五）发行人的主要竞争优势和劣势

1、主要竞争优势

（1）平台优势：“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局

公司主要从事集成电路制造环节中的 12 英寸晶圆代工业务，具备集成电路、功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力，涵盖 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台。公司成立以来，紧密贴合模拟芯片行业品类多样化的产品特点，持续丰富自身产品组合，目前已具备较完整的成熟节点工艺制程，可为客户提供 180-55nm 等多个制程节点的特色晶圆代工服务，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面，公司于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台。截至本招股说明书签署日，公司的硅光工艺技术平台累计投片量已超过 1,000 片，已具备规模化量产能力。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高速可插拔硅光光模块应用，与国际领先水平相当。同时，公司与业界先进水平保持同步，开展近封装光学（NPO）的工艺制造技术研发，目前正在导入 3.2T NPO 产品。未来，公司将进一步开展 65nm 硅光及光电融合工艺的研发和量产，实现从可插拔光模块向近封装光学（NPO）、光电共封装（CPO）的演进，以满足市

场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的集成电路制造企业。

(2) 模式优势：打造“终端、设计与制造”的协同优化模式

晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节，是半导体制造产业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和成本优势，但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能（如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性）更依赖于工艺创新与器件优化，而非仅通过制程尺寸缩减，需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线，基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够以高质量的标准，开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时，公司深度协同芯片设计公司及终端客户，推动终端、设计与制造协同优化的创新模式，共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案，积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性，提升了公司的品牌影响力，奠定了公司未来持续快速发展的基础，是公司市场竞争优势的重要体现。

(3) 区位优势：践行“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路

粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一，汇聚智能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智能家电等万亿级产业集群，拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链基础。随着全球产业链的重构，中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显，终端定义需求，终端牵引设计，已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户，掌握市场动态，积极构建生态的区位优势，通过深度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业，打造紧密的产业联盟，打通从设计到制造、再到应用的关键环节，以高效协同、快速响应的服务模式，灵活的经营策略和充分的产能支持，满足客户的多样化需求，激发产业的创新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作，成功攻克硅基超声波指纹识别芯片的制造技术难题，实现了国内该领域的技术突破，打破境外厂商在该领域长期垄断地位，使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。目前，该创新方案已成功导入 VIVO、OPPO 等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

(4) 人才团队优势：国际化专业人才梯队与市场化管理机制，打造竞争活力

公司的技术及管理专家来自全球各地，具有多家国际知名半导体企业的任职经历，核心管理团队更拥有 20 余年的深厚行业积淀。公司具备强大的企业管理及技术研发能力，并已构建起合理的人才梯队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总数达 1,943 人，硕士及以上学历人员占比为 20.48%，拥有 3 年及以上半导体行业经验者超过 60%。

在治理结构方面，公司拥有多元化和专业化的股东背景、完善的公司治理结构、市场化的经营管理机制，赋予了公司高度的灵活性，使其能够快速响应市场需求变化，精准选择产品和发展路径，高效制定商业决策。此外，公司已对核心骨干员工实施了股权激励计划，这不仅显著提高了核心团队的稳定性，更有效激发了员工的创新创造活力，为公司人才优势的巩固与长期可持续发展奠定了坚实基础。

(5) 质量管理体系优势：构筑完备的认证体系，保障市场口碑

公司已通过 ISO 9001、ISO 50001、ISO 14001、ISO 45001 等国际质量管理体系认证；瞄准车规产品产线质量控制要求，建立完善的生产参数控制及质量控制系统、失效模式与影响分析机制（FMEA），并已通过车规生产线质量管理体系 IATF 16949 认证；按照国际权威的德国汽车工业联合会过程审核标准 VDA6.3 要求，系统性构建面向车规级芯片的全生命周期质量管理体系。

一系列完备的质量管理体系和严格的质量控制标准，提升了公司生产经营的规范化水平，保障了公司晶圆代工服务的产品良率和交付质量，有助于公司建立和维护良好的市场口碑和品牌形象，获得客户的高度认可。

(6) 客户优势：携手境内外芯片设计龙头企业，夯实客户基础

公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累，主要客户涵盖境内外多家半导体行业上市公司和龙头企业，凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力，获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司 & 多家细分领域行业龙头企业：全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大 MCU 芯片设计公司，以及多家显示驱动芯片、电源管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的模拟芯片领域，国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率 80%。

基于对公司研发能力、技术平台、产能支持、产品品质、服务配合度的认可，行业龙头企业与公司建立并维持了良好的合作关系。坚实的客户基础，推动公司产品平台的技术迭代和技术积累，不断提升经营业绩和盈利能力。

2、主要竞争劣势

(1) 产能规模仍有进一步扩大潜力

相较于行业头部企业，公司在总体产能规模上仍有进一步扩大潜力。公司目前产能规模相对较小，限制了公司的快速发展，规模经济效应难以显现。产能规模的有效建设，有利于降低单位成本、提升议价能力、缩短交付周期、加强对大客户的吸引力、提高综合资源利用效益，对公司进一步拓展晶圆代工市场、实现公司业务扩张、增强整体市场竞争力，具有重要的意义。

(2) 融资渠道亟待拓展

晶圆代工属于资本密集型行业，产线建设、产能扩充和技术研发均需要大量的资金投入。随着行业技术的更新迭代和国内半导体行业的竞争加剧，公司仍需投入大量的资金用于持续拓展产品种类、精进制程工艺，从而使公司在激烈的市场竞争环境中占据有利的位置。因此，公司亟需通过资本市场平台拓展融资渠道，帮助公司进一步提高市场占有率、盈利能力及可持续发展能力。

(3) 与国际晶圆代工行业巨头在综合竞争力上仍存在一定差距

美国、韩国、中国台湾等地区进入半导体行业较早，拥有先发优势，经过多年的技术、资本、人才的积累，占据了全球半导体行业中较高的市场份额。自 2017 年成立至今，公司凭借卓越的经营模式、研发能力和人才团队，迅速实现多个工艺技术平台的量产，并获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，但在制程节点、工艺积累、品牌知名度、经营规模等方面与国际晶圆代工行业巨头仍存在一定差距。公司仍需进一步加大科研投入、强化研发团队、增强自主创新能力，以提升综合市场竞争力。

(六) 发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

1、生产线数量及代工晶圆尺寸、主要覆盖工艺节点、工艺技术平台覆盖情况及产品应用领域

发行人与同行业可比公司在生产线数量及代工晶圆尺寸、主要覆盖工艺节点、工艺技术平台覆盖情况及产品应用领域等方面的对比情况如下：

公司名称	生产线数量及代工晶圆尺寸	主要覆盖工艺节点	工艺技术平台覆盖情况	产品应用领域
台积电	13 座晶圆厂 (8/12 英寸)	0.5 μ m-2nm	逻辑芯片、混合信号/射频芯片、电源管理芯片、MEMS 传感器、显示驱动芯片、CMOS 图像传感器、先进封装等	高性能计算、智能手机、物联网、汽车电子、消费电子等
联华电子	12 座晶圆厂 (6/8/12 英寸)	0.6 μ m-14nm	逻辑/混合信号、嵌入式高压、嵌入式非易失性存储器、射频 SOI、BCD 等	移动和无线通信、物联网和穿戴式设备、计算和数据处理、车用电子等
格罗方德	4 座晶圆厂 (8/12 英寸)	180nm-12nm	FD-SOI、射频 SOI、FinFET、硅光、硅锗、BCD 及体硅 CMOS 等	智能移动终端、通信基础设施和数据中心、家庭和工业物联网、汽车电子等
中芯国际	7 座晶圆厂 (8/12 英寸)	0.35 μ m-14nm	电源/模拟、高压显示驱动、IGBT、嵌入式非易失存储器、非易失存储器、混合信号/射频等	智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车等
华虹宏力	5 座晶圆厂 (8/12 英寸)	0.5 μ m-40nm	嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等	消费电子、工业及汽车、通讯产品、计算机等
晶合集成	2 座晶圆厂 (12 英寸)	150nm-28nm	显示驱动、CMOS 图像传感器、电源管理、逻辑芯	消费电子、汽车电子、智能家居、工业

公司名称	生产线数量及代工晶圆尺寸	主要覆盖工艺节点	工艺技术平台覆盖情况	产品应用领域
			片、微控制器等	控制、AI 及物联网等
芯联集成	2 座晶圆厂 (8/12 英寸)	1 μ m-55nm	MEMS 传感器、IGBT、MOSFET、模拟芯片、微控制器等	车载、高端消费、工控等
燕东微	2 座晶圆厂 (6/8/12 英寸)	0.35 μ m-65nm	功率器件、BCD、MEMS 传感器、硅光等	消费电子、新能源、电力电子、智能终端等
发行人	2 座晶圆厂 (12 英寸)	180nm-55nm	混合信号 (MS)、高压显示驱动 (HV)、CMOS 图像传感器 (CIS)、嵌入式非易失存储器 (eNVM)、电源管理 (BCD)、硅光 (SiPho)、功率器件 (MOSFET、IGBT)	消费电子、汽车电子、工业控制、人工智能等

注：相关信息根据同行业可比公司公开披露数据整理，可能与其实际情况存在一定差异，仅供参考比对使用；

资料来源：同行业可比公司官网、招股说明书、年度报告等。

2、技术实力及衡量核心竞争力的关键业务数据、指标

发行人与同行业可比公司在技术实力及衡量核心竞争力的关键业务数据、指标的对比情况如下：

(1) MS 工艺技术平台

发行人的 MS 工艺技术平台的制程节点覆盖 180nm 至 55nm，主要代工的产品包括电容指纹识别芯片、超声波指纹识别芯片、手机电源管理芯片、LED 显示驱动芯片、锂电保护芯片、数模信号处理芯片等。MS 工艺技术衍生自 CMOS 工艺技术，同行业可比公司（如台积电、联华电子、中芯国际等）披露的 MS 工艺技术平台，其应用领域及具体芯片种类均与发行人存在较大差异，故未就该平台的技术指标进行比对。

(2) HV 工艺技术平台

发行人的 HV 工艺技术平台的制程节点覆盖 180nm 至 55nm，主要代工的产品包括触控式及非触控式 LCD 屏幕显示驱动芯片、电子标签显示驱动芯片等。公司已构建覆盖大、中、小全屏幕尺寸的 LCD 显示驱动芯片的工艺技术平台，覆盖包括消费电子、工业控制等终端产品。

HV 工艺技术平台的主要技术指标包括制程节点、低压器件电压、中压器件

电压和高压器件电压等。其中，低压器件电压是指逻辑运算器件正常工作的电压，该指标越小越好；中压器件电压是指面板模拟信号器件正常工作的电压，主要依据产品特性和功能需求进行匹配；高压器件电压是指扫描面板的闸极电压，主要依据产品特性和功能需求进行匹配。发行人与竞争对手的对比情况如下：

公司名称	制程节点	低压器件电压	中压器件电压	高压器件电压
发行人	180nm-55nm	1. 2V-3. 3V	6V-8V	13. 5V-42V
晶合集成	150nm-40nm	1. 1V-3. 3V	6V-8V	13. 5V-32V
中芯国际	0. 3μm-40nm	1. 1V-3. 3V	5. 5V-8V	13. 5V-40V
华虹集团 (上海华力)	55nm-28nm	未披露	6V-8V	20V-32V
联华电子	0. 8μm-22nm	0. 8V-5V	3. 3V-9V	9V-40V

数据来源：招股说明书、定期报告等上市公司公告及官网资料等。

(3) CIS 工艺技术平台

发行人的 CIS 工艺技术平台工艺节点覆盖 153nm 至 55nm，主要代工的产品包括前照式、背照式（前段工艺）CMOS 图像传感器。发行人的 CIS 工艺技术平台已集成高性价比的 Pixel 工艺方案，可为智能手机前/后置摄像头提供特色化的解决方案。

CIS 工艺技术平台的主要技术指标包括制程节点、像素尺寸。其中，像素尺寸是指衡量芯片像素大小的核心指标，以单个像素的物理尺寸来衡量，该指标越小越好。发行人与竞争对手的对比情况如下：

公司名称	制程节点	像素尺寸
发行人	153nm-55nm	最小达 1. 12μm
台积电	0. 5μm-16nm/12nm	最小达 0. 56μm
中芯国际	55nm/40nm	未公开披露
晶合集成	90nm-55nm	最小达 0. 702μm
华虹集团	90nm-55nm（华虹宏力）、 55nm（上海华力）	24μm-0. 7μm（上海华力）
新芯股份	55nm	0. 7μm 及以上

数据来源：招股说明书、定期报告等上市公司公告及官网资料等，其中台积电最小像素尺寸系根据 2022 年公开市场报道填列，晶合集成最小像素尺寸系根据 2024 年公开市场报道填列。

(4) BCD 工艺技术平台

发行人的 BCD 工艺技术平台工艺节点覆盖 180nm 至 90nm，具备 5V-120V 的

超宽电压范围，并可为客户提供丰富多样的器件类型及丰富的工艺选择，可满足多元化的应用场景需求。目前，公司的 BCD 平台产品已成功导入消费电子、工业控制及汽车电子等核心应用领域，覆盖低压、中压、高压范围，形成了完整的全电压工艺技术布局。

BCD 工艺技术平台的主要技术指标包括制程节点、工作电压。其中，工作电压是指模拟信号工作的电压区间，主要依据产品特性和功能需求进行匹配。发行人与竞争对手的对比情况如下：

公司名称	制程节点	工作电压
发行人	180nm-90nm	5V-120V
台积电	0.6μm-22nm	未披露
联华电子	0.5μm-55nm	5V-200V
格罗方德	130nm-55nm	5V-85V
华虹集团	0.35μm-55nm	1.5V-700V
芯联集成	0.35μm、0.18μm	5V-150V、250V-650V

注：发行人与联华电子的数据均基于栅极电压（V_g）为 5V 的 BCD 工艺平台，其他同行业可比公司数据则涵盖其全系列 BCD 平台（含多种栅极电压等级）；
数据来源：招股说明书、定期报告等上市公司公告及官网资料等。

(5) SiPho 工艺技术平台

发行人已于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台，目前已具备规模化量产能力，集成低损耗 Si/SiN 波导、高带宽热/电调制器、面耦合器/端侧耦合器以及高速的锗光电探测器等，为下游客户发展智算中心光互联建设、自动驾驶激光雷达等领域提供关键支撑。

SiPho 工艺技术平台的主要技术指标包括制程节点、传输速率。其中，传输速率是指光模块每秒能够传输的数据量，该指标越大越好。发行人与行业主流水平、竞争对手的对比情况如下：

公司名称	制程节点	传输速率
发行人	90nm	支持单通道 100G/200G 的传输速率，可应用于 800G/1.6T 光模块及 3.2T NPO 等产品
高塔半导体	180nm/45nm	支持单通道 200G 的传输速率，可应用于 800G/1.6T 光模块等产品
SiITerra	未披露	支持单通道 100G 的传输速率，正在进行单通道 200G/400G 传输速率技术的研发，可扩展至 1.6T 和 3.2T 光互连架构

数据来源：定期报告等上市公司公告及官网资料、公开报道等。

三、发行人销售情况和主要客户

(一) 发行人主要产品产能、产量及销量

报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量、产销率及产能利用率情况如下表所示：

单位：万片

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能	61.48	47.80	44.95
产量	59.26	40.53	24.83
销量	58.94	41.04	24.90
产能利用率	96.38%	84.79%	55.23%
产销率	99.47%	101.26%	100.28%

注：产能利用率=产量/产能，产销率=销量/产量。

(二) 发行人主营业务收入构成情况

报告期内，公司按照工艺技术平台分类的主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	197,544.22	78.68%	130,971.78	80.26%	75,585.59	74.05%
功率器件代工	53,543.43	21.32%	32,218.36	19.74%	26,491.90	25.95%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

报告期各期，公司主营业务实现的收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元和 251,087.66 万元，由集成电路代工及功率器件代工业务构成。

(三) 发行人产品的主要客户群体

报告期内，发行人的主要客户群体为境内外知名芯片设计公司，客户产品类别涵盖指纹识别芯片、高压显示驱动芯片、图像传感器、电源管理芯片、功率器件等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司客户近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司等多家细分领域行业龙头企业：全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大 MCU 芯片设计公司，以及多家显示驱动芯片、电源

管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的模拟芯片领域，国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率 80%。

（四）发行人主要产品销售价格的变动情况

报告期内，发行人主要产品的平均销售价格情况如下：

单位：元/片

产品类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
晶圆	4,259.79	3,976.39	4,099.47

报告期各期，公司产品销售单价分别为 4,099.47 元/片、3,976.39 元/片和 4,259.79 元/片，销售均价相对稳定。

（五）发行人前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大销售客户的主营业务收入情况如下：

单位：万元

2025 年度				
序号	客户名称	主要产品	金额	占比
1	客户一	晶圆代工	56,684.69	22.58%
2	客户二	晶圆代工	43,241.95	17.22%
3	客户三	晶圆代工	30,003.62	11.95%
4	客户四	晶圆代工	14,660.89	5.84%
5	客户五	晶圆代工	12,798.43	5.10%
合计			157,389.56	62.68%
2024 年度				
序号	客户名称	主要产品	金额	占比
1	客户二	晶圆代工	31,960.00	19.58%
2	客户一	晶圆代工	24,111.45	14.78%
3	客户三	晶圆代工	17,316.71	10.61%
4	客户四	晶圆代工	12,666.89	7.76%
5	客户五	晶圆代工	12,405.72	7.60%
合计			98,460.77	60.34%
2023 年度				
序号	客户名称	主要产品	金额	占比
1	客户二	晶圆代工	25,635.99	25.11%
2	客户五	晶圆代工	10,743.04	10.52%

3	客户四	晶圆代工	8,126.74	7.96%
4	客户一	晶圆代工	5,784.19	5.67%
5	客户六	晶圆代工	4,730.24	4.63%
合计			55,020.20	53.90%

注：同一控制下主体的销售金额已合并披露。

报告期内，公司向前五大客户的合计销售收入分别为 55,020.20 万元、98,460.77 万元、157,389.56 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 53.90%、60.34%、62.68%。公司不存在对单一客户销售额超过当期营业收入 50%的情形，亦不存在对单一客户的重大依赖。

报告期内，公司主要客户与公司及其董事、高级管理人员、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

四、发行人采购情况和主要供应商

(一) 主要原材料和能源采购情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司原材料采购的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅片	38,368.09	28.22%	23,367.83	29.65%	25,192.40	37.68%
备品备件	21,193.79	15.59%	11,561.40	14.67%	9,287.33	13.89%
气体	19,164.70	14.10%	13,444.59	17.06%	9,827.70	14.70%
化学品	16,812.39	12.37%	10,434.59	13.24%	8,166.25	12.22%
其他	40,409.00	29.72%	20,008.60	25.39%	14,379.58	21.51%
总计	135,947.97	100.00%	78,817.02	100.00%	66,853.26	100.00%

2、主要能源采购情况

报告期内，公司能源采购主要为电和水，具体情况如下：

单位：万元、元/度、元/吨

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	单价	金额	单价	金额	单价
电	23,389.23	0.58	18,468.71	0.65	15,384.85	0.71

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	单价	金额	单价	金额	单价
水	1,541.56	3.93	1,000.39	3.34	798.28	3.34

(二) 主要原材料价格变动趋势

报告期内，主要原材料硅片价格情况如下：

报告期	采购总量（片）	采购总金额（万元）	平均价格（元/片）
2025 年度	733,328	38,368.09	523.20
2024 年度	373,828	23,367.83	625.10
2023 年度	283,050	25,192.40	890.03

注：列示的硅片为用于生产晶圆的硅片，不包含挡控片等非生产用硅片。

报告期各期，公司硅片采购单价分别为 890.03 元/片、625.10 元/片和 523.20 元/片，受公司硅片采购国产化率持续提升与上游市场价格整体回落的双重驱动，公司硅片采购单价呈下降趋势。

(三) 发行人前五大供应商采购情况

报告期各期，发行人前五大原材料供应商情况如下：

单位：万元

2025 年度				
序号	供应商名称	金额	占原材料采购总额比例	主要采购内容
1	供应商三	10,200.76	7.50%	硅片
2	供应商一	7,573.09	5.57%	化学品、气体
3	供应商二	6,300.41	4.63%	研磨垫
4	供应商十五	6,012.00	4.42%	硅片
5	供应商四	5,917.41	4.35%	气体
合计		36,003.68	26.48%	
2024 年度				
序号	供应商名称	金额	占原材料采购总额比例	主要采购内容
1	供应商一	6,363.13	8.07%	化学品、气体
2	供应商六	5,224.53	6.63%	硅片
3	供应商四	5,059.89	6.42%	气体
4	供应商七	4,314.97	5.47%	硅片
5	供应商八	3,371.52	4.28%	气体

合计		24,334.04	30.87%	
2023 年度				
序号	供应商名称	金额	占原材料采购总额比例	主要采购内容
1	供应商六	12,422.25	18.58%	硅片
2	供应商七	9,253.70	13.84%	硅片
3	供应商四	4,921.59	7.36%	气体
4	供应商一	4,531.93	6.78%	化学品、气体
5	供应商九	2,217.55	3.32%	硅片
合计		33,347.02	49.88%	

注：同一控制下主体的采购金额已合并披露。

报告期内，公司向前五大原材料供应商的合计采购金额分别为 33,347.02 万元、24,334.04 万元和 36,003.68 万元，占当期原材料采购总额的比例分别为 49.88%、30.87%、26.48%。公司不存在对单一供应商采购比例超过当年采购总额 50% 的情形，亦不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内，公司主要供应商与公司及其董事、高级管理人员、持股 5% 以上股东之间不存在关联关系。

五、发行人的主要资产情况

（一）主要固定资产情况

公司生产经营使用的固定资产主要为机器设备、房屋及建筑物等，均为经营所必备的资产，各类固定资产维护和运行状况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	固定资产账面价值	成新率
房屋及建筑物	236,622.45	212,993.29	90.01%
机器设备	1,834,346.54	1,019,203.40	55.56%
办公设备	14,754.22	6,507.41	44.11%
运输设备	499.65	137.71	27.56%
其他设备	5,951.54	718.04	12.06%
合计	2,092,174.39	1,239,559.85	59.25%

注：成新率=净值/原值。

1、自有房产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有的自有产权房屋建筑物如下：

序号	所有人	权证编号	位置	建筑面积 (m ²)	用途	权利限制
1	发行人	粤（2023）广州市不动产权第 06040910 号	广州市黄埔区凤凰五路 28 号	132,351.321	房屋： 其他	抵押

2、租赁房产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司租赁的房产情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	面积 (m ²)	用途
1	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	发行人	上海市张江高科技园区盛夏路 570 号 10 层 1003A	2025/7/1-2028/6/30	222.46	办公
2	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	发行人	上海市张江高科技园区盛夏路 570 号 10 层 1003B	2025/7/1-2028/6/30	222.47	办公

(二) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权如下：

序号	权利人	权证号码	坐落	取得方式	用途	面积 (m ²)	终止日期	权利限制
1	发行人	粤（2023）广州市不动产权第 06040910 号	广州市黄埔区凤凰五路 28 号	出让	工业用地	140,069	2068/5/3	抵押
2	粤芯三期	粤（2023）广州市不动产权第 06079114 号	中新广州知识城湾区半导体产业园改革大道以东、钟太快速路以北	出让	工业用地	281,425	2072/12/29	无

2、商标

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共拥有 48 项商标。具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、发行人拥有的商标”。

3、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司已取得境内专利 706 项、境外专利 6 项，其中发明专利 343 项、实用新型专利 369 项。具体情况参见本招股说

明书“第十二节 附件”之“六、发行人拥有的专利”。

4、集成电路布图设计专有权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司已取得集成电路布图设计专有权 33 项。具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、发行人拥有的集成电路布图设计专有权”。

5、软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共拥有软件著作权 3 项，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	开发完成日期	权利取得方式	登记号	登记日期	证书号
1	进口货物追溯系统 V001	发行人	2024/12/31	原始取得	2025SR0963287	2025/6/10	软著登字第15619485 号
2	IE Data Center 软件 3.1.4	发行人	2020/4/10	原始取得	2020SR0962734	2020/8/22	软著登字第5841430 号
3	Business Process Management 软件 6.2.10.0726	发行人	2019/6/30	原始取得	2020SR0962741	2020/8/21	软著登字第5841437 号

6、被授权使用的主要技术许可及 IP 授权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人获得的技术许可包括 IMEC、Sharp 等厂商提供的 CMOS、LCD Driver 及 BCD 技术等相关许可；获得的 IP 授权包括标准单元库、存储器编译器、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟 IP。

（三）与发行人生产经营相关的资质

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有与生产经营相关的主要资质如下：

1、高新技术企业证书

序号	授予主体	证书编号	发证机构	有效期
1	发行人	GR202344012834	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2023/12/28-2026/12/27

2、进出口业务相关登记证书

序号	授予主体	资质/证书名称	许可范围	证书编号	发证机构	核发/备案日期
1	发行人	海关报关单位注册登记	进出口货物收发货人	44019609DS	穗东海关	2018/2/12

序号	授予主体	资质/证书名称	许可范围	证书编号	发证机构	核发/备案日期
2	粤芯三期	海关报关单位注册登记	进出口货物收发货人	4401960S6V	穗东海关	2022/11/29
3	粤芯四期	海关报关单位注册登记	进出口货物收发货人	4401961T68	穗东海关	2025/12/30

3、环境保护类证书

序号	授予主体	资质/证书名称	证书编号	发证机构	有效期
1	发行人	排污许可证	91440101MA5AMY9D1D001U	广州开发区行政审批局	2025/12/29-2030/12/28
2	发行人	城镇污水排入排水管网许可证	穗开审批排水[2024]第 62 号	广州开发区行政审批局	2024/6/12-2029/6/11
3	粤芯三期	排污许可证	91440112MABY65CHX7001Q	广州开发区行政审批局	2025/7/31-2030/7/30
4	粤芯三期	城镇污水排入排水管网许可证	穗开审批排水[2025]第 191 号	广州开发区行政审批局	2025/8/4-2030/8/3
5	发行人	辐射安全许可证	粤环辐证[A1568]	广州市生态环境局	2023/12/6-2027/8/11
6	粤芯三期	辐射安全许可证	粤环辐证[A2122]	广州市生态环境局	2025/4/8-2029/3/28

4、主要管理体系认证证书

序号	持证单位	认证标准	证书编号	有效期
1	发行人	ISO 9001:2015	12 100 59051 TMS	2025/11/10-2028/11/9
2	发行人	IATF 16949:2016	12 111 59051 TMS	2025/11/10-2028/11/9
3	发行人	ISO 50001:2018	01223En014R0M	2023/6/28-2026/6/27
4	发行人	ISO 14001:2015	CN23/00003275	2023/9/4-2026/9/3
5	发行人	ISO 45001:2018	CN23/00003278	2023/9/4-2026/9/3
6	发行人	IECQ QC080000:2017	IECQ-H SGSCN25.0061	2025/11/7-2028/11/6
7	发行人	ISO 27001:2022	12 310 59051 TMS	2024/8/19-2027/8/18

(四) 发行人的特许经营权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在特许经营权。

(五) 发行人所拥有的资源要素与所提供产品或服务的内在联系，以及对公司持续经营的影响

发行人目前所拥有的固定资产、无形资产等资源要素，是所提供产品或服务的必要基础，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营构成重大

不利影响的情况。

六、发行人核心技术及研发情况

（一）核心技术情况

1、主要核心技术及技术来源

截至本招股说明书签署日，发行人的主要核心技术情况如下：

序号	类别	技术名称	技术/工艺特点	技术来源	所处阶段
1	集成电路	MS 混合信号芯片工艺技术平台	1、制程范围涵盖 180nm-55nm，1.2V/1.5V/1.8V/3.3V/5V 等多种电压及组合，适用于指纹识别、电源管理、LED 驱动等多种应用场景； 2、可同时支持铝互联、铜互联等工艺技术； 3、工艺光刻层数显著减少，有效降低成本、缩短生产周期。	技术引进并创新升级	180nm-95nm 量产阶段； 55nm 研发阶段
2		HV 高压显示驱动芯片工艺技术平台	1、制程范围涵盖 180nm-55nm，基于逻辑器件结构，融合 13.5V/18V/32V/40V 高压器件，满足大、中、小屏幕显示驱动芯片的需求； 2、可同时支持铝互联、铜互联等工艺技术； 3、支持触控芯片与显示驱动芯片（TDDI）的融合工艺。	技术引进并创新升级	量产阶段
3		CIS 图像传感器芯片制造技术	1、制程范围涵盖 153nm-55nm，具备前照式全流程生产工艺（153nm）及后照式前段生产工艺技术（55nm）； 2、153nm 的前照式 CIS 工艺支持 1.8V/2.8V 双电压，拥有优秀的 HDR 像素性能，实现低暗电流、高信噪比、宽动态范围等性能指标； 3、55nm 的后照式 CIS 工艺支持 1.2V/2.8V 双电压，拥有较少的光刻层数和高像素性能，实现低暗电流、高信噪比、宽动态范围等性能指标。	自主研发	量产阶段
4		BCD 电源管理芯片工艺技术平台	1、制程范围涵盖 180nm-90nm，核心电压 1.5V/1.8V，高压器件实现 5V-120V 宽电压范围，可为客户提供丰富的器件类型及工艺选择； 2、多种器件结构设计有效减小 LDMOS 的尺寸，降低单位面积下的导通电阻、提高器件功率，从而提升产品性能和性价比； 3、采用高压器件沟道自对准工艺技术，提升器件性能的均匀性与稳定性。	技术引进并创新升级	量产阶段

序号	类别	技术名称	技术/工艺特点	技术来源	所处阶段
5		eNVM 嵌入式非易失存储器芯片工艺技术平台	1、提供 180nm-95nm 工艺节点的嵌入式存储单元； 2、EEPROM 闪存单元面积显著减小，提升 MCU 存储容量密度和处理、存储性能； 3、工艺光刻层次显著减少，有效降低成本、缩短生产周期。	自主研发	180nm-153nm、95nm EEPROM 量产阶段； 110nm eFlash 研发阶段
6		SiPho 硅光芯片制造技术	采用 90nm CMOS 兼容工艺，集成低损耗 Si/SiN 波导、高带宽热/电调制器、面耦合器/端侧耦合器以及高速的锗光电探测器等，满足光互联、自动驾驶等不同应用场景需求。	自主研发	预计将于 2026 年二季度实现量产交付
7	功率器件	MOSFET 金属-氧化物-半导体场效应晶体管制造技术	1、提供丰富多样的器件类型及多种衬底工艺类型，电压范围覆盖 12V-200V； 2、实现小尺寸 pitch，器件面积大幅微缩，性能显著提升； 3、较小的比导通电阻，具备击穿电压高、导通电阻小、工作电流大等综合技术优势。	自主研发	量产阶段
8		IGBT 绝缘栅双极晶体管制造技术	1、采用深沟槽蚀刻工艺、超薄片工艺、背面高能离子注入及激光退火等技术，电压范围覆盖 650V-1700V； 2、实现小尺寸 pitch，器件面积大幅微缩，性能显著提升； 3、具备击穿电压高、导通电阻小、工作电流大、高功率等综合技术优势； 4、器件的结构、性能及可靠性满足新能源汽车、光伏、风电、储能及数据中心等新兴行业特定要求。	自主研发	量产阶段

2、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内，发行人核心技术广泛应用于发行人各类特色工艺技术平台中。发行人应用核心技术产生的收入及营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
核心技术产生的收入	251,087.66	163,190.14	102,077.49
营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
占营业收入的比重	97.23%	97.06%	97.80%

3、核心技术的保护措施

（1）知识产权保护

公司为保护无形资产完整、明确科研成果归属，制定了《粤芯半导体知识产权管理制度》等制度，建立了专利注册申请、商业秘密保护的多层次知识产权管理体系。根据前述规定，对于通过公司职务工作形成的技术发明，以公司为主体向国家知识产权局申请注册专利，并对专利发明人实施专利申请奖金、专利授权奖金、优秀发明人奖励等激励形式；如技术发明不适宜进行公开披露，由专利评审委员会审议通过后可将其列为商业秘密保护。

（2）保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，发行人与核心技术人员、主要研发人员等签署《职务成果、保护商业秘密及竞业限制协议》，约定员工在工作过程中研发的或利用发行人生产工具制造的任何性质的知识产权均属于员工的职务成果，该等职务成果归属于发行人所有。员工与公司的劳动关系结束后的 2 年内，应遵守竞业限制义务，不得设立、经营、参与任何与发行人竞争的实体，不得在该等实体工作。

（3）员工持股计划

为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定高级管理人员及核心员工，发行人通过员工股权激励等方式实现对核心员工的有效激励，以稳固公司的高级管理人员及核心技术团队。

（二）在研项目情况

截至本招股说明书签署日，公司正在进行的对公司经营存在重大影响的研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	研发目标	所处阶段
1	180nm BCD 项目	1、基于消费级、工业级的制造工艺，开发高可靠性车规级 BCD 工艺； 2、开发 BCD 功率器件与 SGT 器件的集成工艺，产品可应用于新能源汽车、工业电机、物联网等领域。	持续研发
2	90nm BCD 项目	1、完成低压大电流平面 Driver MOS（DrMOS）器件研发； 2、开发更低导通电阻的 LDMOS 高压器件。	持续研发
3	95nm MS 项目	完成 95nm 工艺平台的高性价比 DEMOS 器件开发，产品可应用于功放、背光驱动等应用场景。	持续研发
4	55nm MS 项目	完成 55nm 逻辑器件工艺开发及后段铜制程工艺开发，优化器件性能，提高器件密度。	技术研发
5	MCU 工艺平台开发项目	基于逻辑工艺基础，开发适用于多种类型的内嵌存储单元工艺。	持续研发
6	90nm HV 项目	开发高耐压、低功耗和高集成度的高压器件，应用场景拓展至车载显示驱动芯片等。	持续研发
7	55nm HV 项目	开发低功耗、高集成度的触控显示驱动芯片工艺，丰富金属互连方案。	持续研发
8	65nm CIS 项目	开发 55nm 前段与 153nm 后段的融合工艺，优化光罩层数，满足安防等领域的需求。	技术研发
9	90nm SiPho 项目	优化 90nm SiPho 工艺，进一步降低波导损耗、优化锗探测器性能、提升调制器带宽、减小光口耦合损耗，为光互联提供更多工艺解决方案。	持续研发
10	PMOS 项目	开发硼掺杂衬底、高密度、低导通电阻沟槽栅器件工艺。	试生产
11	IGBT 项目	完成 IGBT/FRD 全电压覆盖工艺持续优化。	持续研发
12	140nm HV 项目	开发有竞争力的大屏高清显示驱动芯片工艺。	技术研发

（三）科研实力和成果情况

1、承担的重大科研项目情况

发行人秉承以市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有完整的技术布局，并且形成了较强的技术研发及规模化工艺开发能力。发行人自设立以来，承担了多项国家级、省市级半导体领域相关的科研项目。截至本招股说明书签署日，公司承担的部分重大科研项目情况如下：

序号	项目（课题）名称	项目类别	主管单位	项目执行期
1	面向半导体、芯片领域的产业技术基础公共服务平台建设	国家级	工业和信息化部科技公司	2019 年 6 月-2021 年 6 月

序号	项目（课题）名称	项目类别	主管单位	项目执行期
2	工业芯片测试和应用推广公共服务平台	国家级	工业和信息化部科技公司	2021 年 7 月-2023 年 7 月
3	2023 年面向能源电子的电源管理芯片、隔离器件项目	国家级	工业和信息化部电子信息司	2023 年 8 月-2025 年 7 月
4	工业模拟芯片设计与工艺协同可靠性质量技术及标准研究-子课题：高可靠工艺技术研究	国家级	国家科学技术部	2022 年 10 月-2025 年 9 月
5	高频宽带移动通信用滤波器关键技术研究及产业化应用-子课题：高频宽带滤波器的制备	国家级	国家科学技术部	2022 年 11 月-2025 年 10 月
6	高端通用芯片设计关键技术与产品研发	省级	广东省科学技术厅	2019 年 3 月-2021 年 12 月
7	SiC 新型器件的关键技术研究及应用-子课题：器件测试和可靠性评估	省级	广东省科学技术厅	2019 年 8 月-2021 年 7 月
8	基于模拟特色工艺的器件精准模型及 PDK 工艺库研发	省级	广东省科学技术厅	2021 年 9 月-2024 年 9 月
9	基于 2X 纳米及以下 FDSOI 技术的先导工艺研究及低功耗物联网特色引导芯片研发-子课题：RF backend 无源器件开发及模型提取	省级	广东省科学技术厅	2021 年 9 月-2024 年 9 月
10	半导体先进制程用电子特气的研发及产业化	省级	广东省科学技术厅	2023 年 1 月-2027 年 1 月
11	芯片级化学机械抛光材料的研发及产业化	省级	广东省科学技术厅	2023 年 1 月-2026 年 12 月
12	高端模拟数字转换芯片工艺平台研发	省级	广东省科学技术厅	2022 年 12 月-2026 年 12 月
13	新能源汽车座舱域控制器用关键芯片的产业化与上车验证项目	省级	广东省工业和信息化厅	2022 年 1 月-2024 年 12 月
14	新能源汽车功放系统芯片的上车验证与产业化	省级	广东省工业和信息化厅	2023 年 1 月-2025 年 12 月

2、产学研合作情况

公司与国内知名高校及科研单位进行合作，联合培养人才。公司已与中山大学、华南理工大学、香港科技大学、广东省科学院半导体研究所、广州光电存算芯片融合创新中心等多所高校及科研院所展开合作。粤芯半导体博士后工作站与华南理工大学流动站、中山大学流动站紧密合作，截止报告期末拥有多名在站博士后，相关人员在各自的研发细分领域发挥专业才能。

公司主要的产学研合作情况如下：

序号	合作单位	合作情况
1	中山大学	合作建设本科实习教学基地；建立粤芯半导体博士后工作站合作流动站

序号	合作单位	合作情况
2	华南理工大学	合作开展广东省大学生校外实践教学基地建设项目、广东省联合培养研究生示范基地；联合培养博士生，建立粤芯半导体博士后工作站合作流动站
3	香港科技大学	就开发转化技术等开展项目合作
4	广东省科学院半导体研究所	集成电路人才联合培养
5	广州光电存算芯片融合创新中心	共同建设“光电子与光子芯片研发中试平台”，加速高端光电子与光子芯片技术的研发和成果转化

（四）合作研发情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在正在从事的重要合作研发项目。

（五）研发投入情况

报告期各期，公司研发投入金额分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入的比例分别为 58.00%、26.50%和 16.36%。具体如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
研发投入	42,244.27	44,558.73	60,532.47
营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
占营业收入的比重	16.36%	26.50%	58.00%

（六）研发人员及核心技术人员情况

1、研发人员

公司研发人员认定以其所属部门职责及工作具体内容为依据，具体认定标准如下：（1）主要系在研发中心（TD）及运营中心工艺整合部门（FAB PIE）从事研发相关工作的专业人员等；（2）主要负责参与工艺技术平台及新产品应用平台的研发、测试等研发活动；（3）当期研发工时占比不低于 50%。

报告期各期末，公司研发人员数量、占比、学历分布情况如下：

单位：人

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
硕士及以上	211	165	161
本科	117	89	112
大专及以下	15	25	30
研发人员数量合计	343	279	303

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
公司员工总数	1,943	1,677	1,510
研发人员占比	17.65%	16.64%	20.07%

2、核心技术人员

公司核心技术人员共有 5 名，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（三）其他核心人员”。

3、对核心技术人员实施的约束激励机制

公司重视对包括核心技术人员在内的研发人员的吸纳与留用，通过公平、全面的业绩考核及创新激励机制，提升员工创新能力及积极性，从而促进公司的研发实力。公司对核心技术人员实施的约束激励机制主要包括以下内容：

（1）技术研发激励措施

公司在《粤芯半导体知识产权管理制度》中明确了对员工职务发明的奖励措施，以增加员工技术创新的积极性，培养公司研发氛围，形成公司专利技术保护，包括专利申请奖金、专利授权奖金、商业秘密奖金、技术研发中心季度最佳发明人奖等。

（2）中长期激励措施

公司对核心技术人员和主要研发人员进行中长期激励，以加强公司研发团队的稳定性，公司对相关人员执行的股权激励计划参见“第四节 发行人基本情况”之“十七、发行人正在执行的对其董事、高级管理人员、其他核心人员实行的股权激励及其他制度安排和执行情况”。

（3）约束措施

公司已与核心技术人员签订劳动合同、保密协议及竞业禁止协议等，通过知识产权保护的相关制度对职务工作科技成果归属进行约束，并通过严格的信息保护制度实施来管控机密信息和数据。针对参与专项项目的核心技术人员，公司还要求其签署专项保密协议。

（七）发行人的主要荣誉

截至本招股说明书签署日，公司获得的主要荣誉如下：

序号	荣誉名称	授予部门	获奖时间
1	广东专利优秀奖	广东省市场监督管理局	2026年3月
2	广东省政府质量奖提名奖	广东省人民政府	2025年8月
3	广东省先进集体	广东省委、广东省人民政府	2025年4月
4	国家级绿色工厂	工信部	2025年1月
5	广东省五一劳动奖	广东省总工会	2024年4月
6	广东省重点项目	广东省发改委	2024年3月
7	广东省工程研究中心	广东省发改委	2023年4月
8	广东省企业技术中心	广东省工信厅	2022年5月
9	广东省科普教育基地	广东省科技厅	2022年3月
10	广州市半导体和集成电路产业链链主企业	广州市工信局	2021年12月
11	广东省工程技术中心	广东省科技厅	2021年8月
12	广州市独角兽创新企业	广州市科技局	2021年7月

（八）技术创新的机制、技术储备及技术创新的安排

1、技术创新机制及安排

公司致力于增强特色工艺晶圆代工领域的综合竞争实力。通过吸纳半导体产业科研人才，建立长效激励机制，优化研发与生产流程，扩充工艺技术平台和器件种类、拓展与上下游公司合作的模式，从整体上提升自身技术实力。公司实施的技术创新机制及安排包括以下方面：

（1）科研团队建设及人才选拔机制

公司配合业务发展策略和技术发展路线，制定了核心人才战略，利用各种招聘渠道吸纳匹配公司文化和能力要求的人才，并通过完善的人才发展机制为其提供长远的发展计划。

（2）持续加大研发投入力度

未来，除持续投入模拟特色工艺开发外，公司仍将在现有制程优化、良率提升及产品多元化等领域保持稳定的研发投入。通过深化工艺精进与拓展产品组合，公司将持续为技术创新提供强劲驱动力，支撑长期发展战略。

（3）年度业绩考核激励

公司针对核心技术人员订立明确的年度绩效指标及年度考核，依据考核结果进行调薪及奖金发放。

2、技术储备

公司的技术储备情况参见本节之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（二）在研项目情况”。

七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司自成立以来，一直高度重视环境保护工作，严格遵守国家和地方政府颁布的各项环境保护的法律法规，生产经营活动均按照有关环境保护要求运行，公司已通过 ISO 14001、ISO 45001 等管理体系认证，并建立完善的环境管理制度。

公司生产经营中主要排放的污染物可分为废气、废水、固废。主要污染物及相应处理措施如下：

1、废气

报告期内，公司的废气主要包括氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物等。

公司重视废气污染防治，采用先进适用的废气治理技术和装备，来提高装备配置的密闭性，连续化、自动化水平，并采取有效措施从源头减少废气的排放。项目各类工艺废气、沸石转轮燃烧废气、废水处理站酸性废气都已经过有效收集处理。

2、废水

报告期内，公司废水主要分为生产废水和生活废水，生产废水产生于制造过程使用硫酸等试剂以及清洗工序中，包括酸碱中和废水、含氟废水、含氟含氨废水及研磨废水等。

公司按照雨污分流的原则，建设了完善的厂区给排水管网，对污水收集处理系统采取了必要的防腐、防漏、防渗措施，按照“分类收集、分质处理”原则，对各项废水根据水质水量特点分别采取相应处理。

3、固废

报告期内，公司固体废物包括废硅片、包装箱、废液、机台维护保养产生的沾染性抹布等，所有危废由有资质运输单位外运至第三方专业机构进行处理。

公司针对固废污染防治，设置了危险废物和一般固废暂存库，并安排专人做好危险废物的入库、存放、出库等记录；此外，还设置了危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作，生产过程中产生的各类危险废物委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置，按照相关规定办理危废转移联单。

八、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有一家境外全资子公司粤芯国际，其未实际开展经营活动，不存在境外生产性经营资产。公司境外经营主体的具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2026）第 440A006373 号）。投资者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细阅读公司的财务报告及审计报告。

公司提请投资者注意，本节对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行的分析与讨论，应当结合公司经审计的财务报表及财务报表附注，以及本招股说明书其他章节的内容一并阅读。

本节讨论与分析所指的数据，除非特别说明，均指合并口径数据。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、注册会计师审计意见

致同会计师审计了公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字（2026）第 440A006373 号）。致同会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	636,992.25	158,549.44	268,661.36
交易性金融资产	-	-	221.00
应收票据	-	61.87	179.65
应收账款	26,483.81	16,814.72	9,434.33
应收款项融资	520.22	177.83	708.04

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付款项	1,266.29	2,161.57	10,570.06
其他应收款	10,727.21	1,091.12	828.21
存货	53,882.68	36,621.70	47,233.37
其他流动资产	127,261.61	95,778.95	29,371.81
流动资产合计	857,134.06	311,257.20	367,207.82
非流动资产：			
长期股权投资	6,644.95	7,353.79	1,431.20
其他权益工具投资	7,331.82	7,747.54	11,738.47
固定资产	1,239,559.85	841,784.01	708,891.57
在建工程	158,647.41	546,020.79	290,469.43
使用权资产	143.12	37.14	112.58
无形资产	47,368.57	49,609.01	54,957.53
长期待摊费用	99.82	338.27	702.47
其他非流动资产	130,087.46	196,202.88	467,858.14
非流动资产合计	1,589,883.01	1,649,093.43	1,536,161.40
资产总计	2,447,017.07	1,960,350.63	1,903,369.22
流动负债：			
短期借款	13,010.80	1,476.02	63,633.25
交易性金融负债	-	-	221.00
应付票据	43,899.38	21,123.24	1,662.00
应付账款	139,256.53	116,187.71	140,102.58
合同负债	15,308.43	14,602.52	18,137.84
应付职工薪酬	9,319.53	7,617.98	4,720.88
应交税费	654.12	619.73	333.21
其他应付款	93,449.49	54,579.35	54,442.85
一年内到期的非流动负债	156,632.26	53,504.43	36,517.90
其他流动负债	4,102.95	2,549.06	2,631.89
流动负债合计	475,633.49	272,260.04	322,403.41
非流动负债：			
长期借款	1,349,048.61	964,469.84	835,459.06
租赁负债	83.68	3.08	34.33
长期应付款	161,135.20	17,500.00	984.38

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
递延收益	72,668.15	74,691.15	32,713.84
递延所得税负债	-	-	260.77
非流动负债合计	1,582,935.65	1,056,664.07	869,452.38
负债合计	2,058,569.13	1,328,924.11	1,191,855.78
所有者权益：			
股本	236,559.14	236,559.14	236,559.14
资本公积	1,039,396.37	1,037,066.08	1,021,674.60
其他综合收益	-2,674.58	-2,267.29	1,467.21
未分配利润	-1,008,096.75	-773,514.43	-548,187.52
归属于母公司所有者权益合计	265,184.18	497,843.50	711,513.44
少数股东权益	123,263.76	133,583.02	-
所有者权益合计	388,447.93	631,426.52	711,513.44
负债和所有者权益合计	2,447,017.07	1,960,350.63	1,903,369.22

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
其中：营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
二、营业总成本	520,444.74	406,616.75	328,252.09
其中：营业成本	400,930.13	279,962.98	219,471.79
税金及附加	2,513.97	1,407.07	1,138.42
销售费用	4,154.92	4,266.88	3,214.10
管理费用	36,518.68	48,296.98	27,431.28
研发费用	42,244.27	44,558.73	60,532.47
财务费用	34,082.77	28,124.11	16,464.02
其中：利息费用	36,397.58	31,729.35	28,190.76
利息收入	3,622.46	7,744.57	12,036.15
加：其他收益	43,196.54	24,193.29	53,539.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,208.83	-259.36	854.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	154.18

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-192.52	-78.71	-55.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,527.50	-18,092.99	-22,815.11
三、营业利润（损失以“-”号填列）	-248,940.19	-232,721.63	-192,202.69
加：营业外收入	28.13	42.95	644.35
减：营业外支出	102.92	45.25	153.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
归属于母公司所有者的净利润	-234,582.32	-225,326.91	-191,711.34
少数股东损益	-14,432.65	-7,397.01	-
六、其他综合收益的税后净额	-407.29	-3,734.50	1,475.75
七、综合收益总额	-249,422.26	-236,458.43	-190,235.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-234,989.61	-229,061.42	-190,235.59
归属于少数股东的综合收益总额	-14,432.65	-7,397.01	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益	-0.99	-0.95	-0.81
（二）稀释每股收益	-0.99	-0.95	-0.81

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	265,313.73	173,646.46	109,174.32
收到的税费返还	45.69	211.49	22,316.90
收到其他与经营活动有关的现金	77,897.73	76,870.75	55,085.01
经营活动现金流入小计	343,257.16	250,728.70	186,576.23
购买商品、接受劳务支付的现金	159,260.80	108,024.87	114,673.82

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	62,914.03	51,709.08	47,113.73
支付的各项税费	2,476.02	1,406.19	1,274.80
支付其他与经营活动有关的现金	56,483.76	25,623.98	13,542.01
经营活动现金流出小计	281,134.62	186,764.12	176,604.35
经营活动产生的现金流量净额	62,122.54	63,964.58	9,971.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	130,000.00	347,500.00	1,033,333.80
取得投资收益收到的现金	1,793.85	6,556.93	2,728.75
收到其他与投资活动有关的现金	77,498.00	17,641.58	49,091.61
投资活动现金流入小计	209,291.85	371,698.52	1,085,154.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,072.47	514,839.19	411,075.10
投资支付的现金	111,500.00	227,000.00	826,333.80
支付其他与投资活动有关的现金	26,478.61	100,633.37	33,154.98
投资活动现金流出小计	380,051.08	842,472.56	1,270,563.89
投资活动产生的现金流量净额	-170,759.23	-470,774.05	-185,409.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	50,000.00	150,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	150,000.00	-
取得借款收到的现金	569,034.47	373,742.03	234,885.64
收到其他与筹资活动有关的现金	176,510.20	20,000.00	-
筹资活动现金流入小计	795,544.67	543,742.03	234,885.64
偿还债务支付的现金	92,004.81	293,070.15	227,048.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,372.17	32,462.39	28,190.23
支付其他与筹资活动有关的现金	36,247.04	584.26	92.07

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流出小计	163,624.02	326,116.79	255,330.36
筹资活动产生的现金流量净额	631,920.65	217,625.24	-20,444.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165.64	-199.98	-322.95
五、现金及现金等价物净增加额	523,118.32	-189,384.21	-196,205.51
加：期初现金及现金等价物余额	69,798.94	259,183.15	455,388.66
六、期末现金及现金等价物余额	592,917.26	69,798.94	259,183.15

三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（以下简称“企业会计准则”）编制。此外，公司还结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

财务报表以持续经营为基础列报。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、报告期末纳入合并范围的子公司

截至报告期末，公司合并财务报表范围包括粤芯集成、粤芯三期、粤芯四期和粤芯国际 4 家子公司，具体情况如下：

序号	名称	成立时间	注册地	注册资本	持股比例	取得方式
1	粤芯集成	2022/9/5	广东省广州市	100,000 万元	100.00%	投资设立
2	粤芯三期	2022/9/6	广东省广州市	750,000 万元	80.00%	投资设立
3	粤芯四期	2025/10/10	广东省广州市	5,000 万元	100.00%	投资设立
4	粤芯国际	2018/7/24	中国香港	100 万港币	100.00%	投资设立

2、报告期内合并财务报表范围变化

2025 年 10 月 10 日，粤芯集成出资设立子公司粤芯四期，纳入公司合并财务报表范围。除此以外，报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。

四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

（一）关键审计事项

关键审计事项是致同会计师根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，致同会计师不对这些事项单独发表意见。

致同会计师在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	审计程序
收入确认	
粤芯股份主要从事晶圆代工业务。2023 年度、2024 年度和 2025 年度营业收入金额分别为 104,371.92 万元、168,132.90 万元和 258,236.87 万元。 由于收入是粤芯股份的关键业绩指标之一且对公司经营成果影响重大。因此，致同会计师将收入确认识别为关键审计事项。	致同会计师对收入确认主要执行了以下程序： （1）了解管理层对收入确认相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性，评价与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）抽样检查与客户签订的销售合同、报价单和销售订单，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定； （3）对主营业务收入以及毛利率实施分析性程序，比较分析审计期间主营业务收入及毛利率、与同行业可比公司主营业务收入及毛利率的变动趋势及其合理性； （4）抽样检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、经客户签收的出库签收单、报关单、运输单及物流轨迹等； （5）使用积极式函证方式对重要客户的销售额和往来余额进行函证，就未回函的客户执行了替代性审计程序； （6）查询境内外主要客户的工商资料等基本信息，并进行实地走访，了解客户与粤芯股份的交易金额、交易条款等具体交易内容，核查销售的真实性和交易实质； （7）对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，评价销售收入是否确认在恰当的会计期间。
存货跌价准备的计提	
粤芯股份 2023 年 12 月 31 日、	致同会计师对存货跌价准备主要执行了以

关键审计事项	审计程序
2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日存货账面余额分别为 70,733.45 万元、57,082.29 万元和 84,366.39 万元，存货跌价准备分别为 23,500.07 万元、20,460.59 万元和 30,483.71 万元。 由于存货跌价准备对财务报表影响重大，且确定存货跌价准备涉及管理层的重大会计判断和估计，因此致同会计师将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。	下程序： （1）了解管理层对存货跌价准备计提相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性，评价与存货跌价准备计提相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）复核管理层的存货可变现净值估计的方法，以及在存货可变现净值估计中使用的相关参数； （3）复核管理层对存货可变现净值的估计，包括检查历史销售记录以检验预计售价的合理性，对进一步加工成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估； （4）执行存货监盘程序，并关注残次冷背的存货是否被识别； （5）获取存货跌价准备计算表，复核管理层对存货跌价准备的计算过程，并根据存货跌价准备计提政策重新计算存货跌价准备金额。

（二）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占应收账款余额的 1%以上
账龄超过 1 年的重要预付款项	单笔账龄超过 1 年的预付款项金额占预付款项余额的 10%以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	单笔账龄超过 1 年的应付账款金额占应付账款余额的 10%以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	单笔账龄超过 1 年的合同负债金额占合同负债余额的 10%以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单笔账龄超过 1 年的其他应付款金额占其他应付款余额的 10%以上
重要的非全资子公司	资产总额、收入总额、利润总额占比≥15%
重要的合营企业或联营企业	对合营或联营企业的长期股权投资账面价值超过资产总额 15%的合营或联营企业

五、重要会计政策及会计估计

本部分仅重点列示对报告期内公司资产状况、经营情况和现金流量存在重大影响的重要会计政策及会计估计。公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告，以获取详细的会计政策及会计估计。

（一）收入

1、一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时

确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

（1）公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、具体方法

公司收入主要来源于销售商品，收入确认的具体方法如下：

（1）境内销售

公司根据合同约定将产品在指定地点交付给客户或其委托的其他公司，并经其确认后作为控制权的转移时点，确认销售收入。

（2）境外销售

公司根据合同约定完成产品生产后发货，经向海关申报并完成出口报关手续，在指定地点交付承运人、运送至指定的物流仓、保税区或货物离港、离岸后，在客户取得产品的控制权后确认销售收入。

（二）控制的判断标准和合并财务报表编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资

产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

3、购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

4、丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

（三）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要

求。

仅在公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

3、金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的

合同。

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

5、衍生金融工具及嵌入衍生工具

公司衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

6、金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（四）公允价值计量”。

7、金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其

未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据和应收账款

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：信用等级较低的银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：销售商品、提供服务形成的应收账款

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预

期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金和保证金

其他应收款组合 2：员工借支款

其他应收款组合 3：代扣代缴款

其他应收款组合 4：集团内往来款项

其他应收款组合 5：其他款项

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用

风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

（3）已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（4）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（5）核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（四）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生

经济利益的能力。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（五）存货

1、存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在

原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（六）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

（七）长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的，为公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资

单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十二）资产减值”。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

2、各类固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.8
机器设备	6	5	15.83
办公设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他	5	0-5	20-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十二）资产减值”。

4、每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确

认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（九）在建工程

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十二）资产减值”。

（十）无形资产

公司无形资产包括土地使用权、软件、特许权和专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	3-5 年	直线法
特许权和专利权	2-5 年	直线法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十二）资产减值”。

（十一）研发支出

公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括职工薪酬、物料消耗、

折旧摊销费、维修维护费、专业服务费、软件及专利授权、燃料动力费、股份支付、其他相关费用等。

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十二）资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其

他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）职工薪酬

1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

2、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利

计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

4、辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休

金），按照离职后福利处理。

5、其他长期福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（十四）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给公司，贴息冲减借款费用。

（十五）股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十六）租赁

1、租赁的识别

在合同开始日，公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十七）使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算

的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（1）短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

（3）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

3、公司作为出租人

公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

（2）经营租赁

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（3）租赁变更

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相

当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

4、售后租回

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（十七）使用权资产

1、使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司作为承租人发生的初始直接费用；公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租

赁条款约定状态预计将发生的成本。公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2、使用权资产的折旧方法

公司采用直线法计提折旧。公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3、使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“（十二）资产减值”。

（十八）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解释第 18 号”）。

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行解释第 18 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在应披露的重要会计估计变更。

六、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

（一）主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种、计税依据及税率的情况如下：

税种	计税依据	法定税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率如下：

公司名称	所得税税率
粤芯股份	15%
粤芯集成	25%
粤芯三期	25%
粤芯四期	25%
粤芯国际	16.5%

注：粤芯国际所得税为中国香港利得税。

（二）税收优惠

1、公司于 2020 年 12 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202044009843 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期间适用 15% 的所得税税率。

2、公司于 2023 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202344012834 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期间适用 15% 的所得税税率。

3、根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额。

七、分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。公司根据内部组织形式、管理要求及内部报告制度，未划分不同的经营分部。因此，公司只有一个用于报告的经营分部，按业务类型、应用领域、地区列示的主营业务收入信息，具体内容请参见本节之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

八、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的要求，公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	41,270.23	25,332.66	53,690.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	347.40	1,107.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74.79	-2.30	491.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,701.90	-	-
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	-	-	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净额（税后）	3,075.06	666.08	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	39,822.28	25,011.68	55,289.53
归属于母公司股东的净利润	-234,582.32	-225,326.91	-191,711.34

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-274,404.61	-250,338.60	-247,000.87

报告期内，发行人归属于母公司股东的非经常性损益金额分别为 55,289.53 万元、25,011.68 万元和 39,822.28 万元。报告期内，对公司非经常性损益影响较大的项目主要是计入当期损益的政府补助。

九、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
流动比率（倍）	1.80	1.14	1.14
速动比率（倍）	1.69	1.01	0.99
资产负债率（母公司）	77.61%	59.12%	56.13%
资产负债率（合并）	84.13%	67.79%	62.62%
利息保障倍数（倍）	不适用	不适用	不适用
应收账款周转率（次/年）	11.81	12.68	16.91
存货周转率（次/年）	5.67	4.38	3.28
息税折旧摊销前利润（万元）	32,654.01	-16,697.43	950.32
归属于发行人股东的净利润（万元）	-234,582.32	-225,326.91	-191,711.34
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元）	-274,404.61	-250,338.60	-247,000.87
研发投入占营业收入的比例	16.36%	26.50%	58.00%
每股经营活动的净现金流量（元/股）	0.26	0.27	0.04
每股净现金流量（元/股）	2.21	-0.80	-0.83
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.12	2.10	3.01

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产 - 存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=（总负债/总资产）×100%；
- 4、利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
- 5、应收账款周转率=营业收入/（（期初应收账款余额 + 期末应收账款余额）/2）；

- 6、存货周转率=营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）；
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 8、研发投入占营业收入的比例=（研发费用/营业收入）×100%；
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
- 11、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本；
- 12、为保持指标的可比性，每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量、归属于发行人股东的每股净资产的股份数均按照公司报告期末股本数计算。

（二）净资产收益率和每股收益

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司报告期内的净资产收益率和每股收益情况如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	-61.16%	-0.99	-0.99
	2024 年度	-37.30%	-0.95	-0.95
	2023 年度	-23.87%	-0.81	-0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	-71.54%	-1.16	-1.16
	2024 年度	-41.44%	-1.06	-1.06
	2023 年度	-30.75%	-1.04	-1.04

注：上述各指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S, S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P₁/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照

其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十、经营成果分析

（一）报告期内取得经营成果概述

报告期内，公司经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
营业成本	400,930.13	279,962.98	219,471.79
营业毛利	-142,693.26	-111,830.08	-115,099.88
营业利润	-248,940.19	-232,721.63	-192,202.69
净利润	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
归属于母公司股东的净利润	-234,582.32	-225,326.91	-191,711.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-274,404.61	-250,338.60	-247,000.87

报告期内，公司营业收入分别为 104,371.92 万元、168,132.90 万元和 258,236.87 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-191,711.34 万元、-225,326.91 万元和-234,582.32 万元。受晶圆代工行业前期固定资产投资规模较大导致的折旧规模较大、研发投入较高、模拟芯片产品特性及股份支付等因素影响，截至报告期期末，公司尚处于亏损状态。

（二）营业收入分析

1、营业收入分析

报告期内，公司的营业收入及其构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	251,087.66	97.23%	163,190.14	97.06%	102,077.49	97.80%
其他业务收入	7,149.21	2.77%	4,942.76	2.94%	2,294.42	2.20%
合计	258,236.87	100.00%	168,132.90	100.00%	104,371.92	100.00%

公司专注于从事 12 英寸晶圆特色工艺代工业务，公司营业收入主要来自于晶圆代工业务收入。报告期内，公司主营业务收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元和 251,087.66 万元，占当期营业收入的比例分别为 97.80%、97.06%

和 97.23%；公司主营业务突出，为公司营业收入的主要来源。

报告期内，公司其他业务收入分别为 2,294.42 万元、4,942.76 万元和 7,149.21 万元，占当期营业收入的比例分别为 2.20%、2.94%和 2.77%，占比较低，主要由公司为客户提供的掩膜、探针卡销售等实现的收入。

报告期内，公司收入规模整体呈持续增长趋势。2024 年以来，随着半导体行业市场需求逐步回暖，同时公司产能规模逐步扩大、产品结构持续优化、应用领域逐渐丰富及客户合作关系持续深化等，公司主营业务收入已呈现高速增长趋势。2024 年度及 2025 年度，公司主营业务收入分别较同期增长 59.87%及 53.86%，具体如下：

（1）半导体行业回暖叠加国产替代与政策红利，经营环境持续向好

在行业整体复苏、国产替代加速、政策支持力度加大等多重利好背景下，公司经营态势持续向好，为公司未来持续稳健增长奠定了坚实基础。

受前期半导体行业市场供需调整及宏观经济疲软等因素影响，晶圆代工行业经历了阶段性波动。随着终端需求逐步回暖以及产品工艺技术的进步，自 2024 年以来，晶圆代工市场已呈现明显回升趋势。根据 Yole 统计，2024 年，全球晶圆代工行业市场规模达到 1,410 亿美元，同比增长 16.53%；预计 2029 年全球晶圆代工行业市场规模将达到 2,490 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 12.05%。整体来看，半导体行业已走出低谷，晶圆代工市场展现出强韧的增长动力。

在全球晶圆代工行业整体复苏回暖背景下，受地缘政治不确定性加剧影响，中国市场晶圆代工行业国产化空间巨大。根据 SEMI 等机构统计，2024 年中国晶圆代工行业市场规模提升至 143 亿美元，同比增长 20.17%；预计 2029 年将达到 266 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 13.22%。根据智研咨询统计，中国模拟芯片自给率从 2019 年的 9%提升至 2024 年的 16%左右，国产替代空间广阔。

与此同时，国家“十五五”规划纲要明确强调要“做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力”。这一战略规划表明，晶圆代工行业为国家产业发展战略的重要组成部分，在支撑我国半导体产业实现安全、自主、可持续发展方面发挥着关键作用。在政策支持的有力保障下，中国晶圆代工行业将获得长期稳定的发展空间，市场规模预计将保持快速增长的趋势。

（2）公司产能规模逐渐提升

公司根据既定发展战略规划公司的产能建设，持续加大产线投资扩充产能，以提升制造能力及夯实未来发展基础。报告期内，公司产能已由2023年度的44.95万片提升至2025年度的61.48万片，产能稳定增长为公司产销规模的提升和主营业务收入增长提供重要保障。截至报告期末，公司已拥有两座12英寸晶圆代工厂，未来期间公司第二工厂、第三工厂完成产能释放后合计产能将达12万片/月，有利于进一步增强并保持公司的长远竞争优势。

（3）公司坚持技术驱动，产品结构持续优化，应用领域丰富

公司紧跟国家产业发展战略，坚持技术驱动，持续推进产品研发及迭代升级。公司结合模拟芯片发展趋势及客户需求持续丰富产品矩阵，围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片，逐步实现多品类布局。

报告期内，公司具备集成电路及功率器件晶圆代工的稳定量产供应能力，产品涵盖MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho等多种工艺技术平台，是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的集成电路制造企业。

此外，公司产品已广泛应用于消费电子及工业控制领域，并逐步扩展至汽车电子、人工智能等丰富的终端应用领域，产品终端应用市场规模不断扩大，助力公司业务稳定发展。

（4）公司与合作客户关系持续深化

得益于公司管理团队丰富的半导体行业管理经验及技术团队持续的研发积累，公司自成立以来即坚持贯彻“客户导向”服务理念，可针对不同客户需求作出迅速响应、为客户提供一站式的晶圆代工解决方案。凭借高性能、高可靠性及高性价比的产品和解决方案，公司获得良好的业界口碑及市场认可。报告期内，公司与行业内知名客户的战略合作关系持续深化，客户群体已覆盖半导体行业先进的芯片设计公司等多家细分领域龙头企业，并通过加大境外市场的布局，逐步扩大境外销售的占比。

依托公司对行业知名客户稳定高质的供应能力，2024年度及2025年度，公司主营业务收入分别较同期上升59.87%及53.86%，公司主营业务收入已呈现高

速增长趋势。

2、主营业务收入按代工产品类别分析

按照代工产品类别划分，公司报告期内主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	197,544.22	78.68%	130,971.78	80.26%	75,585.59	74.05%
功率器件代工	53,543.43	21.32%	32,218.36	19.74%	26,491.90	25.95%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

报告期内，公司产品结构总体稳定，主营业务按照代工产品类别可划分为集成电路代工及功率器件代工。报告期各期，公司实现的主营业务收入分别为 102,077.49 万元、163,190.14 万元和 251,087.66 万元。

报告期内，公司集成电路代工实现的收入分别为 75,585.59 万元、130,971.78 万元和 197,544.22 万元，占主营业务收入的比例分别为 74.05%、80.26%和 78.68%。2024 年相较于 2023 年增长了 73.28%，2025 年相较于 2024 年增长了 50.83%。

报告期内，公司功率器件代工实现的收入分别为 26,491.90 万元、32,218.36 万元和 53,543.43 万元，占比分别为 25.95%、19.74%和 21.32%。报告期内，功率器件代工收入规模保持持续增长，其中，2024 年相较于 2023 年增长了 21.62%，2025 年相较于 2024 年增长了 66.19%。

3、主营业务收入分代工产品销售数量、价格与结构变化分析

报告期各期，公司主营业务代工产品的销量及销售均价情况如下：

（1） 集成电路代工

报告期内，集成电路代工产品的销售收入、销售价格和销售量的变化情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售收入（万元）	197,544.22	50.83%	130,971.78	73.28%	75,585.59
销售量（万片）	41.95	37.87%	30.42	70.26%	17.87
销售均价（元/片）	4,709.55	9.40%	4,304.83	1.77%	4,229.98

报告期内，公司集成电路代工产品的销售量及销售均价变动主要受晶圆代工行业供需关系调整及产品结构变动影响所致。2024 年度，公司集成电路代工产品的销售收入较 2023 年度增加 73.28%，主要系市场需求增加及产品品类扩充，带动销量增加，推动业务规模进一步扩大。2025 年度集成电路代工产品的销售收入较 2024 年增加 50.83%，终端需求增长带动销量持续上升，公司集成电路代工产品销售收入持续上涨。

（2）功率器件代工

报告期内，公司功率器件代工产品的销售收入、销售价格和销售量的变化情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售收入（万元）	53,543.43	66.19%	32,218.36	21.62%	26,491.90
销售量（万片）	17.00	60.13%	10.62	51.01%	7.03
销售均价（元/片）	3,149.95	3.79%	3,035.06	-19.47%	3,768.73

报告期内，公司功率器件代工产品的销售量及销售均价变动主要受晶圆代工行业供需关系调整的影响。2023 年度至 2025 年度，公司功率器件代工的销售收入持续增长，主要原因系：2024 年下游市场需求的增加，导致功率器件代工产品销量增加。受半导体行业供需关系调整影响，功率器件代工产品销售均价有所下降，但销售均价下降对收入的影响小于销量增加对功率器件代工产品收入的影响，综合作用下使得功率器件代工产品的销售收入上涨。2025 年度，终端客户需求进一步增加，销量和销售均价均上涨，带动公司功率器件代工产品的销售收入进一步持续上涨。

4、主营业务收入按制程节点分类

报告期内，公司主营业务收入按制程节点分类如下：

单位：万元

制程节点	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm/65nm	32,543.26	12.96%	9,193.32	5.63%	3,995.77	3.91%
90nm/95nm	8,115.55	3.23%	41.23	0.03%	56.95	0.06%
110nm	73,469.11	29.26%	48,711.20	29.85%	21,370.00	20.94%

制程节点	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
153nm/180nm	83,416.30	33.22%	73,026.03	44.75%	50,162.87	49.14%
0.25μm 以上	53,543.43	21.32%	32,218.36	19.74%	26,491.90	25.95%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

报告期内，公司为客户提供 55nm/65nm、90nm/95nm、110nm、153nm/180nm 及 0.25μm 以上多种工艺节点的晶圆代工业务。

公司集成电路代工业务在报告期初以 153nm/180nm 制程节点收入为主，报告期内，公司 153nm/180nm 制程节点收入金额分别为 50,162.87 万元、73,026.03 万元和 83,416.30 万元，占比分别为 49.14%、44.75%及 33.22%。随着公司产品迭代升级及工艺提升，公司集成电路代工业务在以 153nm/180nm 制程节点收入为主的基础上，逐步拓展了 110nm、90nm/95nm 及 55nm/65nm 制程节点收入。其中，公司 55nm/65nm、90nm/95nm 及 110nm 制程节点合计收入金额分别为 25,422.72 万元、57,945.75 万元和 114,127.93 万元，合计占比分别为 24.91%、35.51%和 45.45%，最近三年年均复合增长率达 111.88%，报告期内呈快速上涨趋势。

5、主营业务收入按应用领域分析

报告期内，公司主营业务收入按应用领域分类如下：

单位：万元

应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	195,324.58	77.79%	141,545.08	86.74%	90,590.58	88.75%
工业控制	50,445.74	20.09%	19,265.20	11.81%	9,656.62	9.46%
汽车电子	3,892.42	1.55%	1,773.70	1.09%	1,443.69	1.41%
其他	1,424.91	0.57%	606.16	0.37%	386.61	0.38%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

公司产品已广泛应用于消费电子及工业控制领域，并逐步扩展至汽车电子、人工智能等应用领域，产品下游的应用领域不断丰富。

报告期各期，公司晶圆代工业务收入主要来源于消费电子领域，占主营业务收入的比例分别为 88.75%、86.74%和 77.79%，总体保持稳定。报告期内，公司

晶圆代工业务在工业控制领域的收入金额分别为 9,656.62 万元、19,265.20 万元和 50,445.74 万元，占主营业务收入的比例分别为 9.46%、11.81%和 20.09%，最近三年年均复合增长率达 128.56%，规模及占比不断提升，呈现快速增长趋势。

6、主营业务收入按地域分析

报告期内，公司的主营业务收入按地域分类情况如下：

单位：万元

区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	229,556.10	91.42%	148,193.37	90.81%	97,267.13	95.29%
境外	21,531.56	8.58%	14,996.77	9.19%	4,810.36	4.71%
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

注：地域统计按单体客户所在注册国家及地区划分，因此对于境外客户通过境内主体下单情形统计在境内收入。

公司以境内为主要销售区域。报告期各期，公司境内销售收入分别为 97,267.13 万元、148,193.37 万元和 229,556.10 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 95.29%、90.81%和 91.42%。

报告期各期，公司境外销售收入金额分别为 4,810.36 万元、14,996.77 万元和 21,531.56 万元，最近三年年均复合增长率达 111.57%，占公司主营业务收入的比例分别为 4.71%、9.19%和 8.58%；公司境外客户主要集中于中国台湾、中国香港及新加坡等。报告期内，公司充分发挥区位优势持续深耕境内市场，同时，不断深化与境外客户的合作，并进一步开拓境外客户的境内业务，促进公司主营业务收入规模稳步提升。

7、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司各季度的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	45,917.32	18.29%	35,623.23	21.83%	14,702.62	14.40%
第二季度	57,810.14	23.02%	37,440.89	22.94%	24,720.90	24.22%
第三季度	71,848.37	28.61%	44,535.32	27.29%	27,749.49	27.18%
第四季度	75,511.82	30.07%	45,590.70	27.94%	34,904.49	34.19%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	251,087.66	100.00%	163,190.14	100.00%	102,077.49	100.00%

报告期内，公司主营业务收入不存在显著的季节性波动。报告期内，各季度收入占比整体呈逐季上涨趋势，主要系公司产能逐步爬升、与客户合作关系不断深化所致，收入规模随经营发展稳步提升。除上述情形外，公司主营业务收入不存在显著季节性波动情形。

8、第三方回款情况

报告期内，公司第三方回款金额及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
同一控制下企业代付	-	305.74	1,494.01
其他	-	500.00	-
合计	-	805.74	1,494.01
营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
占营业收入比例	-	0.48%	1.43%

报告期内，公司存在少量第三方回款的情形，第三方回款的相关方均不是发行人的关联方。公司部分客户属于集团公司，第三方回款情况主要为客户所属集团内部不同公司之间的付款安排，具有商业合理性，符合自身经营模式、行业特点。报告期内，发行人不存在因第三方回款导致货款归属纠纷的情况。

报告期内，公司第三方回款总金额占营业收入的比重较低，相关金额比例处于合理可控范围。发行人严格控制第三方回款，要求客户通过对公账户进行转账，当客户存在委托第三方支付的需求时，公司要求客户提供委托付款证明。报告期末，公司不存在第三方回款情况。

9、现金收付货款情况

报告期内，公司不存在现金收付货款情形。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	397,322.90	99.10%	279,049.77	99.67%	219,366.16	99.95%
其他业务成本	3,607.22	0.90%	913.21	0.33%	105.64	0.05%
合计	400,930.13	100.00%	279,962.98	100.00%	219,471.79	100.00%

报告期内，公司营业成本分别 219,471.79 万元、279,962.98 万元和 400,930.13 万元，其中主营业务成本占比分别为 99.95%、99.67%和 99.10%，与主营业务收入变动趋势一致。

2、主营业务成本的构成情况

报告期内，公司主营业务成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	33,656.64	8.47%	31,433.54	11.26%	20,593.21	9.39%
直接人工	3,069.19	0.77%	2,001.29	0.72%	1,909.64	0.87%
制造费用	360,597.08	90.76%	245,614.94	88.02%	196,863.31	89.74%
合计	397,322.90	100.00%	279,049.77	100.00%	219,366.16	100.00%

报告期各期，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中制造费用是最主要的构成部分。

直接材料主要为晶圆制造过程中使用的硅片。报告期各期，公司直接材料金额分别为 20,593.21 万元、31,433.54 万元和 33,656.64 万元，占比分别为 9.39%、11.26%和 8.47%，直接材料占主营业务成本的比例总体保持稳定。2025 年度，受硅片国产化率提升带动采购单价下降影响，直接材料占比较同期有所下降。

直接人工为直接参与生产活动人员的工资、奖金等。报告期各期，直接人工金额分别为 1,909.64 万元、2,001.29 万元和 3,069.19 万元，占比分别为 0.87%、0.72%和 0.77%，金额及占比均相对较低。

制造费用主要为厂房及生产设备的折旧金额等。报告期各期，制造费用分别为 196,863.31 万元、245,614.94 万元和 360,597.08 万元，占比分别为 89.74%、88.02%和 90.76%，制造费用占主营业务成本的比例总体保持稳定。报告期内，

公司为扩充产能持续加大固定资产等资本性投入，折旧规模持续提升，同时随着生产规模扩大，间接材料成本亦有所提高，综合导致制造费用整体上升。

3、主营业务成本的代工产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按代工产品分类构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	301,120.71	75.79%	219,691.23	78.73%	167,816.58	76.50%
功率器件代工	96,202.20	24.21%	59,358.55	21.27%	51,549.57	23.50%
合计	397,322.90	100.00%	279,049.77	100.00%	219,366.16	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要为集成电路代工成本，其成本占主营业务成本的比例分别为 76.50%、78.73%和 75.79%，与收入结构基本一致。

4、主要原材料和能源的采购情况

报告期内，公司主要原材料的采购数量、价格、总金额变动情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”之“（一）主要原材料和能源采购情况”。

（四）毛利及毛利率分析

1、综合毛利分析

报告期内，公司综合毛利构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	-146,235.25	102.48%	-115,859.64	103.60%	-117,288.67	101.90%
其他业务毛利	3,541.99	-2.48%	4,029.55	-3.60%	2,188.79	-1.90%
合计	-142,693.26	100.00%	-111,830.08	100.00%	-115,099.88	100.00%

报告期各期，公司综合毛利分别为-115,099.88 万元、-111,830.08 万元和-142,693.26 万元，主要由主营业务毛利构成。报告期内，公司毛利额为负，主要原因为公司尚处于产能建设及爬坡期，单位固定成本较高。

报告期内，公司其他业务毛利金额分别为 2,188.79 万元、4,029.55 万元和

3,541.99 万元，主要为公司向客户销售光掩模、探针卡等实现的销售毛利。

2、主营业务按代工产品的毛利构成分析

报告期各期，公司主营业务毛利按代工产品构成划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路代工	-103,576.48	70.83%	-88,719.45	76.57%	-92,230.99	78.64%
功率器件代工	-42,658.77	29.17%	-27,140.19	23.43%	-25,057.67	21.36%
合计	-146,235.25	100.00%	-115,859.64	100.00%	-117,288.67	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利分别为-117,288.67 万元、-115,859.64 万元和-146,235.25 万元。报告期内，公司主营业务毛利额为负，主要系公司所处的晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，前期设备及厂房投资规模较大，导致折旧等固定成本较高。在企业经营初期产能尚未完全释放，规模效益尚未显现，使得较高的折旧成本无法被现有收入规模覆盖，从而形成阶段性亏损。

当前，公司晶圆代工业务正处于快速成长期；未来随着公司产能规模逐步释放、产品布局逐渐完善、市场规模逐步扩大等因素影响，公司规模效应显现，盈利水平将有望进一步提升。

3、主营业务毛利率分析

（1）按代工产品构成分析

报告期各期，公司主营业务毛利率按代工产品构成划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
集成电路代工	78.68%	-52.43%	80.26%	-67.74%	74.05%	-122.02%
功率器件代工	21.32%	-79.67%	19.74%	-84.24%	25.95%	-94.59%
合计	100.00%	-58.24%	100.00%	-71.00%	100.00%	-114.90%

报告期各期，公司主营业务收入均由晶圆代工业务构成，主营业务毛利率分别为-114.90%、-71.00%和-58.24%，主要受单位售价及单位成本变动影响。2024 年以来，公司主营业务毛利率已呈现快速改善趋势。

①集成电路代工

报告期内，公司集成电路代工业务毛利率变动情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单位价格（元/片）	4,709.55	4,304.83	4,229.98
单位成本（元/片）	7,178.86	7,220.89	9,391.49
销售量（万片）	41.95	30.42	17.87
毛利率	-52.43%	-67.74%	-122.02%
毛利率变动	15.31%	54.28%	-
单位价格变动对毛利率的影响	14.33%	2.97%	-
单位成本变动对毛利率的影响	0.98%	51.31%	-

注 1：单位价格对毛利率影响=本期毛利率-（上期单位价格-本期单位成本）/上期单位价格；

注 2：单位成本对毛利率影响=（上期单位价格-本期单位成本）/上期单位价格-上期毛利率。

报告期各期，公司集成电路代工毛利率分别为-122.02%、-67.74%和-52.43%。其中，2024 年度及 2025 年度，公司集成电路代工业务毛利率分别较 2023 年回升 54.28 个百分点及 69.59 个百分点，已呈现快速改善趋势。

2024 年以来，随着行业景气度回升，公司产能爬坡及产品竞争力不断提升，公司集成电路代工业务收入规模快速扩张，规模效应逐步显现，进一步摊薄单位固定成本，公司 2024 年度单位成本相较于同期下降 23.11%，拉动集成电路代工业务毛利率实现快速回升。

2025 年度，集成电路代工业务毛利率较同期回升 15.31 个百分点，主要原因为：随着公司产品结构不断完善，集成电路代工业务平均单价较 2024 年升高 404.72 元/片，毛利率受此影响回升 14.33 个百分点，而单位成本较同期基本持平，综合导致 2025 年度公司集成电路代工业务毛利率进一步上涨。

②功率器件代工

报告期内，公司功率器件代工业务毛利率变动情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单位价格（元/片）	3,149.95	3,035.06	3,768.73
单位成本（元/片）	5,659.55	5,591.74	7,333.42
销售量（万片）	17.00	10.62	7.03

毛利率	-79.67%	-84.24%	-94.59%
毛利率变动	4.57%	10.35%	-
单位价格变动对毛利率的影响	6.80%	-35.87%	-
单位成本变动对毛利率的影响	-2.23%	46.21%	-

注 1：单位价格对毛利率影响=本期毛利率-（上期单位价格-本期单位成本）/上期单位价格；

注 2：单位成本对毛利率影响=（上期单位价格-本期单位成本）/上期单位价格-上期毛利率。

报告期各期，公司功率器件代工毛利率分别为-94.59%、-84.24%和-79.67%，2023 年以来，公司功率器件代工毛利率已呈现平稳回升趋势。

2024 年度，市场需求逐步回暖，公司功率器件代工产品的销售数量相较于 2023 年上涨 51.01%，随着产能利用率提高，单位成本相较于 2023 年下降 23.75%，功率器件代工业务毛利率已平稳回升。

2025 年度，功率器件代工业务毛利率较同期升高 4.57 个百分点，主要原因为：功率器件代工业务平均单价受市场行情波动略有提升，同时销量变动相较折旧成本变动较小导致单位成本升高，综合导致功率器件代工业务毛利率小幅回升。

（2）可比上市公司对比分析

报告期各期，公司主营业务毛利率与可比上市公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	21.25%	18.58%	20.14%
华虹宏力	17.87%	15.94%	26.40%
芯联集成	5.56%	0.48%	-7.60%
晶合集成	23.56%	25.48%	21.46%
燕东微	未披露	-19.19%	-19.72%
平均值	17.06%	8.26%	8.14%
发行人	-58.24%	-71.00%	-114.90%

注 1：同行业可比公司数据来源于各公司年报、招股说明书、业绩快报等公开披露资料；

注 2：中芯国际、华虹宏力、晶合集成晶圆代工毛利率，所取字段依次为“集成电路晶圆代工”“集成电路晶圆代工”及“集成电路晶圆制造代工”；

注 3：芯联集成及燕东微 2023 年度至 2024 年度为晶圆代工毛利率，所取字段依次为“集成电路晶圆制造代工”及“晶圆制造”，2025 年度为综合毛利率。

报告期内，公司毛利率呈持续上涨趋势，2024 年度及 2025 年度的主营业务毛利率相较于 2023 年已分别回升 43.90 个百分点及 56.66 个百分点，主营业务毛

利率已逐步提升，呈现改善趋势。公司主营业务毛利率与同行业可比公司变动趋势基本一致，但受公司产线投产阶段、代工产品种类及产品构成等因素影响，公司主营业务毛利率低于同行业可比公司，具体如下：

①产线投产阶段差异

公司所处晶圆代工行业为资本密集型行业，新生产线投产后会在短期内面临较高的固定成本负担，在产能爬坡期产能未充分释放、产销规模和产品种类有限的情况下，毛利率为负符合晶圆代工行业企业发展初期的一般规律。报告期内，相较于同行业可比公司，公司业务发展时间较短，产线尚处于产能爬坡期，因此毛利率为负且低于同行业公司，具有合理性。

同行业可比上市公司中，中芯国际、华虹宏力及燕东微成立至今已超过 20 年，均具备 3 条以上成熟量产产线，其成熟产线建设时间较早，且已过主要的折旧摊销期。经过多年积累及发展，前述公司报告期内产销规模较大，单位产品分摊的固定成本相对较低，因此报告期内毛利率可以维持在较高水平。芯联集成及晶合集成首条产线的首次达产时间早于公司，报告期内产销规模维持在较高水平，毛利率水平相对较高。

②代工产品种类及产品构成差异

公司聚焦特色工艺，以数模混合、硅光及光电融合制造工艺构建差异化竞争优势，由此形成 MS、HV、CIS、BCD、MOSFET、IGBT 及 SiPho 等多品类工艺技术平台布局，可满足多元化市场需求。受模拟芯片品类多样化及工艺类型复杂等特性影响，公司在业务发展初期难以快速形成规模效应，产品细分品类丰富及生命周期长的优势亦需要随产能提升逐步显现。伴随着产品体系完善及产销规模提升，盈利能力有望显著提升。

公司与同行业可比公司均主要从事晶圆代工业务，但在细分产品种类、产品构成及工艺制程等方面与可比公司存在一定程度差异。芯联集成及燕东微以功率器件代工为主，但其产品在细分品类及产品结构等方面与公司存在显著差异；中芯国际产品涵盖大量先进制程为主的逻辑芯片，华虹宏力主要集中在功率器件及嵌入式非易失性存储器，晶合集成以 DDIC 工艺平台晶圆代工为主，在产品构成及工艺制程方面与公司存在较大差异。

③公司毛利率波动趋势与可比公司基本一致

受半导体行业景气度整体回暖、供需格局显著改善影响，同行业可比公司毛利率自 2024 年度以来呈整体回升趋势，可比公司毛利率平均值由 2023 年度的 8.14% 上升至 2025 年度的 17.06%，公司毛利率变动趋势与同行业可比公司基本一致。

（五）期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
销售费用	4,154.92	1.61%	4,266.88	2.54%	3,214.10	3.08%
管理费用	36,518.68	14.14%	48,296.98	28.73%	27,431.28	26.28%
研发费用	42,244.27	16.36%	44,558.73	26.50%	60,532.47	58.00%
财务费用	34,082.77	13.20%	28,124.11	16.73%	16,464.02	15.77%
合计	117,000.64	45.31%	125,246.71	74.49%	107,641.87	103.13%

报告期内，公司期间费用分别为 107,641.87 万元、125,246.71 万元和 117,000.64 万元。公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。

1、销售费用

（1）销售费用构成及变动分析

报告期内，公司销售费用的各项费用明细支出情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,332.30	80.20%	2,870.59	67.28%	2,569.08	79.93%
股份支付	446.45	10.75%	1,041.75	24.41%	256.32	7.97%
办公费	161.47	3.89%	124.38	2.92%	164.43	5.12%
业务招待费	87.17	2.10%	93.01	2.18%	116.98	3.64%
折旧摊销费	79.15	1.90%	93.27	2.19%	86.81	2.70%
其他	48.37	1.16%	43.88	1.03%	20.48	0.64%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	4,154.92	100.00%	4,266.88	100.00%	3,214.10	100.00%

报告期内，公司销售费用分别为 3,214.10 万元、4,266.88 万元和 4,154.92 万元，占营业收入的比例分别为 3.08%、2.54%和 1.61%。报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付和办公费构成，具体分析如下：

①职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 2,569.08 万元、2,870.59 万元和 3,332.30 万元，占销售费用的比例分别为 79.93%、67.28%和 80.20%。公司销售费用中的职工薪酬主要系销售人员的工资、奖金、社保及福利费等，为支持业务发展及战略布局深化，2024 年、2025 年公司销售人员薪酬总额相应增加。

②股份支付

报告期内，公司销售费用中的股份支付费用分别为 256.32 万元、1,041.75 万元和 446.45 万元，占销售费用的比例分别为 7.97%、24.41%和 10.75%。2023 年，销售费用中的股份支付费用较低，主要是由于部分激励对象离职，公司在当期冲回此前已确认的股份支付费用。2025 年，随着部分激励对象服务期届满，当期确认的股份支付费用随之减少。

③办公费

报告期各期，公司销售费用中的办公费分别为 164.43 万元、124.38 万元和 161.47 万元，占销售费用的比例分别为 5.12%、2.92%和 3.89%。公司销售费用中的办公费主要包括销售部门的办公费用、差旅费、会议费等。

（2）与同行业可比公司的销售费用率比较

报告期内，剔除股份支付影响后公司销售费用率与同行业可比公司的比较情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	0.42%	0.45%	0.48%
华虹宏力	0.45%	0.48%	0.44%
晶合集成	0.51%	0.58%	0.69%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
芯联集成	未披露	0.63%	0.32%
燕东微	未披露	2.57%	1.65%
可比公司均值	0.46%	0.94%	0.72%
粤芯半导体	1.44%	1.92%	2.83%

注：1、华虹宏力、燕东微销售费用构成明细中未列示股份支付费用；

2、截至本招股说明书签署日，芯联集成、燕东微尚未披露 2025 年度财务数据。

报告期内，公司剔除股份支付影响后的销售费用率高于同行业可比公司平均水平，其中燕东微的销售费用率与公司相比无显著差异。公司销售费用率较高，主要系公司业务尚处于快速发展阶段，相较于同行业可比上市公司，公司营业收入规模较小，规模效应未能充分显现。

2、管理费用

（1）管理费用构成及变动分析

报告期内，公司管理费用的各项费用明细支出情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	13,567.19	37.15%	16,733.86	34.65%	12,001.86	43.75%
折旧摊销费	9,310.67	25.50%	11,780.28	24.39%	5,234.97	19.08%
水电气及物业管理费	3,928.32	10.76%	7,958.28	16.48%	1,676.77	6.11%
股份支付	3,310.60	9.07%	2,083.07	4.31%	2,979.76	10.86%
办公及租赁费	1,225.28	3.36%	1,775.53	3.68%	1,860.31	6.78%
专业服务费	2,621.81	7.18%	2,443.05	5.06%	1,112.43	4.06%
材料消耗	771.94	2.11%	2,868.09	5.94%	222.67	0.81%
保险费	954.22	2.61%	996.93	2.06%	621.54	2.27%
业务招待费	233.38	0.64%	230.65	0.48%	192.81	0.70%
其他	595.27	1.63%	1,427.24	2.96%	1,528.18	5.57%
合计	36,518.68	100.00%	48,296.98	100.00%	27,431.28	100.00%

报告期内，公司管理费用分别为 27,431.28 万元、48,296.98 万元和 36,518.68 万元，占营业收入比例分别为 26.28%、28.73%和 14.14%。报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、水电气及物业管理费等构成。报告期内，公

司第二工厂逐步建成投产，筹建期间发生的职工薪酬、折旧摊销费、水电气及物业管理费等开办费金额较大，且均计入管理费用，导致 2024 年公司管理费用相对较高。

①职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为 12,001.86 万元、16,733.86 万元和 13,567.19 万元，占管理费用的比重分别为 43.75%、34.65%和 37.15%。2024 年职工薪酬较高，主要是由于公司第二工厂尚未投产，筹建期内相应人力成本均计入管理费用。

②折旧摊销费

报告期内，公司管理费用中的折旧摊销费分别为 5,234.97 万元、11,780.28 万元和 9,310.67 万元，占管理费用的比重分别为 19.08%、24.39%和 25.50%。公司第二工厂建设产生较高资本性开支，由于第二工厂筹建期内相关折旧摊销费均归集于管理费用核算，导致 2024 年、2025 年该项费用支出较高。

③水电气及物业管理费

报告期内，公司管理费用中的水电气及物业管理费分别为 1,676.77 万元、7,958.28 万元和 3,928.32 万元，占管理费用的比重分别为 6.11%、16.48%和 10.76%。2024 年水电气及物业管理费增幅较大，主要是由于公司第二工厂进入测试运营阶段，但尚未投产，相关水电气等费用在筹建期内均计入管理费用。

（2）与同行业可比公司的管理费用率比较

报告期内，剔除股份支付影响后公司管理费用率与同行业可比公司的比较情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	5.04%	6.48%	6.63%
华虹宏力	4.90%	5.65%	4.79%
晶合集成	3.50%	3.66%	3.73%
芯联集成	未披露	1.95%	2.01%
燕东微	未披露	12.51%	8.60%
可比公司均值	4.48%	6.05%	5.16%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
粤芯半导体	12.86%	27.49%	23.43%

注：1、华虹宏力、燕东微管理费用构成明细中未列示股份支付费用；
2、截至本招股说明书签署日，芯联集成、燕东微尚未披露 2025 年度财务数据。

报告期内，公司剔除股份支付影响后管理费用率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司正处于业务拓展期，营业收入体量相对较小，且为驱动产能提升与业务规模扩张，公司推进第二工厂项目建设，筹建期内开办费显著增加。

3、研发费用

（1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发投入不存在资本化情况，研发费用的各项费用明细支出情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧摊销费	12,155.95	28.78%	18,860.34	42.33%	30,458.64	50.32%
职工薪酬	15,009.89	35.53%	12,284.04	27.57%	12,190.59	20.14%
物料消耗	4,394.10	10.40%	3,423.31	7.68%	4,707.14	7.78%
股份支付	2,758.83	6.53%	1,554.58	3.49%	721.98	1.19%
软件及专利授权	2,908.12	6.88%	2,537.22	5.69%	2,484.32	4.10%
维修维护费	1,912.59	4.53%	1,982.04	4.45%	3,800.92	6.28%
燃料动力费	1,359.33	3.22%	1,701.87	3.82%	3,604.25	5.95%
专业服务费	1,068.74	2.53%	1,422.62	3.19%	1,794.25	2.96%
其他相关费用	676.70	1.60%	792.70	1.78%	770.38	1.27%
合计	42,244.27	100.00%	44,558.73	100.00%	60,532.47	100.00%

报告期内，公司研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入的比例分别为 58.00%、26.50%和 16.36%。发行人最近三年累计研发投入金额为 147,335.47 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 27.76%。公司研发费用主要由折旧摊销费、职工薪酬和物料消耗构成。

报告期内，公司一方面进一步深化和拓展 MS、BCD、HV 等特色工艺技术平台，涉及混合信号、电源管理、显示驱动等多个领域，另一方面积极研发 55nm

等制程节点，提升公司核心竞争力，因此 2023 年公司研发支出维持较高水平。2024 年以来研发费用有所减少，主要是由于：随着公司产能利用率提升，研发活动对产线资源的占用有所下降，导致研发活动归集的机器设备折旧等费用有所减少；受研发项目发展规划及推进阶段变化的影响，55nm CIS 项目、153nm MS 项目等研发项目相继实现成果转化，相关产品进入量产阶段，研发支出有所减少，公司持续在新产品、新制程及特色工艺平台领域进行战略布局与深耕，55nm MS 项目、140nm HV 项目、65nm CIS 项目等研发项目正在有序推进并逐步投入。

2023 年、2024 年和 2025 年，公司营业收入分别为 10.44 亿元、16.81 亿元和 25.82 亿元，复合增长率达 57.30%，公司持续经营能力不断增强。2024 年以来，公司营业收入的大幅增长亦导致研发费用占比有所下降。

①折旧摊销费

报告期内，公司研发费用中的折旧摊销费分别为 30,458.64 万元、18,860.34 万元和 12,155.95 万元，占研发费用的比例分别为 50.32%、42.33%和 28.78%。折旧摊销费主要核算研发活动因使用机器设备等而归集的折旧。2024 年以来，公司产能利用率提升，研发活动对产线资源的占用有所下降，导致研发活动归集的机器设备折旧有所减少。

②职工薪酬

报告期内，公司研发费用中的职工薪酬分别为 12,190.59 万元、12,284.04 万元和 15,009.89 万元，占研发费用的比例分别为 20.14%、27.57%和 35.53%。职工薪酬主要核算公司开展研发活动归集的人员薪酬，2023 年至 2025 年，职工薪酬金额总体呈现稳中有升的趋势。

③物料消耗

报告期内，公司研发费用中的物料消耗分别为 4,707.14 万元、3,423.31 万元和 4,394.10 万元，占研发费用的比例分别为 7.78%、7.68%和 10.40%。物料消耗主要核算研发活动直接领用的物料，以及因使用产线资源开展研发活动消耗的材料等。受研发项目发展规划及推进阶段变化的影响，2024 年公司研发活动归集的材料费用有所减少。

（2）与同行业可比公司的研发费用率比较

报告期内，剔除股份支付影响后公司研发费用率与同行业可比公司的比较情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	8.13%	9.27%	10.71%
华虹宏力	11.40%	11.30%	8.99%
晶合集成	13.14%	13.76%	14.54%
芯联集成	未披露	27.98%	28.59%
燕东微	未披露	19.91%	13.92%
可比公司均值	10.89%	16.44%	15.35%
粤芯半导体	15.29%	25.58%	57.31%

注：1、华虹宏力、燕东微研发费用构成明细中未列示股份支付费用；
2、截至本招股说明书签署日，芯联集成、燕东微尚未披露 2025 年度财务数据。

报告期内，公司剔除股份支付影响后研发费用率总体高于同行业可比公司平均水平。公司研发费用率处于较高水平，主要原因为：（1）公司坚持自主研发，持续构建并完善完整的“感知-传输-计算-存储-控制-显示”全链路技术矩阵，同时布局前沿工艺领域，相应研发支出较高；（2）公司主营业务发展时间较短，报告期内仍处于产能爬坡阶段，在工艺技术平台的技术研发及工艺改进的基础投入较大，且营业收入规模较小。

（3）研发项目及投入情况

报告期内，公司研发项目的费用支出及实施进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	整体预算	完成进度	支出金额		
				2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	55nm CIS 项目	40,878.69	已完成	-	2,142.13	11,661.63
2	180nm BCD 项目	42,451.24	进行中	9,573.37	10,135.59	10,229.29
3	153nm MS 项目	25,466.17	已完成	-	-	9,253.83
4	153nm BCD 项目	19,322.66	进行中	3,210.21	4,853.62	4,420.64
5	IGBT 项目	17,301.57	进行中	3,001.36	6,439.58	3,128.66
6	110nm MS 项目	10,985.81	已完成	31.38	3,300.48	3,290.40
7	MOSFET 项目	22,512.57	已完成	-	-	4,425.82

序号	项目名称	整体预算	完成进度	支出金额		
				2025 年度	2024 年度	2023 年度
8	MCU 工艺平台开发项目	22,780.02	进行中	4,431.17	2,439.39	2,372.51
9	55nm MS 项目	12,954.06	进行中	3,221.32	3,781.99	1,746.34
10	110nm HV 项目	7,852.47	已完成	-	-	3,979.35
11	95nm MS 项目	9,608.23	进行中	2,765.61	2,581.05	2,050.20
12	55nm HV 项目	8,776.19	进行中	2,066.77	3,164.70	1,872.68
13	180nm HV 项目	8,074.99	已完成	514.02	1,101.00	1,184.58
14	90nm BCD 项目	16,735.65	进行中	5,144.49	1,143.28	914.50
15	90nm HV 项目	8,215.22	进行中	3,223.28	1,790.02	2.04
16	PMOS 项目	3,716.21	进行中	1,347.15	934.71	-
17	90nm SiPho 项目	8,330.27	进行中	2,175.17	595.80	-
18	65nm CIS 项目	4,296.26	进行中	973.93	155.39	-
19	140nm HV 项目	1,850.21	进行中	565.03	-	-
合计				42,244.27	44,558.73	60,532.47

注：上表研发项目进度及数据的统计截止日为报告期末。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	36,397.58	31,729.35	28,190.76
减：利息收入	3,622.46	7,744.57	12,036.15
融资服务费	250.14	-	-
汇兑损益	689.33	3,782.73	47.26
手续费及其他	368.18	356.60	262.15
合计	34,082.77	28,124.11	16,464.02

报告期内，公司财务费用分别为 16,464.02 万元、28,124.11 万元和 34,082.77 万元，占营业收入的比例分别为 15.77%、16.73%和 13.20%。财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益以及手续费等。报告期内，利息支出主要系公司为满足建设和运营需求向银行借款产生的利息；汇兑损益变动系国内外宏观经济变化形成的汇率波动所致。

（六）其他损益项目分析

1、其他收益

（1）其他收益构成情况

报告期内，公司其他收益的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	41,081.99	24,134.66	53,475.77
代扣代缴个人所得税手续费返还	63.50	58.63	64.16
增值税进项加计抵减	2,051.05	-	-
合计	43,196.54	24,193.29	53,539.93

报告期内，公司其他收益金额分别为 53,539.93 万元、24,193.29 万元和 43,196.54 万元，主要为政府补助。

（2）政府补助构成情况

报告期内，公司政府补助情况如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产/收益相关
直接计入当期损益					
1	粤芯三期项目启动奖励	-	-	16,250.00	与收益相关
2	2023 年技术开发奖励	-	-	9,554.00	与收益相关
3	广东省先进制造业普惠性投资配套奖励	-	-	9,233.20	与收益相关
4	省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）	2,044.00	1,953.20	-	与收益相关
5	2024 年技术开发奖励	-	2,352.00	-	与收益相关
6	十二英寸芯片制造项目（二期）扶持补贴	7,941.45	-	-	与收益相关
7	2025 年技术开发奖励	2,561.00	-	-	与收益相关
8	2025 年技术开发奖励（三期）	2,256.00	-	-	与收益相关
9	其他项目	245.04	247.91	245.90	与收益相关
小计		15,047.49	4,553.11	35,283.10	/
递延收益摊销					

序号	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产/收益相关
1	十二英寸芯片制造项目扶持补贴	6,911.29	9,515.36	9,515.36	与资产相关
2	十二英寸芯片制造项目（三期）扶持补贴	10,929.62	4,247.16	-	与资产相关
3	2020 年度中央外经贸发展专项资金（进口贴息事项）	448.57	543.00	543.00	与资产相关
4	高端模拟数字转换芯片工艺平台研发经费补助	748.51	748.51	612.50	与资产相关
5	2020 年外经贸发展专项资金（进口贴息事项）	481.80	485.86	485.86	与资产相关
6	2021 年先进制造业重大技术改造项目购买设备和工器具投资奖励	589.93	589.93	589.93	与资产相关
7	电源质量保障项目扶持奖励	333.33	333.33	333.33	与资产相关
8	2023 年度中央外经贸发展专项资金（进口贴息事项）	762.14	762.14	317.56	与资产相关
9	2022 年省（市）级促进经济高质量发展专项企业技术改造设备奖励	366.81	366.81	366.81	与资产相关
10	其他项目	775.90	588.96	384.39	与资产相关
小计		22,347.91	18,181.07	13,148.74	/
1	2023 年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）	-	-	4,623.00	与收益相关
2	高端模拟数字转换芯片工艺平台研发经费补助	3,200.00	569.26	-	与收益相关
3	其他项目	486.59	831.22	420.93	与收益相关
小计		3,686.59	1,400.48	5,043.93	/
合计		41,081.99	24,134.66	53,475.77	/

2、投资收益

报告期内，公司投资收益的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-1,208.83	-577.42	-0.71
银行理财产品投资收益	-	-	1,582.16
远期结售汇及外汇期权合同投资收益	-	347.40	-629.10
应收款项融资终止确认收益	-	-29.34	-98.20
合计	-1,208.83	-259.36	854.16

注：损失以“-”填列。

报告期内，公司投资收益分别为 854.16 万元、-259.36 万元和-1,208.83 万元。公司投资收益变动主要受权益法核算的长期股权投资收益和银行理财产品投资收益的影响。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
银行理财产品公允价值变动	-	-	-25.82
远期结售汇及外汇期权合同公允价值变动	-	-	180.00
合计	-	-	154.18

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 154.18 万元、0.00 万元和 0.00 万元。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-28,527.50	-18,092.99	-22,815.11

注：损失以“-”填列。

报告期内，公司资产减值损失分别为-22,815.11 万元、-18,092.99 万元和-28,527.50 万元，均为存货跌价损失。公司尚处产能爬坡阶段，单个产品承担较大的折旧、摊销，未能良好地释放经济效益，导致单个产品生产成本高于可变现净值，叠加公司业务规模在报告期内不断扩大，各期存货余额较大，公司各期存货跌价损失金额相对较高。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 33.22%、35.84%和 36.13%，整体呈现上升趋势。公司存货及跌价准备计提情况参见本节之“十一、资产质量分析”之“（一）流动资产结构分析”之“5、存货”。

5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	0.62	1.19	13.64
应收账款坏账损失	-97.67	-74.55	-67.13
其他应收款坏账损失	-95.48	-5.35	-2.19
合计	-192.52	-78.71	-55.68

注：损失以“-”填列。

报告期内，公司信用减值损失分别为-55.68万元、-78.71万元和-192.52万元，总体金额较小，主要为按照会计准则规定计提的应收账款坏账损失。报告期内，公司对客户主要采用预收款或短账期的信用政策，公司应收账款周转天数约为30天，回款情况良好，报告期内，公司未发生实质性的坏账损失。

6、税金及附加

报告期内，公司税金及附加的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
房产税	2,106.95	987.12	755.49
印花税	316.96	325.59	293.49
土地使用税	84.30	84.30	84.30
其他	5.76	10.06	5.14
合计	2,513.97	1,407.07	1,138.42

报告期内，公司税金及附加分别为 1,138.42 万元、1,407.07 万元和 2,513.97 万元，主要包括房产税、印花税、土地使用税等。

（七）纳税情况

1、增值税

报告期内，公司各期末留抵税额较高，未产生增值税缴纳款项。

2、企业所得税

报告期内，公司尚未实现盈利，未产生所得税费用。

3、公司享受税收优惠情况

公司税收优惠情况请参见本节之“六、适用税率及享受的主要财政税收优惠

政策”之“（二）税收优惠”。

（八）报告期尚未盈利、最近一期期末存在未弥补亏损的分析

由于晶圆制造行业的重资产属性、技术密集型特征、模拟芯片的产品特性及股份支付的影响，报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-191,711.34万元、-225,326.91万元和-234,582.32万元，尚处于未盈利状态。截至2025年末，公司累计未分配利润为-1,008,096.75万元，最近一期期末存在累计未弥补亏损。

1、原因分析

公司所处的晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，对资本实力和研发实力等要求较高，此外，为深入绑定核心骨干，进行股权激励，以及行业周期性波动亦对公司的短期盈利能力造成一定影响，主要原因如下：

（1）固定资产投资规模大，规模效应尚未显现

公司自设立以来，为满足市场及客户需求，以及公司规划的技术平台演进和构建核心制造能力的需要，持续投入资金用于产线建设及设备购置，目前第一工厂已经建成达产转固，第二工厂的主体房屋建筑物已基本竣工转固，2025年一**季度**第二工厂正式投产，仍在持续建设中。由于上述晶圆产线的规划和建设需兼顾公司当前产品需求和未来技术延展布局，因此，造成固定资产投入规模较大、资产折旧金额较高。公司各期厂房、产线投产转固后，相关折旧摊销持续计入公司营业成本及有关费用。报告期内，公司固定资产的折旧费用分别为157,907.60万元、177,478.87万元和240,679.83万元，折旧摊销金额持续攀升，截至2025年末，公司固定资产、无形资产累计折旧摊销金额合计为882,866.72万元。

同时，晶圆制造领域普遍存在产能爬坡周期较长，产能需逐步释放的现实状况。产线良率提升、工艺优化及客户认证均需要较长的时间，产能爬坡阶段尚未产生规模效应导致生产成本低，由此对盈利能力产生重大影响。

（2）持续技术创新与工艺研发需要大量研发投入

晶圆代工行业是技术密集型行业，公司核心竞争力高度依赖于持续的技术创新和工艺研发。公司以“特色工艺平台”和“客户导向”作为核心竞争力，致力于打造多元化的工艺技术平台，形成差异化竞争优势，因此公司需要持续进行高

强度的研发投入，以确保公司工艺能力和良率水平能够满足下游客户的多样化需求。

自设立以来，公司保持大规模的研发投入，研发投入费用占营业收入比重较高。报告期内，公司发生的研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入的比重分别为 58.00%、26.50%和 16.36%。因此，针对核心技术和产品工艺的前期刚性研发投入，短期内会对公司盈利水平造成影响。

（3）平台开发、产品验证周期长，叠加行业周期，影响公司收入增速

模拟芯片存在品类多样化的特点，产品生命周期长，客户粘性高。公司所处的晶圆代工行业技术门槛高，研发验证周期长。公司产品存在一定的验证周期，尚未形成突出的规模效应。

公司作为成立时间较短的晶圆厂，创立初期需要完成技术平台研发、新技术新产品的薄膜、扩散，蚀刻和光刻等工艺技术开发和工艺整合研发。同时公司客户产品导入需要完成产品工艺流程开发及后续产品验证、流程优化等工作，新产品、新平台的导入整体周期较长，影响公司收入增速。

此外，报告期内公司产品下游应用主要集中在消费电子领域。2022 年度以来消费电子市场进入周期性需求疲软，公司晶圆产品放量受到影响。报告期内，公司高端消费级芯片及车规级、工控级芯片等高端产品销售收入占比虽逐渐提升，但尚未形成规模效应。公司高端产品验证、放量周期长，叠加消费电子周期下行，一定程度上影响了公司业绩。

（4）股份支付费用较大

公司重视人才激励与长期发展，为吸引和保留优秀技术和管理人才，实施了多轮次的员工股权激励，相应确认了大额的股份支付费用。报告期内，影响当期损益的股份支付费用分别为 6,717.10 万元、6,371.51 万元和 6,443.68 万元，占当期营业收入比例分别为 6.44%、3.79%和 2.50%，对当期净利润和期末大额未弥补亏损产生一定程度的影响。

2、影响分析

（1）对公司现金流的影响

受益于公司良好的经营能力和现金管理能力，公司经营活动现金流量净额持续为正。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 9,971.89 万元、63,964.58 万元和 62,122.54 万元，为公司带来了充裕的现金流入。同时，公司还积极通过股权融资、银行贷款等渠道补充公司资金并满足公司扩大投资的需求。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-20,444.72 万元、217,625.24 万元和 631,920.65 万元。

公司账面货币资金充足，债务水平合理，主要流动性指标与同行业可比公司相比不存在重大差异。截至 2025 年末，公司货币资金余额为 636,992.25 万元，资金状况良好，可满足公司研发投入、产线建设等需求，公司流动性不存在重大风险。

因此，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司现金流产生重大不利影响。

（2）对公司业务拓展的影响

公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累。凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力，公司获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。

公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的晶圆代工厂，凭借“终端、设计与制造”协同优化的经营模式和“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路，报告期内公司持续导入新客户。截至 2025 年末，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司等多家细分领域行业龙头企业。依托于公司深厚的技术积累及良好的市场口碑等优势，公司不断提升产品市场竞争力，为业务快速拓展奠定基础。

综上，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司业务拓展产生重大不利影响。

（3）对公司人才吸引和团队稳定性的影响

公司自创立之初即重视人才储备及梯队构建工作，并制定了一系列激励员工和保持核心技术人员稳定性的措施。公司核心管理团队汇集了来自中国大陆、美国、新加坡、中国台湾等地区的技术及管理专家，具备深厚的半导体行业运营及管理经验。

公司为员工制定了完善健全的薪酬福利体系，同时，为显著提高核心团队人员的稳定性、最大限度激励核心团队人员的主观能动性，公司对骨干员工实施了股权激励计划，以促进公司业务长远稳定发展。报告期内，公司核心管理人员和核心技术人员保持稳定，人才队伍不断扩大。截至 2025 年末，公司员工总数达 1,943 人，硕士及以上学历人员占比为 20.48%，拥有 3 年及以上半导体行业经验者超过 60%。

综上，尚未盈利及最近一期末存在累计未弥补亏损不会对公司人才吸引及团队稳定性产生重大不利影响。

（4）对公司研发投入的影响

公司专注于特色工艺晶圆代工服务，为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工及特色工艺解决方案，持续积淀公司核心竞争力。报告期内，公司研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入的比例分别为 58.00%、26.50%和 16.36%。

公司通过持续创新研发积累了丰富的核心技术，截至报告期末，公司已取得授权专利（含境外专利）712 项，其中发明专利 343 项。公司承担了多项国家级、省市级半导体领域相关的科研项目，并先后被认定为“广东省企业技术中心”、“广东省工程研究中心”。截至报告期末，公司研发人员占比为 17.65%，研发人员中硕士及以上学历人员占比超过 60%。公司研发能力、研发人才具备竞争优势。未来，公司将继续通过持续研发投入，提高研发效率，不断进行产品迭代升级，提升核心技术的先进性，以增强产品核心竞争力和增强未来盈利能力。

综上，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司研发投入产生重大不利影响。

（5）对公司战略性投入的影响

公司始终关注半导体晶圆代工行业发展趋势，不断提升自身代工工艺水平，拓展产品种类。截至报告期末，公司已有多项战略布局，主要包括：1）面对目前模拟芯片国产化率低的现状，公司战略性精准补充和优化产能，已规划和建设一条新的 12 英寸模拟特色工艺生产线项目（三期项目），并将其作为本次发行的募投项目之一；2）根据目前下游客户对晶圆代工工艺的最新需求，开发新制程和新工艺平台，实现“以模拟为核心，以数字升级为蝶变”的平台布局；3）针对人工智能领域对硅光芯片的需求放量趋势，发展“以光电融合为特色”的复合型技术平台芯片代工工艺，并将相关技术平台研发作为本次发行的募投项目之一，积极布局人工智能领域的硅光芯片技术及应用，实现公司产品差异化；4）进一步开发应用于消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能领域的工艺技术平台，丰富公司产品矩阵。

综上，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损未对公司战略性投入产生重大不利影响。

（6）对生产经营可持续性的影响

公司自成立以来，紧密贴合模拟芯片品类多样化的行业特点，致力于持续强化特色工艺平台与差异化布局。同时，公司一直致力于客户资源的扩展和积累，已成功导入大量优质客户，获得了市场的高度认可和行业口碑。报告期内，公司晶圆产品累计出货量达到 120 万片以上，发展势头良好。

未来，随着人工智能、自动驾驶、智能工业和 AI 终端等新兴产业的快速发展，模拟芯片晶圆代工行业具备较大增长潜力，市场前景广阔。同时，集成电路作为国家鼓励、扶持的战略新兴产业，晶圆代工在其中承担着重要角色，公司作为广东省首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业，为国家集成电路产业战略布局提供了重要的产能支撑。公司构建起的多层次、高价值的特色工艺平台，精准契合了国家对于高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片自主可控与创新发展的迫切要求。

报告期内，公司营业收入分别为 104,371.92 万元、168,132.90 万元和 258,236.87 万元，2023-2025 年均复合增长率高达 57.30%，公司持续经营能力不

断增强。收入的增长将为经营业绩的持续改善提供重要保障。随着公司产能不断提升，规模效益进一步显现，公司将深度强化特色工艺平台能力与构建差异化竞争优势，进一步提升公司持续经营能力。

综上，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对生产经营可持续性产生重大不利影响。

综上所述，截至本招股说明书签署日，发行人尚未盈利及存在累计未弥补亏损未对发行人现金流、业务拓展、人才吸引、核心团队稳定性、研发投入、战略性投入和生产经营可持续性产生显著不利影响。

3、趋势分析

随着全球终端市场的需求增长，模拟芯片晶圆代工市场持续向好。同时，在国家大力倡导集成电路自主可控的背景下，我国模拟芯片国产化替代率和芯片自给率将会显著提升。公司基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够为国产模拟芯片设计公司提供国产化晶圆代工产能支撑和特色化代工服务，为客户实现产品差异化、提升产品国际竞争力提供夯实的制造基础。同时，公司通过对技术和工艺的持续革新和优化，服务中国设计企业崛起，对显著提升我国实现模拟芯片全面国产替代的能力具有重要意义。

收入方面，随着公司持续投入自主研发，特色工艺技术成果转化已体现成效，公司的工艺技术平台围绕应用于“感、传、算、存、控、显”等功能的模拟和数模混合芯片，逐步实现了多品类布局，已形成 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台，工艺制程覆盖 180nm-55nm，构建了完整的“感知-传输-计算-存储-控制-显示”全链路技术矩阵。产品线覆盖指纹识别芯片、LCD 及 LED 显示驱动芯片、电子标签显示驱动芯片、CMOS 图像传感器、电源管理芯片、功率器件、硅光芯片等终端产品，可应用于消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等领域。

公司产品矩阵布局合理完善，叠加下游终端产品需求放量，公司收入结构有望进一步优化，市场份额及营业收入增速预计会进一步提升。

成本及费用方面，随着公司晶圆产线的产能爬坡逐步完成，采购及生产管理体系逐步完善，外加国产设备、材料、软件、IP 供应链日益成熟，公司生产端成

本有望持续优化。同时，随着初创阶段的研发投入逐步见效，公司现有工艺平台和技术水平已逐步成熟，公司产品迭代进入稳定周期，研发投入或逐步稳定。公司也已建立了较为稳定的研发、管理及销售团队，长期来看，未来公司期间费用规模将会趋于稳定。

4、风险因素

随着公司客户持续开拓，经营管理不断优化，以及工艺平台取得重点突破，公司预计未来几年亏损规模将不断收窄，但公司资产折旧费用、研发费用还将持续处于较高水平，叠加股权激励产生的股份支付费用的影响，公司可能还将面临持续亏损的风险。

发行人已在本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”和“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”中披露了发行人“尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险”。

5、投资者保护措施及承诺

为增强公司盈利能力，充分保护投资者的合法权益，公司根据自身经营特点制定了相关措施：（1）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力；（2）增加高端客户储备，加快高端产品导入进度，优化产品结构；（3）强化生产管理，保障生产稳定，加强成本控制；（4）持续研发投入和技术创新，确保公司产品技术持续进行更新迭代；（5）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；（6）完善利润分配政策，强化投资者回报。

发行人已在本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序”中披露了发行人本次发行前滚存的未分配利润（累计未弥补亏损），由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共同享有（承担）的决策程序。发行人已在本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”中披露了发行人股东、董事、高级管理人员等已就股份减持事项的特殊安排做出的相应承诺。

十一、资产质量分析

（一）流动资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	636,992.25	74.32%	158,549.44	50.94%	268,661.36	73.16%
交易性金融资产	-	-	-	-	221.00	0.06%
应收票据	-	-	61.87	0.02%	179.65	0.05%
应收账款	26,483.81	3.09%	16,814.72	5.40%	9,434.33	2.57%
应收款项融资	520.22	0.06%	177.83	0.06%	708.04	0.19%
预付款项	1,266.29	0.15%	2,161.57	0.69%	10,570.06	2.88%
其他应收款	10,727.21	1.25%	1,091.12	0.35%	828.21	0.23%
存货	53,882.68	6.29%	36,621.70	11.77%	47,233.37	12.86%
其他流动资产	127,261.61	14.85%	95,778.95	30.77%	29,371.81	8.00%
合计	857,134.06	100.00%	311,257.20	100.00%	367,207.82	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产等构成，上述项目合计占流动资产的比例分别为 96.59%、98.88%和 98.54%，具体分析如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	592,917.26	93.08%	69,798.94	44.02%	259,183.15	96.47%
其他货币资金	44,074.98	6.92%	88,743.23	55.97%	9,396.17	3.50%
应计利息	-	-	7.27	0.00%	82.04	0.03%
合计	636,992.25	100.00%	158,549.44	100.00%	268,661.36	100.00%

公司货币资金由银行存款、其他货币资金及应计利息构成，其中银行存款和其他货币资金是构成货币资金的主要部分。报告期各期末，公司货币资金余额分

别为 268,661.36 万元、158,549.44 万元和 636,992.25 万元，占流动资产的比例分别为 73.16%、50.94%和 74.32%。

公司其他货币资金主要为保证金。2024 年末公司其他货币资金大幅增长，主要系公司为支付设备采购款开立信用证形成的保证金所致。

2、应收账款

（1）应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面余额	26,751.32	16,984.57	9,529.63
减：坏账准备	267.51	169.85	95.30
应收账款净额	26,483.81	16,814.72	9,434.33
应收账款余额增长率	57.50%	78.23%	238.31%
营业收入	258,236.87	168,132.90	104,371.92
营业收入的增长率	53.59%	61.09%	-32.46%
应收账款余额占当期营业收入比例	10.36%	10.10%	9.13%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 9,434.33 万元、16,814.72 万元和 26,483.81 万元，占流动资产的比例分别为 2.57%、5.40%和 3.09%。公司主要采用先款后货或信用期较短的模式与下游客户进行合作，应收账款余额较低，应收账款回款情况较好，符合行业特性。

报告期各期末，应收账款余额分别为 9,529.63 万元、16,984.57 万元和 26,751.32 万元，应收账款余额占当期营业收入比例分别为 9.13%、10.10%和 10.36%。报告期各期末，公司应收账款账面余额逐年上升，与公司营业收入的增长趋势一致，上述变动系业务规模持续扩张所致。各期末应收账款余额占当期营业收入的比例较为稳定。

（2）应收账款账龄情况及坏账准备

报告期各期末，公司应收账款账龄及坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
6 个月以内	26,751.32	100.00%	16,984.57	100.00%	9,529.63	100.00%
小计	26,751.32	100.00%	16,984.57	100.00%	9,529.63	100.00%
减：坏账准备	267.51	1.00%	169.85	1.00%	95.30	1.00%
应收账款账面价值	26,483.81	99.00%	16,814.72	99.00%	9,434.33	99.00%

报告期内，公司应收账款账龄较短，周转天数约为 30 天，应收账款回款质量较高。报告期内，公司已制定稳健的坏账准备计提政策，并按照会计准则要求及时足额计提坏账准备。

（3）与同行业可比公司坏账计提比例比较

报告期各期末，公司与可比公司坏账准备计提比例对比如下：

公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
中芯国际	0.59%	0.25%	0.15%
华虹宏力	1.02%	1.18%	1.23%
芯联集成	未披露	0.10%	0.10%
晶合集成	0.01%	0.02%	0.19%
燕东微	未披露	7.40%	5.65%
平均	0.54%	1.79%	1.46%
发行人	1.00%	1.00%	1.00%

如上表所示，公司应收账款坏账准备按组合实际计提比例在同行业可比公司的计提比例范围内，公司应收账款坏账计提比例与同行业可比上市公司相比不存在较大差异，应收账款坏账准备计提充分。

（4）应收账款前五名客户

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日				
序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额占比
1	客户三	8,731.45	87.31	32.64%
2	客户一	7,229.90	72.30	27.03%

3	客户十五	3,183.29	31.83	11.90%
4	客户五	1,276.04	12.76	4.77%
5	客户六	1,214.12	12.14	4.54%
合计		21,634.79	216.35	80.87%
2024 年 12 月 31 日				
序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额占比
1	客户一	3,521.54	35.22	20.73%
2	客户三	3,180.88	31.81	18.73%
3	客户九	2,704.57	27.05	15.92%
4	客户五	1,581.63	15.82	9.31%
5	客户四	1,476.49	14.76	8.69%
合计		12,465.11	124.65	73.39%
2023 年 12 月 31 日				
序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额占比
1	客户二	2,364.50	23.64	24.81%
2	客户一	1,860.28	18.60	19.52%
3	客户三	1,226.17	12.26	12.87%
4	客户五	1,010.68	10.11	10.61%
5	客户十	554.15	5.54	5.82%
合计		7,015.78	70.16	73.62%

注：同一控制主体下的金额已合并披露。

报告期各期末，公司应收账款前五名客户的余额合计占应收账款总额比例分别为 73.62%、73.39%和 80.87%，应收账款余额集中度较高。报告期各期末，应收账款余额排名前五的客户均为行业内知名集成电路设计企业，且账龄均在 6 个月以内，公司应收账款质量较高。

3、预付款项

报告期各期末，公司预付款项账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,204.65	95.13%	2,114.48	97.82%	6,861.90	64.92%
1 至 2 年	37.78	2.98%	25.63	1.19%	3,690.05	34.91%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
2 至 3 年	4.67	0.37%	21.46	0.99%	8.10	0.08%
3 年以上	19.19	1.52%	-	-	10.00	0.09%
合计	1,266.29	100.00%	2,161.57	100.00%	10,570.06	100.00%

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 10,570.06 万元、2,161.57 万元和 1,266.29 万元，占流动资产比例分别为 2.88%、0.69%和 0.15%。

报告期内，公司预付款项主要为预付材料采购款，账龄主要为一年以内。2023 年末，公司预付账款金额为 10,570.06 万元，主要系公司年底支付较大金额预付硅片款；2024 年及 2025 年，随着境内外硅片产能扩张，备选的供应商增加，公司采购议价能力提高，预付款余额减少。

4、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账龄构成及坏账计提情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	10,369.00	798.23	630.58
1 至 2 年	176.62	103.41	10.37
2 至 3 年	99.36	7.55	69.96
3 年以上	191.42	195.64	125.67
小计	10,836.40	1,104.84	836.58
减：坏账准备	109.20	13.72	8.37
合计	10,727.21	1,091.12	828.21

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 828.21 万元、1,091.12 万元和 10,727.21 万元，占流动资产比例分别为 0.23%、0.35%和 1.25%。

报告期各期末，公司其他应收款项构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金和保证金	10,095.32	513.40	333.56
代扣代缴款	610.29	514.32	492.61
员工借支款	1.83	-	2.04
其他款项	19.76	63.40	-

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合计	10,727.21	1,091.12	828.21

报告期内，公司其他应收款主要由押金和保证金、代扣代缴款等构成，2025 年末，公司其他应收款余额较大，主要为新增的融资租赁业务保证金。

5、存货

（1）存货构成分析

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	36,975.30	68.62%	25,597.38	69.90%	35,594.82	75.36%
在产品	14,233.41	26.42%	7,167.26	19.57%	6,492.48	13.75%
库存商品	1,389.40	2.58%	2,383.85	6.51%	4,190.93	8.87%
发出商品	1,282.04	2.38%	-	-	-	-
合同履约成本	2.51	0.005%	1,473.21	4.02%	955.14	2.02%
合计	53,882.68	100.00%	36,621.70	100.00%	47,233.37	100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 47,233.37 万元、36,621.70 万元和 53,882.68 万元，占流动资产的比重分别为 12.86%、11.77%和 6.29%。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和合同履约成本，其中，合同履约成本为 NRE 服务对应成本。2024 年末，公司存货账面价值下降，主要系 2024 年半导体行业景气度提升，公司存货周转较快，导致公司原材料和库存商品规模下降。2025 年末，公司存货账面价值较上年末增加，主要系随着公司产能扩大、在手订单增加，公司基于生产计划相应增加了原材料采购和生产投入，故原材料及在产品规模有所上升。

（2）存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货账面余额及存货跌价准备的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	39,910.64	2,935.33	36,975.30	7.35%

在产品	40,360.62	26,127.21	14,233.41	64.73%
库存商品	2,248.23	858.83	1,389.40	38.20%
发出商品	1,844.38	562.34	1,282.04	30.49%
合同履约成本	2.51	-	2.51	-
合计	84,366.39	30,483.71	53,882.68	36.13%
项目	2024 年 12 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	28,764.87	3,167.49	25,597.38	11.01%
在产品	23,071.34	15,904.08	7,167.26	68.93%
库存商品	3,693.49	1,309.63	2,383.85	35.46%
合同履约成本	1,552.60	79.39	1,473.21	5.11%
合计	57,082.29	20,460.59	36,621.70	35.84%
项目	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	38,358.30	2,763.48	35,594.82	7.20%
在产品	23,207.29	16,714.81	6,492.48	72.02%
库存商品	8,212.72	4,021.79	4,190.93	48.97%
合同履约成本	955.14	-	955.14	-
合计	70,733.45	23,500.07	47,233.37	33.22%

报告期各期末，公司按照原材料、在产品、库存商品和合同履约成本等分类对期末存货进行了减值测试。公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，公司根据不同存货的情况确认其可变现净值，可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法如下：

项目	确定可变现净值具体依据
原材料	根据原材料库龄及呆滞情况计提存货跌价准备
在产品	相关产成品预计售价减去预计进一步加工的成本、销售费用和税费后的金额
库存商品	预计售价减去预计销售费用和税费后的金额
发出商品	预计售价减去预计销售费用和税费后的金额
合同履约成本	预计售价减去预计进一步投入的成本、销售费用和税费后的金额

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 33.22%、35.84%和 36.13%，整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
中芯国际	11.15%	11.12%	9.76%
华虹宏力	13.29%	13.78%	13.94%
芯联集成	未披露	18.17%	23.32%
晶合集成	5.81%	2.59%	6.38%
燕东微	未披露	14.06%	1.62%
平均值	10.08%	11.94%	11.00%
发行人	36.13%	35.84%	33.22%

注：华虹宏力和芯联集成存货中分别包括房地产开发成本和开发产品（土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用等），此处计算存货跌价比例时未考虑该等项目。

报告期内，公司存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司，主要原因系公司尚处产能爬坡阶段，单个产品承担较大的折旧、摊销，未能良好地释放经济效益，导致单个产品生产成本高于可变现净值，公司各期末存货跌价计提比例相对较高。

6、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	86,874.25	94,248.81	28,504.10
待认证进项税额	35,755.48	29.95	25.01
待取得抵扣凭证的进项税额	2,211.21	957.35	557.40
待摊费用	1,397.23	540.39	280.00
IPO 发行费用	911.32	-	-
其他	112.12	2.44	5.30
合计	127,261.61	95,778.95	29,371.81

报告期各期末，公司其他流动资产账面金额分别为 29,371.81 万元、95,778.95 万元和 127,261.61 万元，占各期末流动资产的比例分别为 8.00%、30.77%和 14.85%。报告期内，为满足产能扩张需求，公司资本性投入持续增加，导致可抵扣的增值税进项税增长。然而，由于公司尚处于产能爬坡期，销项税额的增长速度暂时滞后于进项税，导致报告期各期末增值税留抵税额及待认证进项税额显著

增加，进而导致其他流动资产增长。

（二）非流动资产结构分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	6,644.95	0.42%	7,353.79	0.45%	1,431.20	0.09%
其他权益工具投资	7,331.82	0.46%	7,747.54	0.47%	11,738.47	0.76%
固定资产	1,239,559.85	77.97%	841,784.01	51.05%	708,891.57	46.15%
在建工程	158,647.41	9.98%	546,020.79	33.11%	290,469.43	18.91%
使用权资产	143.12	0.01%	37.14	0.002%	112.58	0.01%
无形资产	47,368.57	2.98%	49,609.01	3.01%	54,957.53	3.58%
长期待摊费用	99.82	0.01%	338.27	0.02%	702.47	0.05%
其他非流动资产	130,087.46	8.18%	196,202.88	11.90%	467,858.14	30.46%
合计	1,589,883.01	100.00%	1,649,093.43	100.00%	1,536,161.40	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和其他非流动资产等构成，上述项目合计占非流动资产的比例分别为 95.51%、96.05%和 96.13%。

1、长期股权投资

公司长期股权投资主要为对参股公司广州穗开创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉武粤光电技术有限公司和苏州德信芯片科技有限公司的投资。报告期各期末，长期股权投资账面价值分别为 1,431.20 万元、7,353.79 万元和 6,644.95 万元。

2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产的具体分类情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	236,622.45	23,629.17	-	212,993.29
机器设备	1,834,346.54	815,143.14	-	1,019,203.40
办公设备	14,754.22	8,246.81	-	6,507.41

运输设备	499.65	361.93	-	137.71
其他	5,951.54	5,233.49	-	718.04
合计	2,092,174.39	852,614.54	-	1,239,559.85
项目	2024 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	203,902.91	15,695.58	-	188,207.34
机器设备	1,231,278.23	584,982.43	-	646,295.80
办公设备	12,139.28	6,453.85	-	5,685.43
运输设备	463.75	305.53	-	158.22
其他	5,935.31	4,498.10	-	1,437.22
合计	1,453,719.49	611,935.48	-	841,784.01
项目	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	85,640.39	11,675.07	-	73,965.32
机器设备	1,039,721.06	414,827.34	-	624,893.72
办公设备	11,595.42	4,380.87	-	7,214.56
运输设备	463.75	221.20	-	242.55
其他	5,927.55	3,352.13	-	2,575.42
合计	1,143,348.17	434,456.61	-	708,891.57

报告期各期末，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等构成。报告期各期末，机器设备账面余额分别为 1,039,721.06 万元、1,231,278.23 万元和 1,834,346.54 万元，占固定资产比例分别为 90.94%、84.70% 和 87.68%，增幅较快，主要系公司为扩充产能新购机器设备所致。

公司与同行业可比公司的固定资产折旧年限对比如下：

公司名称	类别	折旧年限（年）	残值率（%）
中芯国际	房屋及建筑物	25	0
	机器设备	5-10	0
	办公设备	3-5	0
华虹宏力	房屋及建筑物	25	5
	机器设备	5-7	5
	厂务设施	10	5
	运输工具	5	5

公司名称	类别	折旧年限（年）	残值率（%）
	办公设备	5	5
芯联集成	房屋建筑物	25	0
	机器设备	5-10	0
	动力及基础设施	10	0
	办公设备及其他	3-5	0
晶合集成	房屋及建筑物	20-30	0
	动力及基础设施	20-30	0
	机器设备	5-10	0
	运输设备	4	0
	电子设备及其他	3-5	0
燕东微	房屋及建筑物	20-40	5
	机器设备	5-15	5
	运输工具	5-8	5
	电子专用设备	3-10	5
	办公设备及其他	3-10	5
粤芯半导体	房屋及建筑物	25	5
	机器设备	6	5
	办公设备	5	5
	运输设备	5	5
	其他	5	0-5

报告期内，公司固定资产折旧年限和同行业可比公司之间总体保持一致，不存在重大差异。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程期末余额具体如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
粤芯产业园（三期）	2,800.25	-	2,800.25
安装工程	21,830.85	-	21,830.85
在安装设备	133,591.03	-	133,591.03
其他	425.28	-	425.28

合计	158,647.41	-	158,647.41
项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
粤芯产业园（三期）	33,047.98	-	33,047.98
安装工程	10,750.26	-	10,750.26
在安装设备	500,662.23	-	500,662.23
其他	1,560.32	-	1,560.32
合计	546,020.79	-	546,020.79
项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
粤芯产业园（三期）	228,527.59	-	228,527.59
安装工程	10,662.56	-	10,662.56
在安装设备	51,279.28	-	51,279.28
其他	-	-	-
合计	290,469.43	-	290,469.43

报告期各期末，公司在建工程账面余额分别为 290,469.43 万元、546,020.79 万元和 158,647.41 万元，占非流动资产的比例分别为 18.91%、33.11%和 9.98%。2023 年至 2024 年，公司持续扩充产能，设备及工程投资较多，使得各期末在建工程账面余额逐年增长；2025 年，随着粤芯三期设备转固，在建工程余额有所下降。报告期各期末，公司在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	42,790.32	3,184.09	-	39,606.23
软件	25,493.95	19,221.78	-	6,272.17
特许权和专利权	9,336.48	7,846.31	-	1,490.18
合计	77,620.75	30,252.18	-	47,368.57
项目	2024 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计摊销	减值准备	账面价值

土地使用权	42,790.32	2,328.28	-	40,462.04
软件	24,273.97	16,415.63	-	7,858.34
特许权和专利权	8,501.48	7,212.85	-	1,288.63
合计	75,565.77	25,956.76	-	49,609.01
项目	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	42,790.32	1,472.48	-	41,317.84
软件	23,745.87	12,466.93	-	11,278.94
特许权和专利权	7,999.47	5,638.72	-	2,360.75
合计	74,535.66	19,578.13	-	54,957.53

报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为 54,957.53 万元、49,609.01 万元和 47,368.57 万元，占非流动资产的比例分别为 3.58%、3.01%和 2.98%。

报告期内，公司无形资产主要为土地使用权、软件、特许权和专利权。报告期内，公司无形资产均为正常使用状态，不存在减值迹象，未计提减值准备。

5、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付长期资产款	71,445.57	117,971.17	261,011.80
定期存款本息	54,820.22	74,008.91	204,223.71
待验收无形资产	3,821.67	4,222.80	2,622.63
合计	130,087.46	196,202.88	467,858.14

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 467,858.14 万元、196,202.88 万元和 130,087.46 万元，占各期末非流动资产比例分别为 30.46%、11.90%和 8.18%。

报告期内，公司其他非流动资产主要为预付长期资产款和定期存款本息，其变动主要受报告期内设备到货和长期资产购置款项支付影响。

（三）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标

报告期内，公司应收账款、存货周转能力情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	11.81	12.68	16.91
存货周转率（次/年）	5.67	4.38	3.28

报告期内，公司应收账款周转率变动主要受营收规模影响。报告期内，公司应收账款周转率呈现下降趋势，主要系公司营收规模扩大，应收账款余额增加幅度大于营业收入增长。公司应收账款周转率整体处于较高水平，公司下游客户信用良好、付款稳定，应收账款回款情况良好。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.28、4.38 和 5.67，呈增长趋势。

2、资产周转能力同行业比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司应收账款周转率和存货周转率对比情况如下：

应收账款周转率			
公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	14.74	17.96	10.87
华虹宏力	10.28	8.91	10.27
芯联集成	未披露	6.85	9.33
晶合集成	9.99	9.99	10.59
燕东微	未披露	1.28	2.25
平均值	11.67	9.00	8.66
发行人	11.81	12.68	16.91
存货周转率			
公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中芯国际	2.00	2.07	1.99
华虹宏力	2.45	2.27	2.34
芯联集成	未披露	2.55	2.31
晶合集成	4.82	4.39	3.86
燕东微	未披露	1.47	1.49

平均值	3.09	2.55	2.40
发行人	5.67	4.38	3.28

报告期内，公司应收账款周转率均高于同行业可比公司平均值，公司下游客户信用良好，付款稳定，应收账款回款情况良好。

报告期内，公司存货周转率均高于同行业可比公司平均水平，与晶合集成较为接近，主要系公司基于实际业务需求，持续完善采购与生产管理制度，实现对存货规模的有效管控，使其维持在较高水平。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析

（一）流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	13,010.80	2.74%	1,476.02	0.54%	63,633.25	19.74%
交易性金融负债	-	-	-	-	221.00	0.07%
应付票据	43,899.38	9.23%	21,123.24	7.76%	1,662.00	0.52%
应付账款	139,256.53	29.28%	116,187.71	42.68%	140,102.58	43.46%
合同负债	15,308.43	3.22%	14,602.52	5.36%	18,137.84	5.63%
应付职工薪酬	9,319.53	1.96%	7,617.98	2.80%	4,720.88	1.46%
应交税费	654.12	0.14%	619.73	0.23%	333.21	0.10%
其他应付款	93,449.49	19.65%	54,579.35	20.05%	54,442.85	16.89%
一年内到期的非流动负债	156,632.26	32.93%	53,504.43	19.65%	36,517.90	11.33%
其他流动负债	4,102.95	0.86%	2,549.06	0.94%	2,631.89	0.82%
合计	475,633.49	100.00%	272,260.04	100.00%	322,403.41	100.00%

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债等构成，上述项目合计占流动负债的比例分别为 97.03%、88.28% 和 87.81%。

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用借款	13,010.80	100.00%	1,476.02	100.00%	63,451.79	99.71%
票据贴现	-	-	-	-	181.46	0.29%
合计	13,010.80	100.00%	1,476.02	100.00%	63,633.25	100.00%

报告期各期末，公司短期借款分别为 63,633.25 万元、1,476.02 万元和 13,010.80 万元，占流动负债的比例分别为 19.74%、0.54%和 2.74%。公司出于生产经营需要，根据资金使用安排借入一定金额的短期借款用于日常经营周转。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行承兑汇票	43,899.38	100.00%	21,123.24	100.00%	1,662.00	100.00%
合计	43,899.38	100.00%	21,123.24	100.00%	1,662.00	100.00%

报告期各期末，公司应付票据分别为 1,662.00 万元、21,123.24 万元和 43,899.38 万元，占流动负债的比例分别为 0.52%、7.76%和 9.23%，随着公司业务规模的不断扩大而增加。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货款	35,777.94	25.69%	9,410.31	8.10%	12,243.67	8.74%
设备款	50,004.64	35.91%	55,921.10	48.13%	23,643.31	16.88%
工程款	36,166.11	25.97%	41,663.00	35.86%	94,350.10	67.34%
费用	17,307.84	12.43%	9,193.29	7.91%	9,865.50	7.04%
合计	139,256.53	100.00%	116,187.71	100.00%	140,102.58	100.00%

报告期各期末，公司应付账款分别为 140,102.58 万元、116,187.71 万元和 139,256.53 万元，占流动负债的比例分别为 43.46%、42.68%和 29.28%。2024 年

末，随着工程陆续完结，公司按合同约定支付了相应阶段的工程款项，应付工程款有所减少；2025 年末，公司应付账款较上年末增加 23,068.82 万元，一方面，应付工程款进一步减少，另一方面，随着业务规模扩大，公司原材料采购增加，应付货款有所增加。

4、合同负债

报告期内，公司合同负债主要为预收客户款项。报告期各期末，公司合同负债分别为 18,137.84 万元、14,602.52 万元和 15,308.43 万元，占流动负债比例分别为 5.63%、5.36%和 3.22%。

5、其他应付款

报告期内，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
投资款	50,000.00	53.50%	-	-	-	-
押金及保证金	38,886.96	41.61%	50,127.35	91.84%	52,685.88	96.77%
应付水电燃动及耗材费	363.02	0.39%	2,432.02	4.46%	425.89	0.78%
应付维保费	860.20	0.92%	78.67	0.14%	240.10	0.44%
应付员工福利相关费用	485.44	0.52%	350.85	0.64%	196.86	0.36%
应付物业管理相关费用	207.10	0.22%	155.25	0.28%	24.45	0.04%
其他	2,646.76	2.83%	1,435.22	2.63%	869.66	1.60%
合计	93,449.49	100.00%	54,579.35	100.00%	54,442.85	100.00%

报告期各期末，公司其他应付款分别为 54,442.85 万元、54,579.35 万元和 93,449.49 万元，占公司流动负债的比例分别为 16.89%、20.05%和 19.65%。

报告期内，公司其他应付款主要由投资款、押金及保证金、应付水电燃动及耗材费等构成，其中，押金及保证金占其他应付款的比例分别为 96.77%、91.84%和 41.61%。押金及保证金主要系客户缴纳的产能保证金。2025 年，公司其他应付款新增 5 亿元投资款，主要系粤芯四期收到的尚未达成交割条件的投资款。

6、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 4,720.88 万元、7,617.98 万元

和 9,319.53 万元，占公司流动负债的比例分别为 1.46%、2.80%和 1.96%。报告期内，公司应付职工薪酬总体呈现增长趋势，主要系人员规模扩张所致。

7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款	132,573.80	84.64%	51,410.20	96.09%	36,436.26	99.78%
一年内到期的长期应付款	24,001.65	15.32%	2,062.98	3.86%	-	-
一年内到期的租赁负债	56.81	0.04%	31.26	0.06%	81.64	0.22%
合计	156,632.26	100.00%	53,504.43	100.00%	36,517.90	100.00%

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 36,517.90 万元、53,504.43 万元和 156,632.26 万元，占公司流动负债比例分别为 11.33%、19.65%和 32.93%，主要为一年内到期的长期借款。

（二）非流动负债结构分析

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,349,048.61	85.22%	964,469.84	91.27%	835,459.06	96.09%
租赁负债	83.68	0.005%	3.08	0.0003%	34.33	0.004%
长期应付款	161,135.20	10.18%	17,500.00	1.66%	984.38	0.11%
递延收益	72,668.15	4.59%	74,691.15	7.07%	32,713.84	3.76%
递延所得税负债	-	-	-	-	260.77	0.03%
合计	1,582,935.65	100.00%	1,056,664.07	100.00%	869,452.38	100.00%

1、长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为 835,459.06 万元、964,469.84 万元和 1,349,048.61 万元，占非流动负债的比例分别为 96.09%、91.27%和 85.22%，主要为抵押借款、信用借款和保证借款。

报告期内，公司持续进行固定资产投入，业务规模快速增长，资金需求不断

提高。为匹配晶圆代工行业资本密集的特性并优化融资结构，公司适度增加了长期贷款规模，以保障中长期发展所需的资金支持。

2、长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
股东借款	-	-	984.38
融资租赁公司借款	185,136.85	19,562.98	-
小计	185,136.85	19,562.98	984.38
减：一年内到期长期应付款	24,001.65	2,062.98	-
合计	161,135.20	17,500.00	984.38

公司长期应付款包括股东借款和融资租赁公司借款。报告期各期末，公司长期应付款金额分别为 984.38 万元、17,500.00 万元和 161,135.20 万元，占非流动负债的比例分别为 0.11%、1.66%和 10.18%。2024 年及 2025 年，公司通过融资性售后回租方式进行融资，长期应付款增加。

3、递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为政府补助，金额分别为 32,713.84 万元、74,691.15 万元和 72,668.15 万元，占非流动负债的比例分别为 3.76%、7.07%和 4.59%。

（三）偿债能力分析

1、最近一期末主要债务情况

最近一期末，公司主要债务系银行借款、应付账款、其他应付款、长期应付款，截至 2025 年末，公司主要债务情况参见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析”之“（一）流动负债结构分析”及“（二）非流动负债结构分析”；公司尚未偿还的银行借款情况参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（四）重大借款合同”。

截至报告期末，公司不存在逾期未偿还款项，不存在借款费用资本化情形。

2、未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况

截至报告期末，公司未来十二个月内预计需偿还的流动负债金额合计为446,248.45 万元，主要为短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、一年内到期非流动负债等。报告期内，公司到期的借款本金及利息均已按期归还，银行资信状况良好，与主要金融机构和供应商保持长期良好合作关系，债务融资渠道通畅，且公司经营规模稳步扩大，可预见的未来发生无法偿还负债和利息的风险较低。

3、主要偿债指标分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下：

指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	77.61%	59.12%	56.13%
资产负债率（合并）	84.13%	67.79%	62.62%
指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	32,654.01	-16,697.43	950.32
利息保障倍数（倍）	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	62,122.54	63,964.58	9,971.89

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 62.62%、67.79%和 84.13%，呈持续上升趋势。该变动主要源于公司为产能扩张进行的重大资本性投入，导致债务融资规模增加。同时，由于公司尚处于产能爬坡阶段，前期投入形成的资产所产生的经济效益尚未完全释放，导致资产负债率上升。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 950.32 万元、-16,697.43 万元和 32,654.01 万元，2024 年，公司息税折旧摊销前利润为负数，主要系当年第二工厂产能建设尚未投产，筹建期间发生较大开办费用；2025 年度，随着产能进一步释放，毛利率水平提升，公司息税折旧摊销前利润由负转正。

报告期各期末，公司与同行业可比公司资产负债率对比情况如下：

公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
中芯国际	33.00%	35.17%	35.45%
华虹宏力	36.98%	28.67%	27.20%

公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
芯联集成	未披露	41.68%	49.80%
晶合集成	47.30%	48.23%	54.03%
燕东微	未披露	23.96%	18.81%
平均值	39.10%	35.54%	37.06%
公司	84.13%	67.79%	62.62%

报告期内，公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平主要系公司前期建设资金来源主要系银行贷款和股东贷款，导致债务规模较大。

（四）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（五）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	62,122.54	63,964.58	9,971.89
投资活动产生的现金流量净额	-170,759.23	-470,774.05	-185,409.73
筹资活动产生的现金流量净额	631,920.65	217,625.24	-20,444.72
现金及现金等价物净增加额	523,118.32	-189,384.21	-196,205.51

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	265,313.73	173,646.46	109,174.32
收到的税费返还	45.69	211.49	22,316.90
收到其他与经营活动有关的现金	77,897.73	76,870.75	55,085.01
经营活动现金流入小计	343,257.16	250,728.70	186,576.23
购买商品、接受劳务支付的现金	159,260.80	108,024.87	114,673.82
支付给职工以及为职工支付的现金	62,914.03	51,709.08	47,113.73
支付的各项税费	2,476.02	1,406.19	1,274.80
支付其他与经营活动有关的现金	56,483.76	25,623.98	13,542.01
经营活动现金流出小计	281,134.62	186,764.12	176,604.35

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	62,122.54	63,964.58	9,971.89

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 9,971.89 万元、63,964.58 万元和 62,122.54 万元。公司经营活动现金流量主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，与公司销售收入变动趋势基本一致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	-249,014.97	-232,723.92	-191,711.34
加：资产减值损失	28,527.50	18,092.99	22,815.11
信用减值损失	192.52	78.71	55.68
固定资产折旧	240,679.83	177,478.87	157,907.60
使用权资产折旧	57.71	75.44	75.44
无形资产摊销	4,295.41	6,378.63	6,147.24
长期待摊费用摊销	238.45	364.20	340.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3.10	-	2.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-154.18
财务费用（收益以“-”号填列）	33,054.75	32,337.19	24,770.79
投资损失（收益以“-”号填列）	1,208.83	259.36	-854.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,788.47	-7,481.32	-23,354.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,086.90	-71,252.38	-34,839.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,311.10	133,985.30	42,695.25
其他	6,443.68	6,371.51	6,074.90
经营活动产生的现金流量净额	62,122.54	63,964.58	9,971.89

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系由“固定资产折旧”、“经营性应收项目的变动”、“经营性应付项目的变动”和“存货的变动”引起。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	130,000.00	347,500.00	1,033,333.80
取得投资收益收到的现金	1,793.85	6,556.93	2,728.75
收到其他与投资活动有关的现金	77,498.00	17,641.58	49,091.61
投资活动现金流入小计	209,291.85	371,698.52	1,085,154.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,072.47	514,839.19	411,075.10
投资支付的现金	111,500.00	227,000.00	826,333.80
支付其他与投资活动有关的现金	26,478.61	100,633.37	33,154.98
投资活动现金流出小计	380,051.08	842,472.56	1,270,563.89
投资活动产生的现金流量净额	-170,759.23	-470,774.05	-185,409.73

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-185,409.73 万元、-470,774.05 万元和-170,759.23 万元。报告期内，公司为扩充产能持续进行厂房、设备等长期资产的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资所收到的现金	50,000.00	150,000.00	-
取得借款收到的现金	569,034.47	373,742.03	234,885.64
收到其他与筹资活动有关的现金	176,510.20	20,000.00	-
筹资活动现金流入小计	795,544.67	543,742.03	234,885.64
偿还债务支付的现金	92,004.81	293,070.15	227,048.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,372.17	32,462.39	28,190.23
支付其他与筹资活动有关的现金	36,247.04	584.26	92.07
筹资活动现金流出小计	163,624.02	326,116.79	255,330.36
筹资活动产生的现金流量净额	631,920.65	217,625.24	-20,444.72

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-20,444.72 万元、217,625.24 万元和 631,920.65 万元。报告期内，公司筹资活动现金流入金额较大且呈现一定波动，主要系晶圆代工属于资本密集型行业，公司发展初期为快速推

进产线建设、产能扩充和技术研发，根据自身发展规划及资金需求，通过股权融资、银行贷款等方式补充资金。

（六）公司流动性的重大变化及风险趋势分析

1、流动性分析

报告期内，公司主要流动性指标如下：

指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.80	1.14	1.14
速动比率（倍）	1.69	1.01	0.99

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.14、1.14 和 1.80，速动比率分别为 0.99、1.01 和 1.69，公司流动性指标得到改善。

2、同行业可比公司流动性指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标与同行业可比公司比较情况如下：

财务指标	公司名称	2025 年	2024 年	2023 年
流动比率 （倍）	中芯国际	2.36	1.73	1.84
	华虹宏力	3.56	3.73	6.76
	芯联集成	未披露	1.79	1.03
	晶合集成	1.43	1.31	0.85
	燕东微	未披露	3.09	5.28
	平均值	2.45	2.33	3.15
	公司	1.80	1.14	1.14
速动比率 （倍）	中芯国际	1.81	1.38	1.47
	华虹宏力	3.15	3.29	6.11
	芯联集成	未披露	1.43	0.74
	晶合集成	1.11	1.11	0.75
	燕东微	未披露	2.88	4.84
	平均值	2.02	2.02	2.78
	公司	1.69	1.01	0.99

注：以上数据来源于上市公司定期报告或招股说明书。

公司流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平主要系：公司开展第二工厂项目建设，对资金需求较大，与此同时，华虹宏力、芯联集成和晶合集成

等同行行业可比公司均在 2023 年首次公开发行股票并在科创板上市募集了大量资金，导致其流动比率和速动比率相对较高。

十三、持续经营能力分析

（一）公司的主要经营状况

公司主要从事 12 英寸模拟芯片晶圆代工业务，为下游客户提供多种制程节点、丰富工艺平台的晶圆代工服务。报告期内，公司营业收入分别为 104,371.92 万元、168,132.90 万元和 258,236.87 万元，2023-2025 年均复合增长率高达 57.30%，公司持续经营能力不断增强。

公司秉承以市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有完整的技术布局，并且形成了较强的技术研发及规模化工艺开发能力。公司通过持续创新研发积累了丰富的核心技术，截至报告期末，公司已取得授权专利（含境外专利）712 项，其中发明专利 343 项。公司承担了多项国家级、省市级半导体领域相关的科研项目，并先后被认定为“广东省企业技术中心”、“广东省工程研究中心”。

公司一直致力于客户资源的扩展和积累，已成功导入大量优质客户，获得了市场的高度认可和行业口碑。报告期内，公司晶圆产品累计出货量达到 120 万片以上，公司晶圆代工业务发展势头良好。

（二）与持续经营有关的重大风险或不利因素

对公司经营能力产生重大不利影响的因素包括工艺技术平台迭代不达预期、核心技术泄密风险、核心人员不足或流失风险、公司多方面经营受限风险、固定资产投资风险、政府补助政策变化风险等，具体情况请参见本招股说明书之“第三节 风险因素”。

（三）管理层对持续经营能力的自我研判

未来几年，随着晶圆代工行业持续发展，公司产能产量扩充、持续研发创新、扩展客户资源、不断优化现金流，公司业务规模将持续增长，公司具有持续经营能力。决定公司具有持续经营能力的关键因素具体如下：

1、晶圆代工行业市场潜力大

全球晶圆代工市场规模持续增长。根据 Yole 统计，2024 年，全球晶圆代工市场规模达到 1,410 亿美元，同比增长 16.53%，预计 2029 年全球晶圆代工市场规模将达到 2,490 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 12.05%。同时，中国晶圆代工市场规模保持高速增长趋势。根据 SEMI 等机构统计，2024 年中国晶圆代工行业市场规模提升至 143 亿美元，同比增长 20.17%；预计 2029 年将达到 266 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 13.22%。未来，随着中国半导体产业链逐渐完善、产业内生性及国产替代需求增加，预计中国大陆晶圆代工行业市场规模将持续保持较高速增长趋势。

集成电路是现代科技与经济核心支柱，是国家鼓励、扶持的战略性新兴产业，占据国家发展布局中至关重要的战略地位。目前我国芯片自给率仍较低，国产替代空间巨大。推动模拟芯片自给率提升是国家推动集成电路产业自主可控战略布局的重要组成部分和引导方向。公司是国产芯片设计企业的专用工艺和代工产能支撑。通过特色的“终端-设计-制造”融合的模式和敏捷响应的特色工艺晶圆代工服务，公司将会成为我国芯片国产化替代的受益者。

2、公司产能扩充和产量提升

产能规模的有效建设，有利于降低单位成本、提升议价能力、保证交付周期、加强对大客户的吸引力、提高综合资源利用效益，对公司进一步拓展晶圆代工市场、实现公司业务扩张、增强整体市场竞争力具有重要的意义。公司将在继续巩固模拟特色工艺优势的前提下，战略性地精准补充和优化产能，将重心转向深度强化特色工艺平台能力与构建跨越式差异化竞争优势，实现从“纯模拟代工”向“以模拟为核心，以数字升级为蝶变，以光电融合为特色”的复合型技术平台转型。

3、持续研发创新能力强

公司拥有一支研发经验丰富、技术能力成熟的研发团队，能够快速响应客户的工艺研发和制造需求，凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力，获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。报告期内，公司研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入的比例分别为 58.00%、26.50%

和 16.36%。

4、客户资源优质，合作模式创新

公司坚持特色工艺路线，基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够以高质量的标准，开发具有市场竞争力的工艺平台。同时，公司深度协同芯片设计公司及终端客户，推动终端、设计与制造协同优化的创新模式，共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案，积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。公司不断扩大公司专业品牌和影响力，奠定了公司未来持续快速发展的基础，增强了客户粘性，提升了公司的市场竞争优势。

5、公司现金流持续改善

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 9,971.89 万元、63,964.58 万元和 62,122.54 万元，为公司带来了充裕的现金流入。公司账面货币资金充足，债务水平合理，主要流动性指标与同行业可比公司相比不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 636,992.25 万元，资金状况良好，可满足公司研发投入、厂房建设等需求。未来，随着公司客户持续开拓，经营管理不断优化，以及工艺平台取得重点突破，公司预计未来几年亏损规模将不断收窄，毛利率等指标将会逐渐提升。同时，本次公开发行后，公司净资产将进一步扩大，偿债能力可以进一步改善，公司可以立足于现有业务与技术积累，扩大生产规模、增强研发实力，以更高效地响应市场需求，为公司后续快速发展提供基础。

综上所述，在晶圆代工市场规模逐渐扩大及国产化替代趋势的背景下，受到公司产能扩充和产量提升、持续研发创新能力强、客户资源扩展、现金流持续改善等因素的影响，公司业务规模和盈利能力将逐渐提升，持续经营能力将会进一步增强。

十四、报告期重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况

（一）重大投资事项

2022 年 9 月，粤芯集成出资设立粤芯三期，注册资本为 10 亿元，粤芯集成

认缴 10 亿元，出资比例为 100%；2023 年 8 月，粤芯三期注册资本增至 50 亿元，粤芯集成认缴 50 亿元，出资比例为 100%；2025 年 12 月，粤芯三期注册资本增至 75 亿元，粤芯集成认缴 60 亿元，出资比例为 80.00%。

2025 年 10 月，粤芯集成出资设立粤芯四期，注册资本为 5,000 万元，粤芯集成认缴 5,000 万元，出资比例为 100%。

报告期内，公司其他对外投资情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况”。

（二）资本性支出事项

1、报告期内重大资本性支出

公司所处的晶圆代工行业系技术、资本、人才密集型行业，前期厂房建设和设备购置等投入较大。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 411,075.10 万元、514,839.19 万元和 242,072.47 万元。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行的募集资金投资项目（12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目））及 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线项目（四期项目）。

本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

粤芯四期建设项目的投资总额为 252 亿元。四期项目的实施及推进，将以“十五五”规划纲要中关于集成电路产业发展的相关定位为导向，深度强化公司特色工艺平台能力与构建跨越式差异化竞争优势，基于公司已形成的技术基础，围绕 AI 重点布局五大特色工艺平台的产能建设：65nm 硅光及光电融合工艺平台、40nm 图像传感器工艺平台、40nm 嵌入式存储工艺平台、22nm 混合信号及射频工艺平台和 22nm OLED 显示驱动工艺平台，满足人工智能应用所需的“感知、传输、存储、计算、交互”全技术链的协同突破与迭代。公司将通过持续升级特色工艺水平、提供多样化和专业化的解决方案，最终构建起多层次、高价值的特色工艺平台，精准契合国家对于高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片

自主可控与创新发展的迫切需求。

（三）重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组或股权收购合并事项。

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2026年2月26日，公司2026年第一次临时股东会审议通过关于粤芯四期合资经营方案的议案，粤芯四期拟新增注册资本80亿元，新增注册资本由粤芯集成及广东半导体基金等各方以货币形式认缴，增资价格为1元/注册资本。

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司与设备供应商北京芯鸿伟业科技有限公司存在一起买卖合同纠纷，涉及诉讼保全，公司名下银行存款169.87万元已被冻结。截至2025年12月31日，本案正在审理中。该事项对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

截至2025年12月31日，公司不存在其他应披露而未披露的重大或有事项。

（三）重大担保和诉讼事项

公司的担保、诉讼事项请参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“二、公司对外担保情况”及“三、重大诉讼或仲裁事项”。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露而未披露的其他重要事项。

十六、盈利预测报告

公司未编制盈利预测报告。

十七、公司未来经营状况和盈利能力发展趋势

（一）未来可实现盈利的总体分析

公司主要从事集成电路制造环节中的12英寸晶圆代工业务，具备集成电路、

功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力，涵盖 MS、HV、CIS、eNVM、BCD、MOSFET、IGBT 等工艺技术平台。同时，公司于 2024 年成功推出的 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台现已具备规模化量产能力，以满足国内市场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司成立以来，紧密贴合模拟芯片品类多样化的行业特点，持续丰富自身产品组合，目前已具备较完整的成熟节点工艺制程，可为客户提供 180-55nm 等多个制程节点的特色晶圆代工服务，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。公司秉承以市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有前瞻性的技术布局，并且形成了较强的技术研发及规模化工艺开发能力。公司凭借“终端、设计与制造”的创新协同优化模式，增强了客户粘性，以灵活的经营策略，快速响应客户需求。目前公司的主要客户涵盖境内外多家一流芯片设计公司，终端客户覆盖国内主要的手机厂商、行业知名云服务厂商等。市场的高度认可与良好的行业口碑，扩大了公司专业品牌和影响力，奠定了公司未来持续快速发展的基础。

未来公司将依托制造工艺的持续精进、持续的研发投入、广泛的行业覆盖面、良好的行业认可度、规模化采购优势，围绕保持收入快速增长、优化产品结构、持续降低生产成本、继续研发创新等方面，努力实现收入规模快速增长和产品毛利率水平逐步提高，并采取进一步措施提升公司盈利能力。公司有望未来收窄亏损并实现盈利。

（二）未来可实现盈利的假设条件

- 1、公司经营所涉及的国家和社会环境无重大不利变化；
- 2、公司所遵循的相关法律法规、行业监管体系无重大不利变化；
- 3、国家战略规划、产业鼓励政策和区域发展政策无重大不利变化；
- 4、公司所处行业与市场环境不会发生重大不利变化；
- 5、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其他不可抗力因素；
- 6、公司核心团队保持稳定，无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的重大人事变动；

7、公司技术创新以及研发成果转化表现持续保持较高水平，公司新产品研发符合行业发展趋势、商业化进展顺利，未发生重大不利影响；

8、公司现存客户的合作关系稳定，且基于报告期的客户基础继续市场开发，客户认可度和品牌知名度持续提高，公司行业地位进一步提升；

9、公司制造工艺水平继续提升，在研项目按照公司计划完成并导入客户，公司中高端产品占比按照公司计划进一步提升。公司主要产品的定价机制未发生重大不利改变，维持目前公平竞争的市场环境；

10、公司的收入规模增长基本符合公司预期。收入增长速度预期将高于相对稳定的期间费用增长速度，期间费用率出现合理下降；

11、公司产品结构持续优化，公司产品均价呈平稳增长趋势；公司主要原材料供应稳定，价格无重大变化影响，公司主要产品成本按照公司计划进一步优化和降低；

12、公司第一工厂产能利用率整体保持稳定、不会出现大幅下滑，第二工厂及已启动建设的第三工厂产能利用率逐步提升，规模效益提升；

13、本次公司股票发行上市成功，募集资金顺利到位，募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益。

（三）前瞻性信息及其依据

1、公司未来是否盈利的前瞻性信息

报告期内，公司营业收入规模呈现持续增长态势，2023-2025 年均复合增长率高达 57.30%。公司所处的晶圆代工行业属于重资产投入行业，行业内企业在产能爬坡过程中，会出现由于折旧规模较大但规模效益尚未体现而形成较大亏损的情况。后续随着公司三期产线完成产能爬坡，结合公司收入规模持续扩大、产品结构优化、项目效益释放、固定资产折旧金额下降、生产成本管理加强等因素，公司盈利情况将逐步改善。公司管理层根据现有产能建设、销售计划及研发投入情况等因素，预计公司最早于 2029 年整体实现扭亏为盈，合并报表可实现盈利。

上述预测性信息为发行人管理层基于发行人的经营状况及市场情况做出的预测，受到上述多重因素的影响，该等预测性信息与未来的实际情况可能存在一

定的偏差。发行人提醒投资者注意，本公司前瞻性信息是建立在推测性假设数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者应谨慎使用。

2、前瞻性信息的依据

（1）晶圆代工市场规模持续增长，国产替代空间巨大

全球晶圆代工市场规模持续增长。根据 Yole 统计，2024 年，全球晶圆代工市场规模达到 1,410 亿美元，同比增长 16.53%，预计 2029 年全球晶圆代工市场规模将达到 2,490 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 12.05%。同时，中国晶圆代工市场规模保持高速增长趋势。根据 SEMI 等机构统计，2024 年中国晶圆代工行业市场规模提升至 143 亿美元，同比增长 20.17%；预计 2029 年将达到 266 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 13.22%。未来，随着中国半导体产业链逐渐完善、产业内生性及国产替代需求增加，预计中国大陆晶圆代工行业市场规模将持续保持较高速增长趋势。

集成电路是现代科技与经济核心支柱，是国家鼓励、扶持的战略性新兴产业，占据国家发展布局中至关重要的战略地位。目前我国芯片自给率仍较低，国产替代空间巨大。推动芯片自给率提升是国家推动集成电路产业自主可控战略布局的重要组成部分和引导方向。在国家大力倡导集成电路自主可控的背景下，我国芯片国产化替代率和芯片自给率将会显著提升。

（2）下游应用领域市场需求持续增长

公司主要产品终端应用于消费电子、汽车电子、智能工业和人工智能领域，下游应用领域市场需求将持续增长。

消费电子行业属于国家支柱产业，在国民经济生产中占有重要地位。随着技术创新，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。随着全球经济发展，消费电子产品市场需求持续增长，促进了消费电子行业的快速健康发展。根据 Statista 预测，2028 年全球消费电子市场规模将达到 11,767 亿美元，2018-2028 年均复合增长率约为 2.50%。

车规级和工业级芯片市场需求持续旺盛。受益于智能驾驶和智能座舱的渗透率提升及汽车销量的增加，车用芯片需求量增加。智能座舱与智能驾驶带动单车

芯片数量倍增，更高阶智能驾驶和智能座舱的要求将会驱动更多微控制器、存储、信号处理、电源管理、电机驱动、图像传感器等芯片的需求，进而带动对车规级芯片晶圆代工服务的需求。同时，工业自动化与智能化设备普及率提升带动工业级芯片下游用量增加。自动化与智能化工业设备的逐渐增加将会带动工业级芯片需求。

人工智能带动硅光芯片应用领域快速发展。人工智能行业快速发展，大模型需要处理海量数据，带动对设备算力、连接、存储等要求提升。硅光技术提供了连接和计算的新的解决路径。硅光技术以光代电，硅光模块、数据中心光互联及光电共封装等先进产品预期会持续放量。同时，硅光通信相关产品需求将会在未来几年实现可观增长，为硅光芯片市场注入发展新动力。

（3）公司完善产品布局，新产品逐步放量

公司目前已实现 180nm-55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，已具备 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台的制造能力。公司产品广泛应用于指纹识别、图像传感、显示驱动、光互联和功率器件等领域，可覆盖消费电子、汽车电子、工业控制和人工智能等产业对模拟芯片的应用需求。随着下游终端应用的需求演进，芯片设计公司在特色晶圆代工服务的需求增加，推动公司顺应市场发展，合理布局产品矩阵。产品规划战略上，公司一方面瞄准工控级和车规级工艺技术平台，依托现有平台优势，构建“消费-工业-汽车”多场景解决方案；另一方面，公司布局特色 BCD 工艺平台，开发存储、功率分立器件、高压、大电流、高数字密度等与 BCD 融合集成的技术平台，实现差异化竞争；同时，在人工智能时代的产业背景下，公司顺应大数据、云计算、端侧推理和计算加速的发展趋势，为满足对设备高速连接、数据高速传输等日益增长的需求，积极布局可应用于光模块、光互联和光电共封产品的硅光工艺技术平台，把握硅光晶圆代工技术的先发优势。

公司目前已在汽车电子、工业控制和硅光技术等应用领域实现了产品的前瞻性布局。公司已有多个平台处于车规工艺的研发、验证及量产阶段，其中 18 款产品已通过终端整车厂的车规认证。同时，公司围绕电力、轨道交通、石油石化等关键工业领域，已开展工业芯片工艺开发及工业核心芯片产品技术研究，推动重点工业领域芯片制造国产化进程。此外，公司目前已与多家光芯片设计公司形

成合作，并持续开发光电融合关键技术和有关工艺，部分产品终端客户已涵盖行业知名云服务厂商。

（4）公司持续打造产业生态，丰富公司客户资源

报告期内，公司凭借产业生态打造，持续导入新产品、新客户。凭借“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路，公司打造以晶圆代工为核心，以芯片设计公司和终端应用领域客户为重点的晶圆代工产业生态，持续拓展、导入新产品及新客户。一方面，公司紧跟现有市场趋势及根据现有客户对技术工艺的迭代需求，针对性地研发新制程节点及工艺平台，深度契合客户新产品开发路径，成功实现现有客户新产品的持续导入。另一方面，公司通过深度协同芯片设计公司及终端应用客户，推动终端需求、设计优化与制造工艺协同创新的合作模式，共同探索工艺制造与设计优化的解决方案，有效拓展并引进新客户，进一步扩大客户基础，持续拓展市场份额。

截至 2025 年末，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司等多家细分领域行业龙头企业。依托于公司深厚的技术积累及良好的市场口碑等优势，公司不断提升产品市场竞争力，为业务快速拓展奠定基础。未来，公司将持续发挥产业生态和经营模式优势，深化新客户、新产品的拓展，增强客户粘性，逐步提升公司的市场规模。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》，拟公开发行人民币普通股不超过 788,530,465 股，占发行后总股本的比例不低于 10%，募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后的净额计划用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）	162.50	35.00
2	特色工艺技术平台研发项目	30.00	25.00
2.1	基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封装关键技术研发项目	7.70	7.30
2.2	基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目	6.50	6.20
2.3	基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目	15.80	11.50
3	补充流动资金	15.00	15.00
合计		207.50	75.00

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自有资金以及银行贷款等自筹资金方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述拟投入募集资金总额，则公司根据发展规划及实际生产经营需求，将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定，履行相应法定程序后，合理使用。

（二）募集资金使用管理制度

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司上市后适用的《募集资金管理制度》，规定募集资金存放及使用的内容。公司募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司《募集资金管理制度》进行。

本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专户存储、专款专用的方式管理

募集资金，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督，根据项目的进度安排，按以上募集资金投资项目计划投入。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响

公司本次募集资金投资项目，立足于现有业务与技术积累，旨在扩大生产规模、增强研发实力，以更高效地响应市场需求。项目的实施预计将显著提升公司在 12 英寸特色工艺晶圆代工领域的市场竞争力，全面强化生产能力、研发能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（四）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目系经审慎论证公司主营业务、经营规模、技术水平及管理能力，并紧密契合公司长期发展战略目标后确定，具备充分的合理性与必要性。

相关项目是公司落实既定战略规划、达成业务发展目标的核心举措，旨在特色工艺晶圆代工领域强化差异化竞争格局并丰富业务布局，同时确保与公司当前执行中的建设项目有序协同与有效衔接。

本次募集资金投资项目的顺利实施，将助力公司把握国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片产业生态建设的重要战略机遇期，集中资源突破相关代工产能供给瓶颈，推动公司优势工艺技术的持续升级迭代，拓展客户产品应用场景的深度与广度，并强化对产业链上下游的辐射带动效应，加速构建完善产业生态体系。

（五）募集资金投资项目实施后对同业竞争及独立性的影响

本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，由母公司及控股子公司粤芯三期实施，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（六）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

本次计划实施的募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，主要目标是扩大产能规模、增强研发实力、丰富工艺技术平台，提升公司核心竞争力。本次募集资金重点投向科技创新领域的具体安排参见本节“二、募集资金投资项目介

绍”。

二、募集资金投资项目介绍

（一）12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）

1、项目概况

公司计划建设一条规划月产能 4 万片的 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目，实现年产能 48 万片晶圆，重点面向工业级、车规级等应用市场。本项目的工艺制程覆盖 180nm-90nm，包括 BCD、MS、eNVM、HV、SiPho、IGBT 等特色工艺技术平台，性能水平对标国际主流水准。

本项目的实施主体为粤芯三期，投资规划总额为 162.50 亿元，拟使用募集资金投入 35.00 亿元。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 162.50 亿元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（亿元）	占投资总额比例
1	生产及附属设备购置费	120.52	74.17%
2	建筑工程及安装费	32.32	19.89%
3	土地费用	3.67	2.26%
4	自动化、IP 及其他投资费用	5.99	3.69%
合计		162.50	100.00%

3、项目周期和时间进度

本项目已由公司以自筹资金先行投入建设，并于 2025 年**一季度**开始逐步投产，计划于 2026 年**四季度**达产，实现 12 英寸晶圆产能 4 万片/月。

4、项目涉及土地使用权情况

粤芯三期已取得编号为粤（2023）广州市不动产权第 06079114 号的土地使用权证。

5、项目审批、核准或备案情况

本项目已履行国家相关主管部门审批程序，已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2208-440116-04-01-297167）和《关于广州粤芯半导体技术有

限公司 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期）环境影响报告表的批复》（穗开审批环评〔2022〕244 号）。

（二）特色工艺技术平台研发项目

公司结合实际经营情况与未来发展目标，将本次募集资金中的 25.00 亿元用于特色工艺技术平台研发项目，包括基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封关键技术研发项目、基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目和基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目。本项目的实施主体为发行人。上述研发项目有助于公司拓展在人工智能、物联网、数据中心、汽车电子及工业控制等应用领域的自主创新和研发能力，进一步提升公司特色工艺技术平台的技术水平。

1、基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封关键技术研发项目

（1）项目概况

公司将基于已有 90nm SiPho 工艺技术平台及 CMOS 工艺基础，开展 65nm 硅光集成核心技术研发，包括微环调制器、锗探测器工艺、硅波导、低损耗氮化硅波导、表面和端面耦合器、热调和电调制器等；开展硅基转接板（Silicon Interposer）工艺开发、硅光芯片与电芯片的集成（光引擎）工艺研发。

本项目规划总投资额 7.70 亿元，拟使用募集资金投入 7.30 亿元。通过实施本项目，公司将完成适用于 800G 及以上高速高带宽光模块工艺技术平台、适用于光电共封装的光引擎集成工艺和适用于光输入输出接口的微环调制器工艺的研发。相关工艺的关键性能（如传输损耗、耦合效率、探测器暗电流/响应度等）达到国际先进水平，覆盖数据中心光互联、光电共封装及光输入输出接口等核心应用领域。

（2）项目投资概算

本项目规划总投资额 7.70 亿元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（亿元）	占投资总额比例
1	研发设备购置费	5.90	76.62%
2	委外测试/外包、EDA 工具	0.30	3.90%
3	研发光罩及晶圆耗材	0.70	9.09%

序号	项目名称	投资金额（亿元）	占投资总额比例
4	人力费用	0.80	10.39%
合计		7.70	100.00%

（3）项目周期和时间进度

本项目的研发周期约为 48 个月，公司将根据市场需求、研发计划及研发资金规划等情况逐步开展项目的研发工作。

2、基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目

（1）项目概况

公司将基于现有 180nm-95nm eNVM 工艺基础，开发 40nm eNVM 工艺技术平台的核心关键技术，以推出具备全球竞争力的超低功耗、高可靠性 MCU（微控制器）工艺技术。本项目将结合超低功耗逻辑工艺，采用 SONOS（硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅）技术实现存储单元内嵌。

本项目规划总投资额 6.50 亿元，拟使用募集资金投入 6.20 亿元。通过实施本项目，公司将具备 40nm eNVM 工艺的生产能力，满足工业控制、汽车电子、人工智能、物联网等战略新兴产业对高性能 MCU 的需求。

（2）项目投资概算

本项目规划总投资额 6.50 亿元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（亿元）	占投资总额比例
1	研发设备购置费	4.00	61.54%
2	委外测试/外包、EDA 工具	0.30	4.62%
3	第三方 IP 授权费用	0.50	7.69%
4	研发光罩及晶圆耗材	0.70	10.77%
5	人力费用	1.00	15.38%
合计		6.50	100.00%

（3）项目周期和时间进度

本项目的研发周期约为 60 个月，公司将根据市场需求、研发计划及研发资金规划等情况逐步开展项目的研发工作。

3、基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目

（1）项目概况

公司将基于现有的 OxRAM（氧空位随机存储器）技术，开发与现有的晶体管制造材料和流程兼容的工艺技术，创新发明可替代现有常规的新型存储器件架构，以实现更好的产品性能（如更耐用，低功耗，操作电压小，面积小）。

本项目规划总投资额 15.80 亿元，拟使用募集资金投入 11.50 亿元。通过实施本项目，公司将完成 22nm 逻辑工艺固化及工艺可靠性验证、22nm 逻辑与 RRAM 存储器件的高密度集成，覆盖汽车电子、AI 边缘计算、工业物联网等核心应用领域。

（2）项目投资概算

本项目规划总投资额 15.80 亿元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（亿元）	占投资总额比例
1	研发设备购置费	11.70	74.05%
2	委外测试/外包、EDA 工具	0.70	4.43%
3	第三方 IP 授权费用	1.40	8.86%
4	研发光罩及晶圆耗材	0.80	5.06%
5	人力费用	1.20	7.59%
合计		15.80	100.00%

（3）项目周期和时间进度

本项目的研发周期约为 60 个月，公司将根据市场需求、研发计划及研发资金规划等情况逐步开展项目的研发工作。

4、项目涉及土地使用权情况

本项目将在公司现有厂区内实施，不涉及新增土地及厂房的情况。

5、项目审批、核准或备案情况

本项目已履行国家相关主管部门审批程序，上述研发项目均已获取《广东省企业投资项目备案证》，具体情况如下：

序号	项目名称	备案文号
1	基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封关键技术研	2511-440112-04-05-418259

序号	项目名称	备案文号
	发项目	
2	基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目	2511-440112-04-05-334485
3	基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目	2511-440112-04-05-669957

（三）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 15.00 亿元用于补充公司主营业务发展所需要的流动资金。伴随业务规模持续扩大，公司营运资金需求相应增加。本次拟将部分募集资金用于补充营运资金降低公司资产负债率、优化资本结构，有效满足公司持续研发投入及业务扩张的增长需求，为公司持续经营及长远发展提供资金保障。

三、项目的必要性与可行性分析

（一）项目的必要性

1、公司亟需完成产能扩充，以加快业务拓展，提升市场竞争力

近年来，随着汽车电子、工业控制、人工智能等领域的快速发展，下游市场对半导体产品的需求量不断提升，为制造端的晶圆代工企业提供了产能扩充的空间。根据 Yole 统计，2024 年全球半导体晶圆需求量（等效 12 英寸）约 848 万片/月，预计 2028 年将进一步增长至 1,014 万片/月，2024-2028 年均复合增长率约 4.57%。

2025 年度，公司产能利用率高达 96.38%，总体产能已经趋于饱和。然而，与全球领先的晶圆代工企业相比，公司在产能规模上仍存在一定差距，这在一定程度上制约了公司的持续快速发展。因此，加快推进产能建设，对于公司拓展业务、提升整体市场竞争力具有关键意义。

2、模拟芯片市场需求稳步增长，国产替代空间广阔

根据 Statista 统计，2024 年全球模拟芯片市场规模为 826.8 亿美元，其中中国模拟芯片市场规模为 1,986.4 亿元，约占全球模拟芯片市场规模的 33.39%；2028 年全球模拟芯片市场规模有望增长至 1,160.4 亿美元，中国模拟芯片市场规模将达 2,587.7 亿元，模拟芯片市场空间广阔。根据海关总署数据，2024 年，我

国集成电路进口总额达 3,856 亿美元，出口总额为 1,595 亿美元，贸易逆差为 2,261 亿美元。根据智研咨询统计，中国模拟芯片自给率从 2019 年的 9% 提升至 2024 年的 16% 左右。虽然我国模拟芯片自给率已逐步提升，但相对市场需求自给率仍然较低，国产替代空间巨大。

3、下游应用市场蓬勃发展，多样化场景需求蕴含巨大市场空间

受益于人工智能、云计算、大数据、物联网等行业的蓬勃发展，硅光芯片、微控制器及存算一体芯片在新兴市场的空间巨大。

硅光芯片方面，硅光集成凭借其高性能、低成本、低功耗的光电融合系统，已成为超大规模数据中心内部互联的关键技术。根据 Yole 预测，2029 年全球硅光光模块市场规模预计将达 102.60 亿美元，2023-2029 年均复合增长率接近 40%，市场空间巨大。近年来，全球光电子产业布局加速推进，各国正围绕产业链核心环节展开战略性卡位与系统性投资。虽然中国光模块产业已具备全球竞争力，其中中际旭创、新易盛等企业在 400G/800G 光模块领域市场份额全球领先，但是产业链上游的原材料、设备及芯片制造等环节仍高度依赖进口，亟需通过加快完善相关产业布局，实现光电子产业链自主可控。

微控制器方面，SONOS MCU 凭借其卓越的低功耗特性及硬件级安全优势，精准契合新能源汽车、高端装备制造、工业物联网、智能家居等领域对高性能嵌入式闪存解决方案的迫切需求。在汽车电子领域，其符合车规级标准的高可靠性与长寿命特性，助力智能座舱、车身控制等应用升级；在工业领域，其强化的高温运行稳定性与耐久性，为工业自动化、智能电网等关键基础设施提供可靠支撑。应用市场的多元化扩张，为 SONOS MCU 技术的规模化应用和迭代创新提供了广阔空间和持续动力。

存算一体芯片方面，将数据存储与计算功能融合在同一芯片甚至同一存储单元的集成技术，显著减少了传统计算芯片架构下的传输延迟与功耗损失，提升了计算效率和能效比，高度契合物联网、大数据、云计算等数据密集型应用场景的计算需求。在物联网领域，根据 Gartner 统计，2024 年全球物联网设备出货量约 20.69 亿台，预计 2030 年将达到 28.44 亿台，设备实时产生的环境监测、工业运行等数据需即时处理，存算一体芯片可满足边缘端低延迟计算需求；在大数据与

云计算领域，根据 IDC 统计，2025 年全球将产生 213.56 泽字节（ZB）数据，到 2029 年将达到 527.47 泽字节（ZB），云计算平台需处理海量用户数据，传统架构数据传输效率低下的问题凸显，存算一体芯片可通过并行计算能力提升数据处理速度，降低云端算力成本。此外，自动驾驶、智能安防等领域对实时数据处理要求严苛，如自动驾驶汽车需毫秒级响应传感器数据以保障安全，存算一体芯片的本地高效计算特性可满足此类场景需求。

（二）项目的可行性

1、国家政策为项目提供有利的外围环境和良好的发展机遇

集成电路产业是现代科技与经济的核心支柱，是国家鼓励、扶持的战略性新兴产业，在国家发展中占据至关重要的战略地位。近年来，我国政府陆续出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年（2026-2030 年）规划纲要》等政策，为集成电路行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，促进了集成电路行业的发展，为公司创造了良好的经营环境。

此外，《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024-2030 年）》等政策文件的出台，为模拟及数模混合芯片、硅光芯片、存储芯片、计算芯片等细分领域提供了明确的方向指引和政策保障。

2、已有成熟的研发和量产经验，具备规模化建设发展条件

公司已完成建设粤芯半导体 12 英寸集成电路生产线项目（粤芯一、二期）、第二工厂（粤芯三期）产能逐步释放中，完成了多个工艺技术平台项目的研发和落地，截至 2025 年末已成功实现 6.33 万片/月的量产规模。公司已积累了丰富的工厂管理及运营、技术研发及量产、市场洞察及开拓经验，具备产能扩张、技术创新和市场开拓的坚实基础。公司本次募投项目均建立在已量产验证、已成功开发或已具备研发基础的工艺技术平台、制程节点上，拥有成熟的研发和量产经验，

具备规模化建设发展条件。

3、稳定的客户基础为公司持续发展提供强大助力

公司自成立以来凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力，获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司等多家细分领域行业龙头企业。公司已基于丰富的特色工艺技术平台积累了强大的下游应用客户，丰富的市场资源也将为公司了解市场需求、把握技术动向及不断的技术升级提供强大助力。

4、公司拥有完善的知识产权体系和人才队伍

公司高度重视核心技术的创新和研发人才的培养，形成了完善、健全的知识产权体系和研发人才队伍。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 343 人，占公司人员比例 17.65%；公司已获授权专利（含境外专利）712 项，其中发明专利 343 项。公司先后被评为广东省工程技术研究中心、广东省重点项目、广州市独角兽创新企业等，在集成电路制造领域构建了坚实的技术壁垒。

四、公司未来发展战略及发展规划

（一）公司发展战略规划

集成电路产业作为支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，兼具资金密集、技术密集与人才密集特征。当前，全球集成电路产业格局由于人工智能为主的新兴技术的快速发展而发生深度调整，我国集成电路产业的发展也将迎来重要的战略机遇期。

自成立以来，公司始终聚焦模拟芯片领域，通过与芯片设计企业及终端应用客户深度协同，依托特色工艺技术，助力客户实现产品差异化与竞争力提升，积极推动我国模拟芯片的全面国产化替代进程。公司将持续提升特色工艺差异化竞争力，加快布局硅光互联、存算一体等前沿方向，深度融入国家集成电路产业体系。通过精益产能扩张、高端人才引育与产业链协同创新，切实增强关键环节自主可控能力，力争在人工智能、汽车电子、高端工业等领域形成具有全国乃至全球影响力的工艺平台与产品组合。

未来，公司将紧密围绕产业发展趋势，在与客户协同发展中实现共同成长，立志成为“扎根粤港澳大湾区，产能规模最大、产品线最丰富、体制机制最具创新活力的集成电路特色工艺制造企业”，为中国集成电路产业的战略布局提供重要的产能支撑。

（二）公司报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续加大科研投入力度

自 2017 年成立至今，公司已成功研发并量产近十个门类超过 20 种不同的特色模拟工艺产品，围绕“感、传、算、存、控、显”逐步实现了多品类平台的工艺覆盖。公司的工艺技术平台涵盖 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等，可为客户提供 180-55nm 等制程节点的特色晶圆代工服务。

报告期内，公司坚持技术创新与工艺研发，始终保持较高的研发投入。报告期各期，公司的研发费用分别为 60,532.47 万元、44,558.73 万元和 42,244.27 万元，占营业收入比重分别为 58.00%、26.50%和 16.36%。此外，公司报告期内还承担多项重大科研项目，为我国模拟芯片行业发展做出重要贡献。

2、持续构建卓越人才体系

公司将研发人才队伍建设置于核心战略地位，着力构建涵盖吸引、任用、培养与保留的全周期管理体系。通过提供具备市场竞争力的薪酬结构与业绩激励机制，持续激发研发团队的进取精神与创新能力；同时依托专项福利补贴及多元化关怀发展项目，有效保障研发队伍的稳定性与可持续发展。为进一步加强核心人才稳定性、提高团队凝聚力，公司实施了股权激励计划，以对公司作出突出贡献及对未来发展将发挥重要作用的人员进行激励。

3、持续完善内部治理结构

报告期内，公司持续优化内部管理架构、提升治理水平，以匹配战略发展需求。2023 年 3 月 2 日完成股份改制后，公司持续严格遵循《公司章程》及上市公司的治理要求，进一步完善法人治理结构，系统规范各项议事规则与治理细则，构建了科学、高效的决策机制。

（三）公司未来规划采取的措施

未来，公司将在继续巩固模拟特色工艺优势的前提下，战略性地精准补充和优化产能，将重心转向深度强化特色工艺技术平台能力与构建跨越式差异化竞争优势。发行人本次募集资金投资项目是这一转型的主要承载主体之一，其关键在于深化与中国具有全球竞争力的头部企业和终端产业链协同，通过持续升级特色工艺水平、提供多样化和专业化的解决方案，最终构建起多层次、高价值的特色工艺技术平台，精准契合国家对于高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片自主可控与创新发展的迫切需求。

公司将重点加大对三大关键特色工艺平台的研发投入，旨在加速前沿技术从研发到量产的进程。一是集中资源推进硅光及光电融合工艺平台的技术迭代，满足高速通信和人工智能领域对高带宽、低功耗光互连的迫切需求，夯实公司的领先地位；二是着力攻关存算一体工艺平台，为下一代高能效计算芯片提供核心制造支撑；三是持续深化微控制器工艺平台，增强其在功能安全、可靠性与成本方面的综合竞争力，服务于智能汽车电子系统的快速增长。

公司聚焦领域和战略规划与“十五五”规划纲要高度契合，面向未来，公司将持续立足国家推动集成电路产业高质量发展与做精做细成熟制程的战略思路，在持续夯实高端模拟工艺优势的基础上，进一步深化高端数模混合工艺布局，并重点强化硅光及光电融合工艺的研发与产业化能力，力争成为支撑存算一体、光电融合等新一代信息技术发展的核心制造合作伙伴，持续深度赋能消费电子、工业控制、汽车电子、人工智能等领域。逐步构建“以模拟为核心、以数字升级为蝶变、以光电融合为特色”的“一核两翼”发展格局。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，建立健全了由股东会、董事会、监事会（已取消）、独立董事和高级管理人员组成的公司治理架构。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订公司章程并相应办理工商变更登记备案的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司制定并完善了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理的相关制度，此外，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，并由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

报告期内，公司法人治理结构及制度运行有效，相关机构及人员未出现重大违法违规行为，公司治理方面不存在重大缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制的自我评价意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司管理层认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

致同会计师对公司的内部控制制度进行了审核，出具了《内部控制审计报告》

（致同审字（2026）第 440A006375 号），致同会计师认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）财务内控不规范情形及整改情况

发行人报告期内不存在财务内控不规范情形。

三、发行人报告期内的违法违规行及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，公司及其子公司不存在重大违法违规的情况，不存在受到任何国家行政机关及行业主管部门的重大处罚的情况，亦不存在受到监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司不存在资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情形。

报告期内，公司存在为主要股东提供担保（因股东向公司提供借款、或担保公司向银行贷款所做的反担保）的情形，具体如下：

被担保方	担保金额 （万元）	担保 起始日	担保终止日	担保是否 已经履行 完毕	担保完成 时间
科学城集团	75,000.00	2019-1-28	自主合同项下的贷款期限届满之日起两年	是	2023 年 4 月
科学城集团	220,001.57	2020-12-16	保证合同约定的保证期间届满之日	是	2023 年 2 月

注：1、2019 年 1 月 28 日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行”）签订《保证合同》，担保主债权为广州银行与科学城集团签订的《固定资产借款合同》，该笔借款本金为 7.5 亿元人民币。科学城集团同时向公司借款 9.75 亿元，用于厂房建设工程项目。上述借款均已偿还完毕，该笔担保已于 2023 年 4 月 23 日履行完毕；

2、2019 年 2 月，公司取得广州银行 16 亿元人民币的授信额度，科学城集团为之提供担保。2020 年 12 月 16 日，公司与科学城集团签订《设备抵押（反担保）合同》，为之提供反担保。该笔担保已于 2023 年 2 月 16 日履行完毕，相关设备已经解除抵押。

公司在创立初期，存在因主要股东向公司提供借款而提供担保，或者因主要股东为公司向银行取得授信提供担保，公司提供反担保的情形。上述安排符合公司初创阶段的成长特性，满足公司发展初期的融资需求，有效保证了公司经营计划和战略规划落实推进，帮助公司抓住市场机遇，快速实现投产达产。目前，

公司向主要股东提供的担保均已履行完毕。

自 2023 年 4 月以来，公司未再发生为主要股东及其控制的其他企业进行担保的情形。

五、发行人独立经营情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均具备独立性，具有完整的业务体系和面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整

公司系由粤芯有限整体变更设立，依法继承了粤芯有限的所有资产及业务。公司已经具备与生产经营活动有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；合法、独立地拥有与经营相关的设备、无形资产等主要资产的所有权或使用权；具有独立的原材料采购和产品销售系统；公司拥有独立完整的业务体系及相关资产，该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与主要股东及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

（二）人员独立

公司的董事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定选举、聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在于公司主要股东及其控制的企业中兼任职务并领取薪酬的情形，且不存在公司的财务人员在公司主要股东及其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，具有独立的财务核算体系，并符合《企业会计准则》等相关法规的要求。公司制定了完善的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，能够独立进行财务决策。公司独立在银行开设账户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东会、董事会、审计委员会等决策及监督机构，并根据业务发展需要建立健全了内部经营管理机构，能够独立

行使经营管理职权，与公司主要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的主营业务为集成电路制造环节中的 12 英寸晶圆代工业务。公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力，业务独立于主要股东及其控制的其他企业。

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

公司主要从事集成电路制造环节中的晶圆代工业务，为境内外知名的芯片设计企业提供特色晶圆代工服务。公司主营业务稳定，最近两年内主营业务没有发生重大不利变化。

公司管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。公司报告期内董事、高级管理人员的变动情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况”，该等变动是为了适应公司经营发展的需要、加强公司的治理水平、规范公司法人治理结构，公司的核心管理层保持稳定，相关人员变动对公司日常经营管理不构成不利影响。

公司无实际控制人，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、重大未决诉讼或仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大不利变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争情况

公司无控股股东和实际控制人。公司与持有公司 5%以上股份的主要股东及其控制的企业不存在同业竞争。

持有公司 5%以上股份的股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”。

七、关联方、关联关系和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、发行人控股股东、实际控制人

公司不存在控股股东及实际控制人。

2、发行人的控股子公司、合营企业、联营企业

序号	关联方名称	主要关联关系
1	粤芯集成	发行人持股 100%
2	粤芯三期	粤芯集成持股 80%
3	粤芯四期	粤芯集成持股 100%
4	粤芯国际	发行人持股 100%
5	穗开创芯基金	发行人持有份额 55%
6	武粤光电	粤芯集成持股 20%
7	苏州德信	粤芯集成持股 5.68%

3、持有发行人 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人

序号	关联方名称	主要关联关系
1	誉芯众诚	直接持有公司 16.88%股份
2	广东半导体基金	直接持有公司 11.29%股份，并通过广州华芯盛景间接持有公司 0.11%股份，直接和间接合计持有公司 11.40%股份
3	广州华盈	直接持有公司 9.51%股份
4	科学城集团	直接持有公司 8.82%股份，并通过誉芯众诚、合肥华芯康远间接持有公司 3.25%股份，直接和间接合计持有公司 12.06%股份
5	国投创业基金	直接持有公司 7.05%股份
6	苏州璞然	合计直接持有公司 5.14%股份
	苏州晶璞	
	苏州储芯	

注：上述关联法人的一致行动人亦为公司的关联法人，包括但不限于报告期内与公司发生交易的由科学城集团对外控制的广州科城水投技术服务有限公司、广州黄埔红岭头农业科技有限公司、科学城（广州）数字科技集团有限公司等。

4、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人

序号	关联方名称	关联关系
1	李永喜	间接持有公司 5%以上的股份

5、发行人的董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

6、发行人的董事、高级管理人员、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员

公司董事、高级管理人员、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员亦为发行人的关联方，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

7、发行人的董事、高级管理人员、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	关联方名称	主要关联关系
1	广州金微软件技术有限公司	公司董事长陈谨担任董事长的企业
2	广州芯联心企业管理有限责任公司	公司董事长陈谨担任董事，公司董事 CHEN, WEI TONY（陈卫）担任总经理的企业
3	广州光电存算芯片融合创新中心	公司董事 CHEN, WEI TONY（陈卫）担任管理委员会委员的组织
4	广州金泰丰投资有限公司	公司董事黄铠生担任执行董事、经理，关联自然人李永喜实际控制的企业
5	广州誉新环保科技有限公司	公司董事黄铠生担任董事长，关联自然人李永喜实际控制的企业
6	广州中科投置业有限公司	公司董事黄铠生担任董事长，关联自然人李永喜实际控制的企业
7	天津壹新环保科技有限公司	公司董事黄铠生担任董事的企业
8	广州市万臻房地产有限公司	公司董事黄铠生担任董事的企业
9	华工科创（广东）有限公司	公司董事黄铠生担任董事的企业
10	广东珩创私募基金管理有限公司	公司董事张瑞双对外控制，并担任董事、经理的企业
11	广州如珩企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事张瑞双担任执行事务合伙人的企业

序号	关联方名称	主要关联关系
12	捷创（广州）投资运营有限公司	公司董事毛寒梅担任董事的企业
13	知识城（广州）投资发展集团有限公司	公司董事毛寒梅担任董事的企业
14	知识城（广州）融资租赁有限公司	公司董事毛寒梅担任董事的企业
15	广东粤财创业投资有限公司	公司董事欧阳俊担任副总经理的企业
16	广东芯粤能半导体有限公司	公司董事欧阳俊担任董事的企业
17	深圳市威创聚能投资资产管理有限公司	公司独立董事郑德琨担任董事的企业
18	潍坊星达信息科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任董事长、总经理的企业
19	西安芯威星达电子科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、总经理、财务负责人的企业
20	浙江星通信息科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、经理的企业
21	天津联星高通科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、经理的企业
22	宁波星导信息科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、总经理的企业
23	常州联星智通科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、总经理的企业
24	南京尊丰信息科技有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、经理的企业
25	深圳宙合微电子有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事的企业
26	北京联星科通微电子技术有限公司	公司独立董事庄巍对外控制，并担任执行董事、总经理的企业
27	深圳硅励企业管理合伙企业（有限合伙）	公司独立董事庄巍担任执行事务合伙人的企业
28	常州冠诚投资中心（有限合伙）	公司独立董事庄巍担任执行事务合伙人的企业
29	深圳硅豪企业管理合伙企业（有限合伙）	公司独立董事庄巍担任执行事务合伙人的企业
30	深圳光科智能投资合伙企业（有限合伙）	公司独立董事庄巍担任执行事务合伙人的企业
31	广东连越律师事务所	公司独立董事彭燎原担任高级合伙人的企业
32	广州珠江实业集团有限公司	公司独立董事彭燎原担任董事的企业
33	广东省广晟控股集团有限公司	公司独立董事彭燎原担任董事的企业
34	广州轻工工贸集团有限公司	公司独立董事彭燎原担任董事的企业
35	广芯微电子（广州）股份有限公司	公司董事会秘书吴漾担任董事的企业
36	苏州德信芯片科技有限公司	公司董事会秘书吴漾担任董事的企业
37	武汉武粤光电技术有限公司	公司董事会秘书吴漾担任董事的企业
38	广州市金誉实业投资集团有限公司	公司关联自然人李永喜对外控制，并担任董事长、总经理的企业；黄铠生担任董事的企业

序号	关联方名称	主要关联关系
39	广州金弘投资有限公司	公司关联自然人李永喜对外控制，并担任董事、经理的企业
40	广州市美宣贸易有限公司	公司关联自然人李永喜对外控制的企业
41	广州智光电气股份有限公司	公司关联自然人李永喜对外控制的企业，董事黄铠生担任董事的企业

注：上述关联法人直接或者间接控制的法人或者其他组织亦为公司的关联法人，包括但不限于报告期内与公司发生交易的由广州智光电气股份有限公司对外控制的广东智有盈能源技术有限公司、广东智光能源科技有限公司、广州智光电气技术有限公司、知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司等。

发行人董事、高级管理人员、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东的关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者前述人员（与独立董事关系密切的家庭成员除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、其他关联方

（1）曾经存在的主要关联自然人

序号	关联方名称	主要关联关系
1	魏义良	曾经担任发行人董事，已于 2026 年 3 月卸任
2	杜渝	曾经担任发行人监事，发行人的监事会已于 2025 年 9 月取消
3	黎德坚	曾经担任发行人监事，发行人的监事会已于 2025 年 9 月取消
4	李海涛	曾经担任发行人监事，发行人的监事会已于 2025 年 9 月取消
5	于光宇	曾经担任发行人监事，发行人的监事会已于 2025 年 9 月取消
6	童世峰	曾经担任发行人监事，发行人的监事会已于 2025 年 9 月取消
7	陈明先	曾经担任发行人董事，已于 2025 年 3 月卸任

发行人曾经存在的关联自然人的关系密切的家庭成员亦为发行人曾经的关联自然人，包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（2）曾经存在的主要关联法人

序号	关联方名称	主要关联关系
1	广东粤财基金管理有限公司	发行人董事欧阳俊曾经担任副总经理，已于 2026 年 3 月卸任
2	广东粤财股权投资有限公司	发行人董事欧阳俊曾经担任副总经理，已于 2026 年 3 月卸任
3	深圳力维智联技术有限公司	发行人高级管理人员周来春曾经

序号	关联方名称	主要关联关系
4	深圳市智维技术服务有限公司	担任董事，已于 2025 年 8 月卸任
5	深圳高特高尔夫运动咨询服务有限公司	
6	宏信悦友股份有限公司	发行人独立董事郑德理曾经担任董事，已于 2025 年 7 月卸任
7	广州数字科技集团有限公司	发行人独立董事彭燎原曾经担任董事，已于 2025 年 8 月卸任

发行人董事、高级管理人员、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东的关系密切的家庭成员曾经直接或间接控制的，或者前述人员（与独立董事关系密切的家庭成员除外）曾经担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的曾经的关联方。

发行人曾经存在的关联自然人直接或间接控制的，或曾经直接或间接控制的，或者由前述关联自然人担任或曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，亦为发行人曾经的关联方，包括但不限于报告期内与发行人发生交易的由黎德坚担任董事的广州生产力促进中心有限公司和广州产业投资资本管理有限公司等。

（二）关联交易

1、报告期内关联交易简要汇总

报告期内，公司的关联交易汇总情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性 关联交易	关联销售	4,269.55	1,133.70	665.36
	关联采购	249.80	319.34	401.86
	关键管理人员薪酬	1,547.21	1,527.92	1,382.17
偶发性 关联交易	关联采购	1,195.43	2.36	-
	关联担保	具体请参见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“4、一般关联交易情况”之“（2）一般偶发性关联交易”之“②关联担保”。		
	关联方共同投资	具体请参见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“4、一般关联交易情况”之“（2）一般偶发性关联交易”之“③关联方共同投资”。		

2、重大关联交易的判断标准

参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应当履行董事会审议程序的关联交易标准，公司将达到以下标准之一的关联交易界定为重大关联交易：

- （1）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易；
- （2）公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易。

此外，公司接受关联方担保等行为属于公司单方面获得利益的交易，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，为一般关联交易。

3、重大关联交易情况

报告期内，公司存在重大经常性关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
广芯微电子（广州）股份有限公司	晶圆代工及相关服务	1,425.63	949.83	665.36
武汉武粤光电技术有限公司	晶圆代工及相关服务	2,843.92	183.87	-
合计		4,269.55	1,133.70	665.36

报告期内，公司向关联方广芯微电子（广州）股份有限公司、武粤光电提供晶圆代工及相关服务，报告期各期的销售金额合计分别为 665.36 万元、1,133.70 万元、4,269.55 万元，占公司营业收入的 0.64%、0.67%、1.65%，占比较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。公司预计未来与广芯微电子（广州）股份有限公司、武粤光电的关联交易将持续发生。

报告期内，相关关联交易均为市场化定价，定价机制与公司销售其他同类产品不存在差异，销售价格公允。

4、一般关联交易情况

（1）一般经常性关联交易

①关联采购

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
广东智有盈能源技术有限公司	采购资产、接受劳务	249.80	319.34	401.86
广东智光能源科技有限公司	采购代理购售电服务	注		
合计		249.80	319.34	401.86

注：公司向广东智光能源科技有限公司采购代理购售电服务，2023 年无代理购售电，2024 年代理购售电量 32,312.36 万千瓦时，2025 年代理购售电量 46,711.67 万千瓦时，代理购售电服务费实际结算金额由电网公司与广东智光能源科技有限公司分配结算。

②向关联方支付报酬

报告期内，公司向董事、监事（已取消）、高级管理人员支付报酬情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年	2023 年
关键管理人员薪酬	1,547.21	1,527.92	1,382.17

（2）一般偶发性关联交易

①关联采购

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
广州科城水投技术服务 有限公司	接受劳务	1,142.91	-	-
知识城智光恒运（广 州）综合能源投资运营 有限公司	接受劳务	43.28		
广州黄埔红岭头农业科 技有限公司	采购商品	7.77	-	-
科学城（广州）数字科 技集团有限公司	采购资产	1.47	-	-
广州生产力促进中心有 限公司	接受劳务	-	2.36	-
合计		1,195.43	2.36	-

②关联担保

报告期内，公司作为担保方的关联担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕	担保完成 时间
科学城集团	75,000.00	2019-1-28	自主合同项下的 贷款期限届 满之日起两年	是	2023 年 4 月
科学城集团	220,001.57	2020-12-16	保证合同约定的 的保证期间届 满之日	是	2023 年 2 月

报告期内，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕	担保完成 时间
科学城集团	127,826.56	2019-2-11	自主合同项下每 个单项协议签订 之日起至该笔债务 届满之日起两年	是	2023 年 2 月

③关联方共同投资

2024 年 2 月 27 日，公司的控股子公司粤芯集成与广州产业投资资本管理有限公司投资的中鑫产投、产投中鑫签署《关于广州粤芯三期集成电路制造有限公司之合资经营合同》，中鑫产投、产投中鑫以 1 元/注册资本的价格，认缴粤芯三期新增注册资本共 10 亿元人民币。本次增资完成后，粤芯三期注册资本为 60 亿元，粤芯集成、中鑫产投、产投中鑫分别持股 83.34%、8.33%、8.33%。中鑫产投、产投中鑫同月完成实缴出资，并于 2024 年 5 月 22 日办理工商变更登记。

粤芯三期截至本招股说明书签署日的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况”之“（一）发行人控股子公司”。

2025 年 12 月 1 日，公司与粤芯集成、广东半导体基金、粤芯四期签署《关于广州粤芯四期集成电路制造有限公司之合资经营合同》，广东半导体基金以 1 元/注册资本的价格，认缴粤芯四期新增注册资本 5 亿元人民币。广东半导体基金已于 2025 年 12 月支付投资款 5 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，增资尚未完成交割，因此广东半导体基金投资款未确认为粤芯四期实收资本。

5、关联方往来款项余额

报告期各期末，公司的关联应收、应付款项情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
预付账款	广东智有盈能源技术有限公司	-	18.90	-
其他应收款	科学城（广州）投资集团有限公司	-	63.63	-
应付账款	广州科城水投技术服务有限公司	255.36	-	-
	广东智有盈能源技术有限公司	217.59	2.98	56.96
	知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司	12.85		
	科学城（广州）环保产业投资集团有限公司	-	-	0.47
合同负债	广芯微电子（广州）股份有限公司	54.34	147.75	87.20
	武汉武粤光电技术有限公司	683.36	909.65	-
其他应付款	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000.00	-	-
	广州智光电气技术有限公司	-	20.00	-
长期应付款	科学城（广州）投资集团有限公司	-	-	984.38

注：公司与广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的其他应付款详情请参见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“4、一般关联交易情况”之“（2）一般偶发性关联交易”之“③关联方共同投资”。

6、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司具备独立的采购、生产和销售模式，公司营业收入及利润对关联方不存在重大依赖的情形，报告期内的关联交易均系为满足正常业务需求而发生，具备商业合理性、必要性，定价公允，未对公司的独立性以及财务状况、经营成果等造成重大不利影响。

（三）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

1、关联交易制度的执行情况

为规范关联交易，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等文件中，对关联交易决策的权限、程序等进行了明确规定。报告期内，公司发生的关联交易均依照《公司章程》及有关规定履行了相关审批程序或进行了事后确认。

2026年3月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，对公司报告期内发生的关联交易进行了确认，关联董事回避表决。

2、独立董事关于关联交易的意见

公司独立董事认为，公司在报告期内的关联交易系基于公司业务需要而开展，具有必要性和合理性，且遵循了公平、公正的原则；该等关联交易价格公允、合理；公司与关联方之间关联交易协议文件的签订和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；关联交易不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

（四）发行人减少和规范关联交易的主要措施

1、公司采取规范关联交易的主要措施

公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

为规范与发行人之间的关联交易，持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，公司本次发行前滚存的未分配利润（累计未弥补亏损），由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共同享有（承担）。

二、本次发行前后的股利分配政策差异情况、股利分配政策、决策程序及监督机制

（一）本次发行前后的股利分配政策差异情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《监管规则适用指引——发行类第 10 号》等相关规定，制定、明确和细化了发行后的利润分配原则、形式及时间间隔、现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的决策程序和监督机制等事项。发行后的利润分配政策和未来分红规划更加重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，进一步加强对公司全体股东特别是中小投资者的利益保护和回馈。

（二）本次发行上市后的股利分配政策、决策程序及监督机制

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用的<粤芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年分红回报规划的议案》。本次发行上市后公司利润分配政策具体如下：

1、利润分配的原则

公司实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。在决策和论证过程中应当充分听取和考虑独立董事和中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配的形式

公司可以采用现金分红、股票股利、二者相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润，但公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

3、分红的条件及比例

在满足下列条件时，应当进行分红：

（1）在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%，且最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利

之和。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：

①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 10%；

②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%；

③中国证监会或者证券交易所规定的其他情形。

4、现金分红的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

5、现金分红的期间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

6、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

7、利润分配的决策程序与机制

公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划先制定分配预案并进行审议。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

8、利润分配政策的变更

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会批准。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2）因出现战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为完善公司利润分配政策并保持其连续性和稳定性，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，切实保护投资者合法权益、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》等法律法规及上市后适用的《公司章程（草案）》等的规定和要求，公司第一届董事会第十七次会议对上市后股东回报事宜进行了专项研究论证，综合考虑公司现阶段经营发展的实际情况、长远和可持续发展规划，分析公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资及资金需求等，结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求股东尤其是中小股东的意见和诉求，并在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年分红回报规划的议案》。

四、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排

（一）发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划

公司上市后三年内的分红回报规划具体如下：

“一、分红回报规划制定的基本原则

本规划的制定应符合相关法律、法规和本次发行后适用的《粤芯半导体技术股份有限公司章程（草案）》的规定，以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。

二、分红回报规划制定的考虑因素

公司分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、分红回报规划的调整周期和相关决策机制

公司应以三年为一个周期，审阅公司未来三年的分红回报规划。公司应当在总结三年以来分红回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第二条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的分红回报规划予以调整。

因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体分红回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对分红回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第一条确定的基本原则，重新制定未来三年的分红回报规划，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

四、公司本次发行后三年利润分配的具体政策

（一）利润分配的原则：

公司实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。在决策和论证过程中应当充分听取和考虑独立董事和中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配的形式：

公司可以采用现金分红、股票股利、二者相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润，但公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

（三）分红的条件及比例：

在满足下列条件时，应当进行分红：

1.在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%，且最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由

董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

2.在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

4.上述重大资金支出事项是指以下任一情形：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 10%；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%；

（3）中国证监会或者证券交易所规定的其他情形。

（四）现金分红的条件

1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（五）现金分红的期间间隔：

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（六）股票股利分配的条件：

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（七）利润分配的决策程序与机制：

公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划先制定分配预案并进行审议。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（八）利润分配政策的变更：

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会批准。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1.因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

2.因出现战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

3.因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

4.中国证监会和证券交易所规定的其他事项。”

（二）发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划制定的依据及可行性以及未分配利润的使用安排

公司上市后三年内的分红回报规划的制定依据参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由。”

公司主营业务方向属于国家政策重点支持领域，行业发展趋势良好、前景广阔，公司拥有较强的可持续经营能力，上述利润分配计划具备可行性。

2023 年、2024 年和 2025 年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为-191,711.34 万元、-225,326.91 万元和-234,582.32 万元。报告期内，公司因尚未盈利、不满足分红条件，未进行现金分红。

公司上市后三年内，若达到分红条件时，将严格按照《公司章程（草案）》和股东分红回报规划的相关约定，实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续

性和稳定性。

五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在未弥补亏损的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排情况。截至报告期末，公司未分配利润为-1,008,096.75 万元。

六、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施

截至本招股说明书签署日，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。公司合计持股 51%以上股东、董事、高级管理人员已根据相关法规要求就股份减持事项的特殊安排作出了相应承诺，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

（一）重大销售合同

截至报告期末，公司及其控股子公司与报告期各期前五大客户签订的正在履行的销售框架协议如下：

序号	客户名称	销售内容	合同金额	合同有效期/签订日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	客户二	晶圆制造	框架协议	2024.10.15-2029.10.14	正在履行
2	客户五	晶圆制造	框架协议	2025.01.01-2026.12.31	正在履行
3		晶圆制造	框架协议	2023.07.06-2026.07.05	正在履行
4	客户一	晶圆制造	框架协议	2023.07.01-2027.12.31	正在履行
5		晶圆制造	框架协议	2025.02.10-2027.12.31	正在履行
6		晶圆制造	框架协议	2025.07.30-2028.07.29	正在履行
7	客户四	晶圆制造	框架协议	2019.11.26-长期有效	正在履行
8		晶圆制造	框架协议	2025.05.01-2026.12.31	正在履行

（二）重大原材料采购合同

截至报告期末，公司及其控股子公司正在履行的或报告期内已履行完毕的不含税金额在 3,000 万元或等值外币以上的材料采购订单如下：

序号	供应商名称	主要采购内容	订单金额	订单签订日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	供应商六	硅片	超过 1 亿元	2022/12/22	履行完毕
2			超过 3,000 万元	2022/9/8	履行完毕
3			超过 3,000 万元	2022/2/18	履行完毕
4	供应商七	硅片	超过 1 亿元	2022/12/22	履行完毕
5	供应商九	硅片	超过 3,000 万元	2021/11/2	履行完毕

（三）重大设备采购合同

截至报告期末，公司及其控股子公司正在履行的或报告期内已履行完毕的不含税金额在 40,000 万元或等值外币以上的设备采购订单如下：

序号	供应商名称	主要采购内容	合同金额	合同签订日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	供应商十	设备	超过 6 亿元	2022/12/7	正在履行
2		设备	超过 4 亿元	2022/12/8	正在履行
3	供应商十一	设备	超过 4 亿元	2022/12/7	正在履行
4	供应商十二	设备	超过 6 亿元	2022/9/21	正在履行
5	供应商十三	设备	超过 10 亿元	2022/12/7	正在履行
6	供应商十四	设备	超过 4 亿元	2022/12/8	正在履行
7	供应商十六	设备	超过 4 亿元	2025/12/30	正在履行

（四）重大借款合同

截至报告期末，公司及其控股子公司正在履行的或报告期内已履行完毕的金额在 15.00 亿元及以上的借款合同如下：

序号	贷款人	借款人	金额（亿元）	贷款/授信类型	期限	担保情况	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	中国工商银行股份有限公司广州芳村支行	粤芯半导体	20.00	借款	自首次提款日起 10 年	公司设备抵押	正在履行
2	广发银行股份有限公司广州分行	粤芯半导体	20.00	借款	2021/5/10-2031/5/9	公司设备抵押	正在履行
3	中国进出口银行广东省分行	粤芯半导体	16.25	借款	自首次放款日起 144个月	无	正在履行
4	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	粤芯三期	15.00	借款	自首次提款日起不超过10年（宽限期不超过2年）	子公司设备抵押	正在履行
5	招商银行股份有限公司广州分行	粤芯三期	19.50	借款	2023/3/20-2033/3/19	子公司设备抵押	正在履行
6	兴业银行股份有限公司广州分行	粤芯三期	16.00	借款	2023/3/29-2026/3/28	无	正在履行
7	中国进出口银行广东省分行	粤芯三期	30.00	借款	自首次放款日起 120个月	无	正在履行
8	国家开发银行广东省分行	粤芯半导体	30.00	借款	2025/10/14-2040/10/13	子公司设备抵押、子公司股权质押	正在履行

注：就上述第 7 项借款，粤芯三期已于 2026 年 2 月提供设备抵押担保。

二、公司对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在为其控股子公司之外的第三方提供担

保的情形。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司的控股子公司、董事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司的董事、高级管理人员和其他核心人员最近3年不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

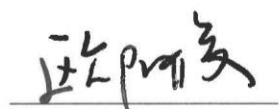
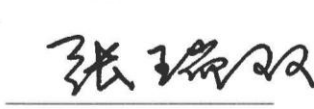
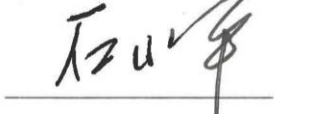
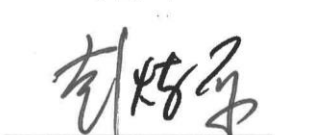
第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

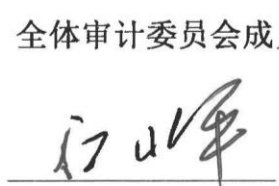
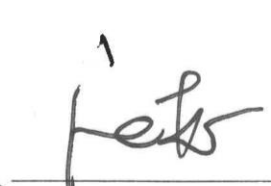
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

		
陈 谨	CHEN, WEI TONY (陈 卫)	黄铠生

		
欧阳俊	张瑞双	毛寒梅
		
HAN, RUIJING (韩瑞津)	石水平	庄 巍
		
郑德瑛	高燎原	

全体审计委员会成员：

		
石水平	陈 谨	庄 巍

粤芯半导体技术股份有限公司



一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事、审计委员会成员之外的高级管理人员：



周来春



DU, YANG

（杜 扬）



吴 漾



粤芯半导体技术股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

二、发行人第一大股东声明

本单位承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

股东（盖章）：广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：万联天泽资本投资有限公司



执行事务合伙人（委派代表）（签字）：


刘海燕

2026 年 4 月 18 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


谭琦琪

保荐代表人：


蒋 迪


杨华川

法定代表人：


林传辉



2026 年 4 月 18 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读粤芯半导体技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：


林传辉



2026 年 4 月 18 日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读粤芯半导体技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：


秦 力



广发证券股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

法定代表人签字:



朱 健



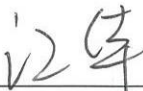
国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

发行人律师声明

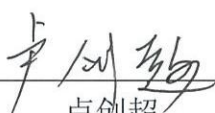
本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师:


江 华


康晓阳


张 政


卢创超

律师事务所负责人:


乔佳平


北京市康达律师事务所
2026年4月18日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读粤芯半导体技术股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对粤芯半导体技术股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容承担相应的法律责任。

本声明仅供粤芯半导体技术股份有限公司申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

签字注册会计师:

中國註冊會計師
余文佑
440100730028

余文佑

中國註冊會計師
林梓韜
110101560538

林梓韧

会计师事务所负责人:

李雲

李惠琦

中国注册会计师
李惠琦
110000150172

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年 4月

2026年 4月 18日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读粤芯半导体技术股份有限公司的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:


潘文中 0100020011


林梓劼 110101560538

会计师事务所负责人:


李惠琦

中国注册会计师
李惠琦
110000150172

致同会计师事务所(特殊普通合伙)



验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读粤芯半导体技术股份有限公司的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述验资复核报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

 
余文佑

 
林梓韧

会计师事务所负责人:


李惠琦



致同会计师事务所(特殊普通合伙)


2026年4月18日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字资产评估师:



黄振鹏(已离职)

资产评估机构负责人:


向绪蒞

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司



2026 年 4 月 18 日

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司

关于离职情况的说明

黄振鹏原为深圳中企华土地房地产资产评估有限公司的员工，系为粤芯半导体技术股份有限公司出具的深中企华评报字（2023）第 003 号资产评估报告的签字资产评估师，因个人原因，已于【2025】年【9】月离职，上述人员的离职不影响本机构出具的上述报告的法律效力。

特此说明！

资产评估机构负责人：



向绪茨

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司



2026年4月18日

第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- (七) 与投资者保护相关的承诺；
- (八) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- (九) 内部控制审计报告；
- (十) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十一) 股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- (十二) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- (十三) 募集资金具体运用情况；
- (十四) 子公司、参股公司简要情况；
- (十五) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

(一) 查阅时间

本次发行承销期间内工作日：上午 9:00 至 11:00、下午 2:00 至 5:00。

（二）查阅地点

在本次发行承销期间，上述备查文件将存放于发行人和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行承销期间内查阅。

三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、信息披露制度和流程

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，制定了《信息披露事务管理办法》，从信息披露的一般要求、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露管理与职责、信息披露的保密措施和责任追究等方面对信息披露进行了明确规定。

根据《信息披露事务管理办法》，公司及信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露；公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息，应当真实、准确、完整，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性地披露；除依法应当披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程（草案）》，公司制定了

《投资者关系管理制度》。

根据《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。

投资者关系管理工作包括的主要职责是：（1）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；（2）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；（3）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；（4）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；（5）保障投资者依法行使股东权利；（6）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；（7）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；（8）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

3、未来开展投资者关系管理的规划

本次发行上市后，公司将持续完善投资者关系管理及相关的制度措施，以保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障；同时，公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化和切实保护投资者权益的目标。

（二）股利分配决策程序

公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合《公司章程（草案）》、盈利情况、资金需求和股东回报规划先制定分配预案并进行审议。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红

具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的,应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(三) 发行人股东投票机制的建立情况

发行人《公司章程(草案)》对股东投票机制作出了规定,包括中小投资者单独计票制、累积投票制、网络投票制、征集投票权等,具体如下:

1、中小投资者单独计票制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、累积投票制

股东会就选举董事进行表决时,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的,或者股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。

3、网络投票制

公司召开股东会的地点为公司住所地,或者会议通知中明确记载的会议地点。股东会设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。

4、征集投票权

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

四、与投资者保护相关的承诺事项

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、发行人合计持股比例不低于发行前股份总数 51%的股东的承诺

发行人合计持股比例不低于发行前股份总数 51%的股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金出具如下承诺：

“自发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不提议由发行人回购上述股份。

本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本企业持股期间，若关于股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本企业愿意依法承担违背上述承诺而产生的法律责任。”

2、发行人其他机构的承诺

发行人其他机构股东农银金融、广州科创产投、苏州璞然、广东广祺智行肆号、广州吉富新芯、广州越秀创达八号、联芯叁号、嘉兴隼满、广东广祺辰途、深圳惠友、广州合信芯赢、合肥华芯康远、广州晶芯、建信金融、知识城集团、

联芯贰号、深圳山海叁号、苏州晶璞、广州广祺欣芯、合肥华登二期、苏州储芯、联芯肆号、联芯陆号、盈科值得一号、广州盛誉、盈科吉运创投、广州华芯盛景、广发乾和、共青城吉富、青岛新鼎、深圳安鹏、中山广发信德、广州产投壹号、淄博盈峰、广东珩芯、联芯伍号、广发信德二期、广州吉富智芯、厦门惠友、广州合信芯达出具如下承诺：

“自发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不提议由发行人回购上述股份。

本企业减持发行人股份的行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本企业持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本企业愿意依法承担违背上述承诺而产生的法律责任。”

3、持有发行人股份的董事、高级管理人员的承诺

持有发行人股份的董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）、黄铠生、魏义良（已离任）、张瑞双、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾出具如下承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持本人持有的发行人首发前股份；如本人在前述期间内离职，仍继续遵守前述承诺。

发行人存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持直接持有的发行人股份。

本人所持有的首发前股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接持有首发前股份的锁定期限自动延长6个月。

本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、高级管理人员的义务,并如实并及时向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。在本人就任时确定的任期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%,自离职之日起半年内,不转让本人所持公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺,任期届满后6个月内继续遵守前述减持要求。

自本承诺函出具之日起,如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就股份锁定及限制转让事宜出台新规定或新措施,本人将严格遵守前述相关规定,根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的本承诺函。

如本人违反上述承诺减持发行人股份的,则出售该部分发行人股份所取得的实际收益(如有)归发行人所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。”

(二) 股东持股及减持意向的承诺

1、发行人持股5%以上股东的承诺

发行人持股5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯出具如下承诺:

“一、本企业持续看好发行人业务发展前景,拟长期持有发行人股份。

二、对于本次发行上市前所持有的发行人股份,本企业将严格遵守已做出的关于股份锁定的相关承诺,在锁定期内不出售本次发行上市前持有的发行人股份。

三、在所持发行人股份的锁定期届满后24个月内,本企业拟减持发行人股份的,每12个月内减持所持发行人股份总数不超过本企业所适用的届时有效的相关法律法规及规范性文件规定的限制。前述减持价格将不低于发行人首次公开

发行股票的发行价（若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价按照规定作相应调整），并在满足本企业已作出各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

四、本企业在锁定期届满后减持发行人股份的，将严格按照相关法律、法规和规范性文件的有关规定执行。本企业在直接或间接与一致行动人合计持有发行人 5% 以上股份期间实施减持时，若计划通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持的，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划，若通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

五、若届时法律法规和中国证监会、深圳证券交易所对于股份锁定期及减持事项有其他特别规定的，且本企业符合相关适用条件的，本企业上述股份锁定期及减持承诺按届时相关规定为准予以执行。

六、如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应责任。如因本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿，并承担有关法律、法规、规范性文件及监管部门规定的其他责任。”

2、持有发行人股份的董事、高级管理人员的承诺

持有发行人股份的董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）、黄铠生、魏义良（已离任）、张瑞双、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”之“3、持有发行人股份的董事、高级管理人员的承诺”。

（三）稳定股价的措施和承诺

1、发行人的承诺

发行人出具如下承诺：

“一、启动和停止股价稳定预案的条件

(一) 启动条件

本公司自本次发行并上市之日起三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),本公司将依据法律、法规及公司章程的规定在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。

(二) 停止条件

在稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1、公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产;

2、继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

二、稳定股价的具体措施

在启动稳定股价措施的条件被触发后,公司将视具体情况按以下先后顺序:公司回购股份、董事(独立董事及不领薪的董事除外)及高级管理人员增持等措施以稳定公司股价。

(一) 公司回购股票

当触发上述股价稳定措施的启动条件时,在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下,公司应依照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后,向社会公众股东回购股份。

公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案,议案须经公司董事会全体董事过半数表决通过,并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东会的通知。回购股份的议案应包括拟回购股份的价格或价格区间、股份数量、回购期限以及届时有效的

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定应包含的其他信息。公司股东会对回购股份的议案做出决议，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司应在股东会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，回购公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

1、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 5%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 15%；

2、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 30%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

（二）董事（独立董事及不领薪的董事除外）、高级管理人员增持股份

当公司启动股价稳定措施后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：

1、董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票。

2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，将其增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、除不可抗力外，上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，董事、高级管理人员增持公司股票的资金金额不低于其上年度从公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 10%，但不超过 30%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4、在稳定股价的预案有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守稳定股价的预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守稳定股价的预案，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

（三）其他稳定股价的措施

1、符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定并保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东会审议同意，公司可通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

2、符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定前提下，公司可通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

3、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的以及中国证监会、证券交易所认可的其他稳定股价的措施。

三、其他方面承诺

本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

四、未履行承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺,需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、行政法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东会审议,尽可能地保护公司投资者利益。

本承诺函自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。”

2、发行人的董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员的承诺

发行人的董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员陈谨、CHEN, WEITONY（陈卫）、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾出具如下承诺：

“一、启动和停止股价稳定预案的条件

（一）启动条件

公司自本次发行并上市之日起三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数;最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),本人将依据法律、法规及公司章程的规定在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。

（二）停止条件

在稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1、公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产;

2、继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

二、稳定股价的具体措施

在启动稳定股价措施的条件被触发后，本人将在公司回购股份后采取以下措施以稳定公司股价。

当公司启动股价稳定措施后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：

1、董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票。

2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，将其增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、除不可抗力外，上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，董事、高级管理人员增持公司股票的资金金额不低于其上年度从公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 10%，但不超过 30%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4、在稳定股价的预案有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守稳定股价的预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守稳定股价的预案，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

三、未履行承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺,需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致,应调减或停发董事、高级管理人员薪酬和/或津贴,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。

本承诺函自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。”

(四) 股份回购和股份买回的措施和承诺

1、发行人的承诺

发行人出具如下承诺:

“1、本公司本次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如中国证监会或者其他有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。”

(五) 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人的承诺

发行人出具如下承诺:

“1、本公司符合创业板上市发行条件,本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。”

(六) 填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产将大幅增

长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。

1、发行人的承诺

发行人出具如下承诺：

“公司拟采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报：

1. 强化募集资金管理

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施进度，尽快实现预期收益。同时，公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度》等相关规定的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现收益。

2. 提高募集资金使用效率

本次公开发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以提升发行人盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目预期效益，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报被摊薄的风险。

3. 完善利润分配政策，强化投资者回报

公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，结合公司实际情况，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，并制定了公司上市后未来三年分红回报规划。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

4. 加强经营管理，完善公司治理

目前公司已制订了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营管理和公司治理水平,完善并强化投资决策程序,全面有效地提升公司经营效率。”

2、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEI TONY (陈卫)、黄铠生、欧阳俊、魏义良(已离任)、张瑞双、毛寒梅、石水平、庄巍、郑德理、彭燎原、HAN, RUIJING (韩瑞津)、周来春、DU, YANG (杜扬)、吴漾出具如下承诺:

“1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3. 本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4. 本人承诺支持董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5. 若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6. 自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

8. 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人愿意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应责任。”

(七) 利润分配政策的承诺

发行人承诺：

“一、为保护上市后中小投资者利益，本公司在本次发行上市的在审期间不进行现金分红。

二、本公司将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》及附件议事规则以及《上市后三年股东分红回报规划》及公司股东会审议通过的其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。

三、如遇相关法律、法规和其他规范性文件修订的，本公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。如本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

(八) 依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人的承诺

发行人出具如下承诺：

“一、本公司承诺本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所或其他有权部门作出最终认定后，依法赔偿投资者损失。

三、若中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：

（一）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段，自中国证监会、深圳证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银

行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

(二) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、深圳证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 10 个工作日内，公司董事会将启动股份回购有关的程序，依照所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定回购本次发行的全部股票，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息或中国证监会认可的其他价格（本公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。

四、若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。

五、若届时法律法规和中国证监会、深圳证券交易所对于依法承担赔偿责任有其他特别规定的，且本公司符合相关适用条件的，本公司上述依法承担赔偿责任按届时相关规定为准予以执行。”

2、发行人合计持股比例不低于发行前股份总数 51%的股东、持股平台、自然人股东的承诺

发行人合计持股比例不低于发行前股份总数 51%的股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金，持股平台联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号，自然人股东陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）出具如下承诺：

“一、发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业/本人将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所或其他有权部门作出最终认定后，依法赔偿投资者

损失。

三、若中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

四、若届时法律法规和中国证监会、深圳证券交易所对于依法承担赔偿责任有其他特别规定的，且本企业/本人符合相关适用条件的，本企业/本人上述依法承担赔偿责任按届时相关规定为准予以执行。”

3、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）、黄铠生、欧阳俊、魏义良（已离任）、张瑞双、毛寒梅、石水平、庄巍、郑德理、彭燎原、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾出具如下承诺：

“一、发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将通过如下方式督促发行人等相关主体依法赔偿投资者损失：

1、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股；

2、在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后 30 个工作日（或证券监督管理部门或其他有权部门要求的其他期限）内，将推动发行人等相关主体启动赔偿投资者损失的相关工作。”

4、发行人保荐机构（主承销商）的承诺

发行人保荐机构（主承销商）广发证券出具如下承诺：

“广发证券为发行人本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因广发证券在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致广发证券制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。”

5、发行人律师的承诺

发行人律师康达出具如下承诺：

“康达为发行人本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因康达在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致康达制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。”

6、发行人会计师、验资机构、验资复核机构会计师的承诺

发行人会计师、验资机构、验资复核机构会计师致同出具如下承诺：

“本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因本所在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。特此承诺。”

7、发行人评估机构的承诺

发行人评估机构中企华出具如下承诺：

“中企华为发行人本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因中企华在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致中企华制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。特此承诺。”

(九) 关于避免同业竞争的承诺

发行人持股 5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯承诺：

“一、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；

二、本承诺函签署后，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；

三、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本企业及本企业直接或间接控制的除公司及其下属公司以外的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本企业及本企业直接或间接控制的除公司及其下属公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；

四、本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为公司股东期间持续有效，不可撤销；

五、本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本企业或本企业直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的，本企业将依法承担相应的法律责任。

六、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：

- （1）本企业不再持有公司 5%以上股份；
- （2）公司股票终止在深圳证券交易所上市。”

(十) 关于减少和规范关联交易的承诺

1、发行人持股 5%以上股东的承诺

发行人持股 5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集

团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯出具如下承诺：

“一、本企业不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，亦不会通过关联交易为公司输送利益，在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。本企业将继续尊重发行人在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性，不会与发行人进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

二、本企业及本企业关联方与公司之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业与公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。

三、本企业及本企业控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及股东的利益。

五、本企业愿意依法承担违反上述承诺的法律责任。”

2、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEITONY（陈卫）、黄铠生、欧阳俊、魏义良（已离任）、张瑞双、毛寒梅、石水平、庄巍、郑德理、彭燎原、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾出具如下承诺：

“本人已向发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

本人及本人关联方与公司之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

在本人作为公司董事/高级管理人员期间,本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制/实施重大影响的其他经济实体将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的,本人、本人关系密切的家庭成员、关系密切的家庭成员控制/实施重大影响的其他经济实体将严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及公司章程等的规定,确保关联交易程序合法、价格公允,且不损害公司及其他股东的利益。

本人承诺不利用作为公司董事/高级管理人员的地位,损害公司及其他股东的合法利益。”

(十一) 关于避免资金占用的承诺

发行人持股 5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯承诺:

“一、截至本承诺出具之日,不存在发行人或其控股企业的资金被本企业及本企业控制的其他企业非经营性占用的情况,也不存在发行人或其控股企业为本企业及本企业控制的其他企业违规提供担保的情形。

二、本企业承诺依法行使股东权利,不滥用股东权利损害发行人或发行人其他股东的合法利益,本企业及本企业控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式非法占用发行人或其控股企业的资金,不会要求发行人或其控股企业违规提供担保。”

(十二) 未履行承诺的约束措施的承诺

1、发行人的承诺

“一、本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的义务和责任。

二、若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的义务或责任,则本公司将采取以下措施予以约束:

1. 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如

下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

(3) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2. 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

2、发行人持股 5%以上股东、持股平台、自然人股东的承诺

发行人持股 5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯，持股平台联芯贰号、联芯叁号、联芯肆号、联芯伍号、联芯陆号，自然人股东陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）出具如下承诺：

“一、本企业/本人保证将严格履行在发行人上市招股说明书中所披露的本企业/本人做出的各项公开承诺事项中的义务和责任。

二、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行公开承诺事项的，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

1、本企业/本人将在股东会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

2、若因本企业/本人未能履行公开承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者由此遭受的损失；

3、在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有

不利影响之前，本企业/本人将暂不收取发行人所分配之红利或派发之红股；

4、如本企业/本人因未能履行公开承诺事项而获得经济收益的，该等收益归发行人所有，本企业/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。

三、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

3、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员陈谨、CHEN, WEI TONY（陈卫）、黄铠生、欧阳俊、魏义良（已离任）、张瑞双、毛寒梅、石水平、庄巍、郑德理、彭燎原、HAN, RUIJING（韩瑞津）、周来春、DU, YANG（杜扬）、吴漾出具如下承诺：

“一、本人保证将严格履行在发行人上市招股说明书中所披露的本人做出的各项公开承诺事项中的义务和责任。

二、如本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行公开承诺事项的，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

- 1、本人将在股东会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；
- 2、若因本人未能履行公开承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴（如有）依法对投资者先行进行赔偿；
- 3、在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将暂不收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；
- 4、如本人因未能履行公开承诺事项而获得经济收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。

三、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

（十三）关于股东信息披露的专项承诺

根据《监管规则适用指引--关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，发行人出具如下承诺：

- “（一）公司已在招股说明书中真实、准确、完整披露了股东信息；
- （二）公司历史沿革中不存在股权代持的情形；
- （三）除已在招股说明书中披露的情形以外，公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
- （四）除已在招股说明书中披露的情形以外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有发行人股份的情形；
- （五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；
- （六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（十四）关于申请文件与预留原件一致的承诺

发行人承诺：

“本公司向贵所报送的首次公开发行股票并在创业板上市全套申请电子文件与本公司预留的相应文件的原件一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对申请电子文件与预留原件的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。”

（十五）关于保证不影响和干扰审核的承诺

发行人及其全体董事、审计委员会成员、高级管理人员，第一大股东，保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人、项目协办人（以下统称承诺人），均已知悉《承诺人廉洁自律规范须知》相关要求，保证严格遵守法律法规、中国证监

会的规定和深圳证券交易所的业务规则，诚实守信、忠实勤勉、廉洁自律，不以任何方式影响和干扰审核工作，并郑重作出以下承诺：

“（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及深圳证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。

（二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、深圳证券交易所上市委委员或者其他利益关系人输送不正当利益：

1. 以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利；

2. 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利；

3. 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

4. 直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；

5. 其他输送不正当利益的情形。

（三）不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。

（四）遵守法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

如违反上述承诺，承诺人自愿接受深圳证券交易所依据其业务规则采取的终止审核、一定期限内不接受申请文件、公开认定不适合担任相关职务等措施。承诺人相关行为违反法律法规的，将承担相应法律责任。”

（十六）关于不谋求控制权的承诺

发行人持股 5%以上股东誉芯众诚、广东半导体基金、广州华盈、科学城集团、国投创业基金、苏州璞然、苏州晶璞、苏州储芯出具如下承诺：

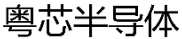
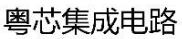
“自 2022 年 1 月 1 日至今，承诺人未对发行人实际控制，并未控制发行人的股东大会/股东会、董事会。承诺人不是发行人的控股股东、实际控制人，也未将发行人纳入本企业的合并报表范围内，未将发行人作为控股子公司进行管理。

为维持发行人控制权的稳定性，除发行人配股、派股、资本公积转增股本外，自本承诺函出具之日起，本企业不会以直接或间接方式主动增持发行人的股份以达到取得发行人控制权之目的，不会以所持有的发行人股份单独或其他方共同谋求发行人的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或其他方共同谋求发行人的实际控制权，不会利用股东地位干预发行人正常生产经营活动。

以上承诺在发行人上市之日起 5 年内持续有效。”

五、发行人拥有的商标

序号	商标权人	注册商标图案	注册号	注册国家	类别	有效期限	取得方式
1	发行人	CSTi	33341570	中国	9	2029/6/27	原始取得
2	发行人		71949619	中国	9	2033/11/27	原始取得
3	发行人		43556814	中国	41	2030/09/13	原始取得
4	发行人		71927873	中国	41	2033/11/27	原始取得
5	发行人	CanSemi	43545500A	中国	7	2030/10/20	原始取得
6	发行人		71929807	中国	7	2033/11/27	原始取得
7	发行人		34844156	中国	9	2030/08/20	原始取得
8	发行人		71932840	中国	9	2033/11/27	原始取得
9	发行人		43545500A	中国	16	2030/10/20	原始取得
10	发行人		71954035	中国	16	2033/11/27	原始取得
11	发行人		43545500A	中国	38	2030/10/20	原始取得
12	发行人		71941397	中国	38	2033/11/27	原始取得
13	发行人		43545500A	中国	40	2030/10/20	原始取得
14	发行人		71926336	中国	40	2033/11/27	原始取得
15	发行人		43545500A	中国	41	2030/10/20	原始取得
16	发行人		71937537	中国	41	2033/11/27	原始取得
17	发行人		43545500A	中国	42	2030/10/20	原始取得
18	发行人		71950790	中国	42	2033/11/27	原始取得

序号	商标权人	注册商标图案	注册号	注册国家	类别	有效期限	取得方式
19	发行人		69712430	中国	35	2033/09/13	原始取得
20	发行人		43565395	中国	7	2031/08/06	原始取得
21	发行人		40948415A	中国	9	2030/07/27	原始取得
22	发行人		34831949	中国	9	2030/12/20	原始取得
23	发行人		62787844	中国	9	2032/08/13	原始取得
24	发行人		71949588	中国	9	2033/11/27	原始取得
25	发行人		43565395	中国	38	2031/08/06	原始取得
26	发行人		43565395	中国	42	2031/08/06	原始取得
27	发行人		52177155	中国	9	2032/08/20	原始取得
28	发行人		52169199	中国	9	2031/12/27	原始取得
29	发行人		52177155A	中国	9	2031/11/13	原始取得
30	发行人		46940160A	中国	9	2031/06/20	原始取得
31	发行人		62807425	中国	9	2032/08/13	原始取得
32	发行人		53686952	中国	7	2031/09/13	原始取得
33	发行人		53693393	中国	16	2031/09/13	原始取得
34	发行人		53683700	中国	40	2031/09/13	原始取得
35	发行人		53692989	中国	7	2031/09/13	原始取得
36	发行人		53678663	中国	9	2031/09/13	原始取得
37	发行人		53685871	中国	16	2031/09/13	原始取得
38	发行人		53693008	中国	40	2031/09/20	原始取得
39	发行人		53680305	中国	7	2031/09/20	原始取得
40	发行人		53690647A	中国	9	2031/11/06	原始取得
41	发行人		62800016	中国	9	2032/09/27	原始取得
42	发行人		53688445	中国	16	2031/09/13	原始取得
43	发行人		53688455	中国	40	2031/09/13	原始取得
44	发行人		62784474	中国	7	2032/08/13	原始取得
45	发行人		62787465	中国	9	2032/08/13	原始取得
46	发行人		62797068	中国	41	2032/08/13	原始取得
47	发行人		62805302	中国	42	2032/08/13	原始取得
48	发行人		69353803	中国	38	2033/08/06	原始取得

六、发行人拥有的专利

(一) 境内专利情况

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
1	发行人	半导体器件和半导体器件版图的非对称型修正方法	发明专利	ZL202511411113.5	2025/9/29	原始取得
2	发行人	BCD 器件及制备方法	发明专利	ZL202511337549.4	2025/9/18	原始取得
3	发行人	一种晶圆光刻过程中对准失败的处理方法及装置	发明专利	ZL202511222740.4	2025/8/29	原始取得
4	发行人	一种金属电容结构及其制备方法	发明专利	ZL202511203606.X	2025/8/27	原始取得
5	发行人	一种硅基锗光电探测器及制备方法	发明专利	ZL202511179150.8	2025/8/22	原始取得
6	发行人	一种双极性晶体管及其制造方法	发明专利	ZL202510865082.4	2025/6/26	原始取得
7	发行人	一种锗外延工艺的监控方法及锗外延晶圆	发明专利	ZL202510820427.4	2025/6/19	原始取得
8	发行人	一种混合式高压 LDMOS 器件及其制备方法	发明专利	ZL202510705362.9	2025/5/29	原始取得
9	发行人	测试晶圆制备方法、测试晶圆及测试晶圆使用方法	发明专利	ZL202510631904.2	2025/5/16	原始取得
10	发行人	一种通孔生成方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202510560786.0	2025/4/30	原始取得
11	发行人	一种抗反射层的厚度确定方法	发明专利	ZL202510259300.X	2025/3/6	原始取得
12	发行人	OPC 修正方法、半导体设备及半导体产品	发明专利	ZL202510244341.1	2025/3/3	原始取得
13	发行人	光刻胶模型优化及构建方法和光刻模型构建方法	发明专利	ZL202510177635.7	2025/2/18	原始取得
14	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202510135810.6	2025/2/7	原始取得
15	发行人	一种加工数据的处理方法	发明专利	ZL202510113880.1	2025/1/24	原始取得
16	发行人	一种半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202510088780.8	2025/1/21	原始取得
17	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202510072523.5	2025/1/17	原始取得
18	发行人	一种快速热处理机台的温度确定方法	发明专利	ZL202510012675.6	2025/1/6	原始取得
19	发行人	一种阵列电容的失效位置确定方法	发明专利	ZL202411978249.X	2024/12/31	原始取得
20	发行人	一种量测结果的图形化输出方法及系统	发明专利	ZL202411774934.0	2024/12/5	原始取得
21	发行人	一种局部隔离氧化层器件结构的制备方法及装置	发明专利	ZL202411772300.1	2024/12/4	原始取得
22	发行人	一种器件结构的制作和有效刻蚀方法及装置	发明专利	ZL202411772297.3	2024/12/4	原始取得
23	粤芯三期	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202411650008.2	2024/11/19	继受取得
24	华南理工大学、发行人	一种 LDMOS 器件及其制备方法	发明专利	ZL202411620988.1	2024/11/14	原始取得
25	发行人	半导体测试结构、晶圆以及金属短路测试方法	发明专利	ZL202411563002.1	2024/11/5	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
26	发行人	一种金属互连器件的阻挡层制备方法	发明专利	ZL202411535593.1	2024/10/31	原始取得
27	发行人	一种光刻机对准方法	发明专利	ZL202411325311.5	2024/9/23	原始取得
28	发行人	隔离结构形成方法、半导体器件制备方法及半导体器件	发明专利	ZL202411323976.2	2024/9/23	原始取得
29	发行人	嵌入式闪存高压器件及其制备方法	发明专利	ZL202411321019.6	2024/9/23	原始取得
30	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202411269357.X	2024/9/11	原始取得
31	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202411266419.1	2024/9/11	原始取得
32	发行人	垂直扩散金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202411266418.7	2024/9/11	原始取得
33	发行人	一种半导体芯片设计中隔离器件的确定方法、装置及设备	发明专利	ZL202411154788.1	2024/8/22	原始取得
34	发行人	一种基于PNPN结构的静电放电器件	发明专利	ZL202411118593.1	2024/8/15	原始取得
35	发行人	一种深沟槽隔离结构的制备方法及半导体器件	发明专利	ZL202410937922.9	2024/7/12	原始取得
36	发行人	一种测试回路异常检测系统、方法及存储介质	发明专利	ZL202410929535.0	2024/7/11	原始取得
37	发行人	嵌入式闪存器件的制作方法	发明专利	ZL202410833427.3	2024/6/26	原始取得
38	发行人	一种半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202410712260.5	2024/6/4	原始取得
39	发行人	一种晶圆量测数据的处理方法、处理设备及存储介质	发明专利	ZL202410676279.9	2024/5/29	原始取得
40	发行人	横向扩散金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202410627191.8	2024/5/21	原始取得
41	发行人	一种半导体晶圆的表面处理方法、装置、电子设备及介质	发明专利	ZL202410598880.0	2024/5/15	原始取得
42	发行人	套刻标记及其制备方法、半导体结构	发明专利	ZL202410557795.X	2024/5/8	原始取得
43	发行人	半导体结构的制备方法及半导体结构	发明专利	ZL202410451328.9	2024/4/16	原始取得
44	发行人	硅光器件的制造方法	发明专利	ZL202410445111.7	2024/4/15	原始取得
45	发行人	一种金属氮化物薄膜的物理气相沉积方法和装置	发明专利	ZL202410397546.9	2024/4/3	原始取得
46	华南理工大学、发行人	一种LDMOS器件及制备方法	发明专利	ZL202410391313.8	2024/4/2	原始取得
47	发行人	一种防止钝化层蚀刻产生电弧击穿的方法及晶圆制备方法	发明专利	ZL202410390467.5	2024/4/2	原始取得
48	发行人	半导体器件的沟槽隔离制备方法以及半导体器件	发明专利	ZL202410358777.9	2024/3/27	原始取得
49	发行人	氮化硅清洗方法及半导体器件	发明专利	ZL202410339420.6	2024/3/25	原始取得
50	粤芯三期	一种电容失效位置确定方法及装置	发明专利	ZL202410331514.9	2024/3/22	继受取得
51	发行人	铜互连结构制备方法、装置、设备以及存储介质	发明专利	ZL202410327832.8	2024/3/21	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
52	发行人	半导体器件及其形成方法	发明专利	ZL202410315756.9	2024/3/20	原始取得
53	发行人	输出接口电路、输出接口电路板及输出接口设备	发明专利	ZL202410305885.X	2024/3/18	原始取得
54	发行人	半导体结构的制备方法及半导体结构	发明专利	ZL202410294585.6	2024/3/15	原始取得
55	发行人	抗 HCI 效应的 LDMOS 器件	发明专利	ZL202410291385.5	2024/3/14	原始取得
56	发行人	一种图形关键尺寸量测方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202410288708.5	2024/3/14	原始取得
57	发行人	炉管设备的清洗方法及半导体工艺方法	发明专利	ZL202410274910.2	2024/3/12	原始取得
58	发行人	一种 LDMOS 器件及其制备方法	发明专利	ZL202410265525.1	2024/3/8	原始取得
59	发行人	金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202410175676.8	2024/2/8	原始取得
60	粤芯三期	一种 Taiko 晶圆分片方法	发明专利	ZL202410146908.7	2024/2/2	继受取得
61	发行人	一种 Taiko 晶圆分片方法	发明专利	ZL202410146901.5	2024/2/2	原始取得
62	发行人	含氟气体刻蚀残留物的清洗方法、晶圆及其制备方法	发明专利	ZL202410131183.4	2024/1/31	原始取得
63	发行人	一种半导体器件及其 N 型阱偏移量的检测方法	发明专利	ZL202410126993.0	2024/1/29	原始取得
64	发行人	一种侧墙制造方法、装置、芯片及电子设备	发明专利	ZL202410107786.0	2024/1/26	原始取得
65	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202410102082.4	2024/1/25	原始取得
66	发行人	一种半导体器件的互连层的制作方法 & 半导体器件	发明专利	ZL202410086962.7	2024/1/22	原始取得
67	发行人	图像传感器及其形成方法	发明专利	ZL202410063815.8	2024/1/17	原始取得
68	发行人	半导体沟槽形貌的检测方法及检测系统	发明专利	ZL202410051422.5	2024/1/15	原始取得
69	发行人	一种深沟槽隔离结构的改善方法	发明专利	ZL202410011750.2	2024/1/4	原始取得
70	发行人	产品生产成本模拟方法、装置、电子设备及介质	发明专利	ZL202410004040.7	2024/1/3	原始取得
71	发行人	一种基于多次喷涂的光刻胶涂布方法、装置、设备及介质	发明专利	ZL202311841817.7	2023/12/29	原始取得
72	发行人	金属连接孔及其形成方法	发明专利	ZL202311834293.9	2023/12/27	原始取得
73	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202311797852.3	2023/12/26	原始取得
74	发行人	半导体器件的斜沟槽的制备方法	发明专利	ZL202311790586.1	2023/12/25	原始取得
75	发行人	一种减少炉管内颗粒的方法	发明专利	ZL202311787174.2	2023/12/22	原始取得
76	发行人	一种嵌入式闪存工艺的 DEMOS 结构及其制备方法	发明专利	ZL202311775120.4	2023/12/22	原始取得
77	发行人	一种耐压深沟槽隔离方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202311764299.3	2023/12/21	原始取得
78	发行人	半导体器件的制造方法及半导体器件	发明专利	ZL202311720707.5	2023/12/14	原始取得
79	发行人	版图修正方法、装置、设备及存储介质	发明专利	ZL202311638969.7	2023/12/4	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
80	发行人	LDMOS 器件及其制备方法	发明专利	ZL202311635934.8	2023/12/1	原始取得
81	发行人	一种椭圆仪偏移预警方法、装置及存储介质	发明专利	ZL202311632440.4	2023/12/1	原始取得
82	华南理工大学、发行人	接触孔制备方法、半导体器件及集成电路板	发明专利	ZL202311500407.6	2023/11/13	原始取得
83	发行人	一种驻波检测方法及装置	发明专利	ZL202311499880.7	2023/11/13	原始取得
84	发行人	一种晶圆的光阻涂布方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202311483222.9	2023/11/9	原始取得
85	发行人	掺杂区域检测方法	发明专利	ZL202311487092.6	2023/11/9	原始取得
86	发行人	晶圆背面工艺的监测方法以及监测晶圆的制备方法	发明专利	ZL202311466003.X	2023/11/7	原始取得
87	华南理工大学、发行人	一种 LDMOS 器件结构及其制备方法	发明专利	ZL202311482359.2	2023/11/9	原始取得
88	发行人	一种介电层及其制作方法	发明专利	ZL202311435064.X	2023/11/1	原始取得
89	发行人	一种隔离结构及其制作方法	发明专利	ZL202311424037.2	2023/10/31	原始取得
90	发行人	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL202311413131.8	2023/10/30	原始取得
91	发行人	图形化工艺质量检测方法、装置、设备以及存储介质	发明专利	ZL202311379153.7	2023/10/24	原始取得
92	发行人	光罩正位识别方法、系统和识别终端	发明专利	ZL202311372083.2	2023/10/23	原始取得
93	发行人	光罩制程偏差的监控方法及监控系统	发明专利	ZL202311368269.0	2023/10/23	原始取得
94	发行人	掩膜关键尺寸的确定方法、装置、设备及存储介质	发明专利	ZL202311375096.5	2023/10/23	原始取得
95	发行人	监控清洗试剂有效刻蚀的方法	发明专利	ZL202311364165.2	2023/10/20	原始取得
96	发行人	一种 IGBT 薄片晶圆的背面金属化的制备方法	发明专利	ZL202311360153.2	2023/10/20	原始取得
97	发行人	一种电脑的远程控制方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202311352799.6	2023/10/19	原始取得
98	发行人	离子注入机台的温控能力检测方法及装置	发明专利	ZL202311352021.5	2023/10/19	原始取得
99	发行人	研磨控制方法、装置、计算机设备、存储介质和产品	发明专利	ZL202311334198.2	2023/10/16	原始取得
100	发行人	一种半导体器件中的互连金属的沉积方法	发明专利	ZL202311337022.2	2023/10/16	原始取得
101	发行人	一种采用炉管的半导体工艺方法、预制品圆及其制备方法	发明专利	ZL202311330115.2	2023/10/16	原始取得
102	发行人	一种控制常压炉管工艺中氧化层膜厚稳定性的方法及系统	发明专利	ZL202311322450.8	2023/10/13	原始取得
103	粤芯三期	一种二氧化硅湿法刻蚀方法	发明专利	ZL202311309273.X	2023/10/11	继受取得
104	发行人	改善离子注入监控稳定性的方法	发明专利	ZL202311309274.4	2023/10/11	原始取得
105	发行人	一种深沟槽隔离方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202311302480.2	2023/10/10	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
106	发行人	一种半导体器件、制造方法及装置	发明专利	ZL202311289271.9	2023/10/8	原始取得
107	发行人	横向扩散金属氧化物半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL202311277937.9	2023/10/7	原始取得
108	发行人	一种芯片内部结构的失效位置确定方法	发明专利	ZL202311280156.5	2023/10/7	原始取得
109	发行人	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL202311264513.9	2023/9/28	原始取得
110	发行人	一种芯片内部结构检测方法	发明专利	ZL202311266359.9	2023/9/28	原始取得
111	发行人	一种浮栅测试器件及其制作方法	发明专利	ZL202311227320.6	2023/9/22	原始取得
112	华南理工大学、发行人	双 T 结构的 LDMOS 器件制备方法	发明专利	ZL202311221044.2	2023/9/21	原始取得
113	发行人	光刻机焦距偏移监测方法、装置、电子设备和存储介质	发明专利	ZL202311212200.9	2023/9/20	原始取得
114	发行人	一种电容测试结构、制备方法、测试方法及应用	发明专利	ZL202311209291.0	2023/9/19	原始取得
115	发行人	线宽测量方法	发明专利	ZL202311195651.6	2023/9/18	原始取得
116	发行人	晶圆的洗边结果检测方法、装置、设备以及存储介质	发明专利	ZL202311200353.1	2023/9/18	原始取得
117	发行人	半导体器件制备方法	发明专利	ZL202311188426.X	2023/9/15	原始取得
118	发行人	半导体器件的制备方法及半导体器件	发明专利	ZL202311162797.0	2023/9/11	原始取得
119	发行人	像素隔离结构及其制备方法、图像传感器	发明专利	ZL202311163051.1	2023/9/11	原始取得
120	发行人	炉管设备的工艺匹配方法	发明专利	ZL202311155525.8	2023/9/8	原始取得
121	发行人	标记型报文的结构转换方法、装置、电子产品和介质	发明专利	ZL202311146068.6	2023/9/7	原始取得
122	发行人	栅极侧墙 ICP 刻蚀用暖机片及其制备方法、暖机方法	发明专利	ZL202311140497.2	2023/9/6	原始取得
123	发行人	一种离子束束流实时监测方法及装置	发明专利	ZL202311101750.3	2023/8/30	原始取得
124	发行人	控片回收方法及硅片	发明专利	ZL202311070850.4	2023/8/24	原始取得
125	发行人	改善静电防护结构的制备方法及其结构	发明专利	ZL202310899745.5	2023/7/21	原始取得
126	发行人	深沟槽隔离结构的形成方法	发明专利	ZL202310882322.2	2023/7/19	原始取得
127	发行人	掺杂多晶硅薄膜的形成方法及其表面缺陷去除方法	发明专利	ZL202310876715.2	2023/7/18	原始取得
128	发行人	横向扩散金属氧化物半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL202310745856.0	2023/6/25	原始取得
129	发行人	半导体顶层金属的 OPC 修补方法	发明专利	ZL202310736057.7	2023/6/21	原始取得
130	发行人	深沟槽隔离结构的制备方法	发明专利	ZL202310736059.6	2023/6/21	原始取得
131	发行人	一种栅极结构及制作方法	发明专利	ZL202310713630.2	2023/6/16	原始取得
132	发行人	高压器件形成方法及嵌入式闪存器件形成方法	发明专利	ZL202310677298.9	2023/6/9	原始取得
133	发行人	高压 MOS 器件及其制备方法	发明专利	ZL202310620579.0	2023/5/30	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
134	发行人	晶圆验收测试结构及检测方法	发明专利	ZL202310614497.5	2023/5/29	原始取得
135	粤芯三期	离子注入工艺中衬底温度的监测方法	发明专利	ZL202310595128.6	2023/5/25	继受取得
136	发行人	一种半导体器件失配模型量测数据处理方法及装置	发明专利	ZL202310573155.3	2023/5/22	原始取得
137	发行人	监测外延层电阻率的方法	发明专利	ZL202310565269.3	2023/5/19	原始取得
138	发行人	LDMOS 器件的制备方法及其结构	发明专利	ZL202310554950.8	2023/5/17	原始取得
139	发行人、广东省科学院半导体研究所	一种存储器的测试方法	发明专利	ZL202310530798.X	2023/5/12	原始取得
140	发行人	磷酸刻蚀残留物的清洗方法、硅晶片及其加工方法、芯片	发明专利	ZL202310533405.0	2023/5/12	原始取得
141	发行人	晶圆表面粗糙化方法及半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202310525028.6	2023/5/11	原始取得
142	发行人	半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202310512076.1	2023/5/9	原始取得
143	发行人	快速建立暗场缺陷扫描检测体系的方法	发明专利	ZL202310505133.3	2023/5/8	原始取得
144	发行人	薄膜器件性能测试结构、测试方法及测试结构的制备方法	发明专利	ZL202310506642.8	2023/5/8	原始取得
145	发行人	晶圆分层对准的方法及装置	发明专利	ZL202310501086.5	2023/5/6	原始取得
146	发行人	半导体机台的异常检测方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202310501126.6	2023/5/6	原始取得
147	发行人	晶圆清洗方法	发明专利	ZL202310508818.3	2023/5/8	原始取得
148	发行人	CMP 工艺中研磨垫修整方法	发明专利	ZL202310498567.5	2023/5/6	原始取得
149	发行人	半导体工艺配方创建方法、装置、存储介质及电子设备	发明专利	ZL202310484981.0	2023/5/4	原始取得
150	发行人	电容结构及其制备方法	发明专利	ZL202310485288.5	2023/5/4	原始取得
151	发行人	晶圆热应力仿真模型的建模方法	发明专利	ZL202310384151.0	2023/4/12	原始取得
152	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202310384155.9	2023/4/12	原始取得
153	发行人	半导体器件、堆叠式复合沟槽结构的制作方法	发明专利	ZL202310205693.7	2023/3/6	原始取得
154	发行人	双晶体管或非型闪存存储结构及其制备方法	发明专利	ZL202310186008.0	2023/3/1	原始取得
155	发行人	闪存器件及其制作方法、电子设备	发明专利	ZL202310178278.7	2023/2/28	原始取得
156	发行人	低介电常数介质层及金属互连结构的制作方法	发明专利	ZL202310170157.8	2023/2/27	原始取得
157	发行人	一种高深宽比接触孔的制作方法	发明专利	ZL202310160705.9	2023/2/24	原始取得
158	发行人	测试图形的获取方法、系统、装置、计算机设备和介质	发明专利	ZL202310159889.7	2023/2/24	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
159	发行人	深硅刻蚀优化方法	发明专利	ZL202310159497.0	2023/2/24	原始取得
160	发行人	半导体器件中的钨填充方法	发明专利	ZL202310161018.9	2023/2/24	原始取得
161	发行人	半导体器件	发明专利	ZL202310158733.7	2023/2/24	原始取得
162	发行人	嵌入式快闪存储器及嵌入式快闪存储器栅极及制备方法	发明专利	ZL202310147063.9	2023/2/22	原始取得
163	发行人	压力校准方法、设备、装置及介质	发明专利	ZL202310108081.6	2023/2/14	原始取得
164	发行人	半导体结构、芯片及其应用和膜层沉积方法	发明专利	ZL202310106571.2	2023/2/13	原始取得
165	发行人	LOD 效应模型的优化方法、集成电路的制造方法	发明专利	ZL202310092683.7	2023/2/10	原始取得
166	发行人	金属互连线及其制造方法	发明专利	ZL202310076788.3	2023/2/8	原始取得
167	发行人	扩散阻挡层及其制备方法、集成电路 Cu 互连结构	发明专利	ZL202310066518.4	2023/2/6	原始取得
168	发行人	对准标记组件和晶圆对准标记检测装置	发明专利	ZL202310049557.3	2023/2/1	原始取得
169	发行人	一种测量薄片晶圆翘曲的方法	发明专利	ZL202310046245.7	2023/1/31	原始取得
170	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202310047136.7	2023/1/31	原始取得
171	发行人	半导体结构的制备方法及半导体结构	发明专利	ZL202310047169.1	2023/1/31	原始取得
172	发行人	一种缺陷检测方法	发明专利	ZL202310046257.X	2023/1/31	原始取得
173	发行人	半导体器件制备方法及监测光刻工艺化学品杂质的方法	发明专利	ZL202310056078.4	2023/1/16	原始取得
174	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202310025802.7	2023/1/9	原始取得
175	发行人	一种半导体器件制造工艺的优化方法	发明专利	ZL202310028127.3	2023/1/9	原始取得
176	发行人	半导体纳米通孔制作量测方法	发明专利	ZL202310017502.4	2023/1/6	原始取得
177	发行人	金属钨膜及其制备方法	发明专利	ZL202310009875.7	2023/1/5	原始取得
178	发行人	半导体测试结构及半导体测试方法	发明专利	ZL202211651879.7	2022/12/22	原始取得
179	发行人	形成金属硅化物的工艺参数的检测方法	发明专利	ZL202211636397.4	2022/12/20	原始取得
180	发行人	沟槽的形成方法	发明专利	ZL202211592481.0	2022/12/13	原始取得
181	发行人	光刻设备基准聚焦变动后产品的风险评估方法	发明专利	ZL202211552623.0	2022/12/6	原始取得
182	发行人	晶圆平整度的监控方法	发明专利	ZL202211552625.X	2022/12/6	原始取得
183	发行人	半导体结构及其制备方法、半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202211555861.7	2022/12/6	原始取得
184	发行人	离子注入机台注入角度监控方法	发明专利	ZL202211496370.X	2022/11/28	原始取得
185	发行人、广东省大湾区集成电路与系统	一种用于光刻胶的参数优化方法、装置、设备及存储介质	发明专利	ZL202211471556.X	2022/11/23	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
	应用研究院					
186	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202211452971.0	2022/11/21	原始取得
187	发行人	一种存储盘主备切换方法、装置、计算机设备	发明专利	ZL202211438005.3	2022/11/17	原始取得
188	发行人	半导体工艺方法和半导体蚀刻设备	发明专利	ZL202211438650.5	2022/11/17	原始取得
189	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202211409929.0	2022/11/11	原始取得
190	发行人	具有双应力衬垫结构的CMOS器件的制造方法	发明专利	ZL202211401810.9	2022/11/10	原始取得
191	发行人	晶圆检测方法、装置、计算机设备及可读存储介质	发明专利	ZL202211394692.3	2022/11/9	原始取得
192	发行人	半导体光刻方法、系统、设备和计算机可读存储介质	发明专利	ZL202211314537.6	2022/10/26	原始取得
193	华南理工大学、发行人	光罩及半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202211293266.0	2022/10/21	原始取得
194	发行人	浅沟槽隔离结构的制备方法	发明专利	ZL202211276822.3	2022/10/19	原始取得
195	发行人	多晶硅干法刻蚀的方法及半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202211256544.5	2022/10/14	原始取得
196	发行人	反相器及其制备方法	发明专利	ZL202211220031.9	2022/10/8	原始取得
197	发行人	一种闪存结构及其制作方法	发明专利	ZL202211194892.4	2022/9/29	原始取得
198	发行人	掩膜结构的制备方法、掩膜结构、半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202211179072.8	2022/9/27	原始取得
199	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202211172310.2	2022/9/26	原始取得
200	发行人	半导体器件刻蚀方法和半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202211166503.7	2022/9/23	原始取得
201	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202211154849.5	2022/9/22	原始取得
202	发行人	低缺陷掺杂多晶硅及其制备方法	发明专利	ZL202211157224.4	2022/9/22	原始取得
203	发行人	通孔刻蚀方法以及金属互连结构的制作方法	发明专利	ZL202211147073.4	2022/9/21	原始取得
204	发行人	SRAM 字线电压产生电路及调节电路	发明专利	ZL202211117232.6	2022/9/14	原始取得
205	发行人	硅化物工艺监测方法	发明专利	ZL202211050983.0	2022/8/30	原始取得
206	发行人	蚀刻速率测试方法	发明专利	ZL202211028819.X	2022/8/26	原始取得
207	发行人	一种离子注入工艺监控方法	发明专利	ZL202211011240.2	2022/8/23	原始取得
208	发行人	半导体器件的制造方法及半导体器件	发明专利	ZL202210996055.7	2022/8/19	原始取得
209	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202210989705.5	2022/8/18	原始取得
210	发行人	半导体器件及其形成方法	发明专利	ZL202210971532.4	2022/8/15	原始取得
211	发行人	ETL 调度平台及其部署方法、计算机可读存储介质	发明专利	ZL202210971604.5	2022/8/15	原始取得
212	发行人	溅射方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210958211.0	2022/8/11	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
213	发行人	溅射方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210958190.2	2022/8/11	原始取得
214	发行人	铜互连结构的制作方法	发明专利	ZL202210958201.7	2022/8/11	原始取得
215	发行人	半导体结构的形成方法	发明专利	ZL202210947270.8	2022/8/9	原始取得
216	发行人	多晶硅薄膜及其形成方法	发明专利	ZL202210947274.6	2022/8/9	原始取得
217	发行人	接触插塞的形成方法	发明专利	ZL202210941182.7	2022/8/8	原始取得
218	发行人	一种金属硬掩膜一体化刻蚀的方法及装置	发明专利	ZL202210941070.1	2022/8/8	原始取得
219	发行人	具有钝化膜的晶圆刻蚀后的清洗方法和半导体封装方法	发明专利	ZL202210929128.0	2022/8/3	原始取得
220	发行人	图像处理方法、装置、计算机设备和存储介质	发明专利	ZL202210894948.0	2022/7/28	原始取得
221	发行人	半导体器件制作方法及半导体器件	发明专利	ZL202210881601.2	2022/7/26	原始取得
222	发行人	MIM 电容结构的形成方法	发明专利	ZL202210844689.0	2022/7/19	原始取得
223	发行人	粘附金属层的溅射方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210844693.7	2022/7/19	原始取得
224	发行人	半导体器件及形成方法	发明专利	ZL202210839282.9	2022/7/18	原始取得
225	发行人	屏蔽栅沟槽功率器件的制造方法	发明专利	ZL202210828997.4	2022/7/15	原始取得
226	发行人	曝光方法	发明专利	ZL202210826955.7	2022/7/14	原始取得
227	发行人	套刻误差的补偿方法	发明专利	ZL202210821647.5	2022/7/13	原始取得
228	发行人	闪存存储器及其版图结构	发明专利	ZL202210807510.4	2022/7/11	原始取得
229	发行人	半导体器件及其制备方法	发明专利	ZL202210783243.1	2022/7/5	原始取得
230	发行人	二维关系型数据转换为可视化树表的方法和装置	发明专利	ZL202210764838.2	2022/7/1	原始取得
231	发行人	一种 LDMOS 晶体管及其制作方法	发明专利	ZL202210745452.7	2022/6/29	原始取得
232	发行人	TDDb 性能提升的金属电容结构及其制造方法	发明专利	ZL202210737831.1	2022/6/28	原始取得
233	发行人	嵌入式闪存的制备方法	发明专利	ZL202210695044.5	2022/6/20	原始取得
234	发行人	用于原子力显微镜的探针损伤检测方法	发明专利	ZL202210659131.5	2022/6/13	原始取得
235	发行人	一种闪存结构及其制作方法	发明专利	ZL202210659132.X	2022/6/13	原始取得
236	发行人	半导体器件单元及其制备方法	发明专利	ZL202210631940.5	2022/6/7	原始取得
237	发行人	一种 pFlash 结构及其制备方法	发明专利	ZL202210627305.X	2022/6/6	原始取得
238	发行人	半导体结构及其制备方法	发明专利	ZL202210603975.8	2022/5/31	原始取得
239	发行人	一种 IO 器件结构及其制备方法	发明专利	ZL202210596098.6	2022/5/30	原始取得
240	发行人	一种 Flash 结构及其制备方法	发明专利	ZL202210596139.1	2022/5/30	原始取得
241	发行人	LDMOS 器件及其制作方法	发明专利	ZL202210532562.5	2022/5/17	原始取得
242	发行人	非易失性存储器及其版图结构	发明专利	ZL202210526070.5	2022/5/16	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
243	发行人	一种半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202210526030.0	2022/5/16	原始取得
244	发行人	一种半导体结构的制备方法	发明专利	ZL202210526048.0	2022/5/16	原始取得
245	发行人	半导体结构的形成方法	发明专利	ZL202210470835.8	2022/4/28	原始取得
246	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202210455052.2	2022/4/28	原始取得
247	发行人	晶圆制造的配方数据收集方法和装置	发明专利	ZL202210448370.6	2022/4/27	原始取得
248	发行人	一种半导体结构的制作方法	发明专利	ZL202210413418.X	2022/4/20	原始取得
249	发行人	供酸装置及湿刻系统	发明专利	ZL202210376482.5	2022/4/12	原始取得
250	发行人	高压 MOS 器件的制作方法	发明专利	ZL202210376511.8	2022/4/12	原始取得
251	发行人	具有栅场板结构的横向功率器件及其制备方法	发明专利	ZL202210357476.5	2022/4/7	原始取得
252	发行人	一种全包围栅器件及其制作方法	发明专利	ZL202210328549.8	2022/3/31	原始取得
253	发行人	参数获取装置、方法、离子注入方法和半导体工艺设备	发明专利	ZL202210291961.7	2022/3/24	原始取得
254	发行人	一种提高 Taiko 晶圆在机台装载台位置扫描成功率的方法	发明专利	ZL202210279736.1	2022/3/22	原始取得
255	发行人	一种 Taiko 晶圆传送方法	发明专利	ZL202210279781.7	2022/3/22	原始取得
256	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202210266594.5	2022/3/18	原始取得
257	发行人	一种功率器件及其制备方法	发明专利	ZL202210248569.4	2022/3/15	原始取得
258	发行人	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL202210244121.5	2022/3/14	原始取得
259	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202210244348.X	2022/3/14	原始取得
260	发行人	一种半导体器件的形成方法及半导体器件	发明专利	ZL202210227839.3	2022/3/10	原始取得
261	发行人	一种沟槽型双层栅功率 MOSFET 及其制造方法	发明专利	ZL202210221344.X	2022/3/9	原始取得
262	发行人	氮氧化硅栅介质层的测量方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210214057.6	2022/3/7	原始取得
263	发行人	半导体器件的形成方法	发明专利	ZL202210154488.8	2022/2/21	原始取得
264	发行人	铁电存储器单元、其制备方法及其铁电存储器的布局结构	发明专利	ZL202210135470.3	2022/2/15	原始取得
265	发行人	图像传感器、其制备方法及其电子设备	发明专利	ZL202210097559.5	2022/1/27	原始取得
266	发行人	晶圆测试装置的调节方法	发明专利	ZL202210089602.3	2022/1/26	原始取得
267	发行人	半导体器件的缺陷检测方法、装置及电子设备	发明专利	ZL202210076635.4	2022/1/24	原始取得
268	发行人	自动识别产品制造设备警报级别的系统及方法	发明专利	ZL202210050354.1	2022/1/17	原始取得
269	发行人、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院	对准标记形成方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210046398.7	2022/1/17	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
270	发行人	氮化硅蚀刻方法	发明专利	ZL202210029447.6	2022/1/12	原始取得
271	发行人	掩模层的重工方法及氮化硅蚀刻方法	发明专利	ZL202210029442.3	2022/1/12	原始取得
272	发行人	屏蔽栅沟槽功率器件的制造方法	发明专利	ZL202210029445.7	2022/1/12	原始取得
273	发行人	金属电容结构及其制备方法	发明专利	ZL202210024334.7	2022/1/11	原始取得
274	发行人	栅介质层的厚度的监控方法	发明专利	ZL202210024342.1	2022/1/11	原始取得
275	发行人	解决因晶圆翘曲形变导致对准偏差的方法	发明专利	ZL202210024325.8	2022/1/11	原始取得
276	发行人	非易失性闪存存储器及其擦除方法	发明专利	ZL202210019508.0	2022/1/10	原始取得
277	发行人	半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202210019518.4	2022/1/10	原始取得
278	发行人	用于监控微刻蚀风险的衬底结构及监控方法	发明专利	ZL202210019520.1	2022/1/10	原始取得
279	发行人	金属-绝缘体-金属电容器结构及形成方法	发明专利	ZL202210012721.9	2022/1/7	原始取得
280	发行人	改善热载流子注入的 NMOS 的形成方法	发明专利	ZL202210012683.7	2022/1/7	原始取得
281	发行人	空气中分子污染物的检测方法 及铜互连结构的形成方法	发明专利	ZL202210012673.3	2022/1/7	原始取得
282	发行人	离子束流分布的测定方法	发明专利	ZL202111649958.X	2021/12/30	原始取得
283	发行人	椭偏仪光谱浮动模型及建立方法	发明专利	ZL202111658726.0	2021/12/30	原始取得
284	发行人	半导体器件的终端结构版图	发明专利	ZL202111615563.8	2021/12/28	原始取得
285	发行人	检测结构及其制备方法、膜层内空洞的检测方法	发明专利	ZL202111615564.2	2021/12/28	原始取得
286	发行人	半导体器件的缺陷检测方法 及电子设备	发明专利	ZL202111619470.2	2021/12/27	原始取得
287	发行人	光刻对准方法	发明专利	ZL202111634615.6	2021/12/24	原始取得
288	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202111566891.3	2021/12/21	原始取得
289	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202111566892.8	2021/12/21	原始取得
290	发行人	晶片背面减薄的异常返工方法	发明专利	ZL202111537647.4	2021/12/15	原始取得
291	发行人	电容式指纹传感器及电路	发明专利	ZL202111436411.1	2021/11/30	原始取得
292	发行人	局部氧化物层的制备方法、 半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202111417865.4	2021/11/26	原始取得
293	发行人	局部氧化物层的制备方法、 半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202111417870.5	2021/11/26	原始取得
294	发行人	非易失性存储器的形成方法	发明专利	ZL202111344598.2	2021/11/15	原始取得
295	发行人	硅通孔结构及其形成方法	发明专利	ZL202111143622.6	2021/9/28	原始取得
296	发行人	芯片密封环	发明专利	ZL202111136274.X	2021/9/27	原始取得
297	发行人	MOSFET 的仿真方法	发明专利	ZL202111136264.6	2021/9/27	原始取得
298	发行人	芯片密封环	发明专利	ZL202111117149.4	2021/9/23	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
299	发行人	验证探针异常和接触异常的装置和方法以及晶圆测试方法	发明专利	ZL202111109029.X	2021/9/22	原始取得
300	发行人	产能规划方法及可读存储介质	发明专利	ZL202111089963.X	2021/9/17	原始取得
301	发行人	MCU 半导体器件的形成方法	发明专利	ZL202111066008.4	2021/9/13	原始取得
302	发行人	金属电容结构及其制备方法	发明专利	ZL202111066013.5	2021/9/13	原始取得
303	发行人	金属电容结构及其制备方法	发明专利	ZL202111066027.7	2021/9/13	原始取得
304	发行人	晶圆清洗方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202111066014.X	2021/9/13	原始取得
305	发行人	晶圆清洗方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202111066032.8	2021/9/13	原始取得
306	发行人	对准标记及晶圆分片方法	发明专利	ZL202111066009.9	2021/9/13	原始取得
307	发行人	供气系统及离子源的供气方法	发明专利	ZL202111029351.1	2021/9/1	原始取得
308	发行人	业务数据更新方法、业务方法及可读存储介质	发明专利	ZL202110985278.9	2021/8/26	原始取得
309	发行人	离子注入装置及离子注入方法	发明专利	ZL202110841079.0	2021/7/23	原始取得
310	发行人	狭缝组件及离子注入机台	发明专利	ZL202110821872.4	2021/7/19	原始取得
311	发行人	温度监测方法	发明专利	ZL202110834111.2	2021/7/19	原始取得
312	发行人	半导体器件结构及其形成方法	发明专利	ZL202110781840.6	2021/7/12	原始取得
313	发行人	漏电测试结构及漏电测试方法	发明专利	ZL202110731413.7	2021/6/30	原始取得
314	发行人	一种石英反应腔的清洗方法	发明专利	ZL202110560081.0	2021/5/21	原始取得
315	发行人	电性测试结构	发明专利	ZL202110436891.5	2021/4/22	原始取得
316	发行人	离子注入角度的监测方法及校正方法	发明专利	ZL202110407565.1	2021/4/15	原始取得
317	发行人	湿法刻蚀工艺建模方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202110402308.9	2021/4/14	原始取得
318	发行人	蚀刻方法及 CMOS 图像传感器的制造方法	发明专利	ZL202110342975.2	2021/3/30	原始取得
319	发行人	半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202110236077.9	2021/3/3	原始取得
320	发行人	晶圆多方向测试装置	发明专利	ZL202110093927.4	2021/1/22	原始取得
321	发行人	基于 AGV 小车的自动控制系统及方法	发明专利	ZL202110083445.0	2021/1/21	原始取得
322	发行人	屏蔽栅沟槽功率器件的制造方法	发明专利	ZL202110032009.0	2021/1/11	原始取得
323	发行人	沟槽型功率器件的制备方法	发明专利	ZL202011637785.5	2020/12/31	原始取得
324	发行人	沟槽型功率器件的制备方法	发明专利	ZL202011624731.5	2020/12/31	原始取得
325	发行人	微透镜阵列的制作方法 & 图像传感器的制作方法	发明专利	ZL202110524317.5	2021/5/13	原始取得
326	发行人	一种光刻胶形貌的三维重建方法	发明专利	ZL202011401381.6	2020/12/2	原始取得
327	发行人	一种位置检测传感器、晶圆盒位置检测装置及方法	发明专利	ZL202011269843.3	2020/11/13	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
328	发行人	改善铝蚀刻工艺腐蚀缺陷的方法及装置	发明专利	ZL202011239555.3	2020/11/9	原始取得
329	发行人	晶圆背面粗糙化控制方法以及功率器件制造方法	发明专利	ZL202011004603.0	2020/9/22	原始取得
330	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202010802312.X	2020/8/11	原始取得
331	发行人	半导体器件的制备方法	发明专利	ZL202010752868.2	2020/7/30	原始取得
332	发行人	晶圆的湿法清洗方法及半导体器件的制造方法	发明专利	ZL202010394440.5	2020/5/11	原始取得
333	发行人	气体传送管路以及半导体设备	发明专利	ZL201911398519.9	2019/12/30	原始取得
334	发行人	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL201911403450.4	2019/12/30	原始取得
335	发行人	晶圆表面金属合金化处理方法	发明专利	ZL201911398469.4	2019/12/30	原始取得
336	发行人	屏蔽栅沟槽功率器件的制造方法	发明专利	ZL202010317839.3	2020/4/21	原始取得
337	发行人	一种沟槽型功率器件及其制作方法	发明专利	ZL201710564633.9	2017/7/12	继受取得
338	发行人	法拉第杯及离子注入机	实用新型	ZL202421279863.2	2024/6/5	原始取得
339	发行人	用于物理气相沉积设备的治具	实用新型	ZL202420274615.2	2024/2/4	原始取得
340	发行人	一种水过滤器外壳的拆装工具	实用新型	ZL202420138754.2	2024/1/19	原始取得
341	发行人	一种半导体制造设施用吸尘器	实用新型	ZL202420087206.1	2024/1/12	原始取得
342	发行人	一种轴承结构拆卸工具	实用新型	ZL202323598405.3	2023/12/27	原始取得
343	发行人	一种承载平台装置	实用新型	ZL202323224138.3	2023/11/29	原始取得
344	发行人	一种真空吸嘴	实用新型	ZL202323101568.6	2023/11/17	原始取得
345	发行人	一种检测工具	实用新型	ZL202323089296.2	2023/11/16	原始取得
346	发行人	校准工具	实用新型	ZL202323089293.9	2023/11/16	原始取得
347	发行人	导轨组件及移动装置	实用新型	ZL202323028208.8	2023/11/9	原始取得
348	发行人	石英清洗装置	实用新型	ZL202322981443.0	2023/11/6	原始取得
349	发行人	一种晶圆清洗模块用晶圆厚度检测装置及晶圆清洗槽宽度自动调节系统	实用新型	ZL202322991611.4	2023/11/6	原始取得
350	发行人	气体管路逆止阀及检测系统	实用新型	ZL202322961573.8	2023/11/2	原始取得
351	发行人	针对于钢结构焊接防火星喷射的高度可调节安全装置	实用新型	ZL202322957891.7	2023/11/1	原始取得
352	发行人	电感耦合型等离子体反应腔	实用新型	ZL202322866788.1	2023/10/24	原始取得
353	发行人	一种用于机台清洁的无尘布夹具	实用新型	ZL202322747390.6	2023/10/13	原始取得
354	发行人	贴膜返工装置	实用新型	ZL202322745202.6	2023/10/13	原始取得
355	发行人	一种离子产生装置的检查工具	实用新型	ZL202322726634.2	2023/10/10	原始取得
356	发行人	一种电磁制动万向轮及移动装置	实用新型	ZL202322707998.6	2023/10/10	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
357	发行人	一种万向轮及移动装置	实用新型	ZL202322707994.8	2023/10/10	原始取得
358	发行人	机台曝光稳定装置	实用新型	ZL202322678676.3	2023/10/7	原始取得
359	发行人	晶圆的切割道结构	实用新型	ZL202322678640.5	2023/10/7	原始取得
360	发行人	液体检测辅助装置及半导体生产线	实用新型	ZL202322627739.2	2023/9/26	原始取得
361	发行人	一种吸盘式安全带挂点装置	实用新型	ZL202322612930.X	2023/9/25	原始取得
362	发行人	一种基于 RFID 的防护面罩	实用新型	ZL202322565193.2	2023/9/20	原始取得
363	发行人	测漏装置	实用新型	ZL202322565181.X	2023/9/20	原始取得
364	发行人	一种预防副产物堵塞管路的装置及副产物处理系统	实用新型	ZL202322553302.9	2023/9/19	原始取得
365	发行人	用于物理气相沉积设备的治具	实用新型	ZL202322528100.9	2023/9/15	原始取得
366	发行人	固定治具及半导体设备	实用新型	ZL202322493434.7	2023/9/13	原始取得
367	发行人	一种晶圆位置矫正装置	实用新型	ZL202322440823.3	2023/9/7	原始取得
368	发行人	一种半导体工艺腔体结构	实用新型	ZL202322425283.1	2023/9/6	原始取得
369	发行人	一种分析磁场装置及离子注入设备	实用新型	ZL202322391100.9	2023/9/4	原始取得
370	发行人	一种晶圆温度监控装置	实用新型	ZL202322351500.7	2023/8/31	原始取得
371	发行人	一种用于半导体晶圆的喷涂装置	实用新型	ZL202322339565.X	2023/8/29	原始取得
372	发行人	一种用于安装化学机械抛光头的辅助装置	实用新型	ZL202322324659.X	2023/8/29	原始取得
373	发行人	芯片组件	实用新型	ZL202322343480.9	2023/8/29	原始取得
374	发行人	一种像素单元及摄像装置	实用新型	ZL202322306619.2	2023/8/25	原始取得
375	发行人	传感器夹持工具	实用新型	ZL202322307298.8	2023/8/25	原始取得
376	发行人	用于扩散炉的清洗设备	实用新型	ZL202322280642.9	2023/8/24	原始取得
377	发行人	一种标签存储装置及包装盒	实用新型	ZL202322284220.9	2023/8/24	原始取得
378	发行人	安装装置	实用新型	ZL202322269663.0	2023/8/22	原始取得
379	发行人	位置校准工具	实用新型	ZL202322252058.2	2023/8/21	原始取得
380	发行人	晶圆研磨装置	实用新型	ZL202322226628.0	2023/8/17	原始取得
381	发行人	一种燃烧控制系统及燃烧设备	实用新型	ZL202322190027.9	2023/8/14	原始取得
382	发行人	一种半导体设备维保保护装置	实用新型	ZL202322168352.5	2023/8/11	原始取得
383	发行人	用于半导体加工设备的保护罩及半导体加工设备	实用新型	ZL202322158623.9	2023/8/10	原始取得
384	发行人	一种用于半导体电性失效分析测试的夹具结构	实用新型	ZL202322154344.5	2023/8/10	原始取得
385	发行人	一种密封检测装置及气相沉积设备	实用新型	ZL202322139755.7	2023/8/9	原始取得
386	发行人	一种掩膜版机台以及掩膜版转移系统	实用新型	ZL202322130281.X	2023/8/8	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
387	发行人	一种远程等离子体设备的辅助安装工具	实用新型	ZL202322107952.0	2023/8/7	原始取得
388	发行人	一种晶圆固定装置及晶圆镀膜设备	实用新型	ZL202322106600.3	2023/8/4	原始取得
389	发行人	一种辅助装配装置及离子注入设备	实用新型	ZL202322068732.1	2023/8/2	原始取得
390	发行人	一种空中走行机构自动检查装置	实用新型	ZL202322071890.2	2023/8/2	原始取得
391	发行人	一种晶圆温度监控装置	实用新型	ZL202322039219.X	2023/7/31	原始取得
392	发行人	一种光源提供装置	实用新型	ZL202322019430.5	2023/7/28	原始取得
393	发行人	喷嘴清洗装置	实用新型	ZL202322010423.9	2023/7/27	原始取得
394	发行人	一种机械手轴承更换装置	实用新型	ZL202321973892.4	2023/7/25	原始取得
395	发行人	一种取环清洁装置及晶圆加工设备	实用新型	ZL202321901739.0	2023/7/18	原始取得
396	发行人	推车的固定装置	实用新型	ZL202321850210.0	2023/7/13	原始取得
397	发行人	一种腔体清洁装置	实用新型	ZL202321832542.6	2023/7/13	原始取得
398	发行人	治具车	实用新型	ZL202321822945.2	2023/7/11	原始取得
399	发行人	清洁装置	实用新型	ZL202321822958.X	2023/7/11	原始取得
400	发行人	CUP 螺丝固定工具	实用新型	ZL202321789277.8	2023/7/7	原始取得
401	发行人	晶圆承载盘的清洁工具	实用新型	ZL202321756957.X	2023/7/5	原始取得
402	发行人	晶圆化学液涂布监测装置、FDC 系统及晶圆涂布系统	实用新型	ZL202321759496.1	2023/7/5	原始取得
403	发行人	一种烘烤治具及烘烤设备	实用新型	ZL202321716964.7	2023/7/3	原始取得
404	发行人	一种炉管辅助安装治具	实用新型	ZL202321716963.2	2023/7/3	原始取得
405	发行人	光刻胶涂布装置	实用新型	ZL202321734123.9	2023/7/3	原始取得
406	发行人	具有防脱落功能的万用表	实用新型	ZL202321696705.2	2023/6/29	原始取得
407	发行人	清洗夹具	实用新型	ZL202321696743.8	2023/6/29	原始取得
408	发行人	加热器辅助拆装治具	实用新型	ZL202321661836.7	2023/6/28	原始取得
409	发行人	离子束萃取机构及离子注入设备	实用新型	ZL202321674724.5	2023/6/28	原始取得
410	发行人	半导体设备	实用新型	ZL202321570976.3	2023/6/19	原始取得
411	发行人	一种半导体设备	实用新型	ZL202321561331.3	2023/6/19	原始取得
412	发行人	辅助定位卡尺	实用新型	ZL202321390182.9	2023/6/2	原始取得
413	发行人	夹持装置	实用新型	ZL202321354910.0	2023/5/30	原始取得
414	发行人	高压 MOS 器件	实用新型	ZL202321345819.2	2023/5/30	原始取得
415	发行人	一种晶圆夹具拆解工作台	实用新型	ZL202321162835.8	2023/5/15	原始取得
416	发行人	一种用于 FAB 车间的扶手载车	实用新型	ZL202321131700.5	2023/5/10	原始取得
417	发行人	一种涂胶显影设备及其 NMA 保护盖板	实用新型	ZL202321131728.9	2023/5/10	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
418	发行人	一种用于图像传感器的开盖装置	实用新型	ZL202321083347.8	2023/5/6	原始取得
419	发行人	机械手目标位置校准辅助工具	实用新型	ZL202321067855.7	2023/5/6	原始取得
420	发行人	一种扳手结构	实用新型	ZL202321028791.X	2023/5/4	原始取得
421	发行人	一种无线 AP 吊顶安装装置	实用新型	ZL202321028161.2	2023/4/28	原始取得
422	发行人	一种主轴清洗装置	实用新型	ZL202321028119.0	2023/4/28	原始取得
423	发行人	一种辅助安装钟摆阀密封环的工具	实用新型	ZL202321028130.7	2023/4/28	原始取得
424	发行人	光刻机中的光束检测装置	实用新型	ZL202321002687.3	2023/4/27	原始取得
425	发行人	定位安装装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320996169.1	2023/4/27	原始取得
426	发行人	清洁石	实用新型	ZL202321002829.6	2023/4/27	原始取得
427	发行人	石英环境保护装置	实用新型	ZL202321002834.7	2023/4/27	原始取得
428	发行人	盛装溶液容器	实用新型	ZL202321002842.1	2023/4/27	原始取得
429	发行人	半导体光刻机台管路	实用新型	ZL202321002862.9	2023/4/27	原始取得
430	发行人	热板排风装置	实用新型	ZL202321002868.6	2023/4/27	原始取得
431	发行人	光刻机中的机械臂结构	实用新型	ZL202320992974.7	2023/4/26	原始取得
432	发行人	一种晶圆工作台夹取装置	实用新型	ZL202320993004.9	2023/4/26	原始取得
433	发行人	一种用于测试电阻温度系数的装置	实用新型	ZL202320992720.5	2023/4/26	原始取得
434	发行人	一种静电吸附盘清洗工具	实用新型	ZL202320989144.9	2023/4/26	原始取得
435	发行人	晶圆取片工具	实用新型	ZL202320992799.1	2023/4/26	原始取得
436	发行人	一种气泡水平仪	实用新型	ZL202320964854.6	2023/4/25	原始取得
437	发行人	前开放式晶圆盒	实用新型	ZL202320964841.9	2023/4/25	原始取得
438	发行人	抛光液输送装置及研磨设备	实用新型	ZL202320964805.2	2023/4/25	原始取得
439	发行人	一种石英盖板安装工具	实用新型	ZL202320964868.8	2023/4/25	原始取得
440	发行人	一种内六角扳手	实用新型	ZL202320962236.8	2023/4/25	原始取得
441	发行人	一种晶圆运输车	实用新型	ZL202320965109.3	2023/4/25	原始取得
442	发行人	镊子	实用新型	ZL202320964309.7	2023/4/25	原始取得
443	发行人	取 O 型圈的装置	实用新型	ZL202320964826.4	2023/4/25	原始取得
444	发行人	晶圆夹持装置	实用新型	ZL202320959845.8	2023/4/24	原始取得
445	发行人	一种上电极安装工具	实用新型	ZL202320960038.8	2023/4/24	原始取得
446	发行人	一种基于 RFID 的槽罐加药系统	实用新型	ZL202320960066.X	2023/4/24	原始取得
447	发行人	一种防挡溅环平整度的检测装置	实用新型	ZL202320943714.0	2023/4/24	原始取得
448	发行人	显影后冲洗装置	实用新型	ZL202320959921.5	2023/4/24	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
449	发行人	一种用于 FAB 内施工区域的施工警示装置	实用新型	ZL202320960007.2	2023/4/24	原始取得
450	发行人	修复工具	实用新型	ZL202320959946.5	2023/4/24	原始取得
451	发行人	晶圆辅助抓取装置以及装配组件	实用新型	ZL202320945824.0	2023/4/24	原始取得
452	发行人	一种吸尘器的吸嘴套筒和吸尘器	实用新型	ZL202320945865.X	2023/4/24	原始取得
453	发行人	一种拆卸辅助工具	实用新型	ZL202320396874.8	2023/3/6	原始取得
454	发行人	贴膜校正系统	实用新型	ZL202320389163.8	2023/3/3	原始取得
455	发行人	安全保护系统及安全鞋	实用新型	ZL202320340855.3	2023/2/28	原始取得
456	发行人	一种石英盖板的安装辅助工具	实用新型	ZL202320334947.0	2023/2/28	原始取得
457	发行人	光刻胶溶剂喷吐量称量装置	实用新型	ZL202320364314.4	2023/2/28	原始取得
458	发行人	一种超声波流量计夹具	实用新型	ZL202320346855.4	2023/2/27	原始取得
459	发行人	机械臂固定装置	实用新型	ZL202320346887.4	2023/2/27	原始取得
460	发行人	工艺腔体高度调节工具	实用新型	ZL202320346866.2	2023/2/27	原始取得
461	发行人	一种降噪安全头帽	实用新型	ZL202320324177.1	2023/2/27	原始取得
462	发行人	螺丝装卸工具	实用新型	ZL202320333361.2	2023/2/24	原始取得
463	发行人	一种干法刻蚀设备	实用新型	ZL202320309080.3	2023/2/24	原始取得
464	发行人	一种半导体检测机台的承载盘辅助工具	实用新型	ZL202320333542.5	2023/2/24	原始取得
465	发行人	机台汞灯温度检测系统	实用新型	ZL202320307648.8	2023/2/22	原始取得
466	发行人	一种辅助拆卸控压环活塞装置	实用新型	ZL202320307755.0	2023/2/22	原始取得
467	发行人	一种清洁腔体涂层的工具	实用新型	ZL202320307730.0	2023/2/22	原始取得
468	发行人	定位装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320269858.2	2023/2/21	原始取得
469	发行人	一种刻蚀机电极辅助拆卸装置	实用新型	ZL202320294442.6	2023/2/21	原始取得
470	发行人	一种刻蚀机钟摆阀外壳安装工具	实用新型	ZL202320297591.8	2023/2/21	原始取得
471	发行人	拆装治具	实用新型	ZL202320235927.8	2023/2/15	原始取得
472	发行人	一种光罩盒	实用新型	ZL202320262135.X	2023/2/17	原始取得
473	发行人	夹取装置	实用新型	ZL202320236759.4	2023/2/15	原始取得
474	发行人	一种蚀刻机摆阀的辅助装置	实用新型	ZL202320251261.5	2023/2/16	原始取得
475	发行人	安装治具	实用新型	ZL202320226253.5	2023/2/15	原始取得
476	发行人	晶圆废环清理装置及晶圆片切环装置	实用新型	ZL202320236763.0	2023/2/15	原始取得
477	发行人	半导体设备	实用新型	ZL202320209026.1	2023/2/14	原始取得
478	发行人	一种晶圆片收取工具	实用新型	ZL202320230618.1	2023/2/14	原始取得
479	发行人	一种辅助安装工具	实用新型	ZL202320200546.6	2023/2/9	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
480	发行人	一种辅助拆装工具	实用新型	ZL202320161793.X	2023/2/8	原始取得
481	发行人	一种晶圆承载装置及探针机	实用新型	ZL202320161922.5	2023/2/8	原始取得
482	发行人	一种晶圆片揭膜辅助工具	实用新型	ZL202320179533.5	2023/2/6	原始取得
483	发行人	一种多功能探针卡盒	实用新型	ZL202320165281.0	2023/2/6	原始取得
484	发行人	一种晶圆吸附装置	实用新型	ZL202320123190.0	2023/2/6	原始取得
485	发行人	气枪	实用新型	ZL202320080233.1	2023/1/12	原始取得
486	发行人	一种防止排液阀与排液管连接处松动的固定装置	实用新型	ZL202320149277.5	2023/2/1	原始取得
487	发行人	一种便携式拆装套环螺丝工具	实用新型	ZL202320149432.3	2023/2/1	原始取得
488	发行人	一种清洁腔体涂层的工具	实用新型	ZL202320149415.X	2023/2/1	原始取得
489	发行人	施工围篱	实用新型	ZL202320082885.9	2023/1/28	原始取得
490	发行人	叉盖装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320113708.2	2023/1/18	原始取得
491	发行人	晶圆卡盘清洁装置	实用新型	ZL202320154294.8	2023/1/17	原始取得
492	发行人	贴纸安装工具及半导体无尘生产系统	实用新型	ZL202320159590.7	2023/1/16	原始取得
493	发行人	静电卡盘的拆装工具	实用新型	ZL202320111222.5	2023/1/13	原始取得
494	发行人	一种机械手臂的辅助校准工具	实用新型	ZL202320076465.X	2023/1/10	原始取得
495	发行人	一种支撑杆高度辅助校准工具	实用新型	ZL202320069835.7	2023/1/10	原始取得
496	发行人	晶圆传送盒取放装置	实用新型	ZL202320020281.1	2023/1/5	原始取得
497	发行人	一种晶圆清洗固定装置	实用新型	ZL202320042585.8	2023/1/3	原始取得
498	发行人	一种晶圆传送盒	实用新型	ZL202223584431.6	2022/12/30	原始取得
499	发行人	一种晶圆盒	实用新型	ZL202223537727.2	2022/12/29	原始取得
500	发行人	一种晶圆环收集工具	实用新型	ZL202223606305.6	2022/12/29	原始取得
501	发行人	一种位置校准工具	实用新型	ZL202223606303.7	2022/12/29	原始取得
502	发行人	夹持装置	实用新型	ZL202223606302.2	2022/12/29	原始取得
503	发行人	清洗治具及清洗机	实用新型	ZL202223519622.4	2022/12/28	原始取得
504	发行人	暗场缺陷检验设备的辅助工具	实用新型	ZL202223536455.4	2022/12/28	原始取得
505	发行人	蚀刻金属机台真空管路的防护装置	实用新型	ZL202223531034.2	2022/12/27	原始取得
506	发行人	靶材与磁铁间距测量工具	实用新型	ZL202223483599.8	2022/12/26	原始取得
507	发行人	一种拆卸辅助工具	实用新型	ZL202223481281.6	2022/12/26	原始取得
508	发行人	一种蚀刻氧化机台的辅助装置	实用新型	ZL202223544834.8	2022/12/26	原始取得
509	发行人	用于蚀刻机台中间腔体的清理装置	实用新型	ZL202223523454.6	2022/12/26	原始取得
510	发行人	一种静电吸附盘的拆装设备	实用新型	ZL202223522546.2	2022/12/26	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
511	发行人	一种微光照度传感器调节装置	实用新型	ZL202223506071.8	2022/12/26	原始取得
512	发行人	清洁工具	实用新型	ZL202223461170.9	2022/12/24	原始取得
513	发行人	一种安装工具及辅具	实用新型	ZL202223451954.3	2022/12/21	原始取得
514	发行人	一种拆卸辅助工具	实用新型	ZL202223400746.0	2022/12/19	原始取得
515	发行人	夹持装置	实用新型	ZL202223425527.8	2022/12/19	原始取得
516	发行人	恒温水路监测装置及系统、PVD 设备	实用新型	ZL202223420458.1	2022/12/16	原始取得
517	发行人	辅助拆卸工具	实用新型	ZL202223384495.1	2022/12/16	原始取得
518	发行人	气体分布盘、电极板和半导体蚀刻系统	实用新型	ZL202223426204.0	2022/12/16	原始取得
519	发行人	螺钉安装工具	实用新型	ZL202223355977.4	2022/12/14	原始取得
520	发行人	螺钉拆卸工具	实用新型	ZL202223354999.9	2022/12/14	原始取得
521	发行人	一种用于晶圆运转的锁止装置	实用新型	ZL202223362504.7	2022/12/13	原始取得
522	发行人	机械手臂临时夹持装置	实用新型	ZL202223364129.X	2022/12/12	原始取得
523	发行人	密封圈拆卸工具	实用新型	ZL202223333915.3	2022/12/12	原始取得
524	发行人	磁控管铝环辅助安装工具	实用新型	ZL202223333919.1	2022/12/12	原始取得
525	发行人	一种便携式螺丝刀收纳工具	实用新型	ZL202223356907.0	2022/12/12	原始取得
526	发行人	空调箱及其检修门	实用新型	ZL202223330116.0	2022/12/9	原始取得
527	发行人	压力检测电路、装置及化学机械研磨设备	实用新型	ZL202223319913.9	2022/12/9	原始取得
528	发行人	一种用于晶圆承载盘的防护装置	实用新型	ZL202223315481.4	2022/12/9	原始取得
529	发行人	流体流量检测装置	实用新型	ZL202223328735.6	2022/12/8	原始取得
530	发行人	垫具	实用新型	ZL202223298406.1	2022/12/8	原始取得
531	发行人	一种夹持工具及拆卸辅助工具	实用新型	ZL202223291285.8	2022/12/8	原始取得
532	发行人	一种安装工具	实用新型	ZL202223290329.5	2022/12/8	原始取得
533	发行人	用于管道外壁的积水装置	实用新型	ZL202223293848.7	2022/12/7	原始取得
534	发行人	一种预防副产物掉落的机构	实用新型	ZL202223254090.6	2022/12/6	原始取得
535	发行人	石英配件运输装置	实用新型	ZL202223248507.8	2022/12/5	原始取得
536	发行人	一种化学气相沉积设备	实用新型	ZL202223247407.3	2022/12/5	原始取得
537	发行人	一种可移动手持式气体侦测装置	实用新型	ZL202223154337.7	2022/11/25	原始取得
538	发行人	一种半导体槽式湿法清洗管线系统	实用新型	ZL202223137764.4	2022/11/24	原始取得
539	发行人	提高气相沉积均匀性的气体管路	实用新型	ZL202223110932.0	2022/11/22	原始取得
540	发行人	离子萃取操控器的装卸治具	实用新型	ZL202223110800.8	2022/11/22	原始取得
541	发行人	一种改善氮化硅薄膜颗粒缺陷的管路系统	实用新型	ZL202223110799.9	2022/11/22	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
542	发行人	高压断路器小车的操作手柄 以及高压断路器小车	实用新型	ZL202223099700.X	2022/11/22	原始取得
543	发行人	一种晶圆工作台面清理用传 感器防护装置	实用新型	ZL202223100477.6	2022/11/22	原始取得
544	发行人	一种圆环件拆装辅助装置	实用新型	ZL202223107328.2	2022/11/22	原始取得
545	发行人	红外传感器组件	实用新型	ZL202223107122.X	2022/11/22	原始取得
546	发行人	一种用于气体混合腔安装的 辅助工具	实用新型	ZL202223101420.8	2022/11/22	原始取得
547	发行人	一种晶圆清洁及干燥装置	实用新型	ZL202223110048.7	2022/11/22	原始取得
548	发行人	一种废硫酸回收利用装置	实用新型	ZL202223091971.0	2022/11/16	原始取得
549	发行人	一种晶舟结构	实用新型	ZL202223032159.0	2022/11/15	原始取得
550	发行人	检测装置和光刻机	实用新型	ZL202223013210.3	2022/11/11	原始取得
551	发行人	栅氧化层完整性测试结构	实用新型	ZL202222998210.7	2022/11/10	原始取得
552	发行人	光阻涂覆设备	实用新型	ZL202223002176.X	2022/11/10	原始取得
553	发行人	冲洗臂	实用新型	ZL202222984412.6	2022/11/9	原始取得
554	发行人	防干扰保护装置及 PVD 设备	实用新型	ZL202222984569.9	2022/11/8	原始取得
555	发行人	防爆柜	实用新型	ZL202222891484.6	2022/10/31	原始取得
556	发行人	散热片的搬运工具	实用新型	ZL202222844858.9	2022/10/27	原始取得
557	发行人	一种石英通气管治具	实用新型	ZL202222844840.9	2022/10/27	原始取得
558	发行人	按钮防触碰保护装置	实用新型	ZL202222831121.3	2022/10/26	原始取得
559	发行人	预防性维护管道污染的保护 机构以及基板处理装置	实用新型	ZL202222810462.2	2022/10/25	原始取得
560	发行人	清洗装置	实用新型	ZL202222782667.4	2022/10/21	原始取得
561	发行人	真空压力规保护阀	实用新型	ZL202222752530.4	2022/10/19	原始取得
562	发行人	一种光刻单透镜及光刻机透 镜组	实用新型	ZL202222734832.9	2022/10/17	原始取得
563	发行人	一种半导体制备装置及清洁 组件	实用新型	ZL202222718962.3	2022/10/14	原始取得
564	发行人	气瓶推车及其固定框架	实用新型	ZL202222696835.8	2022/10/13	原始取得
565	发行人	基板处理装置与加热器防护 支架	实用新型	ZL202222698558.4	2022/10/13	原始取得
566	发行人	光罩	实用新型	ZL202222677261.X	2022/10/11	原始取得
567	发行人	光罩	实用新型	ZL202222682275.0	2022/10/11	原始取得
568	发行人	光罩	实用新型	ZL202222677253.5	2022/10/11	原始取得
569	发行人	一种手持式光罩夹具	实用新型	ZL202222655447.5	2022/10/9	原始取得
570	发行人	晶圆辅助抓取工具	实用新型	ZL202222648275.9	2022/10/8	原始取得
571	发行人	一种温度检测装置及离子注 入机台	实用新型	ZL202222581056.3	2022/9/27	原始取得
572	发行人	一种探针盒取放工具	实用新型	ZL202222587988.9	2022/9/27	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
573	发行人	一种水平检测装置	实用新型	ZL202222524909.X	2022/9/22	原始取得
574	发行人	VCR 接头免拆除装置	实用新型	ZL202222497435.4	2022/9/16	原始取得
575	发行人	轨道清洁小车	实用新型	ZL202222434750.2	2022/9/14	原始取得
576	发行人	一种货梯防撞装置、货梯及货物运输装置	实用新型	ZL202222446542.4	2022/9/13	原始取得
577	发行人	一种用于半导体设备的隔绝维护装置	实用新型	ZL202222388925.0	2022/9/8	原始取得
578	发行人	光刻机机盖的放置装置	实用新型	ZL202222353764.1	2022/9/5	原始取得
579	发行人	原子力显微镜的校准标片	实用新型	ZL202222328192.1	2022/9/2	原始取得
580	发行人	台阶仪的校准标片	实用新型	ZL202222328247.9	2022/9/2	原始取得
581	发行人	一种辅助安装 CKD 主阀的工具	实用新型	ZL202222323343.4	2022/9/1	原始取得
582	发行人	水平置物装置	实用新型	ZL202222332113.4	2022/9/1	原始取得
583	发行人	烟气出口启闭装置及无尘室消防排烟系统	实用新型	ZL202222290791.9	2022/8/30	原始取得
584	发行人	一种防静电光罩	实用新型	ZL202222309043.0	2022/8/29	原始取得
585	发行人	晶圆翘曲度的检测装置	实用新型	ZL202222216285.5	2022/8/22	原始取得
586	发行人	离子源辅助安装工具	实用新型	ZL202222174866.7	2022/8/18	原始取得
587	发行人	一种光阻剂吸管及光阻瓶	实用新型	ZL202222134619.4	2022/8/12	原始取得
588	发行人	光罩拾取装置和光刻设备	实用新型	ZL202222001040.0	2022/7/29	原始取得
589	发行人	离子源灯丝安装工具	实用新型	ZL202221985891.7	2022/7/29	原始取得
590	发行人	灯丝夹具	实用新型	ZL202221987793.7	2022/7/29	原始取得
591	发行人	一种装药辅助工具	实用新型	ZL202221982894.5	2022/7/29	原始取得
592	发行人	一种化学机械研磨机台滚轮更换装置	实用新型	ZL202221965761.7	2022/7/28	原始取得
593	发行人	一种尾排管路结构及离子注入设备	实用新型	ZL202221829818.0	2022/7/15	原始取得
594	发行人	一种保压舱及气密性测试装置	实用新型	ZL202221850061.3	2022/7/15	原始取得
595	发行人	一种辅助装卸工具	实用新型	ZL202221813259.4	2022/7/13	原始取得
596	发行人	管道疏通装置	实用新型	ZL202221718174.8	2022/7/4	原始取得
597	发行人	OHT 养护辅助工具	实用新型	ZL202221686910.6	2022/7/1	原始取得
598	发行人	倾斜度监测仪	实用新型	ZL202221596614.7	2022/6/23	原始取得
599	发行人	一种汞灯装卸装置及光刻设备	实用新型	ZL202221565205.0	2022/6/21	原始取得
600	发行人	一种利用垫片补偿密封间隙的真空闸阀	实用新型	ZL202221511171.7	2022/6/15	原始取得
601	发行人	橡胶圈辅助安装装置	实用新型	ZL202221248496.0	2022/5/20	原始取得
602	发行人	一种晶圆转速的测量装置及晶圆加工设备	实用新型	ZL202221237127.1	2022/5/18	原始取得
603	发行人	测速装置	实用新型	ZL202221174160.4	2022/5/16	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
604	发行人	用于高电流离子注入设备的离子源	实用新型	ZL202221146330.8	2022/5/12	原始取得
605	发行人	天车复位辅助装置	实用新型	ZL202221094803.4	2022/5/9	原始取得
606	发行人	取环装置及晶圆切环设备	实用新型	ZL202221089444.3	2022/5/7	原始取得
607	发行人	研磨头安装辅助装置	实用新型	ZL202221124416.0	2022/5/7	原始取得
608	发行人	半导体清洗设备	实用新型	ZL202221056099.3	2022/4/29	原始取得
609	发行人	恒流阀	实用新型	ZL202221046245.4	2022/4/29	原始取得
610	发行人	配件存放单元及配件存放组件	实用新型	ZL202221004781.8	2022/4/27	原始取得
611	发行人	一种用于晶片上试纸安置的组件	实用新型	ZL202221004196.8	2022/4/27	原始取得
612	发行人	一种用于电子发射枪的组装装置	实用新型	ZL202221007242.X	2022/4/27	原始取得
613	发行人	一种废气输送装置	实用新型	ZL202220967536.0	2022/4/25	原始取得
614	发行人	一种机台侦测传感器的保护组件和机台侦测装置	实用新型	ZL202220991408.X	2022/4/24	原始取得
615	发行人	一种运动平台线缆的支撑装置	实用新型	ZL202220947405.6	2022/4/22	原始取得
616	发行人	防漏液机台盖板	实用新型	ZL202220857240.3	2022/4/13	原始取得
617	发行人	热电偶辅助安装装置	实用新型	ZL202220844490.3	2022/4/12	原始取得
618	发行人	一种活动夹具	实用新型	ZL202220752617.9	2022/3/31	原始取得
619	发行人	水箱推车	实用新型	ZL202220752612.6	2022/3/31	原始取得
620	发行人	一种非接触式声压结构	实用新型	ZL202220698021.5	2022/3/28	原始取得
621	发行人	用于溅射靶材平面度的测量治具	实用新型	ZL202220674126.7	2022/3/25	原始取得
622	发行人	水平调整工具	实用新型	ZL202220622648.2	2022/3/21	原始取得
623	发行人	一种晶圆对准装置	实用新型	ZL202220630490.3	2022/3/21	原始取得
624	发行人	一种手动晶圆取出器	实用新型	ZL202220676347.8	2022/3/21	原始取得
625	发行人	一种单片晶圆清洗机的组装夹具	实用新型	ZL202220594869.3	2022/3/18	原始取得
626	发行人	一种温度校准辅助装置及温度校准装置	实用新型	ZL202220618505.4	2022/3/17	原始取得
627	发行人	一种石英片装卸装置	实用新型	ZL202220592620.9	2022/3/17	原始取得
628	发行人	一种便于涂胶显影机检测的门板组件	实用新型	ZL202220583318.7	2022/3/17	原始取得
629	发行人	湿法槽式晶圆清洗机台的取样阀安全联锁组件	实用新型	ZL202220545584.0	2022/3/14	原始取得
630	发行人	一种用于晶圆清洗机的喷淋装置	实用新型	ZL202220546254.3	2022/3/14	原始取得
631	发行人	一种磨刀板的自动供应装置	实用新型	ZL202220499075.9	2022/3/9	原始取得
632	发行人	一种手动撕膜机	实用新型	ZL202220497185.1	2022/3/9	原始取得
633	发行人	打磨工具	实用新型	ZL202220502178.6	2022/3/8	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
634	发行人	一种光罩辅助取出工具	实用新型	ZL202220463515.5	2022/3/4	原始取得
635	发行人	一种手臂橡胶圈辅助装卸工具	实用新型	ZL202220461939.8	2022/3/4	原始取得
636	发行人	一种运输光罩的推车装置	实用新型	ZL202220412496.3	2022/2/28	原始取得
637	发行人	阀门保护装置和气柜	实用新型	ZL202220304470.7	2022/2/14	原始取得
638	发行人	一种光罩吸取器	实用新型	ZL202220272981.5	2022/2/10	原始取得
639	发行人	一种夹持工具	实用新型	ZL202220258964.6	2022/2/8	原始取得
640	发行人	一种反光镜	实用新型	ZL202320082794.5	2023/1/28	原始取得
641	发行人	晶圆及其防腐蚀芯片层	实用新型	ZL202220187140.4	2022/1/24	原始取得
642	发行人	拆卸工具	实用新型	ZL202220126134.8	2022/1/18	原始取得
643	发行人	拆装工具	实用新型	ZL202220128503.7	2022/1/18	原始取得
644	发行人	一种液位自动控制系统和冷冻机	实用新型	ZL202220128369.0	2022/1/18	原始取得
645	发行人	晶圆包装盒	实用新型	ZL202220115881.1	2022/1/17	原始取得
646	发行人	晶圆传送盒	实用新型	ZL202220115903.4	2022/1/17	原始取得
647	发行人	一种夹持工具	实用新型	ZL202220093613.4	2022/1/13	原始取得
648	发行人	辅助安装工具	实用新型	ZL202220064496.9	2022/1/11	原始取得
649	发行人	一种更换治具	实用新型	ZL202220021717.4	2022/1/6	原始取得
650	发行人	夹持装置	实用新型	ZL202220030463.2	2022/1/4	原始取得
651	发行人	一种研磨及供应装置	实用新型	ZL202123415895.X	2021/12/31	原始取得
652	发行人	测温装置及半导体机台	实用新型	ZL202123455600.1	2021/12/31	原始取得
653	发行人	一种液体检测装置及洗涤塔	实用新型	ZL202123448733.6	2021/12/30	原始取得
654	发行人	一种漏水疏导装置	实用新型	ZL202123448510.X	2021/12/30	原始取得
655	发行人	一种喷头校准工具	实用新型	ZL202123406414.9	2021/12/30	原始取得
656	发行人	气体混合装置和半导体工艺设备	实用新型	ZL202123406397.9	2021/12/30	原始取得
657	发行人	一种晶圆矫正装置	实用新型	ZL202123406389.4	2021/12/30	原始取得
658	发行人	石英环拆卸装置	实用新型	ZL202123343014.8	2021/12/28	原始取得
659	发行人	气体分流器拆卸装置	实用新型	ZL202123343013.3	2021/12/28	原始取得
660	发行人	一种存放铁环的柜子	实用新型	ZL202123350139.3	2021/12/28	原始取得
661	发行人	一种安装或拆卸上电极的装置	实用新型	ZL202123370603.5	2021/12/28	原始取得
662	发行人	一种薄膜检测装置以及贴膜与揭膜机台	实用新型	ZL202123327920.9	2021/12/27	原始取得
663	发行人	半导体设备的盖板结构	实用新型	ZL202123433054.1	2021/12/24	原始取得
664	发行人	冷却塔水过滤装置	实用新型	ZL202123321466.6	2021/12/24	原始取得
665	发行人	一种折叠报警安全锥	实用新型	ZL202123284105.9	2021/12/24	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
666	发行人	干法刻蚀设备	实用新型	ZL202123244978.7	2021/12/22	原始取得
667	发行人	一种非接触式电磁施压装置	实用新型	ZL202123170677.4	2021/12/16	原始取得
668	发行人	一种过滤装置	实用新型	ZL202123161923.X	2021/12/15	原始取得
669	发行人	自锁装置	实用新型	ZL202123146547.7	2021/12/14	原始取得
670	发行人	一种用于机械手臂的夹力检测工具及机械手臂	实用新型	ZL202123039299.6	2021/12/6	原始取得
671	发行人	辅助安装装置	实用新型	ZL202122998903.1	2021/11/30	原始取得
672	发行人	气体分配盘拆装工具	实用新型	ZL202123001153.2	2021/11/30	原始取得
673	发行人	一种搬运治具	实用新型	ZL202122915485.5	2021/11/25	原始取得
674	发行人	固定支架及半导体蚀刻设备	实用新型	ZL202122926819.9	2021/11/25	原始取得
675	发行人	一种取小球和针的工具	实用新型	ZL202122835046.3	2021/11/18	原始取得
676	发行人	一种对卷膜进行限位的装置	实用新型	ZL202122833532.1	2021/11/18	原始取得
677	发行人	轨道清洁装置	实用新型	ZL202122806919.8	2021/11/16	原始取得
678	发行人	一种防止小球和针掉落遗失的工具	实用新型	ZL202122743280.3	2021/11/10	原始取得
679	发行人	一种离子注入机的分析磁场单元	实用新型	ZL202122735099.8	2021/11/9	原始取得
680	发行人	一种用于辅助机械手臂的位置校准工具及机械手臂	实用新型	ZL202122629052.3	2021/10/29	原始取得
681	发行人	一种晶圆保护装置	实用新型	ZL202122629045.3	2021/10/29	原始取得
682	发行人	一种防脱模装置及真空贴膜机	实用新型	ZL202122629042.X	2021/10/29	原始取得
683	发行人	探针卡及晶圆测试系统	实用新型	ZL202122460860.1	2021/10/12	原始取得
684	发行人	晶圆承载卡盘及晶圆测试系统	实用新型	ZL202122450717.4	2021/10/11	原始取得
685	发行人	一种摆阀的气路结构和制造芯片的设备	实用新型	ZL202122442029.3	2021/10/11	原始取得
686	发行人	处理天车宕机的工具	实用新型	ZL202122329641.X	2021/9/24	原始取得
687	发行人	晶圆运输推车	实用新型	ZL202122157803.6	2021/9/7	原始取得
688	发行人	化学机械研磨设备	实用新型	ZL202122157805.5	2021/9/7	原始取得
689	发行人	搬运口结构	实用新型	ZL202122113389.9	2021/9/1	原始取得
690	发行人	焊接洁净棚	实用新型	ZL202122091200.0	2021/8/31	原始取得
691	发行人	一种晶圆支撑装置和快速退火炉	实用新型	ZL202121959371.4	2021/8/19	原始取得
692	发行人	治具	实用新型	ZL202121819300.4	2021/8/5	原始取得
693	发行人	显影液收集装置	实用新型	ZL202121742039.2	2021/7/28	原始取得
694	发行人	保护晶圆的装置	实用新型	ZL202121321993.4	2021/6/11	原始取得
695	发行人	气柜	实用新型	ZL202121320823.4	2021/6/11	原始取得
696	发行人	机械丝杠润滑工具和半导体设备	实用新型	ZL202121097640.0	2021/5/20	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
697	发行人	一种承载盘拆装辅助装置	实用新型	ZL202121056834.6	2021/5/17	原始取得
698	发行人	密封圈拆卸装置	实用新型	ZL202121048224.1	2021/5/14	原始取得
699	发行人	晶圆翘曲度的检测装置	实用新型	ZL202120893553.X	2021/4/27	原始取得
700	发行人	取液装置及取液系统	实用新型	ZL202120894170.4	2021/4/27	原始取得
701	发行人	一种设备更换辅助装置	实用新型	ZL202120724650.6	2021/4/9	原始取得
702	发行人	一种机台真空吸盘的清洁保护装置及机台设备	实用新型	ZL202023350686.7	2020/12/31	原始取得
703	发行人	一种光罩转移器	实用新型	ZL202023095538.5	2020/12/21	原始取得
704	发行人	气体分配盘拆卸装置和刻蚀设备	实用新型	ZL202020969949.3	2020/6/1	原始取得
705	发行人	管道泄漏检测装置	实用新型	ZL201922455303.3	2019/12/30	原始取得
706	发行人	喷嘴、辅助安装工具和干法刻蚀装置	实用新型	ZL201922455283.X	2019/12/30	原始取得

注：粤芯三期自发行人处继受取得的 5 项专利原由发行人原始取得。

(二) 境外专利情况

序号	专利权人	专利名称	专利类型	注册国家	专利号	申请日
1	发行人	SEMICONDUCTOR DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF	发明专利	美国	US12431394B2	2024/11/27
2	发行人	LDMOS DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF	发明专利	美国	US12414323B1	2024/11/27
3	发行人	SEMICONDUCTOR DEVICE STRUCTURE AND METHOD FOR FORMING SAME	发明专利	美国	US12432944B2	2022/1/29
4	发行人	LEAKAGE TESTING STRUCTURE AND LEAKAGE TESTING METHOD	发明专利	美国	US12313679B2	2022/1/29
5	发行人	WAFER CLEANING METHOD AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	发明专利	美国	US12437986B2	2022/1/28
6	发行人	METAL-INSULATOR-METAL CAPACITOR STRUCTURE AND PREPARATION METHOD THEREFOR	发明专利	美国	US12317523B2	2022/1/28

七、发行人拥有的集成电路布图设计专有权

序号	布图设计权利人	名称	登记号	申请日	登记日
1	发行人	适合激光隐切的版图设计	BS.225524120	2022/3/4	2022/7/5
2	发行人	seal ring 的版图设计	BS.225524139	2022/3/4	2022/7/22
3	发行人	poly fuse pad 外置的版图设计	BS.225524147	2022/3/4	2022/7/6

序号	布图设计 权利人	名称	登记号	申请日	登记日
4	发行人	MOS 功率器件的接线版图设计	BS.225524155	2022/3/4	2022/7/22
5	发行人	ESD GGNMOS 的 Layout 版图设计	BS.22552418X	2022/3/4	2022/7/6
6	发行人	优化 SRAM Power 和 Ground 走线的版图设计	BS.225524198	2022/3/4	2022/7/5
7	发行人	MOS 与 pn 结串接的版图设计	BS.225532417	2022/3/28	2022/8/8
8	发行人	PAD 结构的版图	BS.225552493	2022/5/17	2022/9/16
9	发行人	一种优化 PAD 结构的版图设计	BS.225605392	2022/10/11	2023/2/15
10	发行人	一种优化 PAD 结构的版图设计	BS.225605422	2022/10/11	2023/2/15
11	发行人	一种优化 Mismatch 电阻结构的版图设计	BS.225605430	2022/10/11	2023/2/15
12	发行人	一种优化 Varactor 结构的版图设计方法	BS.235550310	2023/6/28	2023/10/13
13	发行人	一种优化 Varactor 结构的版图设计方法	BS.23555314X	2023/7/6	2023/10/13
14	发行人	一种优化 ESD 二极管结构的版图设计方法	BS.235560669	2023/7/31	2023/12/27
15	发行人	一种 SRAM Bitcell 的版图设计方法	BS.235574228	2023/9/7	2023/12/27
16	发行人	一种测量 WPE 效应的版图设计方法	BS.235574236	2023/9/7	2023/12/27
17	发行人	一种优化 Dummy 结构的版图设计方法	BS.235574260	2023/9/7	2023/12/27
18	发行人	一种优化 Dummy 结构的版图设计方法	BS.235574252	2023/9/7	2023/12/27
19	发行人	一种开尔文电阻的版图设计	BS.235579521	2023/9/25	2024/1/17
20	发行人	SRAM	BS.235598895	2023/11/23	2024/2/29
21	发行人	SRAM Bit Cell	BS.245514635	2024/3/7	2024/7/15
22	发行人	一种 Kelvin 式电阻 testkey 器件的版图设计	BS.245533095	2024/5/11	2024/8/27
23	发行人	一种 Mismatch MOS testkey 器件的版图设计	BS.245533117	2024/5/11	2024/8/27
24	发行人	一种 MOS testkey 器件的版图设计	BS.245533125	2024/5/11	2024/8/27
25	发行人	一种电阻 testkey 器件的版图设计	BS.245533133	2024/5/11	2024/8/27
26	发行人	一种测量 LOD 效应的版图设计	BS.245578137	2024/10/9	2025/1/17
27	发行人	一种 PID testkey 的版图设计	BS.245580328	2024/10/15	2025/1/20
28	发行人	一种优化 MOS 管源端与漏端连线的版图设计	BS.245580336	2024/10/15	2025/1/20
29	发行人	一种优化 MOS 管栅极连线的版图设计	BS.245580344	2024/10/15	2025/1/20
30	发行人	一种优化 Dummy 结构的版图设计	BS.245595627	2024/11/28	2025/2/25

序号	布图设计 权利人	名称	登记号	申请日	登记日
		计			
31	发行人	一种 MOM CAP 版图设计	BS.245595635	2024/11/28	2025/2/25
32	发行人	一种 MOS Cap 器件的版图设计	BS.245597646	2024/12/4	2025/4/3
33	发行人	一种保护二极管的版图设计	BS.245597654	2024/12/4	2025/4/3